

## 科创板投资风险提示

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

# 上海韬盛电子科技股份有限公司

(TwinSolution Technology (Shanghai) Co., Ltd.)

(中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号 1 幢 201/02, 201/04,  
201/06 室)



TwinSolution

## 首次公开发行股票并在科创板上市

## 招股说明书

(申报稿)

本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐人（主承销商）



华泰联合证券有限责任公司

HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

## 声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

## 致投资者的声明

### 一、本公司上市的目的

公司专注于半导体测试接口领域，主要为下游芯片设计、晶圆制造、封装测试等产业链各环节客户提供关键测试硬件方案。公司是境内最早独立研发芯片测试接口并实现规模化量产的企业之一，率先实现了高端芯片测试接口的国产替代和自主可控，并在芯片测试接口取得市场领先地位的基础上，逐步拓展晶圆测试接口业务。公司坚守自主创新发展路径，为人工智能、自动驾驶、先进存储等多个新兴领域的硬科技客户，提供半导体测试接口解决方案。

通过本次上市，公司一方面可以进一步拓宽融资渠道，提升核心业务领域经营规模和研发投入，巩固市场地位、增强竞争优势并实现可持续发展；另一方面也有利于公司优化治理结构、吸引优秀人才，进一步增强、完善团队能力建设和公司治理水平，为股东和行业持续创造价值，为我国半导体产业测试环节自主可控作出更多贡献，更好地回报投资者。

### 二、本公司现代企业制度的建立健全情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制定并执行了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》等各项制度文件，公司股东会、董事会及专门委员会、独立董事和董事会秘书能够依法规范运行，形成了职责明确、相互制衡、科学高效的公司治理体系，有效维护了公司及股东的合法权益，有助于公司实现长期可持续发展。公司已按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，在采购、生产、销售等业务环节制定了严格的内控流程，形成精细化的管理体系。

### 三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次募集资金将投资于苏州韬盛半导体测试接口及测试探针生产基地建设项目、苏州晶晟晶圆测试探针研发及晶圆测试探针卡生产基地建设项目、上海总部及研发中心建设项目、天津韬盛研发中心项目以及补充流动资金。本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务，本次融资能够提升公司在半导体测试接口

领域技术水平和研发优势、丰富公司测试接口产品线布局、巩固市场地位，有力支持公司经营战略，是公司推进未来发展规划重要举措。

#### 四、本公司持续经营能力及未来发展规划

公司专注于半导体测试接口的研发、设计、生产和销售，致力于为人工智能、自动驾驶、先进存储等多个新兴领域的硬科技客户，提供国际一流的半导体测试接口解决方案。报告期内，公司已经形成了上百类测试探针和超 4,000 种芯片测试接口技术方案，广泛应用于 CPU、GPU、AI 芯片、自动驾驶芯片等各类高端芯片的测试环节，助力关键测试硬件耗材的国产替代。此外，公司积极开拓第二增长曲线，拓展晶圆测试领域的核心硬件耗材 MEMS 探针卡业务，通过持续的研发投入，突破 MEMS 探针卡的技术瓶颈，实现了 MEMS 探针的自主生产，布局了核心部件多层复合陶瓷基板（MLC）核心技术。公司 2D 及 2.5D MEMS 探针卡通过了下游行业龙头客户严苛的技术验证，实现了销售。

2022 年-2024 年，公司经营规模快速增长，营业收入复合增长率达 41.54%。未来，公司将持续以国家产业战略和市场需求为导向，以自主创新为驱动，进一步加大境内外市场开拓力度，不断提升公司的行业地位和影响力。公司亦将持续投入资金和人力资源，加强研发团队建设，完善内部管理，不断提升在高端芯片测试接口和 MEMS 探针卡领域的技术实力和产业化运营能力，进一步巩固竞争优势、提升市场地位，力争成为国际半导体测试接口行业的领军者。

董事长签字： 

殷岚勇

上海韬盛电子科技股份有限公司



2025年 12月 26日

## 发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次公开发行股票不超过 1,093.3091 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【 】元
预计发行日期	【 】年【 】月【 】日
拟上市的证券交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	不超过 4,373.2364 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）
保荐人（主承销商）	华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期	【 】年【 】月【 】日

## 目 录

声明.....	1
致投资者的声明 .....	2
一、本公司上市的目的.....	2
二、本公司现代企业制度的建立健全情况.....	2
三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划.....	2
四、本公司持续经营能力及未来发展规划.....	3
发行概况 .....	4
目 录.....	5
第一节 释 义 .....	9
一、一般释义.....	9
二、专业释义.....	11
第二节 概 览 .....	14
一、重大事项提示.....	14
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....	16
三、本次发行概况.....	17
四、发行人主营业务经营情况.....	18
五、发行人符合科创板定位.....	24
六、发行人报告期主要财务数据及财务指标.....	25
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.....	25
八、发行人选择的具体上市标准.....	26
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.....	26
十、募集资金运用与未来发展规划.....	26
十一、其他对发行人有重大影响的事项.....	27
第三节 风险因素 .....	28
一、与发行人相关的风险.....	28
二、与行业相关的风险.....	32
三、其他风险.....	32
第四节 发行人基本情况 .....	34

一、发行人基本情况.....	34
二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况.....	34
三、发行人成立以来重要事件.....	49
四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况.....	49
五、发行人的股权结构.....	49
六、发行人控股及参股公司情况.....	50
七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.....	55
八、特别表决权或类似安排.....	61
九、协议控制架构的情况.....	61
十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为.....	62
十一、发行人股本情况.....	62
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.....	74
十三、发行人与董事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况.....	82
十四、董事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.....	82
十五、董事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况.....	83
十六、董事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.....	85
十七、董事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.....	86
十八、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.....	88
十九、发行人员工情况.....	92
<b>第五节 业务和技术 .....</b>	<b>94</b>
一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.....	94
二、发行人所处行业的基本情况.....	110
三、发行人所处行业的竞争情况.....	126
四、销售情况和主要客户.....	134
五、采购情况和主要供应商.....	137

六、发行人的主要固定资产和无形资产.....	140
七、发行人的核心技术及研发情况.....	146
八、发行人环境保护和安全生产情况.....	158
九、发行人的境外经营及境外资产情况.....	159
<b>第六节 财务会计信息与管理层分析 .....</b>	<b>160</b>
一、财务报表.....	160
二、主要会计政策和会计估计.....	167
三、非经常性损益情况.....	187
四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况.....	188
五、主要财务指标.....	192
六、经营成果分析.....	194
七、资产质量分析.....	218
八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....	232
九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等 事项.....	244
十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....	245
十一、盈利预测信息.....	245
<b>第七节 募集资金运用与未来发展规划 .....</b>	<b>246</b>
一、募集资金运用情况.....	246
二、未来发展与规划.....	247
<b>第八节 公司治理与独立性 .....</b>	<b>251</b>
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.....	251
二、发行人内部控制情况.....	251
三、报告期内发行人违法违规情况.....	252
四、发行人资金占用和对外担保情况.....	252
五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力.....	253
六、同业竞争.....	254
七、关联方及关联交易.....	255
<b>第九节 投资者保护 .....</b>	<b>264</b>
一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序.....	264

二、发行人的股利分配政策.....	264
<b>第十节 其他重要事项 .....</b>	<b>270</b>
一、重要合同.....	270
二、对外担保情况.....	272
三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项.....	272
四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项.....	272
<b>第十一节 声明 .....</b>	<b>273</b>
一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明.....	273
一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明.....	274
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	275
三、保荐人（主承销商）声明.....	276
四、发行人律师声明.....	278
五、承担审计业务的会计师事务所声明.....	279
六、承担评估业务的资产评估机构声明.....	280
七、承担验资业务的机构声明.....	282
<b>第十二节 附件 .....</b>	<b>284</b>
一、备查文件.....	284
二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.....	284
三、与投资者保护相关的承诺.....	287
四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.....	306
五、股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.....	307
六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.....	309
七、募集资金具体使用情况.....	309

## 第一节 释 义

在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

### 一、一般释义

发行人、韬盛科技、股份公司、公司	指	上海韬盛电子科技股份有限公司
韬盛有限	指	上海韬盛电子科技有限公司，系发行人前身
苏州厚积	指	苏州厚积企业管理中心（有限合伙），系公司股东，曾用名苏州厚积投资管理企业（有限合伙）
景宁水獭	指	景宁水獭企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
上海水獭	指	上海水獭投资合伙企业（有限合伙），系公司历史股东
张江火炬	指	上海张江火炬创业投资有限公司，系公司历史股东
毅达贰号	指	江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东，曾用名中小企业发展基金（江苏有限合伙贰号）
柘中君信	指	柘中君信（上海）私募基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
尚顾山高	指	山东尚顾山高新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
毅达创投	指	苏州高投毅达创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
安徽中安	指	安徽中安优选战新贰号投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
俱成创投	指	南京俱成秋实贰号创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
混改基金	指	江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙），系公司股东
华峰测控	指	北京华峰测控技术股份有限公司，系公司股东
昊日长晶	指	上海昊日长晶企业管理中心（有限合伙），系公司股东
皓骏创投	指	上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
江苏装备基金	指	江苏苏州高端装备产业专项母基金（有限合伙），系公司股东
毅达众创	指	江苏高投毅达众创创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
昆山玉澄	指	昆山市玉澄德蒙股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
山高弘金	指	烟台山高弘金股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
苏州韬盛	指	苏州韬盛电子科技有限公司，系公司全资子公司
苏州晶晟	指	苏州晶晟微纳半导体科技有限公司，系公司全资子公司
天津韬盛	指	天津韬盛芯海设计有限公司，系公司全资子公司
美国韬盛	指	TwinSolution USA Inc.，系公司设立于美国的全资子公司
香港韬盛	指	Twinsolution International Limited，系公司设立于中国香港特别行政区的全资子公司
韩国韬盛	指	Gemini Technology Inc.，系公司设立于韩国的控股孙公司

BVI 韬盛	指	Gemini Capital Inc.，系公司设立于英属维尔京群岛的全资孙公司
开曼韬盛	指	Gemini Technology Co., Ltd, 系公司设立于开曼群岛的全资孙公司
新加坡韬盛	指	Gemini Test Technology Pte. Ltd., 系公司设立于新加坡的全资孙公司
客户 X	指	包括客户 X1 及同一控制下企业, 系全球领先的信息与通信技术解决方案供应商
日月光	指	日月光投资控股股份有限公司及受同一控制下的相关交易主体, 系全球封装测试厂商龙头
芯云半导体	指	杭州芯云半导体集团有限公司及受同一控制下的相关交易主体, 系专业的封装测试厂商
地平线	指	地平线征程（上海）科技有限公司及受同一控制下的相关交易主体, 系领先的自动驾驶芯片设计企业
矽佳半导体	指	矽佳半导体科技（江苏）股份有限公司及受同一控制下的相关交易主体, 系专业的封装测试厂商
客户 Z	指	客户 Z1 及同一控制下的相关交易主体, 系领先的人工智能芯片设计企业
华天科技	指	天水华天科技股份有限公司及同一控制下的相关交易主体, 系专业的封装测试厂商
长江存储	指	长江存储科技有限责任公司, 系全球领先的存储芯片供应商
燧原科技	指	上海燧原科技股份有限公司及受同一控制下的相关交易主体, 系专业的 AI 芯片设计企业
安路科技	指	上海安路信息科技股份有限公司及受同一控制下的相关交易主体, 系专业的 FPGA 芯片设计企业
渠梁电子	指	渠梁电子有限公司及受同一控制下的相关交易主体, 系专业的封装测试厂商
通富微电	指	通富微电子股份有限公司及受同一控制下的相关交易主体, 系专业的封装测试厂商
苏试试验	指	苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司及受同一控制下的相关交易主体, 系专业的第三方实验室
本次发行	指	公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书、招股书	指	上海韬盛电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
报告期	指	2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月
报告期各期末	指	2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 6 月末
基准日	指	2025 年 6 月 30 日
保荐人、主承销商	指	华泰联合证券有限责任公司
发行人律师、国浩、国浩律师	指	国浩律师（上海）事务所
申报会计师、容诚、容诚会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《上海韬盛电子科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	上市后适用的《上海韬盛电子科技股份有限公司章程（草案）》

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
企业会计准则	指	《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
新股	指	公司首次公开发行时拟向社会公众发行的股份
A 股	指	每股面值 1.00 元的人民币普通股

## 二、专业释义

芯片测试接口	指	Socket, 俗称测试插座或测试座, 一种应用于芯片测试的硬件, 是测试机台与待测芯片连接的媒介
芯片测试	指	通过专业设备与技术, 检测芯片是否存在功能缺陷、性能是否符合设计规格, 核心目的是筛选不合格芯片、保障最终产品可靠性, 避免劣质芯片流入市场, 同时为芯片设计优化与制造工艺改进提供数据支撑
晶圆测试接口	指	Probe Card, 又称探针卡, 一种应用于晶圆测试的硬件, 是测试机台与待测晶圆连接的媒介
晶圆测试	指	通过专业设备与技术, 检测晶圆是否存在功能缺陷、性能是否符合设计规格
MEMS	指	以微机电科学为基础, 设计、制造具有特定功能的微型器件
半导体	指	半导体是一类导电能力介于导体和绝缘体之间的材料, 其核心特性是导电性能可通过外界条件灵活调控, 是现代电子技术的基础, 广泛用于制造芯片、二极管、晶体管等关键电子元件
集成电路	指	Integrated Circuit, 是一种微型电子器件, 通过光刻、掺杂等工艺, 将大量晶体管、电阻、电容等电子元件及它们之间的连线, 实现特定电路功能
KGD	指	Known Good Die, 意为“已知合格芯片”或“良品裸晶粒”
CPU	指	Central Processing Unit, 即中央处理器, 是计算机等电子设备的运算核心和控制核心
GPU	指	Graphics Processing Unit, 即图形处理器, 最初设计用于高效处理计算机图形渲染, 目前也被广泛地应用于 AI 模型训练、大数据分析等场景
AI 芯片	指	专为高效处理人工智能任务（如机器学习、深度学习中的模型训练与推理）设计的专用芯片, 核心目标是解决通用芯片处理 AI 任务时效率低、功耗高的问题
2.5D/3D 封装	指	半导体行业为突破传统平面封装性能瓶颈、实现“高密度集成”而发展的先进封装技术
CoWoS 封装	指	Chip on Wafer on Substrate 封装, 是一种先进的半导体封装工艺, 广泛应用于高性能计算、人工智能和数据中心等领域。
PoP 封装	指	Package on Package 封装, 是一种叠层封装技术, 通过将多个芯片垂直堆叠在同一封装位置, 实现更高的功能集成度和更小的 PCB 占用空间
Chiplet 封装	指	将大型单片芯片划分为多个小芯片（芯粒）, 再通过跨芯片互联和封装技术进行集成的封装方式

SoC	指	System on Chip, 是系统级芯片, 也称为片上系统, 是一种集成电路技术, 将一个完整的电子系统集成在单个芯片上
存储芯片	指	用于存储、读取数据和指令的半导体器件, 是电子设备（如手机、电脑、服务器）实现“数据记忆”功能的核心硬件, 相当于设备的“记忆单元”
FLASH 存储	指	Flash Memory, 是一种非易失性存储设备, 主要分为 NOR FLASH 和 NAND FLASH 两大类
NOR FLASH	指	属于 FLASH 存储的一种类型, 即使在断电后也能保持数据, 具有随机读取速度快和可直接执行代码等特点, 常用于存储系统的启动代码、嵌入式系统的程序代码等
NAND FLASH	指	属于 FLASH 存储的一种类型, 即使在断电后也能保持数据, 具有高存储密度和较快的读写速度等特点, 适合用于大容量数据存储, 如固态硬盘等
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory, 即动态随机存取存储器, 是一种半导体存储器, 主要用于计算机的主存储器
HBM	指	High Bandwidth Memory, 是一种新型的内存技术, 主要用于 CPU 和 GPU。它通过将多个 DRAM 芯片垂直堆叠, 并使用硅通孔技术实现高速互连, 从而显著提高内存的带宽和数据传输速度
多层复合陶瓷基板 (MLC)	指	Multi-Layer Ceramic, 以陶瓷为基材, 利用同质共烧或低温共烧工艺, 将导电层、介质层、阻抗控制层叠合在数十甚至上百层内部空间, 构成高密度互连网络
Gbps	指	千兆比特每秒, 是衡量数据传输速率的单位
PCB	指	Printed Circuit Board, 即印制电路板, 又称印刷线路板, 是重要的电子部件, 电子元器件电气相互连接的载体
PCBA	指	Printed Circuit Board Assembly, 是印刷电路板组件制作的简称
WLCSP	指	Wafer Level Chip Scale Packaging, 即晶圆级芯片封装方式
DDR3、DDR4	指	分别代表第三代、第四代双倍数据速率（Double Data Rate）同步动态随机存取存储器
DSA	指	Device Specific Adaptor, 为用于并行测试存储芯片的芯片测试接口技术方案
ADAS	指	Advanced Driving Assistance System, 即高级驾驶辅助系统
同轴	指	一种由内外导体及中间介质构成的双导体传输结构, 具有低辐射损耗和抗干扰特性
芯片成品测试	指	Final Test, 测试对象是针对封装切割完成的芯片成品
可靠性测试	指	Burn-in Test, 又称老化测试, 通过模拟芯片在长期使用过程中受到的各种环境因素（如温度、湿度和电压等）来评估其性能和可靠性
CIS	指	Cmos Image Sensor, 即 CMOS 图像传感器

### 特别说明：

1、本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异, 均因计算过程中的四舍五入所形成。

2、本招股说明书中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计, 包括本公司的市场份额等信息, 来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。本公

司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于其它原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。

3、本招股说明书中涉及第三方数据的来源均真实可靠，并非专门为本次发行准备，公司未为此支付费用或提供帮助。

## 第二节 概 览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书全文，并特别关注以下重要事项及公司风险。

#### （一）特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读招股说明书“第三节 风险因素”章节，特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

#### 1、技术创新及产品迭代的风险

公司专注于半导体测试接口领域，主要为下游芯片设计、晶圆制造、封装测试等产业链各环节客户提供关键测试硬件方案。作为半导体测试环节的核心硬件，测试接口产品需要适配下游半导体产业的发展节奏与需求变化，随着下游先进制程、先进封装技术的发展，测试接口产品面临高密度、高频率、高功耗、高耐温等复杂挑战，人工智能、自动驾驶等多元化应用场景也对测试接口提出更高个性化需求，公司需持续开展前瞻性创新研发并推出迭代性产品，以契合下游客户的测试需求，在竞争中建立技术壁垒与市场优势。

若公司未能精准把握半导体技术演进动态与测试需求发展趋势，导致技术创新及产品迭代无法满足市场需求，则公司可能丧失市场竞争力，面临行业地位下降、无法维持业务持续增长的风险。

#### 2、产品研发不及预期的风险

近年来公司在测试接口领域持续加大研发投入，在深耕芯片测试接口业务的同时，积极开拓探针卡（晶圆测试接口）业务，尤其是在先进 MEMS 探针卡领域持续进行高强度研发投入。报告期各期公司研发投入金额分别为 1,533.29 万元、3,071.56 万元、3,933.22 万元以及 2,707.10 万元，报告期内累计研发投入 11,245.16 万元。目前公司在探针卡领域的销售规模总体较小，MEMS 探针卡产

品尚未实现大规模量产，公司仍需保持大规模研发投入。未来若公司新产品研发不及预期，尤其是在探针卡领域，若新研发产品无法满足行业技术路线发展趋势要求，甚至出现研发失败的情况，将对公司的盈利能力及未来经营发展产生不利影响。

### 3、经营业绩波动甚至亏损的风险

报告期内，公司营业收入分别为 16,525.60 万元、20,859.03 万元、33,107.46 万元和 19,189.96 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 1,742.71 万元、-915.18 万元、1,141.58 万元以及 788.27 万元。受益于人工智能、自动驾驶等高端芯片市场的快速发展，公司芯片测试接口等产品需求持续提升，收入规模逐年增长，公司 2022 至 2024 年营业收入的复合增速达到 41.54%，但由于 2022 年底起公司持续加大对 MEMS 探针卡业务的研发投入，公司总体利润水平受到影响。若未来下游行业需求下滑，将会产生公司产品售价下降、销售量减少等不利情形，影响公司经营业绩。此外，若公司新技术及新产品研发不及预期，也将进一步对公司经营业绩造成负面影响，使公司面临业绩波动甚至亏损的风险。

### 4、市场竞争加剧的风险

在芯片测试接口领域，高端产品市场仍然由日本、韩国、美国等境外公司占据主导地位，本土厂商相对较少。同时，近年来中国大陆半导体行业的快速发展带动半导体测试行业的需求增长，吸引了越来越多的本土市场参与者，公司未来将面临境外龙头企业和中国本土新进入者的双重竞争。在日趋激烈的市场竞争环境下，若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术创新、提升产品性能与服务质量，或现有竞争对手通过调整经营策略等方式抢占市场，则公司可能出现客户流失、市场份额下降等情形，公司的市场竞争地位和经营能力将受到不利影响。

### 5、半导体行业周期波动的风险

报告期内，公司主要向芯片设计、晶圆制造、封装测试等半导体企业提供半导体测试接口等测试硬件，公司业务与半导体行业的发展高度相关，而全球半导体行业发展总体呈现一定的周期性特点。目前，随着以人工智能为代表的新兴应

用对芯片算力和存力的需求快速增长，以及终端消费市场需求回暖，全球半导体行业进入上升周期，半导体测试需求持续增长。若未来半导体行业出现周期性波动而进入下行周期，半导体企业测试需求将随之减少，则公司的生产经营将受到不利影响。

## （二）本次发行相关主体作出的重要承诺

本公司提示投资者认真阅读控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员等相关方作出的承诺，具体承诺事项参见本招股说明书之“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”。

## （三）上市后分红政策

本公司提示投资者认真阅读本公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划，详细参阅招股说明书之“第九节 投资者保护”。

## 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况			
发行人名称	上海韬盛电子科技股份有限公司	成立日期	2007年4月19日
注册资本	3,279.9273万元	法定代表人	殷岚勇
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号1幢201/02，201/04，201/06室（200000）	主要生产经营地址	苏州市
控股股东	殷岚勇	实际控制人	殷岚勇
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
（二）本次发行的有关中介机构			
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	主承销商	华泰联合证券有限责任公司
发行人律师	国浩律师（上海）事务所	其他承销机构	无
审计机构	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构（如有）	万隆（上海）资产评估有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		保荐人母公司华泰证券股份有限公司持股5%以上的股东江苏省国信集团有限责任公司持有发行人股东混改基金6%份额，穿透持有发行人0.1374%股权。除此之外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证	

		券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系	
<b>（三）本次发行其他有关机构</b>			
<b>股票登记机构</b>	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	<b>收款银行</b>	中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行
<b>其他与本次发行有关的机构</b>	无		

### 三、本次发行概况

<b>（一）本次发行的基本情况</b>			
<b>股票种类</b>	人民币普通股（A股）		
<b>每股面值</b>	1.00元		
<b>发行股数</b>	不超过 1,093.3091 万股	<b>占发行后总股本比例</b>	不低于 25.00%
<b>其中：发行新股数量</b>	不超过 1,093.3091 万股	<b>占发行后总股本比例</b>	不低于 25.00%
<b>股东公开发售股份数量</b>	无	<b>占发行后总股本比例</b>	不适用
<b>发行后总股本</b>	不超过 4,373.2364 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）		
<b>每股发行价格</b>	【】元		
<b>发行市盈率</b>	【】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）		
<b>发行前每股净资产</b>	【】元	<b>发行前每股收益</b>	【】元
<b>发行后每股净资产</b>	【】元	<b>发行后每股收益</b>	【】元
<b>发行市净率</b>	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
<b>发行方式</b>	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所认可的其他方式		
<b>发行对象</b>	符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外		
<b>承销方式</b>	余额包销		
<b>募集资金总额</b>	【】万元		
<b>募集资金净额</b>	【】万元		
<b>募集资金投资项目</b>	苏州韬盛半导体测试接口及测试探针生产基地建设项目 苏州晶晟晶圆测试探针研发及晶圆测试探针卡生产基地建设项目 上海总部及研发中心建设项目 天津韬盛研发中心项目 补充流动资金		

发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，包括： 1、保荐及承销费用【】万元； 2、审计及验资费【】万元； 3、律师费【】万元； 4、用于本次发行的信息披露费用【】万元； 5、发行手续费及其他费用【】万元。
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况（如有）	【】
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况（如有）	保荐人将安排依法设立的另类投资子公司或实际控制保荐人的证券公司依法设立的另类投资子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐人及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则（如有）	不适用
（二）本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

#### 四、发行人主营业务经营情况

##### （一）主要业务、主要产品或服务及其用途

公司专注于半导体测试接口领域，主要产品包括芯片测试接口、探针卡等，主要为下游芯片设计、晶圆制造、封装测试等产业链各环节客户提供关键测试硬件方案。

公司是境内最早独立研发芯片测试接口并实现规模化量产的企业之一，实现了高端芯片测试接口的国产替代和自主可控。公司坚守自主创新发展路径，为人工智能、自动驾驶、先进存储等多个新兴领域的硬科技客户，提供芯片测试接口全套技术解决方案，产品涵盖以 CPU、GPU、AI 芯片为代表的高端数字芯片和以 2.5D/3D 封装、CoWoS 封装、PoP 封装、Chiplet 封装为代表的先进封装芯片。根据 Yole 披露的公开市场数据，2024 年公司芯片测试接口营收规模位居境内第一，以公司销售收入测算，2024 年公司销售额位居全球芯片测试接口领域第 11 位。报告期内公司主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

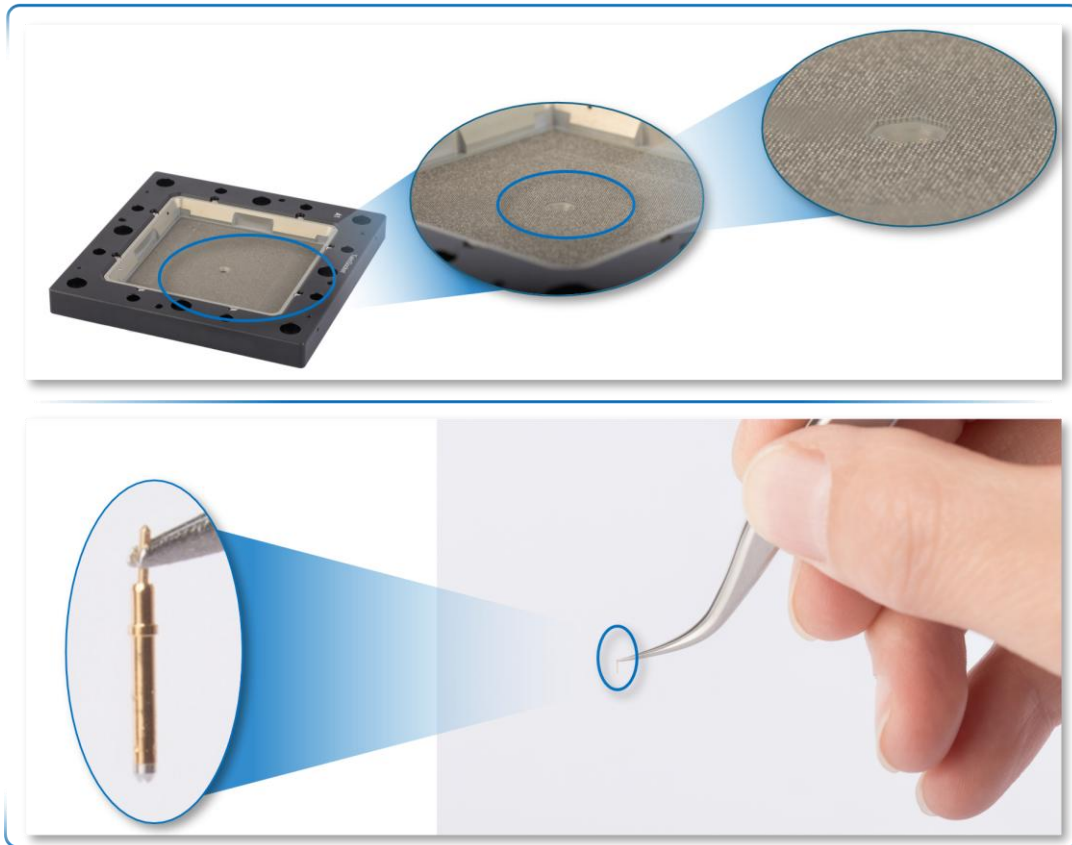
项目	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
芯片测试接口业务	16,526.22	86.12%	28,618.57	86.44%	17,391.63	83.38%	13,829.95	83.69%
探针卡业务	1,575.65	8.21%	3,435.69	10.38%	1,702.05	8.16%	1,095.64	6.63%
测试设备业务	1,088.10	5.67%	1,053.19	3.18%	1,765.35	8.46%	1,600.01	9.68%
合计	<b>19,189.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>33,107.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,859.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,525.60</b>	<b>100.00%</b>

测试环节作为半导体产业链“质量中枢”，贯穿芯片从纳米级微观结构到宏观功能实现的全维度品质把控，是半导体产业链的关键环节之一。芯片测试接口是测试环节“咽喉要道”，在测试环节承担着测试机台和待测芯片之间精密连接、信号传输及数据交互功能，其产品性能直接决定了测试环节的精确性和效率。随着半导体制程迈向 2nm 及以下、高端算力和自动驾驶等新型应用场景爆发，芯片测试接口面临电磁场、力场、热力场等多物理场耦合的复杂挑战，突破芯片测试接口 224Gbps 级信号传输、万针级规模、微纳精密制造等技术瓶颈，已成为推动我国芯片测试行业升级、保障本土半导体产业链自主可控的关键环节。

在芯片测试接口领域，公司凭借早期布局形成显著的先发优势，核心技术能力与方案储备居于领先地位。公司具备高速高频测试探针自主研发和制造能力，已累计形成上百类测试探针技术方案，可精准匹配不同芯片类型的测试需求；同时，报告期内公司累计开发超 4,000 种芯片测试接口技术方案，能够满足从研发到量产阶段针对高低温、耐久、大电流、高功耗等多重场景下严苛的测试要求。公司形成多种高端芯片测试接口精密制造工艺，成功突破芯片测试接口的微纳精密制造瓶颈。公司深耕芯片测试接口领域，可精准匹配人工智能、自动驾驶、手机 SoC、先进存储等多元领域客户的个性化需求，提供覆盖全流程的芯片测试接口定制化解决方案：人工智能领域，公司已深度服务客户 X、客户 Z、沐曦股份、摩尔线程等头部芯片企业，为 AI 芯片从研发到量产的测试环节提供关键支撑，助力我国人工智能产业自主可控；自动驾驶领域，公司覆盖地平线、Momenta 等自动驾驶技术领军者，以及理想汽车、蔚来汽车等知名车企，其中，报告期内公司凭借稳定的技术实力与交付能力，成为地平线芯片测试接口的第一大供应商；手机 SoC 领域，公司持续为客户 X、小米玄戒等企业提供芯片测试接口解决方案，为“中国芯”打破国外垄断提供关键测试硬件；先进存储领域，公司成

功为长江存储开发了首个能够实现 512 颗存储芯片并行测试的国产 DSA 芯片测试接口，有效助力本土存储产业链实现关键环节的国产替代。

芯片测试接口探针间距低至0.13mm，仅相当于发丝直径，探针密度与人类头发密度相当



依托在芯片测试接口的龙头地位与深厚技术沉淀，公司持续向晶圆测试探针卡领域纵深拓展，业务布局同步覆盖存储领域及非存储领域，构建起多维度、高壁垒的产品矩阵。在人工智能领域，公司 MEMS 探针卡成功切入以客户 Z 为代表的多家境内头部客户供应链体系，实现了商业化落地，为公司探针卡业务在高端晶圆测试赛道打开增长空间。在存储领域，公司构建了清晰明确的 MEMS 探针卡技术迭代路线图，截至本招股说明书签署日，相关产品已在 FLASH 存储晶圆测试场景中完成技术验证并实现了商业应用。

公司芯片测试接口业务主体苏州韬盛获国家级专精特新重点“小巨人”企业等多项荣誉称号；截至 2025 年 6 月 30 日，公司已获境内授权专利 77 项，其中发明专利 26 项；境外专利 4 项。凭借良好的品牌声誉、强大的研发实力、长期的经验积累、领先的产品性能和优质的本地化服务，报告期内公司已服务超 700 家单体客户，较为全面地覆盖各领域代表性硬科技客户：

在 GPU 和 AI 芯片领域，如客户 X、客户 Z、沐曦股份、摩尔线程、壁仞科技、昆仑芯、平头哥、全志科技、瑞芯微、燧原科技、清微智能、此芯科技等；在 CPU 领域，如飞腾公司、海光信息、龙芯中科、奕斯伟计算等；在手机 SoC 芯片领域，如客户 X、小米玄戒等；在自动驾驶领域，如地平线、Momenta、芯擎科技、理想汽车、蔚来汽车等；在存储领域，如长江存储、澜起科技、联芸科技等；在射频通信芯片领域，如翱捷科技、唯捷创芯、卓胜微等；在功率芯片领域，如杰华特、南芯科技、圣邦微、英诺赛科、展芯科技、伏达半导体等；在封测领域，如长电科技、华天科技、京隆科技、利扬芯片、渠梁电子、日月光、盛合晶微、通富微电、伟测科技、矽佳半导体、芯云半导体、甬矽半导体等<sup>1</sup>。

---

<sup>1</sup> 排名不分先后，按照名称首字母顺序排列，下同

**公司覆盖各领域代表性品牌，全面助力集成电路科技自立自强**

### GPU和AI芯片

 客户X	 客户Z	 沐曦股份	 摩尔线程	 壁仞科技	 昆仑芯
 平头哥	 全志科技	 瑞芯微	 燧原科技	 清微智能	 此芯科技

### CPU

 飞腾公司	 海光信息	 龙芯中科	 奕斯伟计算
---	---	---	--

### 手机SoC芯片

 客户X	 小米玄戒
---	---

### 自动驾驶

 地平线	 Momenta	 芯擎科技	 理想汽车	 蔚来汽车
--	--	---	---	---

### 存储

 长江存储	 澜起科技	 联芸科技	 翱捷科技
--	--	--	--

### 射频

 唯捷创芯	 卓胜微
---	---

### 功率芯片

 杰华特	 南芯科技	 圣邦微	 英诺赛科	 展芯科技	 伏达半导体
--	---	--	---	--	--

### 封测

 长电科技	 华天科技	 京隆科技	 利扬芯片	 渠梁电子	 日月光
 盛合晶微	 通富微电	 伟测科技	 矽佳半导体	 芯云半导体	 甬矽半导体

公司积极践行“走出去”，在韩国设立设计和工程研发中心，并在中国香港、美国和新加坡等地区和国家设立销售和服务中心，与国际大厂同台竞技，已进入英伟达（Nvidia）、苹果（Apple）、高通（Qualcomm）、亚马逊（Amazon）、亚德诺（Analog Devices）、意法半导体（ST）、芯源系统（MPS）、安世半导体（Nexperia）、微芯科技（Microchip）等境外知名客户的供应链体系。

## （二）所需主要原材料及重要供应商

公司采购的原材料主要包括金属结构部件、探针、非金属结构部件、电气部件、设备部件等。公司主要根据销售需求、生产需要、安全库存、市场价格及采购周期等因素综合确定原材料采购计划。公司重要供应商包括 Will Co.Ltd、Megatouch Co., Ltd.、浙江金连接科技股份有限公司、深圳市新富城电子有限公司、Mikuro Spring CO.,Ltd.、M.D.Mechanical Devices Ltd.和苏州德百尼机械科技有限公司等。

公司主要采购情况及重要供应商情况详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“五、采购情况和主要供应商”。

## （三）主要生产模式

公司主要产品为测试接口，测试接口具有鲜明的客制化特征，每一款测试接口产品均需要根据客户芯片或晶圆的技术参数和产品特性进行定制化生产。

在产品生产过程中，计划部门负责制定生产计划并进行排产安排。采购部门则根据生产计划，及时采购所需的原材料。质检部门负责对产品进行全面的质量检测和监控，以确保产品质量符合标准。产品生产完成后，只有经过质检部门检测并确认合格的产品，才会被允许入库。仓库部门随后负责对入库的产成品进行存储和管理，确保产品的安全与有序存放，以便于后续的发货和配送工作。

## （四）销售方式和渠道及重要客户

公司通过直销模式向客户销售，销售部门牵头制定销售计划、开发新客户与维护现有客户关系、产品定价、签订销售合同、接收订单。经过商务谈判和内部评估等一系列流程后，销售部门取得正式的销售合同或订单。公司下游面向芯片设计公司、封装测试公司、第三方实验室等各类客户群体。公司重要客户包括客户 X、地平线、客户 Z、长江存储、燧原科技、安路科技、日月光、芯云半导体、矽佳半导体、华天科技、渠梁电子、通富微电、苏试试验等。

公司主要销售情况及重要客户情况详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“四、销售情况和主要客户”。

## （五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

芯片测试接口行业，尤其是高端芯片测试接口，设计和制造工艺复杂、门槛较高，现阶段市场份额主要被境外厂商长期占据。据 Yole 数据，2024 年度全球芯片测试接口行业，Yamaichi（日本）位居第一，颖崑科技（中国台湾）位居第二，Leeno（韩国）、Cohu（美国）和 Enplas（日本）分别位列第三至第五。

公司是境内最早自主研发生产芯片测试接口产品的企业之一，根据 Yole 披露的公开市场数据，2024 年公司芯片测试接口营收规模位居境内第一，以公司实际销售收入测算，2024 年公司销售额位居全球芯片测试接口领域第 11 位。

## 五、发行人符合科创板定位

### （一）公司符合科创板行业领域的要求

公司所属行业领域	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	公司主营业务为半导体测试接口的研发、生产和销售，主要产品包括芯片测试接口和探针卡。 根据《国民经济行业分类》，公司属于“C 制造业”之“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《战略性新兴产业分类》，公司主营业务属于“1、新一代信息技术产业”中的“1.2 电子核心产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。 根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属于其中规定的“新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”，符合科创板的行业定位要求。
	<input type="checkbox"/> 高端装备	
	<input type="checkbox"/> 新材料	
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域		

公司所属行业符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》第五条（一）中所规定的“新一代信息技术领域——半导体和集成电路”行业领域的要求。

### （二）公司符合科创属性规定的规定

根据《科创属性评价指引（试行）》和《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年 4 月修订）》，公司符合科创属性评价标准情况如下：

科创属性相关指标一	是否符合	指标情况
最近三年研发投入占营业收入比例 5% 以上，或者最近三	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司 2022 年至 2024 年，公司研发投入分别为 1,533.29 万元、3,071.56 万元以

科创属性相关指标一	是否符合	指标情况
年研发投入金额累计在 8,000 万元以上		及 3,933.22 万元，公司最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为 12.11%
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	√是 □否	截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发人员共 58 人，占公司员工总数的 14.57%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 7 项以上	√是 □否	截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有可应用于公司主营业务并能够产业化的境内发明专利 26 项
最近三年营业收入复合增长率达到 25%，或者最近一年营业收入金额达到 3 亿元	√是 □否	2022 年至 2024 年度，公司营业收入分别为 16,525.60 万元、20,859.03 万元和 33,107.46 万元，公司最近三年营业收入复合增长率为 41.54%，且最近一年营业收入金额超过 3 亿元

## 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标

项目	2025.6.30 /2025年1-6月	2024.12.31/ 2024年	2023.12.31/ 2023年	2022.12.31/ 2022年
资产总额（万元）	68,668.45	53,833.22	37,760.87	24,425.74
归属于母公司所有者权益（万元）	42,120.18	26,221.35	24,404.12	11,776.26
资产负债率（合并）	38.68%	51.31%	35.38%	51.76%
营业收入（万元）	19,189.96	33,107.46	20,859.03	16,525.60
净利润（万元）	837.56	1,206.56	-822.92	1,741.67
其中：芯片测试业务	3,034.64	5,281.46	2,384.06	3,355.10
晶圆测试业务	-2,197.08	-4,074.90	-3,206.98	-1,613.43
归属于母公司所有者的净利润（万元）	840.20	1,214.27	-813.16	1,752.15
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	788.27	1,141.58	-915.18	1,742.71
基本每股收益（元）	0.27	0.40	-0.28	0.67
稀释每股收益（元）	0.27	0.40	-0.28	0.67
加权平均净资产收益率（%）	2.46	4.80	-3.91	16.64
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,116.18	213.06	-463.08	697.59
现金分红（万元）	-	-	1,000.00	-
研发投入占营业收入的比例	14.11%	11.88%	14.73%	9.28%

注：报告期内公司分业务类型的财务数据引用自申报会计师出具的《关于上海韬盛电子科技股份有限公司分业务类型信息的专项核查报告》，芯片测试业务包括芯片测试接口及测试设备的研发、生产和销售，晶圆测试业务即探针卡的研发、生产和销售。

## 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为 2025 年 6 月 30 日，财务报告审计截止日至本招

股说明书签署日，发行人主要经营状况正常，主要业务开展情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化。

## 八、发行人选择的具体上市标准

公司 2024 年度营业收入为 33,107.46 万元，归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为 1,141.58 万元；结合报告期内公司股权融资估值及同行业上市公司估值情况，公司预计发行后总市值不低于人民币 10 亿元。公司符合《上市规则》中“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”的上市标准。

## 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排。

## 十、募集资金运用与未来发展规划

### （一）募集资金运用

本次募集资金投资项目经股东会确定，由董事会负责实施，主要用于投资如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	苏州韬盛半导体测试接口及测试探针生产基地建设项目	58,127.00	40,000.00
2	苏州晶晟晶圆测试探针研发及晶圆测试探针卡生产基地建设项目	73,604.00	50,000.00
3	上海总部及研发中心建设项目	6,073.00	4,000.00
4	天津韬盛研发中心项目	3,155.00	1,800.00
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		<b>150,959.00</b>	<b>105,800.00</b>

若公司首次公开发行新股实际募集资金净额不能满足上述募投项目的资金需求，董事会可以根据拟投资项目实际情况对上述单个或多个项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金解决。

公司首次公开发行新股募集资金到位前，若因生产经营或市场竞争等因素致

使必须及时对上述全部或部分项目进行前期投入的,公司拟通过自筹资金进行先期投入,待募集资金到位后,将以募集资金置换前期投入资金。

本次募集资金运用具体情况详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

## (二) 未来发展规划

公司以国家战略及相关产业政策为指引,顺应半导体测试接口国产化发展趋势,致力于成为行业内领先的芯片测试接口和探针卡的研发及生产制造企业,打造高端测试接口领域领先的国产品牌。公司深耕测试接口行业十余年,建立了完善的测试接口设计、制造、装配、检测及市场应用体系,公司坚持自主创新,已与国内多家知名头部硬科技芯片客户建立了良好的长期战略合作关系,在行业内已建立较高的品牌知名度。

未来,公司仍将以客户产品需求和技术发展趋势为导向,专注重点应用领域和战略客户群体,大力开拓高端测试接口。公司将聚焦国家战略需求,坚持高端化、规模化、高质量的发展理念,充分发挥技术工艺、产品质量、市场地位、经营规模等优势。此外,公司将持续加大对技术和研发投入,致力于攻克我国高端测试接口领域的核心关键技术,打破技术垄断,加快国产替代,并积极开拓下游领域知名客户,进一步提升品牌知名度,扩大市场份额,巩固公司在行业中的领先地位。公司亦将不断改善治理结构,优化人才结构,健全人才吸引与发展机制,确保公司业务的可持续发展。

公司未来发展规划的具体情况请参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”的相关内容。

## 十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股说明书签署日,不存在其他对发行人有重大影响的事项。

## 第三节 风险因素

### 一、与发行人相关的风险

#### （一）经营风险

##### 1、技术创新及产品迭代的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“1、技术创新及产品迭代的风险”。

##### 2、产品研发不及预期的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“2、产品研发不及预期的风险”。

##### 3、技术泄密及关键人才流失的风险

依托在芯片测试接口领域掌握的先进测试探针设计技术、芯片测试接口阻抗精准匹配技术等一系列关键核心技术，公司目前已建立完善的产品线并可满足人工智能、自动驾驶、先进存储等新兴下游应用领域的多样化半导体测试需求。同时，测试接口全套技术解决方案的开发需深度融合电磁学、电子学、机械力学以及热力学等多学科交叉技术。若未来公司因核心技术信息保管不善导致技术研发成果泄露，或公司出现关键人才流失及人才储备不足的情况，公司的业务经营及长期发展将面临不利影响。

##### 4、部分原材料向境外厂商采购的风险

公司生产所需的原材料主要包括金属结构部件、探针、非金属结构部件、电气部件等材料，其中顶部柱塞、弹簧、功能性探针、空间转接基板等原材料存在向境外供应商采购的情况。若未来国际政治经济形势、主要境外供应商所在国家贸易政策发生重大不利变化，或相关境外供应商自身出现经营风险，则公司主要原材料的采购将受到不利影响，对公司经营业绩产生一定影响。

##### 5、经营场所租赁的风险

报告期内，公司生产经营场所通过租赁方式取得。虽然公司对经营场所的租赁行为处于长期持续稳定状态，但未来若出现租赁合同到期无法续期、无法继续

履行、租金大幅上调或出租方违约的情况,则公司将面临更换生产经营场所,承担更高额房租成本的情况,或因搬迁产生额外成本,短期内公司的正常生产经营将受到不利影响。

## (二) 财务风险

### 1、经营业绩波动甚至亏损的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“(一) 特别风险提示”之“3、经营业绩波动甚至亏损的风险”。

### 2、毛利率波动的风险

报告期各期,公司综合毛利率分别为 42.95%、34.96%、35.99%和 36.79%,毛利率变动主要受销售单价、采购成本等因素影响。若未来公司所处市场出现行业竞争恶化、销售单价持续下降的情况,或公司无法实现研发成果的有效转化、采购成本控制不力,公司可能面临毛利率波动或持续下滑的风险。

### 3、存货跌价的风险

报告期各期末,公司存货主要包括原材料、在产品、半成品、库存商品和发出商品,其账面余额分别为4,637.55万元、5,329.15万元、8,316.38万元和10,046.95万元,保持持续增长,其跌价准备分别为297.33万元、663.25万元、972.89万元和1,144.41万元。若公司主要产品的价格出现大幅下滑或者销售不畅,而公司未能及时有效应对并做出相应调整,将可能使得存货可变现净值低于成本,则将产生较大的存货跌价损失,对公司的经营业绩将产生不利影响。

### 4、经营活动现金流净额波动的风险

报告期各期,公司的经营活动现金流量净额分别为697.59万元、-463.08万元、213.06万元和1,116.18万元。公司经营活动现金流量净额存在一定波动,主要受业务规模变动、客户回款、原材料采购备货、研发投入等因素影响。未来随着公司经营规模的持续扩张,营运资金需求日益增加,若下游客户无法及时履行结算义务,或公司资金周转及使用效率降低,公司将面临经营活动现金流量净额波动及流动性风险。

## 5、税收优惠政策变化的风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。公司重要子公司苏州韬盛、苏州晶晟分别于 2017 年、2024 年开始被认定为高新技术企业。若未来以上子公司不能通过高新技术企业复审或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，将对公司未来的经营业绩产生不利影响。

### （三）内部控制及管理风险

#### 1、实际控制人控制不当风险

在本次发行前，公司实际控制人殷岚勇通过直接和间接方式合计控制公司 44.83% 的股份，本次发行后殷岚勇控制的股权比例将有所下降，但仍保持绝对控股地位。尽管公司通过相关制度安排尽可能避免实际控制人操纵公司的现象发生，但如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司财务管理、人事、发展战略、经营决策等重大事项施加不利影响，其他股东的利益可能受到损害。

#### 2、经营规模扩张带来的管理风险

报告期内，公司业务及资产规模持续扩张，随着本次发行后募集资金到位以及公司发展战略的逐步实施，未来公司在资产、业务、人员等方面的规模都将进一步扩大，公司在资源配置、经营管理、制度建设、信息化支持等各方面将面临更高的要求和挑战，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。若公司不能根据资本市场和业务发展的需要及时提高自身经营管理能力并优化经营管理体系，或者未能严格执行内部控制的相关要求，则公司的经营效率和发展质量将受到不利影响。

### （四）募集资金相关风险

#### 1、募集资金投资项目实施风险

公司本次募集资金将用于苏州韬盛半导体测试接口及测试探针生产基地建设项目、苏州晶晟晶圆测试探针研发及晶圆测试探针卡生产基地建设项目、上海总部及研发中心建设项目、天津韬盛研发中心项目和补充流动资金，均围绕公司

主营业务展开。若公司未能及时完成前述建设项目环评等审批手续，可能导致该项目无法按期开工建设，并对项目的实施产生不利影响。

此外，本次募投项目系基于当前公司的业务状况、产业政策、行业发展趋势等设计，但募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精准预测，如果在未来生产经营中公司面临的市场环境发生较大变化，或募集资金不能及时到位，或在项目实施过程中，遇到宏观政策、市场环境、技术变革、财务状况等项目规划所依赖的各项条件发生变化导致项目未能如期完成，或募投项目新增产能无法及时消化导致未能实现预期效益，则将对公司的经营成果产生不利影响。

## **2、本次发行即期回报被摊薄的风险**

本次发行上市完成后，公司净资产规模和总股本将会有较大幅度的增加，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标可能在短期内出现一定幅度的下降。同时，募投项目建设实施存在一定的周期，募集资金到位后，募投项目不能立即产生收入和利润，短期内公司净利润增长幅度可能会低于总股本和净资产的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

## **3、募集资金投资项目产能消化风险**

公司本次募集资金投资项目中，苏州韬盛半导体测试接口及测试探针生产基地建设项目、苏州晶晟晶圆测试探针研发及晶圆测试探针卡生产基地建设项目为公司现有产品的升级扩产。本次募集资金投资项目建设完成后，公司相关产品产能均将大幅增加。若后续市场需求和客户订单不及预期，无法消化募集资金投资项目新增产能，将导致项目无法实现预期收益，从而对公司未来经营业绩产生不利影响。

## **4、募集资金投资项目新增固定资产折旧风险**

公司本次募集资金投资项目的实施需要较大规模的固定资产尤其是机器设备投入，在募集资金投资项目投产后，公司固定资产折旧及费用摊销金额将呈现增长。若公司本次募集资金投资项目达产后未能实现预期收益，相关折旧及摊销金额将对公司盈利能力产生不利影响。

## 二、与行业相关的风险

### （一）市场竞争加剧的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“4、市场竞争加剧的风险”。

### （二）半导体行业周期波动的风险

详见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“5、半导体行业周期波动的风险”。

### （三）国际贸易摩擦的风险

近年来，国际政治经济形势日益复杂，部分国家采取提高关税、限制进出口等措施加强贸易保护，国际贸易环境存在诸多不稳定因素。公司所处的半导体产业链全球化程度较高，国际贸易环境的恶化对半导体产业的影响较大，公司下游客户受到不同程度的影响，同时，公司存在向境外供应商采购部分原材料及设备的情况。未来，若国际贸易摩擦进一步升级，部分国家或地区出台对公司或公司所处行业不利的限制政策，导致公司及公司所处产业链受到不利影响，或导致公司境外供应链稳定性受到冲击，进而对公司的经营业绩及未来发展产生不利影响。

## 三、其他风险

### （一）本次发行失败的风险

公司本次申请首次公开发行股票并在科创板上市，发行结果将受到发行时点国内外宏观经济环境、证券资本市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可程度及股价未来趋势判断等多种内外部因素的影响，具有较大不确定性，故可能存在因发行后公司总市值未达到公司所选择上市标准对应的市值条件，或者投资者认购数量不足而导致发行失败的风险。

### （二）股票价格波动的风险

股票价格不仅取决于公司自身的经营业绩和发展潜力，国内外经济形势、政治环境、宏观调控政策、资本市场走势以及各类重大突发事件等外部因素都可能改变投资者的心理预期并影响二级市场供求关系，进而影响到股票价格。基于上

述不确定性因素，公司上市后股价可能会偏离其实际价值而产生波动，从而直接或间接对投资者造成损失。投资者应充分了解科创板市场的投资风险以及公司所披露的相关风险因素，审慎作出投资决策。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

（一）注册名称（中文）：上海韬盛电子科技股份有限公司

注册名称（英文）：TwinSolution Technology (Shanghai) Co., Ltd.

（二）注册资本：3,279.9273 万元

（三）法定代表人：殷岚勇

（四）成立日期：2007 年 4 月 19 日

（五）住所和邮政编码：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 1 幢 201/02，201/04，201/06 室（200000）

（六）电话号码：0512-67069862

（七）互联网网址：www.twinsolution.com

（八）电子信箱：security@twinsolution.com

（九）负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室

负责人：赵月玲

联系方式：0512-67069862

### 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况

#### （一）发行人设立情况

##### 1、有限公司的设立情况

2007 年 3 月 25 日，殷岚勇、高凯签署了《上海韬盛电子科技有限公司章程》，约定设立韬盛有限，注册资本为 50.00 万元，其中殷岚勇、高凯分别以货币方式认缴出资 33.50 万元、16.50 万元。

2007 年 4 月 19 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局核发了设立时的《企业法人营业执照》。韬盛有限设立时的股权结构及出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	殷岚勇	33.50	67.00%	货币
2	高凯	16.50	33.00%	货币
合计		50.00	100.00%	-

## 2、股份公司的设立情况

2015年5月13日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（大华审字[2015]005500号），截至2015年4月30日，韬盛有限净资产为28,538,939.57元。

2015年5月15日，万隆（上海）资产评估有限公司出具了《评估报告》（万隆评报字（2015）第1238号），截至2015年4月30日，韬盛有限净资产评估值为27,249,342.63元。

2015年5月17日，韬盛有限召开股东会并作出决议，全体股东一致同意韬盛有限整体变更设立股份有限公司。改制方案为以2015年4月30日为基准日的经审计净资产折为股份有限公司的股本总额22,840,000股，每股面值1元，剩余5,698,939.57元计入资本公积。

2015年6月28日，韬盛科技召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会，审议通过了股份公司设立相关议案，并签署了《上海韬盛电子科技股份有限公司章程》。

2015年6月28日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2015]000710号），截至2015年6月28日，韬盛科技已收到发起人股东缴纳的注册资本（股本）2,284.00万元，均系净资产折股投入。

2015年7月10日，上海市工商行政管理局核发了变更后的《营业执照》（注册号310115001007984）。

本次整体变更完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例	出资方式
1	殷岚勇	931.3974	40.78%	净资产折股
2	苏州厚积	623.6507	27.31%	净资产折股
3	高凯	465.6987	20.39%	净资产折股
4	闫立民	133.4805	5.84%	净资产折股

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例	出资方式
5	张江火炬	129.7727	5.68%	净资产折股
	合计	2,284.0000	100.00%	-

## (二) 股本和股东变化情况

### 1、公司的股本演变情况

时间	股本演变	股权结构
2007.04	韬盛有限设立; (注册资本: 50万元)	殷岚勇67.00%; 高凯33.00%
2008.08	增资 (注册资本: 100万元)	殷岚勇67.00%; 高凯33.00%
2010.02	增资 (注册资本: 210万元)	殷岚勇47.62%; 高凯23.81%; 周明7.14%; 王强7.14%; 田治峰7.14%; 闫立民7.14%
2010.12	增资 (注册资本: 525万元)	殷岚勇47.62%; 高凯23.82%; 周明7.14%; 王强7.14%; 田治峰7.14%; 闫立民7.14%
2012.08	增资 (注册资本: 1,050万元)	殷岚勇47.62%; 高凯23.81%; 周明7.14%; 王强7.14%; 田治峰7.14%; 闫立民7.14%
2014.09	股权转让 (注册资本: 1,050万元)	殷岚勇47.62%; 高凯23.81%; 闫立民7.14%; 苏州厚积21.43%
2014.10	增资 (注册资本: 1,260万元)	殷岚勇47.62%; 高凯23.81%; 闫立民7.14%; 苏州厚积21.43%
2015.02	增资 (注册资本: 1,400万元)	殷岚勇42.86%; 高凯21.43%; 闫立民6.43%; 苏州厚积29.29%
2015.05	增资 (注册资本: 1,540万元)	殷岚勇40.78%; 高凯20.39%; 闫立民5.84%; 苏州厚积27.31%; 张江火炬5.68%
2015.07	股份制改革, 股本总额2,284万元	殷岚勇40.78%; 高凯20.39%; 闫立民5.84%; 苏州厚积27.31%; 张江火炬5.68%
2015.07	增资 (注册资本: 2,524万元)	殷岚勇36.90%; 高凯18.45%; 闫立民5.29%; 苏州厚积28.83%; 张江火炬5.14%; 上海水獭5.39%
2020.09	股权转让 (注册资本: 2,524万元)	殷岚勇36.90%; 高凯18.45%; 苏州厚积25.60%; 张江火炬5.14%; 上海水獭5.39%; 华峰测控8.52%
2021.09	股权转让 (注册资本: 2,524万元)	殷岚勇36.90%; 高凯18.45%; 苏州厚积25.60%; 张江火炬5.14%; 景宁水獭5.39%; 华峰测控8.52%
2021.10	股权转让 (注册资本: 2,524万元)	殷岚勇36.90%; 高凯18.45%; 苏州厚积24.65%; 张江火炬5.14%; 景宁水獭6.34%; 华峰测控8.52%
2021.12	股权转让、增资 (注册资本: 2,624万元)	殷岚勇35.50%; 苏州厚积20.66%; 高凯17.75%; 华峰测控8.19%; 景宁水獭6.10%; 张江火炬4.95%; 毅达贰号3.43%; 毅达创投3.43%
2022.11	减资 (注册资本: 2,494.2273万元)	殷岚勇37.34%; 苏州厚积21.74%; 高凯18.67%; 华峰测控8.62%; 景宁水獭6.41%; 毅达贰号3.61%; 毅达创投3.61%
2022.12	增资 (注册资本: 2,623.4273万元)	殷岚勇35.50%; 苏州厚积20.66%; 高凯17.75%; 景宁水獭11.02%; 华峰测控8.20%; 毅达贰号3.43%; 毅达创投3.43%
2023.03	股权转让、增资(注册资本: 2,810.9273万元)	殷岚勇33.13%; 苏州厚积16.93%; 高凯16.57%; 景宁水獭10.29%; 华峰测控7.39%; 柘中君信4.64%; 毅达贰号3.20%; 毅达创投3.20%; 俱成创投2.79%; 皓骏创投1.86%
2023.04	增资 (注册资本: 2,960.9273万元)	殷岚勇31.46%; 苏州厚积16.07%; 高凯15.73%; 景宁水獭9.77%; 华峰测控7.01%; 柘中君信4.41%; 高顺山高4.22%; 毅达贰号3.04%; 毅达创投3.04%; 俱成创投2.64%; 皓骏创投1.76%; 山高弘金0.84%
2023.06	增资 (注册资本: 3,060.9273万元)	殷岚勇30.43%; 苏州厚积16.66%; 高凯15.21%; 景宁水獭9.45%; 华峰测控6.79%; 柘中君信4.26%; 高顺山高4.08%; 毅达贰号2.94%; 毅达创投2.94%; 俱成创投2.56%; 吴日长晶2.16%; 皓骏创投1.71%; 山高弘金0.82%
2024.12	转让 (注册资本: 3,060.9273万元)	殷岚勇30.43%; 苏州厚积16.66%; 高凯15.21%; 景宁水獭9.45%; 华峰测控4.37%; 柘中君信4.26%; 毅达贰号4.15%; 高顺山高4.08%; 毅达创投2.94%; 俱成创投2.56%; 吴日长晶2.16%; 皓骏创投1.71%; 毅达众创1.21%; 山高弘金0.82%
2025.01	转让 (注册资本: 3,060.9273万元)	殷岚勇30.43%; 苏州厚积16.66%; 高凯15.21%; 景宁水獭7.81%; 柘中君信5.90%; 华峰测控4.37%; 毅达贰号4.15%; 高顺山高4.08%; 毅达创投2.94%; 俱成创投2.56%; 吴日长晶2.16%; 皓骏创投1.71%; 毅达众创1.21%; 山高弘金0.82%
2025.03	股权转让、增资 (注册资本: 3,279.9273万元)	殷岚勇28.40%; 苏州厚积14.42%; 高凯14.20%; 景宁水獭7.29%; 毅达贰号6.07%; 柘中君信5.50%; 高顺山高3.81%; 毅达创投2.74%; 安徽中安2.74%; 俱成创投2.39%; 混改基金2.29%; 华峰测控2.19%; 吴日长晶2.01%; 皓骏创投1.59%; 江苏装备基金1.37%; 毅达众创1.13%; 昆山玉澄1.10%; 山高弘金0.76%

## 2、报告期初发行人股本情况

报告期初，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	殷岚勇	931.3974	35.50%
2	苏州厚积	542.1312	20.66%
3	高凯	465.6987	17.75%
4	华峰测控	215.0000	8.19%
5	景宁水獭	160.0000	6.10%
6	张江火炬	129.7727	4.95%
7	毅达贰号	90.0000	3.43%
8	毅达创投	90.0000	3.43%
合计		<b>2,624.0000</b>	<b>100.00%</b>

## 3、报告期内的股本和股东变化情况

报告期内，公司股本和股东变化情况概况如下：

序号	时间	变动类型	具体变化情况
1	2022年11月	减资（注册资本：2,494.2273万元）	公司注册资本由2,624.0000万元减少至2,494.2273万元，减少的129.7727万元全部为原股东张江火炬持有股份，减资完成后，张江火炬不再持有公司股份。本次减资价格为25.00元/股。
2	2022年12月	增资（注册资本：2,623.4273万元）	公司注册资本由2,494.2273万元增加至2,623.4273万元，增加的129.20万元由景宁水獭认购。本次增资价格为25.00元/股。
3	2023年3月	增资（注册资本：2,810.9273万元）	公司注册资本由2,623.4273万元增加至2,810.9273万元，增资187.50万元，其中柘中君信认购93.75万元、俱成创投认购56.25万元、皓骏创投认购37.50万元。本次增资价格均为40.00元/股。
4	2023年3月	转让（注册资本：2,810.9273万元）	苏州厚积分别以1,250.00万元、750.00万元、251.70万元向柘中君信、俱成创投、皓骏创投转让36.75万股、22.05万股、7.40万股；华峰测控以248.30万元向皓骏创投转让7.30万股。本次转让价格均为34.01元/股。
5	2023年4月	增资（注册资本：2,960.9273万元）	公司注册资本由2,810.9273万元增加至2,960.9273万元，增资150.00万元，其中尚颀山高认购125.00万元，山高弘金认购25.00万元。本次增资价格均为40.00元/股。
6	2023年6月	增资（注册资本：3,060.9273万元）	公司注册资本由2,960.9273万元增加至3,060.9273万元，增资100.00万元，其中昊日长晶认购66.00万元、苏州厚积认购34.00

序号	时间	变动类型	具体变化情况
			万元。本次增资价格均为 10.00 元/股。
7	2024 年 12 月	转让（注册资本： 3,060.9273 万元）	华峰测控分别以 1,480.00 万元、1,480.00 万元向毅达贰号、毅达众创转让 37.00 万股、37.00 万股。本次转让价格均为 40.00 元/股。
8	2025 年 1 月	转让（注册资本： 3,060.9273 万元）	景宁水獭以 2,000.00 万元向柘中君信转让 50.00 万股。本次转让价格为 40.00 元/股。
9	2025 年 3 月	增资（注册资本： 3,180.9273 万元）	公司注册资本由 3,060.9273 万元增加至 3,180.9273 万元，增资 120.00 万元，其中混改基金认购 75.00 万元、江苏装备基金认购 45.00 万元。本次增资价格均为 65.00 元/股。
10	2025 年 3 月	增资（注册资本： 3,279.9273 万元）	公司注册资本由 3,180.9273 万元增加至 3,279.9273 万元，增资 99.00 万元，其中安徽中安认购 45.00 万元、毅达贰号认购 36.00 万元、昆山玉澄认购 18.00 万元。本次增资价格均为 70.00 元/股。
11	2025 年 3 月	转让（注册资本： 3,279.9273 万元）	华峰测控分别以 1,800.00 万元、678.00 万元向安徽中安、昆山玉澄转让 45.00 万股、16.95 万股；苏州厚积分别以 1,440.00 万元、42.00 万元向毅达贰号、昆山玉澄转让 36.00 万股、1.05 万股。本次转让价格均为 40.00 元/股。

注：报告期内股本和股东变化时间以工商登记时间或转让协议签署时间为准，下同。

### （1）2022 年 11 月减资

2022 年 6 月 16 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，决议同意公司减资。

2022 年 7 月 15 日，公司在《解放日报》刊登了减资公告，并履行了相应的减资程序。2022 年 10 月 10 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，决议同意张江火炬以 25 元/股的价格以减资的方式退出公司。2022 年 11 月 3 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，全体股东一致同意公司注册资本由 2,624.0000 万元减少至 2,494.2273 万元。

2022 年 11 月 16 日，上海市市场监督管理局向韬盛科技换发新的《营业执照》。

本次减资完成后，韬盛科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	殷岚勇	931.3974	37.34%
2	苏州厚积	542.1312	21.74%
3	高凯	465.6987	18.67%

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
4	华峰测控	215.0000	8.62%
5	景宁水獭	160.0000	6.41%
6	毅达贰号	90.0000	3.61%
7	毅达创投	90.0000	3.61%
合计		<b>2,494.2273</b>	<b>100.00%</b>

### (2) 2022年12月增资

2022年12月2日,公司召开2022年第四次临时股东大会,决议同意公司注册资本增至2,623.4273万元,新增注册资本129.20万元由景宁水獭出资3,230.00万元认购,其中129.20万元计入注册资本,3,100.80万元计入公司资本公积。

2022年12月20日,上海市市场监督管理局向韬盛科技换发新的《营业执照》。

本次增资完成后,韬盛科技的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	殷岚勇	931.3974	35.50%
2	苏州厚积	542.1312	20.66%
3	高凯	465.6987	17.75%
4	景宁水獭	289.2000	11.02%
5	华峰测控	215.0000	8.20%
6	毅达贰号	90.0000	3.43%
7	毅达创投	90.0000	3.43%
合计		<b>2,623.4273</b>	<b>100.00%</b>

### (3) 2023年3月增资及转让

2023年2月28日,韬盛科技召开2023年第一次临时股东大会,决议同意:①公司注册资本增至2,810.9273万元,新增注册资本187.50万元中,由柘中君信出资3,750.00万元认购93.75万元,由俱成创投出资2,250.00万元认购56.25万元,由皓骏创投出资1,500.00万元认购37.50万元;②苏州厚积及华峰测控将其持有的部分股份转让给柘中君信、皓骏创投、俱成创投;③修改公司章程。

本次增资的具体情况如下：

股东名称	投资金额 (万元)	认缴注册资本 (万元)	计入资本公积金额 (万元)
柘中君信	3,750.00	93.75	3,656.25
俱成创投	2,250.00	56.25	2,193.75
皓骏创投	1,500.00	37.50	1,462.50

本次股份转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让的股份数 (万股)	转让对价 (万元)
苏州厚积	柘中君信	36.75	1,250.0000
	俱成创投	22.05	750.0000
	皓骏创投	7.40	251.7007
华峰测控	皓骏创投	7.30	248.2993

2023年3月22日，上海市市场监督管理局向韬盛科技换发新的《营业执照》。

本次增资及转让完成后，韬盛科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	殷岚勇	931.3974	33.13%
2	苏州厚积	475.9312	16.93%
3	高凯	465.6987	16.57%
4	景宁水獭	289.2000	10.29%
5	华峰测控	207.7000	7.39%
6	柘中君信	130.5000	4.64%
7	毅达贰号	90.0000	3.20%
8	毅达创投	90.0000	3.20%
9	俱成创投	78.3000	2.79%
10	皓骏创投	52.2000	1.86%
合计		<b>2,810.9273</b>	<b>100.00%</b>

#### （4）2023年4月增资

2023年4月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，决议同意公司注册资本增至2,960.9273万元，新增注册资本150.00万元中，由尚颀山高出资5,000.00万元认购125.00万元，由山高弘金出资1,000.00万元认购25.00万元；

并修改公司章程。

本次增资的具体情况如下：

股东名称	投资金额 (万元)	认缴注册资本 (万元)	计入资本公积金额 (万元)
尚颀山高	5,000.00	125.00	4,875.00
山高弘金	1,000.00	25.00	975.00

2023年4月25日，上海市市场监督管理局向韬盛科技换发新的《营业执照》。

本次增资完成后，韬盛科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	殷岚勇	931.3974	31.46%
2	苏州厚积	475.9312	16.07%
3	高凯	465.6987	15.73%
4	景宁水獭	289.2000	9.77%
5	华峰测控	207.7000	7.01%
6	柘中君信	130.5000	4.41%
7	尚颀山高	125.0000	4.22%
8	毅达贰号	90.0000	3.04%
9	毅达创投	90.0000	3.04%
10	俱成创投	78.3000	2.64%
11	皓骏创投	52.2000	1.76%
12	山高弘金	25.0000	0.84%
合计		<b>2,960.9273</b>	<b>100.00%</b>

#### （5）2023年6月增资

2023年6月16日，韬盛科技召开2022年年度股东大会，决议同意公司注册资本增至3,060.9273万元，新增注册资本由苏州厚积、昊日长晶认购；并修改公司章程。

本次增资的具体情况如下：

股东名称	投资金额 (万元)	认缴注册资本 (万元)	计入资本公积 金额（万元）
苏州厚积	340.00	34.00	306.00
昊日长晶	660.00	66.00	594.00

2023年6月19日，上海市市场监督管理局向韬盛科技换发新的《营业执照》。

本次增资完成后，韬盛科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	殷岚勇	931.3974	30.43%
2	苏州厚积	509.9312	16.66%
3	高凯	465.6987	15.21%
4	景宁水獭	289.2000	9.45%
5	华峰测控	207.7000	6.79%
6	柘中君信	130.5000	4.26%
7	尚颀山高	125.0000	4.08%
8	毅达贰号	90.0000	2.94%
9	毅达创投	90.0000	2.94%
10	俱成创投	78.3000	2.56%
11	昊日长晶	66.0000	2.16%
12	皓骏创投	52.2000	1.71%
13	山高弘金	25.0000	0.82%
合计		<b>3,060.9273</b>	<b>100.00%</b>

#### （6）2024年12月转让

2024年12月26日，华峰测控、毅达贰号、毅达众创签订《关于上海韬盛电子科技有限公司之股份转让协议》，约定华峰测控分别以1,480.00万元、1,480.00万元向毅达贰号、毅达众创转让37.00万股、37.00万股。

本次股份转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让的股份数（万股）	转让对价（万元）
华峰测控	毅达贰号	37.00	1,480.00
	毅达众创	37.00	1,480.00

本次转让完成后，韬盛科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	殷岚勇	931.3974	30.43%
2	苏州厚积	509.9312	16.66%
3	高凯	465.6987	15.21%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
4	景宁水獭	289.2000	9.45%
5	华峰测控	133.7000	4.37%
6	柘中君信	130.5000	4.26%
7	毅达贰号	127.0000	4.15%
8	尚颀山高	125.0000	4.08%
9	毅达创投	90.0000	2.94%
10	俱成创投	78.3000	2.56%
11	昊日长晶	66.0000	2.16%
12	皓骏创投	52.2000	1.71%
13	毅达众创	37.0000	1.21%
14	山高弘金	25.0000	0.82%
	<b>合计</b>	<b>3,060.9273</b>	<b>100.00%</b>

#### （7）2025年1月转让

2025年1月20日，景宁水獭、柘中君信签订《关于上海韬盛电子科技股份有限公司之股份转让协议》，约定景宁水獭以2,000.00万元向柘中君信转让50.00万股。

本次转让完成后，韬盛科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	殷岚勇	931.3974	30.43%
2	苏州厚积	509.9312	16.66%
3	高凯	465.6987	15.21%
4	景宁水獭	239.2000	7.81%
5	柘中君信	180.5000	5.90%
6	华峰测控	133.7000	4.37%
7	毅达贰号	127.0000	4.15%
8	尚颀山高	125.0000	4.08%
9	毅达创投	90.0000	2.94%
10	俱成创投	78.3000	2.56%
11	昊日长晶	66.0000	2.16%
12	皓骏创投	52.2000	1.71%
13	毅达众创	37.0000	1.21%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
14	山高弘金	25.0000	0.82%
	合计	<b>3,060.9273</b>	<b>100.00%</b>

### （8）2025年3月增资及转让

2025年2月24日，公司召开2025年第一次临时股东大会，决议同意公司注册资本增至3,180.9273万元，新增注册资本120.00万元中，由混改基金出资4,875.00万元认购75.00万元，由江苏装备基金出资2,925.00万元认购45.00万元，并修改公司章程。

2025年3月16日，公司召开2025年第二次临时股东大会，决议同意①公司注册资本增至3,279.9273万元，新增注册资本99.00万元中，由安徽中安出资3,150.00万元认购45.00万元，由昆山玉澄出资1,260.00万元认购18.00万元，由毅达贰号出资2,520.00万元认购36.00万元；②苏州厚积及华峰测控将其持有的部分股份转让给安徽中安、昆山玉澄、毅达贰号；③修改公司章程。

本次增资的具体情况如下：

股东名称	投资金额（万元）	认缴注册资本（万元）	计入资本公积金额（万元）
混改基金	4,875.00	75.00	4,800.00
江苏装备基金	2,925.00	45.00	2,880.00
安徽中安	3,150.00	45.00	3,105.00
昆山玉澄	1,260.00	18.00	1,242.00
毅达贰号	2,520.00	36.00	2,484.00

本次股份转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让的股份数（万股）	转让对价（万元）
华峰测控	安徽中安	45.00	1,800.00
	昆山玉澄	16.95	678.00
苏州厚积	昆山玉澄	1.05	42.00
	毅达贰号	36.00	1,440.00

2025年4月7日，上海市市场监督管理局向韬盛科技换发新的《营业执照》。

本次增资及转让完成后，韬盛科技的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	殷岚勇	931.3974	28.40%
2	苏州厚积	472.8812	14.42%
3	高凯	465.6987	14.20%
4	景宁水獭	239.2000	7.29%
5	毅达贰号	199.0000	6.07%
6	柘中君信	180.5000	5.50%
7	尚颀山高	125.0000	3.81%
8	毅达创投	90.0000	2.74%
9	安徽中安	90.0000	2.74%
10	俱成创投	78.3000	2.39%
11	混改基金	75.0000	2.29%
12	华峰测控	71.7500	2.19%
13	昊日长晶	66.0000	2.01%
14	皓骏创投	52.2000	1.59%
15	江苏装备基金	45.0000	1.37%
16	毅达众创	37.0000	1.13%
17	昆山玉澄	36.0000	1.10%
18	山高弘金	25.0000	0.76%
合计		<b>3,279.9273</b>	<b>100.00%</b>

#### 4、报告期末发行人股本情况

报告期末，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	殷岚勇	931.3974	28.40%
2	苏州厚积	472.8812	14.42%
3	高凯	465.6987	14.20%
4	景宁水獭	239.2000	7.29%
5	毅达贰号	199.0000	6.07%
6	柘中君信	180.5000	5.50%
7	尚颀山高	125.0000	3.81%
8	毅达创投	90.0000	2.74%
9	安徽中安	90.0000	2.74%

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
10	俱成创投	78.3000	2.39%
11	混改基金	75.0000	2.29%
12	华峰测控	71.7500	2.19%
13	昊日长晶	66.0000	2.01%
14	皓骏创投	52.2000	1.59%
15	江苏装备基金	45.0000	1.37%
16	毅达众创	37.0000	1.13%
17	昆山玉澄	36.0000	1.10%
18	山高弘金	25.0000	0.76%
	合计	<b>3,279.9273</b>	<b>100.00%</b>

### （三）历次股权变动过程曾经存在瑕疵或者纠纷情况

历次股权变动过程中，发行人不存在出资瑕疵或纠纷情况。

### （四）关于对赌协议的情况

根据韬盛科技各股东于 2025 年 3 月 18 日签署的《关于上海韬盛电子科技股份有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），公司曾存在特殊权利安排，具体如下：

涉及特殊权利安排的股东名称	主要对赌条款及股东特殊权利安排
毅达贰号、毅达创投、毅达众创（统称为 A 轮投资方）	<p><b>回购权：</b>若公司未能在 2027 年 12 月 31 日前就合格 IPO 申报获得相关证券监管部门或相关交易所的受理，或未能在 2028 年 12 月 31 日前完成合格 IPO，或发生其他回购事项，则 A 轮投资方有权要求回购 A 轮投资方持有的全部或者部分通过增资取得的增发股权，但回购主体由实际控制人在公司、创始股东及第三方之间进行选择（可择一或共同回购）；如果 A 轮投资方新股回购事项触发且全体投资方（华峰测控除外）以认购新股方式取得的公司增发股权已全部完成回购，自该日起 18 个月内，若 A 轮投资方尚有未完成出售的通过受让老股方式取得的股份，A 轮投资方有权要求公司以减资方式回购该等股份。</p> <p><b>其他特殊权利安排：</b>优先认购权、反稀释权、限制出售、共同出售权和转让权等。</p>
景宁水獭	<p><b>回购权：</b>若公司的主营业务发生重大变化、公司现有核心人员发生重大变化等约定的回购事项发生，则景宁水獭有权要求公司创始股东回购其持有的全部或者部分公司股权。</p> <p><b>其他特殊权利安排：</b>优先认购权、反稀释权、限制出售、共同出售权和转让权等。</p>
柘中君信、尚颀山高、俱成创投、皓骏创投、山高弘金	<p><b>回购权：</b>若公司未能在 2027 年 12 月 31 日前就合格 IPO 申报获得相关证券监管部门或相关交易所的受理，或未能在 2028 年 12 月 31 日前完成合格 IPO，或发生其他回购事项，则 B 轮投资方有权要求创始股东回</p>

涉及特殊权利安排的股东名称	主要对赌条款及股东特殊权利安排
（统称为 B 轮投资方）	<p>购 B 轮投资方持有的全部或者部分通过增资取得的增发股权；如果 B 轮投资方新股回购事项触发且全体投资方（华峰测控除外）以认购新股方式取得的公司增发股权已全部完成回购，自该日起 18 个月内，若 B 轮投资方尚有未完成出售的通过受让老股方式取得的股份，B 轮投资方有权要求公司以减资方式回购该等股份。</p> <p><b>其他特殊权利安排：</b>优先认购权、反稀释权、限制出售、共同出售权和转让权等。</p>
毅达贰号、安徽中安、混改基金、江苏装备基金、昆山玉澄（统称为 C 轮投资方）	<p><b>回购权：</b>若公司未能在 2027 年 12 月 31 日前就合格 IPO 申报获得相关证券监管部门或相关交易所的受理，或未能在 2028 年 12 月 31 日前完成合格 IPO，或发生其他回购事项，则 C 轮投资方有权要求创始股东回购 C 轮投资方持有的全部或者部分通过增资取得的增发股权；如果 C 轮投资方新股回购事项触发且全体投资方（华峰测控等不具有特殊权利的投资方除外）以认购新股方式取得的公司增发股权已全部完成回购，自该日起 18 个月内，若 C 轮投资方尚有未完成出售的通过受让老股方式取得的股份，C 轮投资方有权要求公司以减资方式回购该等股份。</p> <p><b>其他特殊权利安排：</b>优先认购权、反稀释权、限制出售、共同出售权和转让权等。</p>
华峰测控	<p><b>其他特殊权利安排：</b>优先认购权、反稀释权、限制出售、共同出售权和转让权等。</p>

注：上表中创始股东指殷岚勇、高凯、苏州厚积、昊日长晶。

发行人、创始股东与上述 14 家机构股东（以下简称“特殊权利股东”）已于 2025 年 11 月 26 日签署《关于上海韬盛电子科技股份有限公司股东协议之补充协议》，协议约定的特殊股东权利条款终止的主要内容如下：

各方确认并同意，对《股东协议》中可能构成公司上市障碍或对公司上市进程造成任何不利影响的安排及与此安排有关的条款（以下简称“特殊股东权利条款”）作出如下安排：

“（1）《股东协议》第 4 条约定的投资方回购权中约定的公司需履行的义务、承担的责任内容，均于本补充协议签署生效之日终止，并视为自始无效；其他特殊股东权利条款（包括但不限于《股东协议》第 5 条约定的投资方的其他权利条款等）中约定的公司需履行的义务、承担的责任内容，均于公司向上海证券交易所提交上市申请之日终止，并视为自始无效；

（2）上述特殊股东权利条款中约定的实际控制人及/或创始股东需履行的义务、承担的责任内容均于公司向上海证券交易所提交上市申请之日终止，并视为自始无效。

各方确认并同意，公司完成上市后将按照上市公司相关法律、法规及规范性

文件规范运作，《股东协议》第 2.1 条董事会的相关约定条款，以及如存在投资方与公司、创始股东等约定的超出一般股东权利的其他特殊权利（除本协议约定终止的特殊权利条款外），均于公司向上海证券交易所提交上市申请之日终止，并视为自始无效。

投资方确认，其按照本补充协议的约定不可撤销地放弃特殊股东权利条款项下的权利及其他不同于一般公众股东的权利，且上述权利终止后不可恢复。”

发行人、实际控制人殷岚勇与除华峰测控、景宁水獭、柘中君信、皓骏创投外的特殊权利股东签署《声明函》，约定若发行人申报材料被受理后，如发行人本次上市进程终止，则殷岚勇有义务和权力与前述股东在本次上市进程终止之日起 180 日内回购前述股东持有的公司股份，并签署相应的股份回购协议。

综上，《关于上海韬盛电子科技有限公司股东协议之补充协议》《声明函》签署后，发行人不再作为对赌协议当事人，对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定，不与公司市值挂钩，且不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。

#### （五）关于代持及解除情况

自设立以来，发行人直接股东不存在股权代持的情形。发行人直接股东苏州厚积合伙人层面曾存在部分合伙人未及时办理工商变更登记，作为隐名合伙人持有苏州厚积实际出资份额的情形。具体情况如下：

2015 年 7 月，苏州厚积增资，由于涉及人员较多，出于避免频繁变更工商的考虑，苏州厚积未就此次增资办理相应工商变更登记，本次增资共涉及 24 名自然人，对应发行人层面 114.50 万股。

序号	时间	增资方	对应发行人层面股份数（万股）	未办理工商变更的原因
1	2015 年 7 月	蔡中来等 23 名 发行人员工	90.50	为避免员工离职等不确定性因素带来的持股平台股份变动过于频繁，公司未为部分持股平台合伙人办理工商变更手续
2		张东明	24.00	因看好公司未来发展前景，通过持股平台增资发行人，但考虑到张东明非公司员工，公司未办理工商变更手续
合计			<b>114.50</b>	-

截止报告期初,苏州厚积隐名出资份额涉及的人员已通过办理工商变更登记、份额转让或退伙等方式予以还原,具体情况如下:

序号	还原方式	具体情况	涉及人员
情况一	完成工商变更	2020年12月苏州厚积办理工商变更手续,完成还原。	曹子意等 共计14人
情况二	相关人员离职,全部出资份额转让给殷岚勇或/和高凯,退出苏州厚积	相关人员离职时将其财产份额转让给殷岚勇或/和高凯并退出持股平台,2020年12月苏州厚积办理殷岚勇或/和高凯受让份额的工商手续。	秦娇等共 计8人
	相关人员离职,通过减资退伙方式退出苏州厚积	吴彦于2015年7月增资取得苏州厚积10.2425万元财产份额(对应发行人15.1909万股股份),该次增资未办理工商变更。2020年10月,吴彦离职,经友好协商,吴彦从苏州厚积退伙,退伙资金来源为苏州厚积向外部股东华峰测控转让对应的发行人股份。	吴彦
情况三	相关人员从苏州厚积退伙	张东明2015年7月增资取得苏州厚积16.1821万元财产份额(对应发行人24万股股份),该次增资未办理工商变更;2020年1月,张东明和外部投资人王见驰签订转让协议,张东明将其于2015年7月通过增资获得的苏州厚积16.1821万元隐名份额转让给王见驰。因王见驰非公司员工,故其在苏州厚积工商资料中亦未显名。 2021年,王见驰要求将其通过苏州厚积隐名持有的发行人24万股股份转由通过景宁水獭间接持有。 2021年6月至12月,各方先后完成王见驰增资景宁水獭、景宁水獭受让苏州厚积持有的发行人24万股股份、王见驰从苏州厚积退伙。至此,上述份额完成还原。	张东明

综上所述,苏州厚积曾存在的隐名出资份额事项已解决完毕,相关股权权属清晰,不存在纠纷或潜在纠纷。

### 三、发行人成立以来重要事件

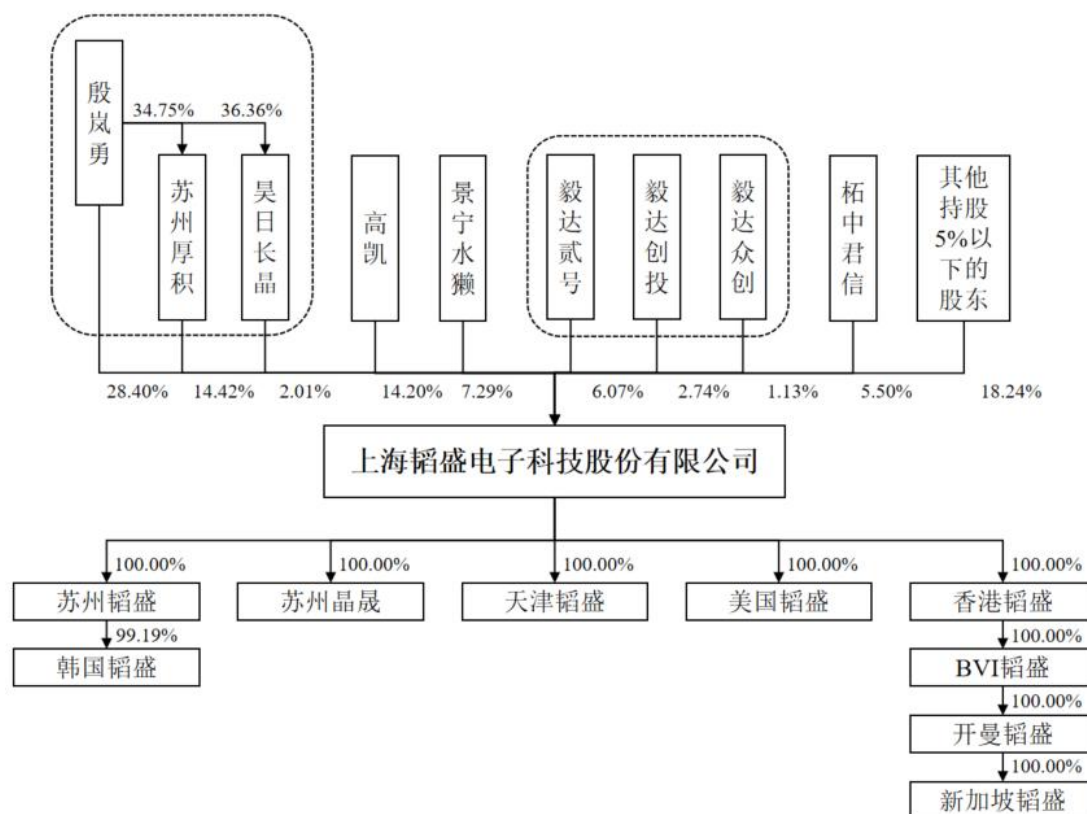
报告期内,公司未发生重大资产重组等重要事件。

### 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况

发行人自成立至今,未在其他证券市场上市或挂牌。

### 五、发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日,公司股权结构如下图所示:



注：同一虚线方框内的股东之间存在一致行动关系。

## 六、发行人控股及参股公司情况

截至本招股说明书签署日，发行人共有 3 家境内子公司和 6 家境外子公司，不存在参股公司或分支机构，具体情况如下：

### (一) 重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司

#### 1、苏州韬盛

公司名称	苏州韬盛电子科技有限公司
成立时间	2012 年 1 月 5 日
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
注册地和主要生产经营地	苏州工业园区唯新路 83 号 3 幢 2 单元
经营范围	设计、销售：集成电路测试电路板和软件；研发、组装加工生产、销售：集成电路测试设备、测试插座、老化插座、测试探针卡，并提供相关售后服务；从事上述产品与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	芯片测试接口业务的研发、生产、销售主体
股东构成及控制情况	韬盛科技 100% 持股

最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年6月30日/2025年1-6月	54,730.88	26,645.12	19,233.30	3,477.17
2024年12月31日/2024年度	46,297.43	20,606.44	32,554.47	6,216.41

注：以上财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 2、苏州晶晟

公司名称	苏州晶晟微纳半导体科技有限公司			
成立时间	2021年6月22日			
注册资本	15,000万元			
实收资本	15,000万元			
注册地和主要生产经营地	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路188号C幢101-102、201-203			
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；电子测量仪器销售；集成电路芯片及产品销售；工业自动控制系统装置销售；电子专用材料研发；特种陶瓷制品制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；电子测量仪器制造；光电子器件制造；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	晶圆测试接口业务的研发、生产、销售主体			
股东构成及控制情况	韬盛科技100%持股			
最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年6月30日/2025年1-6月	13,299.41	6,190.08	776.31	-1,784.07
2024年12月31日/2024年度	8,613.63	2,904.14	2,594.50	-3,062.66

注：以上财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 3、天津韬盛

公司名称	天津韬盛芯海设计有限公司			
成立时间	2023年7月3日			
注册资本	2,000.00万元			
实收资本	1,000.00万元			
注册地和主要生产经营地	天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-1539			

经营范围	一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	测试电路板的研发设计主体			
股东构成及控制情况	韬盛科技 100% 持股			
最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年6月30日/2025年1-6月	906.83	849.42	134.31	-40.93
2024年12月31日/2024年度	460.23	382.85	235.10	-85.10

注：以上财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 4、香港韬盛

公司名称	Twinsolution International Limited			
成立时间	2014年6月24日			
股本	1,560,000 股			
注册地和主要生产经营地	UNIT C, 17/F, UNITED CENTRE, 95 QUEENSWAY, ADMIRALTY			
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	境外销售平台			
股东构成及控制情况	韬盛科技 100% 持股			
最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年6月30日/2025年1-6月	1,173.12	1,036.69	273.21	-118.43
2024年12月31日/2024年度	1,304.17	1,145.90	659.84	-186.49

注：以上财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 5、美国韬盛

公司名称	TwinSolution USA Inc.			
成立时间	2016年3月24日			
股本	100,000 股			
注册地和主要生产经营地	2378 Walsh Ave, Suite C, Santa Clara, CA 95051			
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	北美销售中心			
股东构成及控制情况	韬盛科技 100% 持股			
最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润

2025年6月30日/2025年1-6月	175.21	61.82	107.35	50.35
2024年12月31日/2024年度	91.68	11.47	59.27	4.99

注：以上财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 6、韩国韬盛

公司名称	Gemini Technology Inc.			
成立时间	2022年3月29日			
股本	6,150,000股			
注册地和主要生产经营地	京畿道华城市东滩尖端产业1路51-9, 6层606号			
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	晶圆测试接口的研发中心			
股东构成及控制情况	苏州韬盛持股比例为99.19%，韩国韬盛社长金基锡持股比例为0.81%			
最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年6月30日/2025年1-6月	392.80	140.02	446.60	-313.45
2024年12月31日/2024年度	502.59	238.24	506.84	-820.05

注：以上财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 7、BVI韬盛

公司名称	Gemini Capital Inc.			
成立时间	2024年7月4日			
股本	50,000股			
注册地和主要生产经营地	Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands			
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	系发行人投资控股企业，无实际经营			
股东构成及控制情况	香港韬盛持股100%			
最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年6月30日/2025年1-6月	-	-	-	-
2024年12月31日/2024年度	-	-	-	-

注：以上财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 8、开曼韬盛

公司名称	Gemini Technology Co., Ltd			
成立时间	2024年7月30日			
股本	50,000股			
注册地和主要生产经营地	3-212 Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 30746, Seven Mile Beach, Grand Cayman KY1-1203, Cayman Islands			
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	系发行人投资控股企业，无实际经营			
股东构成及控制情况	BVI 韬盛持股 100%			
最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年6月30日/2025年1-6月	-	-	-	-
2024年12月31日/2024年度	-	-	-	-

注：以上财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 9、新加坡韬盛

公司名称	GEMINI TEST TECHNOLOGY PTE. LTD.			
成立时间	2024年11月8日			
股本	50,000股			
注册地和主要生产经营地	152 BEACH ROAD #11-05 GATEWAY EAST Singapore 189721			
经营范围	电子行业贸易			
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	发行人半导体测试产品销售推广平台			
股东构成及控制情况	开曼韬盛持股 100%			
最近一年及一期主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年6月30日/2025年1-6月	0.24	-3.34	-	-3.34
2024年12月31日/2024年度	-	-	-	-

注：以上财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### （二）其他子公司及参股公司

截至本招股说明书签署日，除前述子公司外，公司不存在其他子公司或参股公司。

## 七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况

### （一）控股股东、实际控制人的基本情况

#### 1、控股股东、实际控制人

截至本招股说明书签署日，殷岚勇直接持有发行人 28.40%的股份，并通过苏州厚积控制发行人 14.42%的股份、通过昊日长晶控制发行人 2.01%的股份。综上，殷岚勇通过直接和间接方式合计控制发行人 44.83%的股份。此外，殷岚勇担任发行人董事长、总经理、首席运营官，对发行人的股东会和董事会决议以及重大经营决策事项具有重大影响。因此，殷岚勇为发行人的控股股东、实际控制人。殷岚勇先生的基本情况如下：

殷岚勇，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码1201071971\*\*\*\*\*。1990年9月至1994年6月，就读于东南大学电子工程系物理电子技术专业，获学士学位；2003年8月至2005年7月，就读于加拿大西安大略大学，获工商管理硕士学位。1994年9月至2001年8月，就职于摩托罗拉系统（中国）有限公司，历任半导体事业部测试工程师、系统集成工程师、晶圆测试工程师；2002年5月至2004年7月，就职于Electroglas International Inc.，任销售经理；2004年8月至2006年3月，就职于库力索法（上海）国际贸易有限公司，任测试产品事业部中国区总经理；2006年10月至2013年12月，就职于美博科技（苏州）有限公司，担任董事总经理；2007年4月至今，先后担任发行人执行董事、董事长、总经理、首席运营官。

#### 2、控股股东、实际控制人的一致行动人

截至本招股说明书签署日，殷岚勇作为苏州厚积的执行事务合伙人并持有苏州厚积 37.47%的出资份额，间接控制发行人 14.42%的股份；作为昊日长晶的执行事务合伙人并持有昊日长晶 36.36%的出资份额，间接控制发行人 2.01%的股份。因此，苏州厚积、昊日长晶为殷岚勇的一致行动人。

（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形

截至本招股说明书签署日，控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

（三）其他持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东的基本情况

截至本招股说明书签署日，除控股股东、实际控制人外，其他持有发行人5%以上股份的主要股东有苏州厚积、高凯、景宁水獭、毅达贰号及其一致行动人（毅达创投、毅达众创）、栢中君信。

### 1、苏州厚积

截至本招股说明书签署日，苏州厚积直接持有公司 14.42%的股份，其基本情况如下：

企业名称	苏州厚积
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	913205943138749643
成立时间	2014年8月21日
出资额	318.8428万元人民币
执行事务合伙人	殷岚勇
住所	苏州工业园区唯华路3号君地商务广场5幢1807室
经营范围	企业管理服务、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

苏州厚积的主营业务系作为持股平台直接持有发行人股权，与发行人主营业务无关。苏州厚积的出资人构成和出资比例，参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十八、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排”之“（二）持股平台的基本信息及人员构成”之“1、苏州厚积”。

### 2、高凯

截至本招股说明书签署日，高凯直接持有公司 14.20%的股份，其基本情况如下：高凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 2101031977\*\*\*\*\*。

### 3、景宁水獭

截至本招股说明书签署日，景宁水獭直接持有公司 7.29% 的股份，其基本情况如下：

企业名称	景宁水獭企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91331127MA2HK0Y443
成立时间	2021 年 1 月 19 日
出资额	1,055.2948 万元
执行事务合伙人	赵仁志
住所	浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道金鹤路 9 号 2 幢 515 室
经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

景宁水獭的主营业务为作为持股平台持有发行人股份，与发行人主营业务无关。截至本招股说明书签署日，景宁水獭的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资比例
1	赵仁志	普通合伙人	27.5299	2.61%
2	王见驰	有限合伙人	405.8824	38.46%
2	陈敏珊	有限合伙人	123.5294	11.71%
3	孙国宁	有限合伙人	92.6471	8.78%
4	龚平	有限合伙人	87.4700	8.29%
5	万红	有限合伙人	58.8235	5.57%
6	杨丰才	有限合伙人	55.8825	5.30%
7	李宝刚	有限合伙人	38.8235	3.68%
8	王江龙	有限合伙人	35.2941	3.34%
9	李扬	有限合伙人	35.2941	3.34%
10	鲁晖	有限合伙人	32.3536	3.07%
12	李振林	有限合伙人	22.0588	2.09%
13	徐捷	有限合伙人	17.6471	1.67%
14	张雪波	有限合伙人	17.6470	1.67%
15	陆艳洁	有限合伙人	4.4118	0.42%
合计			1,055.2948	100.00%

#### 4、毅达贰号及其一致行动人（毅达创投、毅达众创）

毅达贰号、毅达创投、毅达众创的私募基金管理人的执行事务合伙人均为西藏爱达汇承私募基金管理有限公司，因此前述三名股东系一致行动关系。截至本招股说明书签署日，毅达贰号直接持有公司 6.07% 的股份，毅达创投直接持有公司 2.74% 的股份，毅达众创直接持有公司 1.13% 的股份，三名股东合计直接持有公司 9.94% 的股份。其基本情况如下：

##### （1）毅达贰号

企业名称	江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320114MA273RNX30
成立时间	2021 年 9 月 18 日
出资额	400,000 万元
执行事务合伙人	南京毅达汇中创业投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：尤劲柏）
住所	南京市雨花台区雨花街道明城大道 42 号 301 室
经营范围	一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

毅达贰号的主营业务为创业投资、投资管理等，与发行人主营业务无关。截至本招股说明书签署日，毅达贰号的出资人构成和出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额(万元)	出资比例
1	南京毅达汇中创业投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	4,000.00	1.00%
2	国家中小企业发展基金有限公司	有限合伙人	105,000.00	26.25%
3	江苏高科技投资集团有限公司	有限合伙人	101,500.00	25.38%
4	南京市雨花台区创新投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	60,000.00	15.00%
5	南京毅达中小壹号创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	48,400.00	12.10%
6	南京毅达贰号中小创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	35,100.00	8.78%
7	江苏省政府投资基金（有限合伙）	有限合伙人	17,500.00	4.38%
8	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	2.50%
9	南京毅达汇员中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8,000.00	2.00%
10	西藏爱达汇承私募基金管理有限公司	有限合伙人	5,500.00	1.38%

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额(万元)	出资比例
11	江苏省广播电视集团有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.25%
合计			<b>400,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## (2) 毅达创投

企业名称	苏州高投毅达创业投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320583MA22XN9Q5G
成立时间	2020年11月3日
出资额	31,500万元
执行事务合伙人	南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)(委派代表:应文禄)
住所	苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心11幢
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

毅达创投的主营业务为创业投资、投资管理等,与发行人主营业务无关。截至本招股说明书签署日,毅达创投的出资人构成和出资比例如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额(万元)	出资比例
1	南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)	普通合伙人	300.00	0.95%
2	江苏高科技投资集团有限公司	有限合伙人	8,700.00	27.62%
3	苏州裕新股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	7,500.00	23.81%
4	昆山高新创业投资有限公司	有限合伙人	6,000.00	19.05%
5	昆山市国科创业投资有限公司	有限合伙人	3,000.00	9.52%
6	宝银金投资有限公司	有限合伙人	2,500.00	7.94%
7	江苏申林投资股份有限公司	有限合伙人	2,000.00	6.35%
8	马川良	有限合伙人	1,500.00	4.76%
合计			<b>31,500.00</b>	<b>100.00%</b>

## (3) 毅达众创

企业名称	江苏高投毅达众创创业投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320583MABXDJF139
成立时间	2022年8月19日
出资额	100,000万元
执行事务合伙人	南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)(委派代表:黄韬)

住所	昆山市玉山镇登云路 258 号汇金财富广场 1 号楼 701 室
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

毅达众创的主营业务为创业投资、投资管理等，与发行人主营业务无关。截至本招股说明书签署日，毅达众创的出资人构成和出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资比例
1	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	普通合伙人	1,000.00	1.00%
2	南京毅达汇创创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	25,000.00	25.00%
3	江苏高科技投资集团有限公司	有限合伙人	25,000.00	25.00%
4	昆山市产业发展引导基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000.00	20.00%
5	昆山创业控股集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	10.00%
6	南京金陵饭店集团有限公司	有限合伙人	5,000.00	5.00%
7	昆山高新创业投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	5.00%
8	太仓文鑫科创投资有限公司	有限合伙人	2,900.00	2.90%
9	昆山市玉山镇泾河村股份经济合作社	有限合伙人	2,100.00	2.10%
10	南京毅达汇员汇创创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	2.00%
11	西藏爱达汇承私募基金管理有限公司	有限合伙人	2,000.00	2.00%
合计			<b>100,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## 5、柘中君信

截至本招股说明书签署日，柘中君信直接持有公司 5.50% 的股份，其基本情况如下：

企业名称	柘中君信（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310000MAC4XCHP8U
成立时间	2022 年 12 月 27 日
出资额	120,000 万元
执行事务合伙人	上海爱建君信企业咨询合伙企业（有限合伙）
住所	上海市松江区茸梅路 555 号 2 幢 8 楼 803 室
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事

	经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	-------------------------------------

柘中君信的主营业务为创业投资、投资管理等，与发行人主营业务无关。截至本招股说明书签署日，柘中君信的出资人构成和出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资比例
1	上海爱建君信企业咨询合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	1,200.00	1.00%
2	上海爱建集团股份有限公司	有限合伙人	30,000.00	25.00%
3	上海柘中集团股份有限公司	有限合伙人	30,000.00	25.00%
4	上海松江创业投资管理有限公司	有限合伙人	23,000.00	19.17%
5	上海国泰君安创新股权投资母基金中心（有限合伙）	有限合伙人	8,000.00	6.67%
6	上海悦来港教育科技有限公司	有限合伙人	5,000.00	4.17%
7	嘉兴昀曜星泽创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	4.17%
8	上海爱建信托有限责任公司	有限合伙人	4,350.00	3.63%
9	上海寓馨企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,000.00	2.50%
10	锐奇控股股份有限公司	有限合伙人	3,000.00	2.50%
11	上海爱屋投资管理有限公司	有限合伙人	3,000.00	2.50%
12	上海迎水投资管理有限公司	有限合伙人	2,450.00	2.04%
13	上海松江城乾投资有限公司	有限合伙人	1,000.00	0.83%
14	上海比雷福实业有限公司	有限合伙人	1,000.00	0.83%
合计			<b>120,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## 八、特别表决权或类似安排

截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

## 九、协议控制架构的情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在协议控制架构的安排。

十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人报告期内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

## 十一、发行人股本情况

### (一) 本次发行前后公司股本情况

发行人本次发行前的总股本为 3,279.9273 万股，本次拟公开发行股票数量不超过 1,093.3091 万股，不低于发行后总股本的 25.00%，本次发行前后股本结构预计如下：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		股数(万股)	比例	股数(万股)	比例
1	殷岚勇	931.3974	28.40%	931.3974	21.30%
2	苏州厚积	472.8812	14.42%	472.8812	10.81%
3	高凯	465.6987	14.20%	465.6987	10.65%
4	景宁水獭	239.2000	7.29%	239.2000	5.47%
5	毅达贰号	199.0000	6.07%	199.0000	4.55%
6	柘中君信	180.5000	5.50%	180.5000	4.13%
7	尚颀山高	125.0000	3.81%	125.0000	2.86%
8	毅达创投	90.0000	2.74%	90.0000	2.06%
9	安徽中安	90.0000	2.74%	90.0000	2.06%
10	俱成创投	78.3000	2.39%	78.3000	1.79%
11	混改基金	75.0000	2.29%	75.0000	1.71%
12	华峰测控	71.7500	2.19%	71.7500	1.64%
13	昊日长晶	66.0000	2.01%	66.0000	1.51%
14	皓骏创投	52.2000	1.59%	52.2000	1.19%

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		股数（万股）	比例	股数（万股）	比例
15	江苏装备基金	45.0000	1.37%	45.0000	1.03%
16	毅达众创	37.0000	1.13%	37.0000	0.85%
17	昆山玉澄	36.0000	1.10%	36.0000	0.82%
18	山高弘金	25.0000	0.76%	25.0000	0.57%
19	公司新股预计 发行数量	-	-	1,093.3091	25.00%
合计		<b>3,279.9273</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,373.2364</b>	<b>100.00%</b>

## （二）本次发行前的前十名股东情况

本次发行前，本公司前十名股东及持股情况如下：

序号	简称	持股数量（万股）	持股比例
1	殷岚勇	931.3974	28.40%
2	苏州厚积	472.8812	14.42%
3	高凯	465.6987	14.20%
4	景宁水獭	239.2000	7.29%
5	毅达贰号	199.0000	6.07%
6	柘中君信	180.5000	5.50%
7	尚颀山高	125.0000	3.81%
8	毅达创投	90.0000	2.74%
9	安徽中安	90.0000	2.74%
10	俱成创投	78.3000	2.39%
合计		<b>2,871.9773</b>	<b>87.56%</b>

## （三）本次发行前的前十名自然人股东及其担任发行人职务情况

本次发行前，公司有 2 名自然人股东，其持股及在本公司任职情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	比例（%）	职务
1	殷岚勇	931.3974	28.40%	董事长、总经理、 首席运营官
2	高凯	465.6987	14.20%	香港韬盛副总经理

## （四）发行人股本中国有股份或外资股份情况

截至本招股说明书签署日，发行人股本中不存在应标注“SS”、“CS”的国有股份，发行人亦不存在外资股东。

### （五）发行人申报前十二个月新增股东的情况

截至本招股说明书签署日，发行人本次公开发行申报前 12 个月内新增股东 5 名，为毅达众创、混改基金、江苏装备基金、安徽中安、昆山玉澄，具体情况如下：

#### 1、新增股东的入股原因、入股价格及定价依据

序号	股东名称	协议签署时间	取得股数（万股）	股份来源	入股原因	入股价格及定价依据
1	毅达众创	2024 年 12 月	37.0000	转让	老股东基于投资策略、锁定收益考虑，转让部分老股；新股东作为专业投资机构，认可发行人未来发展战略和行业前景，通过受让老股、增资新股的方式投资发行人	经各方友好协商，并考虑公司经营发展情况、老股转让折价等因素，确定转让价格为 40.00 元/股
2	混改基金	2025 年 3 月	75.0000	增资		经各方友好协商，并考虑公司经营发展情况等因素，确定增资价格为 65.00 元/股
3	江苏装备基金	2025 年 3 月	45.0000	增资		经各方友好协商，并考虑公司经营发展情况等因素，确定增资价格为 65.00 元/股
4	安徽中安	2025 年 3 月	45.0000	转让		经各方友好协商，并考虑公司经营发展情况、老股转让折价等因素，确定转让价格为 40.00 元/股、增资价格为 70.00 元/股
			45.0000	增资		
5	昆山玉澄	2025 年 3 月	18.0000	转让	经各方友好协商，并考虑公司经营发展情况、老股转让折价等因素，确定转让价格为 40.00 元/股、增资价格为 70.00 元/股	
			18.0000	增资		

#### 2、新增股东的基本情况

##### （1）毅达众创

截至本招股说明书签署日，毅达众创直接持有公司 1.13% 的股份，其基本情况如下参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况”之“（三）其他持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东的基本情况”之“4、毅达贰号及其一致行动人（毅达创投、毅达众创）”之“（3）毅达众创”。

截至本招股说明书签署日，毅达众创的执行事务合伙人为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙），其基本情况如下：

企业名称	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320100MA1MFEH23R
成立时间	2016年2月23日
出资额	10,000万元
执行事务合伙人	西藏爱达汇承私募基金管理有限公司（委派代表：应文禄）
住所	南京市建邺区江东中路359号国睿大厦二号楼4楼B504室
经营范围	受托管理私募股权投资基金；股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）的出资人构成和出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资比例
1	西藏爱达汇承私募基金管理有限公司	普通合伙人	9,900.00	99.00%
2	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	有限合伙人	100.00	1.00%
合计			<b>10,000.00</b>	<b>100.00%</b>

## （2）混改基金

截至本招股说明书签署日，混改基金直接持有公司2.29%的股份，其基本情况如下：

企业名称	江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320000MACNKU14X0
成立时间	2023年6月28日
出资额	500,000万元
执行事务合伙人	江苏高投创业投资管理有限公司（委派代表：陈宁）
住所	南京市建邺区白龙江东街9号B2幢北楼4层401-477室
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，混改基金的出资人构成和出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资比例
1	江苏高投创业投资管理有限公司	普通合伙人	5,000.00	1.00%

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资比例
2	江苏高投创新投资有限责任公司	有限合伙人	60,000.00	12.00%
3	江苏高投创智投资有限责任公司	有限合伙人	60,000.00	12.00%
4	徐州矿务集团有限公司	有限合伙人	50,000.00	10.00%
5	南京金陵饭店集团有限公司	有限合伙人	40,000.00	8.00%
6	南京凤凰创业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	30,000.00	6.00%
7	江苏云杉资本管理有限公司	有限合伙人	30,000.00	6.00%
8	江苏省港口集团有限公司	有限合伙人	30,000.00	6.00%
9	江苏省国信集团有限公司	有限合伙人	30,000.00	6.00%
10	南京市建邺区高科技投资集团有限公司	有限合伙人	30,000.00	6.00%
11	江苏省农垦集团有限公司	有限合伙人	20,000.00	4.00%
12	江苏省环保集团有限公司	有限合伙人	20,000.00	4.00%
13	江苏省沿海开发集团有限公司	有限合伙人	20,000.00	4.00%
14	江苏省苏豪控股集团有限公司	有限合伙人	20,000.00	4.00%
15	江苏睿辉股权投资管理有限责任公司	有限合伙人	10,000.00	2.00%
16	江苏省铁路集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	2.00%
17	江苏钟山宾馆集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	2.00%
18	江苏省盐业集团有限责任公司	有限合伙人	10,000.00	2.00%
19	江苏省国际货运班列有限公司	有限合伙人	10,000.00	2.00%
20	江苏省电影集团有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.00%
合计			<b>500,000.00</b>	<b>100.00%</b>

截至本招股说明书签署日，混改基金的执行事务合伙人为江苏高投创业投资管理有限责任公司，其基本情况如下：

企业名称	江苏高投创业投资管理有限责任公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	913200007040485477
成立时间	1999年1月29日
注册资本	10,000万元
法定代表人	陈宁
住所	南京市虎踞路99号高投大厦
经营范围	创业投资管理，企业资产管理，投资信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

	法自主开展经营活动)
--	------------

截至本招股说明书签署日，江苏高投创业投资管理有限公司的股东信息具体如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	江苏高科技投资集团有限公司	10,000.00	100.00%
	合计	10,000.00	100.00%

### （3）江苏装备基金

截至本招股说明书签署日，江苏装备基金直接持有公司 1.37% 的股份，其基本情况如下：

企业名称	江苏苏州高端装备产业专项母基金（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91320509MADYJCJ7L5P
成立时间	2024 年 8 月 27 日
出资额	600,000 万元
执行事务合伙人	苏州战新私募基金管理有限公司（委派代表：何鲲）
住所	苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）迎宾大道 333 号苏州湾东方创投基地 33 号楼
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，江苏装备基金的出资人构成和出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资比例
1	苏州战新私募基金管理有限公司	普通合伙人	6,000.00	1.00%
2	江苏省战略性新兴产业母基金有限公司	有限合伙人	150,000.00	25.00%
3	苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司	有限合伙人	137,000.00	22.83%
4	苏州创新投资集团有限公司	有限合伙人	92,000.00	15.33%
5	中新苏州工业园区投资管理有限公司	有限合伙人	20,000.00	3.33%
6	苏州市吴中金融控股集团有限公司	有限合伙人	20,000.00	3.33%
7	太仓市资产经营集团有限公司	有限合伙人	20,000.00	3.33%
8	常熟市常新产业发展有限公司	有限合伙人	20,000.00	3.33%

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资比例
9	张家港暨阳高端制造产业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000.00	3.33%
10	苏州创元投资发展（集团）有限公司	有限合伙人	13,000.00	2.17%
11	苏州市港航投资发展集团有限公司	有限合伙人	13,000.00	2.17%
12	苏州市农业发展集团有限公司	有限合伙人	13,000.00	2.17%
13	苏州交通投资集团有限责任公司	有限合伙人	13,000.00	2.17%
14	昆山创业控股集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	1.67%
15	苏州高新区国昇资本运营有限公司	有限合伙人	10,000.00	1.67%
16	昆山国创投资集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	1.67%
17	苏州高新创业投资集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	1.67%
18	苏州相城经济技术开发区漕湖资本投资有限公司	有限合伙人	10,000.00	1.67%
19	苏州市相城金融控股（集团）有限公司	有限合伙人	10,000.00	1.67%
20	苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司	有限合伙人	3,000.00	0.50%
合计			<b>600,000.00</b>	<b>100.00%</b>

截至本招股说明书签署日，江苏装备基金的执行事务合伙人为苏州战新私募基金管理有限公司，其基本情况如下：

企业名称	苏州战新私募基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320508MADW28A22K
成立时间	2024年8月2日
注册资本	12,000万元
法定代表人	何鲲
住所	江苏省苏州市姑苏区沧浪街道东大街101号
经营范围	一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，苏州战新私募基金管理有限公司的股东信息具体如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	苏州创新投资集团有限公司	9,000.00	75.00%
2	江苏高投战新私募基金管理有限公司	3,000.00	25.00%

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
	合计	12,000.00	100.00%

#### （4）安徽中安

截至本招股说明书签署日，安徽中安直接持有公司 2.74% 的股份，其基本情况如下：

企业名称	安徽中安优选战新贰号投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91340100MAD6DN9B78
成立时间	2023 年 12 月 15 日
出资额	100,000 万元
执行事务合伙人	安徽中安资本管理有限公司
住所	安徽巢湖经济开发区龙泉路 9 号 A 楼四层
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至本招股说明书签署日，安徽中安的出资人构成和出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资比例
1	安徽中安资本管理有限公司	普通合伙人	1,000.00	1.00%
2	安徽省铁路发展基金股份有限公司	有限合伙人	89,000.00	89.00%
3	安徽巢湖经济开发区东鑫科创产业投资引导基金有限公司	有限合伙人	10,000.00	10.00%
	合计		100,000.00	100.00%

截至本招股说明书签署日，安徽中安的执行事务合伙人为安徽中安资本管理有限公司，其基本情况如下：

企业名称	安徽中安资本管理有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91340100353213677X
成立时间	2015 年 8 月 14 日
注册资本	10,000 万元
法定代表人	方荣
住所	合肥高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 F5-00045 室

<b>经营范围</b>	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
-------------	---

截至本招股说明书签署日，安徽中安资本管理有限公司的股东信息具体如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	安徽省铁路发展基金股份有限公司	10,000.00	100.00%
<b>合计</b>		<b>10,000.00</b>	<b>100.00%</b>

### （5）昆山玉澄

截至本招股说明书签署日，昆山玉澄直接持有公司 1.10% 的股份，其基本情况如下：

<b>企业名称</b>	昆山市玉澄德蒙股权投资基金合伙企业（有限合伙）
<b>企业类型</b>	有限合伙企业
<b>统一社会信用代码</b>	91320583MADCF9MWXN
<b>成立时间</b>	2024 年 3 月 13 日
<b>出资额</b>	20,000 万元
<b>执行事务合伙人</b>	昆山市国科创业投资有限公司（委派代表：陆晓强）
<b>住所</b>	江苏省苏州市昆山市玉山镇登云路 258 号汇金财富广场 1 号楼 703 室
<b>经营范围</b>	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，昆山玉澄的出资人构成和出资比例如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资金额（万元）	出资比例
1	昆山市国科创业投资有限公司	普通合伙人	200.00	1.00%
2	昆山创业控股集团有限公司	有限合伙人	7,800.00	39.00%
3	昆山沪苏新城科创发展有限公司	有限合伙人	6,000.00	30.00%
4	昆山汇创投资有限公司	有限合伙人	6,000.00	30.00%
<b>合计</b>			<b>20,000.00</b>	<b>100.00%</b>

截至本招股说明书签署日，昆山玉澄的执行事务合伙人为昆山市国科创业投资有限公司，其基本情况如下：

企业名称	昆山市国科创业投资有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	913205837311608172
成立时间	2001年8月31日
注册资本	72,500万元
法定代表人	陆晓强
住所	昆山市玉山镇登云路258号汇金财富广场1号楼701室
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，昆山市国科创业投资有限公司的股东信息具体如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	昆山创业控股集团有限公司	71,600.00	98.76%
2	昆山市创业投资有限公司	900.00	1.24%
合计		72,500.00	100.00%

### 3、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员的关联关系

截至本招股说明书签署日，申报前十二个月新增股东毅达众创与发行人其他股东具有关联关系，具体如下：

新增股东	原始其他股东	关联关系
毅达众创	毅达贰号	毅达贰号、毅达创投、毅达众创三家股东的私募基金管理人的执行事务合伙人均为西藏爱达汇承私募基金管理有限公司，因此该三名股东具有一致行动关系
	毅达创投	

除此以外，申报前十二个月新增股东与发行人其他股东、董事、监事会取消前在任监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 4、新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系

截至本招股说明书签署日，新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。

## 5、新增股东是否存在股份代持情形

截至本招股说明书签署日，新增股东不存在股份代持情形。

## 6、新增股东的股份锁定情况

截至本招股说明书签署日，发行人本次公开发行申报前 12 个月内新增股东均已根据《监管规则适用指引——发行类第 4 号》等相关法律法规及规范性文件出具股份锁定承诺，具体承诺内容请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”之“（一）关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

### （六）本次发行前各股东之间的关联关系、一致行动关系

截至本招股说明书签署日，本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东各自持股比例如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数	持股比例	关联关系、一致行动关系
1	殷岚勇	931.40	28.40%	殷岚勇直接持有发行人 28.40% 的股份，作为苏州厚积的执行事务合伙人并持有苏州厚积 37.47% 的出资份额，作为昊日长晶的执行事务合伙人并持有昊日长晶 36.36% 的出资份额，三者为一致行动关系
	苏州厚积	472.88	14.42%	
	昊日长晶	66.00	2.01%	
	合计	<b>1,470.28</b>	<b>44.83%</b>	
2	毅达贰号	199.00	6.07%	毅达贰号、毅达创投、毅达众创私募基金管理人的执行事务合伙人均为西藏爱达汇承私募基金管理有限公司，三者为一致行动关系
	毅达创投	90.00	2.74%	
	毅达众创	37.00	1.13%	
	合计	<b>326.00</b>	<b>9.94%</b>	

除此之外，本次发行前公司股东之间不存在其他关联关系。

### （七）公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响

本次发行不存在发行人股东公开发售股份的情况。

### （八）入股交易价格明显异常的股东情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在入股交易价格明显异常的股东情况。

### （九）申报时存在私募投资基金等金融产品股东的情况

截至本招股说明书签署日，发行人共有 18 名股东，其中机构股东 16 名，自

然人股东 2 名。机构股东中 12 名股东为私募投资基金，均已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等规定进行登记或备案，具体情况如下：

序号	私募基金股东	私募基金备案编码	相应私募基金管理人	私募基金管理人登记编号
1	毅达贰号	SSW693	南京毅达汇中创业投资管理合伙企业（有限合伙）	P1073255
2	柘中君信	SZF329	君信（上海）股权投资基金管理有限公司	P1066511
3	尚颀山高	SVV988	上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）	P1002076
4	毅达创投	SNH038	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	P1032972
5	安徽中安	SAFX95	安徽中安资本管理有限公司	P1022375
6	俱成创投	SNC449	南京俱成股权投资管理有限公司	P1069480
7	混改基金	SB6086	江苏高科技投资集团有限公司	P1000486
8	皓骏创投	STC285	上海善扬股权投资管理有限公司	P1071363
9	江苏装备基金	SAQA19	苏州战新私募基金管理有限公司	P1074995
10	毅达众创	SXC651	南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）	P1032972
11	昆山玉澄	SAKE83	昆山市国科创业投资有限公司	P1066716
12	山高弘金	SK8530	山高致远（天津）私募基金管理有限公司	P1062481

除上述机构股东外，发行人其他机构股东不属于私募投资基金或私募基金管理人，具体情况如下：

苏州厚积和昊日长晶系公司员工间接持有发行人股份的持股平台，除持有发行人股份外，苏州厚积和昊日长晶不进行任何其他投资活动。其投资资金均为自有资金，不存在非公开募集行为及委托管理的情况，也未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为基金管理人管理资产，也未参与募集设立或管理私募投资基金，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需履行私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案程序。

景宁水獭系各合伙人间接持有发行人股份的持股平台，除持有发行人股份外，景宁水獭不进行任何其他投资活动。其投资资金均为自有资金，不存在非公开募集行为及委托管理的情况，也未委托基金管理人管理其资产，亦未受托成为

基金管理人管理资产，也未参与募集设立或管理私募投资基金，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，不需履行私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案程序。

华峰测控系依法设立并存续的上市公司，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，不需履行私募投资基金管理人登记或私募投资基金备案程序。

## 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况

### （一）董事会成员

公司董事由股东会选举产生，任期为3年，任期届满可连选连任。公司本届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。

现任董事基本情况如下：

序号	姓名	在公司担任的董事职务	提名人	本届董事会任职期限
1	殷岚勇	董事长	殷岚勇	2024年12月至2027年12月
2	施元军	董事	殷岚勇	2024年12月至2027年12月
3	何金芳	董事	殷岚勇	2024年12月至2027年12月
4	高嘉阳	董事	毅达贰号、毅达创投、毅达众创	2025年3月至2027年12月
5	赵仁志	董事	景宁水獭	2024年12月至2027年12月
6	欧嘉骏	董事	柘中君信	2024年12月至2027年12月
7	丁仁刚	独立董事	殷岚勇	2024年12月至2027年12月
8	徐健	独立董事	殷岚勇	2024年12月至2027年12月
9	夏克金	独立董事	殷岚勇	2024年12月至2027年12月

上述各位董事简历如下：

#### 1、殷岚勇

殷岚勇先生的简历，详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。

## 2、施元军

施元军，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998 年 7 月至 2003 年 11 月，就职于超威半导体（中国）有限公司，担任高级工艺工程师；2003 年 12 月至 2006 年 5 月，就职于 Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.，担任高级自动化工程师；2006 年 5 月至 2008 年 10 月，就职于飞索半导体（中国）有限公司，担任 SoC 测试经理；2008 年 10 月至 2010 年 10 月，就职于安拓锐高新测试技术（苏州）有限公司，担任探针组装经理；2010 年 10 月至 2014 年 3 月，就职于美博科技（苏州）有限公司，担任研发经理；2014 年 3 月入职公司，现任公司董事、副总经理。

## 3、何金芳

何金芳，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003 年 3 月至 2010 年 5 月，就职于和舰科技（苏州）有限公司，担任资深助理工程师；2010 年 6 月至 2011 年 1 月，就职于英特尔半导体（大连）有限公司，担任高级资深助理工程师；2011 年 4 月至 2014 年 4 月，就职于美博科技（苏州）有限公司，担任销售；2014 年 5 月入职公司，现任公司董事、副总经理。

## 4、高嘉阳

高嘉阳，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 6 月至 2016 年 9 月，就职于苏州元禾控股有限公司，担任项目经理；2016 年 9 月至今，就职于江苏毅达股权投资基金管理有限公司，担任投资总监、合伙人；现任公司董事。

## 5、赵仁志

赵仁志，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年 7 月至 2002 年 3 月，就职于摩托罗拉（中国）电子有限公司，担任软件工程师；2002 年 3 月至 2007 年 4 月，就职于全领信息科技（上海）有限公司，担任运营副总经理；2007 年 4 月至 2016 年 10 月，就职于国际商业机器（中国）有限公司，担任咨询合伙人；2016 年 10 月至 2020 年 5 月，就职于上海赛可电子商务有限公司，担任新车事业部副总经理；2020 年 5 月至 2022 年 6 月，就职于深圳齐心集团股份有限公司，担任副总裁；2022 年 7 月至 2024 年 1 月，

就职于上海九久商务咨询有限公司，担任副总经理；2024年2月至今，就职于浙江金沃精工股份有限公司，担任运营总监；现任公司董事。

## 6、欧嘉骏

欧嘉骏，男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年3月至2018年9月，就职于上海长江国弘投资管理有限公司，担任投资经理；2018年10月至今，就职于君信（上海）股权投资基金管理有限公司，担任投资总监；现任公司董事。

## 7、丁仁刚

丁仁刚，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2004年2月，就职于射阳县黄海电控厂，担任会计；2004年3月至2004年9月，就职于苏州智能开关有限公司，担任会计；2004年10月至2004年11月，就职于和成（中国）有限公司，担任会计；2004年12月至2006年3月，就职于苏州锦海捷亚国际物流有限公司，担任会计；2006年4月至2006年7月，就职于安邦财产保险股份有限公司苏州分公司，担任会计；2006年8月至2007年7月，就职于江苏公证天业会计师事务所有限公司苏州分所，担任审计；2007年8月至2013年6月，就职于苏州工业园区胜浦街道办事处，担任资产管理科会计；2013年6月至2016年10月，就职于苏州工业园区斜塘街道办事处，担任资产管理科会计；2016年11月至2022年3月，就职于苏州常兴会计师事务所（普通合伙），担任项目经理；2022年4月至今，就职于北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所，担任副所长；现任公司独立董事。

## 8、徐健

徐健，男，1973年出生，中国国籍，美国永久居留权，硕士研究生学历。1996年9月至1999年9月，就职于天津市外总集团有限公司，担任业务员；1999年10月至2002年5月，就职于天津天石户外用品股份有限公司，担任经理；2004年10月至2014年9月，就职于中国国际金融股份有限公司，历任经理、高级经理、副总经理、执行总经理、董事总经理；2014年10月至2019年2月，就职于瑞银证券有限责任公司，历任董事总经理、证券部销售主管、证券部主管、战略客户主管；2019年5月至2022年5月，就职于摩根大通证券（中国）有限公

司，担任证券公司副总经理兼证券部主管，董事总经理；现任公司独立董事。

## 9、夏克金

夏克金，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990 年 12 月至 1992 年 3 月，就职于四通集团公司，担任研究开发部项目经理；1992 年 4 月至 2000 年 11 月，就职于北京迪艾电脑有限公司，担任 ATE 部部门经理；2000 年 12 月至 2005 年 3 月，就职于泰瑞达中国子公司，担任技术应用经理；2005 年 4 月至 2006 年 9 月，就职于安捷伦科技（上海）有限公司，担任服务支持经理；2006 年 10 月至 2011 年 7 月，就职于惠瑞捷半导体科技（上海）有限公司，担任技术支持经理、中国区总经理；2011 年 8 月至 2023 年 2 月，就职于爱德万测试（中国）管理有限公司，担任高级总监、副总裁；2023 年 3 月至今，就职于上海华泰软件工程有限公司，担任高级顾问；2023 年 12 月至今，担任北京华峰测控技术股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

### （二）监事会成员

截至本招股说明书签署日，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。取消监事会前，公司监事由股东大会和职工代表大会选举产生，任期为 3 年，任期届满可连选连任。

取消监事会前公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，基本情况如下：

序号	姓名	在公司担任的 监事职务	提名人	本届监事会任职期限
1	杨文君	监事会主席、职工代表监事	职工代表大会	2024 年 12 月至 2025 年 12 月
2	徐亮	监事	殷岚勇	2024 年 12 月至 2025 年 12 月
3	姚瑾怡	监事	殷岚勇	2024 年 12 月至 2025 年 12 月

2025 年 12 月 20 日，发行人股东大会审议取消了监事会，并对《公司章程》及相关制度进行相应修改，由审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。

### （三）高级管理人员

公司高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	在公司担任的职务	任职期间
1	殷岚勇	董事长、总经理、首席运营官	2025年2月至2027年12月
2	施元军	董事、副总经理	2025年2月至2027年12月
3	何金芳	董事、副总经理	2025年2月至2027年12月
4	赵月玲	董事会秘书、财务总监	2025年2月至2027年12月

注：殷岚勇自2025年12月起兼任公司首席运营官。

上述各位高级管理人员简历如下：

### 1、殷岚勇

殷岚勇先生的简历，详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。

### 2、施元军

施元军先生的简历，详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。

### 3、何金芳

何金芳女士的简历，详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。

### 4、赵月玲

赵月玲，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年3月至2012年3月，就职于苏州久腾光电科技有限公司，担任会计；2012年3月入职公司，历任公司会计、法务、人事经理、财务经理等，现任公司董事会秘书、财务负责人。

### （四）核心技术人员

发行人共有核心技术人员4名，具体情况如下：

## 1、核心技术人员名单

序号	姓名	性别	在公司担任职务
1	殷岚勇	男	董事长、总经理、首席运营官、核心技术人员
2	施元军	男	董事、副总经理、核心技术人员
3	吉迎冬	男	苏州韬盛研发总监、核心技术人员
4	王守旭	男	苏州晶晟研发经理、核心技术人员

## 2、核心技术人员简历

(1) 殷岚勇：简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。

(2) 施元军：简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“（一）董事会成员”。

(3) 吉迎冬：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年2月至2006年11月，就职于库力索法半导体（苏州）有限公司，担任高级设计师；2006年12月至2021年11月，就职于安拓锐高新测试技术（苏州）有限公司，历任设计主管、研发经理、质量经理等职务；2021年12月至今，就职于苏州韬盛，担任研发总监。

(4) 王守旭：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013年7月至2023年9月，就职于中国电子科技集团公司第五十五研究所，担任副主管设计师；2023年10月至今就职于苏州晶晟，担任研发经理。

## 3、核心技术人员认定依据

发行人根据其核心技术领域及相关人员在研发及经营过程中所发挥的作用认定公司的核心技术人员，公司核心技术人员认定的原则及依据如下：

(1) 拥有一定的学历和科研背景，拥有深厚且与公司业务匹配的资历背景，对行业理解深刻、独到；

(2) 目前在公司核心技术研发岗位上担任重要职务，或发挥重要作用、拥有突出贡献、具备创新实力等；

(3) 主导公司核心技术研发、公司核心专利申请、重要研发项目,符合公司未来战略发展方向。

姓名	学历与专业资质、获得奖项情况	重要科研成果、对公司研发的具体贡献
殷岚勇	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本科毕业于东南大学电子工程专业</li> <li>● 自 1994 年起从事半导体行业,拥有超 30 年半导体行业研发和管理经验。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司创始人,现任公司董事长、总经理、首席运营官,负责公司芯片测试接口和探针卡核心技术的研发。</li> <li>● 主导了公司多款芯片测试接口的开发;主导了公司 2D MEMS 探针卡、2.5D MEMS 探针卡核心技术的研发。</li> </ul>
施元军	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本科毕业于苏州大学物理系电子工程专业</li> <li>● 自 1998 年起从事半导体行业,拥有近 30 年半导体行业研发和管理经验。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 现任公司董事、副总经理,负责公司探针卡相关核心技术的研发。</li> <li>● 负责并参与了公司芯片测试接口领域包括同轴技术、阻抗匹配技术、高频传输技术等多项核心技术的研发工作。</li> <li>● 主导了公司 2D MEMS 探针卡、2.5D MEMS 探针卡相关核心技术的研发,带领团队攻克了核心部件 MEMS 探针制造工艺技术难题。</li> </ul>
吉迎冬	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 硕士研究生学历,本科毕业于东南大学,硕士毕业于苏州大学。</li> <li>● 自 2005 年起从事半导体行业,拥有约 20 年半导体行业研发经验。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 现任苏州韬盛研发总监,负责公司芯片测试接口相关核心技术的研发,主导了公司应用于包括高密度超大面积高端算力数字芯片、高功耗芯片的芯片测试接口的研发工作,包括芯片测试接口的设计、仿真以及验证。</li> </ul>
王守旭	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 博士研究生学历,博士毕业于南京理工大学化学工程与技术专业;</li> <li>● 自 2013 年起从事半导体行业,拥有超过 10 年半导体行业研发经验;</li> <li>● 发表微纳领域相关的学术论文 11 篇。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 现任苏州晶晟研发经理,完成多个系列 MEMS 探针成套工艺的研发,主导开发了提升公司 MEMS 探针耐流性能的新型工艺,主导开发了 MEMS 探针良率提升技术。</li> </ul>

综上,殷岚勇、施元军、吉迎冬、王守旭符合发行人核心技术人员的认定标准,认证依据充分。

#### (五) 董事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日,公司董事、高级管理人员及核心技术人员在除发行人及其控股子公司以外的其他单位兼职情况如下:

姓名	在发行人所任职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人的关系
殷岚勇	董事长、总经理、首席运营官	苏州厚积	执行事务合伙人	发行人股东
		昊日长晶	执行事务合伙人	发行人股东
高嘉阳	董事	江苏毅达股权投资基金管理有限公司	合伙人	发行人股东毅达贰号、毅达创投、毅达众创私募基金

姓名	在发行人所任职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人的关系
				基金管理人的执行事务合伙人均为西藏爱达汇承私募基金管理有限公司，系江苏毅达股权投资基金管理有限公司 100% 持股的公司
		江苏泰特尔新材料科技股份有限公司	董事	无其他关联关系
		南京贝迪新材料科技（集团）股份有限公司	董事	无其他关联关系
		苏州亚科科技股份有限公司	董事	无其他关联关系
		艺唯科技股份有限公司	董事	无其他关联关系
		昆山科腾生物科技有限公司	董事	无其他关联关系
		江苏邦融微电子有限公司	董事	无其他关联关系
		深圳市壹倍科技有限公司	董事	无其他关联关系
		江苏科瑞恩科技股份有限公司	董事	无其他关联关系
		浙江嘉泰禾清科技有限公司	董事	无其他关联关系
		苏州诺存微电子有限公司	董事	无其他关联关系
		苏州中科瑞龙科技有限公司	董事	无其他关联关系
赵仁志	董事	景宁水獭	执行事务合伙人	发行人股东
		浙江金沃精工股份有限公司	运营总监	无其他关联关系
欧嘉骏	董事	君信（上海）股权投资基金管理有限公司	投资总监	发行人私募基金股东柘中君信的管理人
		武汉优炜芯科技有限公司	董事	无其他关联关系
丁仁刚	独立董事	北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所	副所长	无其他关联关系
		苏州祥亨彩光电有限公司	监事	无其他关联关系
		苏州欧米欧机电有限公司	监事	无其他关联关系
夏克金	独立董事	上海华泰软件工程有限公司	高级顾问	无其他关联关系
		北京华峰测控技术	独立董事	发行人股东

姓名	在发行人所任职务	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人的关系
		股份有限公司		

注：上述“无其他关联关系”指除任职可能导致的关联关系以外，与本公司不存在其他关联关系。

截至本招股说明书签署日，本公司董事、高级管理人员及核心技术人员除上述兼职外，不存在其他兼职情况。

#### （六）董事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。

#### （七）最近三年是否涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员最近三年不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。

### 十三、发行人与董事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况

在公司任职的董事、高级管理人员和其他核心人员均与公司签署了劳动合同，公司高级管理人员、其他核心人员与公司签署了保密协议、竞业限制协议。上述协议履行情况正常，不存在违约情形。

除上述协议外，公司董事、高级管理人员和其他核心人员未与公司签订对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的其他协议。

### 十四、董事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况

公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或间接持有公司股份的情况如下表所示：

序号	姓名	职务或亲属关系	直接持股比例	间接持股比例	通过何公司间接持股	合并持股比例	股份质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况
1	殷岚勇	董事长、总经理、首席运营官	28.40%	6.13%	苏州厚积、昊日长晶	34.53%	无
2	施元军	董事、副总经理	-	0.45%	苏州厚积、昊日长晶	0.45%	无
3	何金芳	董事、副总经理	-	1.19%	苏州厚积	1.19%	无
4	高嘉阳	董事	-	作为毅达资本合伙人经层层穿透后持有公司少量股份，持股比例较低	毅达贰号、毅达创投、毅达众创	作为毅达资本合伙人经层层穿透后持有公司少量股份，持股比例较低	无
5	赵仁志	董事	-	0.19%	景宁水獭	0.19%	无
6	龚平	董事赵仁志的配偶	-	0.60%	景宁水獭	0.60%	无
7	赵月玲	董事会秘书、财务负责人	-	0.80%	苏州厚积、昊日长晶	0.80%	无
8	吉迎冬	研发总监	-	0.30%	苏州厚积	0.30%	无
9	王守旭	研发经理	-	0.02%	昊日长晶	0.02%	无
合计						<b>38.10%</b>	-

## 十五、董事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况

### （一）董事变动情况

最近两年，公司董事变动情况如下：

期间	人数	董事会成员	变动原因
2023年1月至2023年2月	6人	<b>董事：</b> 殷岚勇、施元军、何金芳、姚瑾怡、蔡琳、高嘉阳	-
2023年2月至2023年6月	7人	<b>董事：</b> 殷岚勇、施元军、何金芳、杨红举、蔡琳、高嘉阳、欧嘉骏	公司引入外部机构股东，由柘中君信提名并选举欧嘉骏为公司董事；同时，由殷岚勇提名并选举杨红举为公司董事，姚瑾怡不再担任公司董事
2023年6月至2024年8月	9人	<b>董事：</b> 殷岚勇、施元军、何金芳、杨红举、蔡琳、欧嘉骏 <b>独立董事：</b> 夏克金、徐健、丁仁刚	高嘉阳因个人原因辞去董事职位；同时，公司为进一步完善治理结构，新增选举三名独立董事
2024年8月至2025年3月	9人	<b>董事：</b> 殷岚勇、施元军、何金芳、杨红举、赵仁志、欧嘉骏 <b>独立董事：</b> 夏克金、徐健、丁	蔡琳因个人原因辞去公司董事职位，为保障董事会正常履职，由景宁水獭提名并选举赵仁志

期间	人数	董事会成员	变动原因
		仁刚	为董事
2025年3月至今	9人	<b>董事:</b> 殷岚勇、施元军、何金芳、欧嘉骏、赵仁志、高嘉阳 <b>独立董事:</b> 夏克金、徐健、丁仁刚	杨红举因个人原因辞去公司董事职位; 同时由毅达贰号、毅达创投、毅达众创提名并选举高嘉阳为公司董事

## (二) 监事变动情况

最近两年, 公司监事变动情况如下:

期间	人数	监事会成员	变动原因
2023年1月至2023年2月	3	杨文君、徐亮、杨红举	-
2023年3月-2025年12月	3	杨文君、徐亮、姚瑾怡	经股东会决议, 姚瑾怡担任公司监事, 杨红举不再担任公司监事
2025年12月起	0	-	2025年12月20日, 发行人股东大会审议取消了监事会及监事, 并对《公司章程》及相关制度进行相应修改, 由审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。

## (三) 高级管理人员变动情况

最近两年, 公司高级管理人员变动情况如下:

期间	人数	高级管理人员及任职	变动原因
2023年1月至2023年4月	4	殷岚勇(总经理)、施元军(副总经理)、何金芳(副总经理)、赵月玲(董事会秘书、财务负责人)	公司章程明确: 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员
2023年4月至2025年12月	5	殷岚勇(总经理), 施元军(副总经理)、何金芳(副总经理)、赵月玲(董事会秘书、财务负责人)、高凯(首席运营官)	2023年3月, 公司根据经营管理需要, 任命高凯为首席运营官; 同年4月, 公司章程修订, 明确: 公司总经理、首席运营官、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员
2025年12月至今	4	殷岚勇(总经理、首席运营官), 施元军(副总经理)、何金芳(副总经理)、赵月玲(董事会秘书、财务负责人)	公司根据经营发展需要, 高凯转岗为香港韬盛副总经理, 负责海外市场开拓, 首席运营官由总经理殷岚勇兼任

## (四) 其他核心技术人员变动情况

最近二年, 公司核心技术人员变动情况如下:

期间	人数	核心技术人员	变动原因
2023年1月至2023	3	殷岚勇、吉迎冬、施元军	-

期间	人数	核心技术人员	变动原因
年 10 月			
2023 年 10 月至今	4	殷岚勇、吉迎冬、施元军、王守旭	苏州晶晟聘请王守旭为公司研发经理

#### （五）最近两年公司董事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化

最近两年内，公司董事、高级管理人员的变动主要原因系发行人外部股东提名董事，以及公司不断完善法人治理结构；公司的主要决策层、管理层核心人员殷岚勇未发生变化；核心技术人员除因发展需要新增聘请王守旭外，未发生变化。公司董事、高级管理人员、核心技术人员的变化未影响发行人经营决策的稳健性、核心技术及可持续经营能力；前述人员任职情况的变化符合《公司法》及当时公司章程的相关规定，并已履行了必要的法律程序。

### 十六、董事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及其他核心人员不存在与公司及其业务相关的其他对外投资情况。除持有公司及公司持股平台股权外，本公司董事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况如下：

姓名	职务	投资单位	经营范围	注册资本（万元）	持股比例
高嘉阳	董事	南京毅达汇员汇创业投资合伙企业（有限合伙）	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	2,000.00	2.50%
高嘉阳	董事	南京毅达同盈企业管理咨询中心（有限合伙）	企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	200.00	4.18%
高嘉阳	董事	南京毅达汇员汇澄创业投资合伙企业（有限合伙）	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	850.00	11.76%
赵仁志	董事	景宁水獭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	1,055.2948	2.61%
欧嘉骏	董事	君润硅（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	1,810.00	22.10%

姓名	职务	投资单位	经营范围	注册资本 (万元)	持股 比例
			依法自主开展经营活动)		
欧嘉骏	董事	君景锋（上海） 私募基金合伙企业（有限合伙）	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	2,410.00	6.64%
欧嘉骏	董事	无锡拓海五号股权投资合伙企业（有限合伙）	一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	1,000.00	20.00%
欧嘉骏	董事	上海君信创富企业管理中心（有限合伙）	企业管理，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	181.80	5.95%
夏克金	董事	上海启泰春华管理咨询合伙（有限合伙企业）	一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息技术咨询服务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；财务咨询；认证咨询；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	240.00	12.50%

除上述对外投资外，公司董事、高级管理人员及其他核心人员无其他重大对外投资情况，上述人员的对外投资均未与发行人业务产生利益冲突。

## 十七、董事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况

### （一）薪酬组成、确定依据及履行的程序

公司董事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、津贴及奖金等组成。公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

经公司2022年年度股东大会审议通过，独立董事津贴为7.88万元/年（税前）。

## （二）报告期内薪酬总额占发行人利润总额的比例

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬总额及其占公司利润总额的比例如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
薪酬总额	399.70	724.71	672.23	620.62
利润总额	1,231.47	2,066.69	-355.27	2,254.76
占比	32.46%	35.07%	-	27.53%

## （三）最近一年薪酬具体情况

董事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及其关联企业获得收入情况如下：

姓名	在发行人所任职务	2024年度薪酬（万元）	2024年是否在实际控制人控制的其他企业领薪
殷岚勇	董事长、总经理、首席运营官	112.20	否
施元军	董事、副总经理	70.00	否
何金芳	董事、副总经理	97.69	否
高嘉阳	董事	-	否
赵仁志	董事	-	否
欧嘉骏	董事	-	否
丁仁刚	独立董事	7.88	否
徐健	独立董事	7.88	否
夏克金	独立董事	7.88	否
赵月玲	董事会秘书、财务负责人	76.37	否
吉迎冬	苏州韬盛研发总监、核心技术人员	60.70	否
王守旭	苏州晶晟研发经理、核心技术人员	52.20	否

上述人员中，高嘉阳、赵仁志和欧嘉骏为外部投资机构股东提名的董事，不在公司领取薪酬；丁仁刚、徐健、夏克金仅在公司领取独立董事津贴，不享有其他福利待遇。

除上述情况外，本公司其他董事、高级管理人员及核心技术人员均在公司领薪并享受社会保险、住房公积金等，且最近一年未在公司及其关联企业享受其他

待遇和退休金计划。

## 十八、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排

### （一）发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排汇总

为了体现增强公司凝聚力、维护公司长期稳定发展的导向，建立健全激励约束长效机制，兼顾员工与公司长远利益，为公司持续发展夯实基础。报告期内，公司实施股权激励的情况如下：

序号	激励时间	实施平台	股权激励具体实施情况	授予价格	授予对象	服务期
1	2022年8月	苏州厚积	殷岚勇、高凯出让其所持有的苏州厚积部分财产份额	6.00元/股	3名发行人员工	5年
2	2023年8月	昊日长晶	昊日长晶 10.00元/股认缴韬盛科技增发的 66.00万元注册资本	10.00元/股	39名发行人员工	5年
3	2023年8月	苏州厚积	苏州厚积 10.00元/股认缴韬盛科技增发的 34.00万元注册资本	10.00元/股	16名发行人员工	5年

注：激励时间以股权激励协议签署时间为准。

截至本招股说明书签署日，除上述情况外，发行人无正在执行的其他股权激励或相关制度安排，亦不存在本次公开发行前制定上市后实施的员工期权计划。

### （二）持股平台的基本信息及人员构成

#### 1、苏州厚积

截至本招股说明书签署日，苏州厚积的基本信息如下：

企业名称	苏州厚积企业管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	913205943138749643
成立时间	2014年8月21日
出资额	318.8428万元
执行事务合伙人	殷岚勇
住所	苏州工业园区唯华路3号君地商务广场5幢1807室
经营范围	企业管理服务、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，苏州厚积的出资人构成和出资比例构成如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	殷岚勇	普通合伙人	119.4744	37.4713%

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额(万元)	出资比例
2	何金芳	有限合伙人	26.2347	8.2281%
3	徐亮	有限合伙人	20.2074	6.3377%
4	高凯	有限合伙人	19.3258	6.0612%
5	赵月玲	有限合伙人	17.4401	5.4698%
6	陈莹	有限合伙人	17.0524	5.3482%
7	杨红举	有限合伙人	11.1493	3.4968%
8	施元军	有限合伙人	9.3519	2.9331%
9	杨文君	有限合伙人	8.5871	2.6932%
10	刘凯	有限合伙人	7.5778	2.3767%
11	姚瑾怡	有限合伙人	7.4409	2.3337%
12	吉迎冬	有限合伙人	6.7426	2.1147%
13	高宗英	有限合伙人	6.6111	2.0735%
14	杨宗茂	有限合伙人	5.3257	1.6703%
15	张浩	有限合伙人	3.796	1.1906%
16	黄国峰	有限合伙人	3.5061	1.0996%
17	车红娟	有限合伙人	2.9937	0.9389%
18	李亚鹏	有限合伙人	2.6971	0.8459%
19	陈思翰	有限合伙人	2.4274	0.7613%
20	曹子意	有限合伙人	2.2250	0.6978%
21	张军	有限合伙人	2.0227	0.6344%
22	余艳萍	有限合伙人	2.0227	0.6344%
23	司建新	有限合伙人	2.0227	0.6344%
24	刘家庆	有限合伙人	2.0227	0.6344%
25	陶君虎	有限合伙人	1.8205	0.5710%
26	贾祥杰	有限合伙人	1.6856	0.5287%
27	刘欣	有限合伙人	1.3485	0.4229%
28	郜加杰	有限合伙人	1.3484	0.4229%
29	曹静	有限合伙人	1.0113	0.3172%
30	刘秀容	有限合伙人	0.6743	0.2115%
31	王丽丽	有限合伙人	0.6743	0.2115%
32	石磊	有限合伙人	0.6742	0.2115%
33	王胜	有限合伙人	0.6742	0.2115%
34	刘鹏	有限合伙人	0.6742	0.2115%

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
合计			318.8428	100.0000%

## 2、昊日长晶

企业名称	上海昊日长晶企业管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310115MACKYG8E12
成立时间	2023年5月26日
出资额	66万元人民币
执行事务合伙人	殷岚勇
住所	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号8幢19号楼3层
经营范围	一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本招股说明书签署日，昊日长晶的出资人构成和出资比例构成如下：

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
1	殷岚勇	普通合伙人	24.00	36.3636%
2	万兴权	有限合伙人	5.00	7.5758%
3	刘逢春	有限合伙人	5.00	7.5758%
4	徐波	有限合伙人	3.00	4.5455%
5	张友俊	有限合伙人	2.00	3.0303%
6	张宜山	有限合伙人	2.00	3.0303%
7	黄凯健	有限合伙人	2.00	3.0303%
8	马萌萌	有限合伙人	2.00	3.0303%
9	赵国锋	有限合伙人	1.00	1.5152%
10	梁纯亮	有限合伙人	1.00	1.5152%
11	丁彩云	有限合伙人	1.00	1.5152%
12	高凯	有限合伙人	1.00	1.5152%
13	郑恩典	有限合伙人	1.00	1.5152%
14	李红兵	有限合伙人	1.00	1.5152%
15	张丽	有限合伙人	1.00	1.5152%
16	何武	有限合伙人	1.00	1.5152%
17	符寿康	有限合伙人	1.00	1.5152%
18	于勇	有限合伙人	1.00	1.5152%

序号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
19	孔令涛	有限合伙人	1.00	1.5152%
20	施元军	有限合伙人	1.00	1.5152%
21	王守旭	有限合伙人	0.75	1.1364%
22	陈莹	有限合伙人	0.50	0.7576%
23	李刚	有限合伙人	0.50	0.7576%
24	许成朋	有限合伙人	0.50	0.7576%
25	李亚鹏	有限合伙人	0.50	0.7576%
26	嵇宇	有限合伙人	0.50	0.7576%
27	张涛	有限合伙人	0.50	0.7576%
28	孙委	有限合伙人	0.50	0.7576%
29	赵海宁	有限合伙人	0.50	0.7576%
30	朱佑润	有限合伙人	0.50	0.7576%
31	赵班	有限合伙人	0.50	0.7576%
32	赵月玲	有限合伙人	0.50	0.7576%
33	李文琴	有限合伙人	0.50	0.7576%
34	杨仁祥	有限合伙人	0.50	0.7576%
35	王勇强	有限合伙人	0.50	0.7576%
36	沈婷婷	有限合伙人	0.50	0.7576%
37	吕兰秀	有限合伙人	0.50	0.7576%
38	侯起胜	有限合伙人	0.25	0.3788%
合计			<b>66.00</b>	<b>100.00%</b>

### （三）持股平台人员股份锁定期、离职后的股份处理安排

前述激励计划中激励对象服务期为5年，服务期内无论激励对象担任何种职务或者从事何种工作任务，均应尽最大限度以其技术及能力履行职责，维护或满足公司的利益和需要。激励对象在服务期内离职的，由发行人实控人或其指定第三方原价回购离职股权。

### （四）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响

公司实施股权激励，是为了吸引与保留优秀的技术骨干和经营管理人才，不影响公司控制权的变化。公司股权激励的实施有利于稳定核心人员，进一步增强公司的竞争力，对公司未来的财务状况及经营成果有着积极的影响，有利于促进

公司的持续快速发展。

报告期内，由于实施股权激励，公司于 2022 年、2023 年和 2024 年及 2025 年 1-6 月确认的股份支付金额分别为 233.07 万元、474.15 万元、602.96 万元和 328.64 万元，股份支付金额较大，对净利润影响较大。

除上述情况外，截至本招股说明书签署日，本公司不存在正在执行的对董事、高级管理人员、核心技术人员和其他员工实行的其他股权激励及其他制度安排，亦不存在其他上市后的行权安排。

## 十九、发行人员工情况

### （一）员工人数

报告期内，发行人及其子公司正式员工人数变化情况如下：

项目	2025 年 6 月末	2024 年末	2023 年末	2022 年末
员工人数（人）	455	398	295	237

### （二）员工结构

#### 1、专业结构

截至 2025 年 6 月 30 日，公司员工的专业结构情况如下表所示：

分类	人数（人）	占比
管理人员	31	6.81%
研发人员	70	15.38%
生产人员	325	71.43%
销售人员	29	6.37%
合计	455	100.00%

#### 2、学历结构

截至 2025 年 6 月 30 日，公司员工的受教育程度情况如下表所示：

分类	人数（人）	占比
硕士及以上	21	4.62%
本科	158	34.73%
专科及以下	276	60.66%

分类	人数（人）	占比
合计	455	100.00%

### 3、年龄结构

截至 2025 年 6 月 30 日，公司员工的年龄结构如下表所示：

分类	人数（人）	占比
30 岁及 30 岁以下	146	32.09%
31 岁至 40 岁	227	49.89%
41 岁至 50 岁	75	16.48%
50 岁以上	7	1.54%
合计	455	100.00%

#### （三）员工社保及公积金缴纳情况

项目	缴纳情况	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
社保	已缴纳人数	448	392	292	234
	未缴纳人数	7	6	3	3
	未缴纳原因	当月新入职员工			
公积金	已缴纳人数	432	377	281	224
	未缴纳人数	23	21	14	13
	未缴纳原因	1、当月新入职员工； 2、境外子公司员工无需缴纳公积金			
员工人数		455	398	295	237

#### （四）劳务外包与劳务派遣

报告期内，发行人为提高用工的灵活性并应对生产高峰，存在劳务外包情形，相关劳务外包人员从事整理、包装等可替代性较强的工作，报告期内，公司劳务外包金额分别为 112.00 万元、145.01 万元、304.25 万元和 153.66 万元。报告期内，公司不存在劳务派遣用工。

## 第五节 业务和技术

### 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况

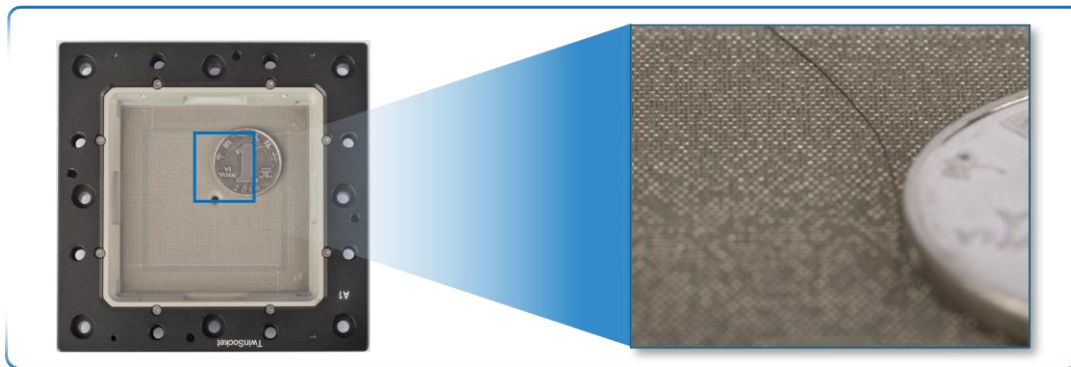
#### （一）公司主营业务基本情况

公司专注于半导体测试接口领域，产品包括芯片测试接口和探针卡等，主要为下游芯片设计、晶圆制造、封装测试等产业链各环节客户提供关键测试硬件方案。公司是境内最早独立研发芯片测试接口并实现规模化量产的企业之一，实现了高端芯片测试接口的国产替代和自主可控。公司坚守自主创新发展路径，为人工智能、自动驾驶、先进存储等多个新兴领域的硬科技客户，提供芯片测试接口全套技术解决方案，产品涵盖以 CPU、GPU、AI 芯片为代表的高端数字芯片和以 2.5D/3D 封装、CoWoS 封装、PoP 封装、Chiplet 封装为代表的先进封装芯片。根据 Yole 披露的公开市场数据，2024 年公司芯片测试接口营收规模位居境内第一，以公司销售收入测算，2024 年公司销售额位居全球芯片测试接口领域第 11 位。

测试环节作为半导体产业链“质量中枢”，贯穿芯片从纳米级微观结构到宏观功能实现的全维度品质把控，是半导体产业链的关键环节之一。芯片测试接口是测试环节“咽喉要道”，在测试环节承担着测试机台和待测芯片之间精密连接、信号传输及数据交互功能，其产品性能直接决定了测试环节的精确性和效率。随着半导体制程迈向 2nm 及以下、高端算力和自动驾驶等新型应用场景爆发，芯片测试接口面临电磁场、力场、热力场等多物理场耦合的复杂挑战，突破芯片测试接口 224Gbps 级信号传输、万针级规模、微纳精密制造等技术瓶颈，已成为推动我国芯片测试行业升级、保障本土半导体产业链自主可控的关键环节。

在芯片测试接口领域，公司凭借早期布局形成显著的先发优势，核心技术能力与方案储备居于领先地位。公司具备高速高频测试探针自主研发和制造能力，已累计形成上百类测试探针技术方案，可精准匹配不同芯片类型的测试需求；同时，报告期内公司累计开发超 4,000 种芯片测试接口技术方案，能够满足从研发到量产阶段针对高低温、耐久、大电流、高功耗等多重场景下严苛的测试要求。公司形成多种高端芯片测试接口精密制造工艺，成功突破芯片测试接口的微纳精密制造瓶颈。

公司形成多种高端芯片测试接口精密制造工艺，成功突破芯片测试接口的微纳精密制造瓶颈



芯片测试接口与发丝、1元硬币比较

公司深耕芯片测试接口领域，可精准匹配人工智能、自动驾驶、手机 SoC、先进存储等多元领域客户的个性化需求，提供覆盖全流程的芯片测试接口定制化解决方案：人工智能领域，公司已深度服务客户 X、客户 Z、沐曦股份、摩尔线程等头部芯片企业，为 AI 芯片从研发到量产的测试环节提供关键支撑，助力我国人工智能产业自主可控；自动驾驶领域，公司覆盖地平线、Momenta 等自动驾驶技术领军者，以及理想汽车、蔚来汽车等知名车企，其中，报告期内公司凭借稳定的技术实力与交付能力，成为地平线芯片测试接口的第一大供应商；手机 SoC 领域，公司持续为客户 X、小米玄戒等企业提供芯片测试接口解决方案，为“中国芯”打破国外垄断提供关键测试硬件；先进存储领域，公司成功为长江存储开发首个能够实现 512 颗存储芯片并行测试的国产 DSA 芯片测试接口，有效助力本土存储产业链加速实现关键环节的国产替代。

依托在芯片测试接口的龙头地位与深厚技术沉淀，公司持续向晶圆测试探针卡领域纵深拓展，业务布局同步覆盖非存储领域及存储领域，构建起多维度、高壁垒的产品矩阵。在人工智能领域，公司 MEMS 探针卡成功切入以客户 Z 为代表的多家境内头部客户供应链体系，实现了商业化落地，为公司探针卡业务在高端晶圆测试赛道打开增长空间。在存储领域，公司构建了清晰明确的 MEMS 探针卡技术迭代路线图，截至本招股说明书签署日，相关产品已在 FLASH 存储晶圆测试场景中完成技术验证并实现了商业应用：2D MEMS 探针卡取得境内领先的存储芯片供应商普冉股份订单，将服务于其 NOR FLASH 产品的晶圆测试环节；2.5D MEMS 探针卡在由中国集成电路检测与测试创新联盟、长江存储联合主办“2024 年度测试联盟·长存擂台赛”中，顺利通过严苛的技术认证并获得合

格供应商资质，并于同年向长江存储出货，应用于其 NAND FLASH 产品的晶圆测试，进一步巩固了公司在高端存储晶圆测试领域的竞争优势。此外，公司开展 3D MEMS 探针卡技术预研，并储备了相关核心技术，未来可覆盖 DRAM、HBM 等存储晶圆测试场景，精准匹配 AI 时代高端存储的技术诉求，有望成为公司下一阶段重要的收入增长引擎。同时，在核心部件方面，公司实现了 MEMS 探针的自主可控，保障供应链与产品性能稳定性；布局了核心部件多层复合陶瓷基板（MLC）相关技术，为国产高端芯片晶圆测试提供关键支撑。

凭借良好的品牌声誉、强大的研发实力、长期的经验积累、领先的产品性能和优质的本地化服务，报告期内公司已服务超 700 家客户，较为全面地覆盖各领域代表性硬科技客户：在 GPU 和 AI 芯片领域，如客户 X、客户 Z、沐曦股份、摩尔线程、壁仞科技、昆仑芯、平头哥、全志科技、瑞芯微、燧原科技、清微智能、此芯科技等；在 CPU 领域，如飞腾公司、海光信息、龙芯中科、奕斯伟计算等；在手机 SoC 芯片领域，如客户 X、小米玄戒等；在自动驾驶领域，如地平线、Momenta、芯擎科技、理想汽车、蔚来汽车等；在存储领域，如长江存储、澜起科技、联芸科技等；在射频通信芯片领域，如翱捷科技、唯捷创芯、卓胜微等；在功率芯片领域，如杰华特、南芯科技、圣邦微、英诺赛科、展芯科技、伏达半导体等；在封测领域，如长电科技、华天科技、京隆科技、利扬芯片、渠梁电子、日月光、盛合晶微、通富微电、伟测科技、矽佳半导体、芯云半导体、甬矽半导体等。

**公司覆盖各领域代表性品牌，全面助力集成电路科技自立自强**

### GPU和AI芯片

 客户X	 客户Z	 沐曦股份	 摩尔线程	 壁仞科技	 昆仑芯
 平头哥	 全志科技	 瑞芯微	 燧原科技	 清微智能	 此芯科技

### CPU

 飞腾公司	 海光信息	 龙芯中科	 奕斯伟计算
---	---	---	--

### 手机SoC芯片

 客户X	 小米玄戒
---	---

### 自动驾驶

 地平线	 Momenta	 芯擎科技	 理想汽车	 蔚来汽车
--	--	---	---	---

### 存储

 长江存储	 澜起科技	 联芸科技	 翱捷科技
--	--	--	--

### 射频

 唯捷创芯	 卓胜微
---	---

### 功率芯片

 杰华特	 南芯科技	 圣邦微	 英诺赛科	 展芯科技	 伏达半导体
--	---	--	---	--	--

### 封测

 长电科技	 华天科技	 京隆科技	 利扬芯片	 渠梁电子	 日月光
 盛合晶微	 通富微电	 伟测科技	 矽佳半导体	 芯云半导体	 甬矽半导体

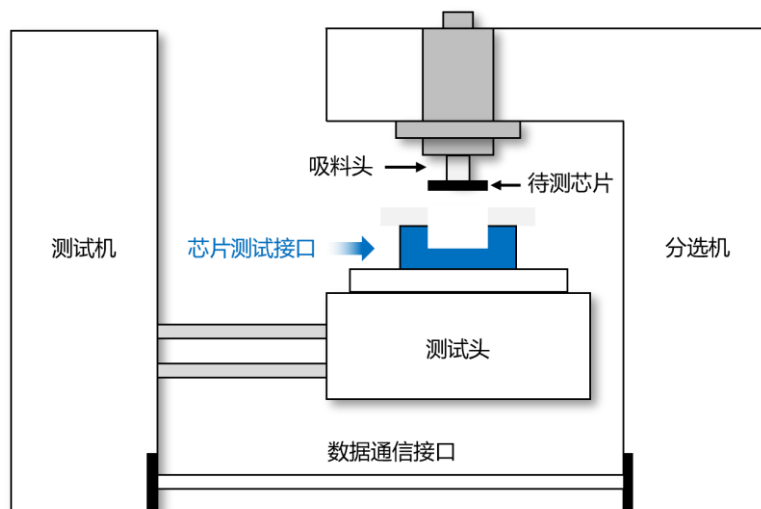
公司积极践行“走出去”，在韩国设立设计和工程研发中心，并在中国香港、美国和新加坡等地区和国家设立销售和服务中心，与国际大厂同台竞技，已进入英伟达（Nvidia）、苹果（Apple）、高通（Qualcomm）、亚马逊（Amazon）、亚德诺（Analog Devices）、意法半导体（ST）、芯源系统（MPS）、安世半导体（Nexperia）、微芯科技（Microchip）等境外知名客户的供应链体系。



## （二）公司主要产品基本情况

### 1、芯片测试接口（Test Socket）

在芯片驱动的数字时代，每一颗即将投入应用的先进芯片均须完成最终的“成人礼”——性能与可靠性测试，作为这场“成人礼”中不可或缺的核心角色，芯片测试接口既是检验复杂制程工序是否达标的最后一道关键关卡，更是补强我国先进制程高端芯片自主可控产业链的重要支撑环节。



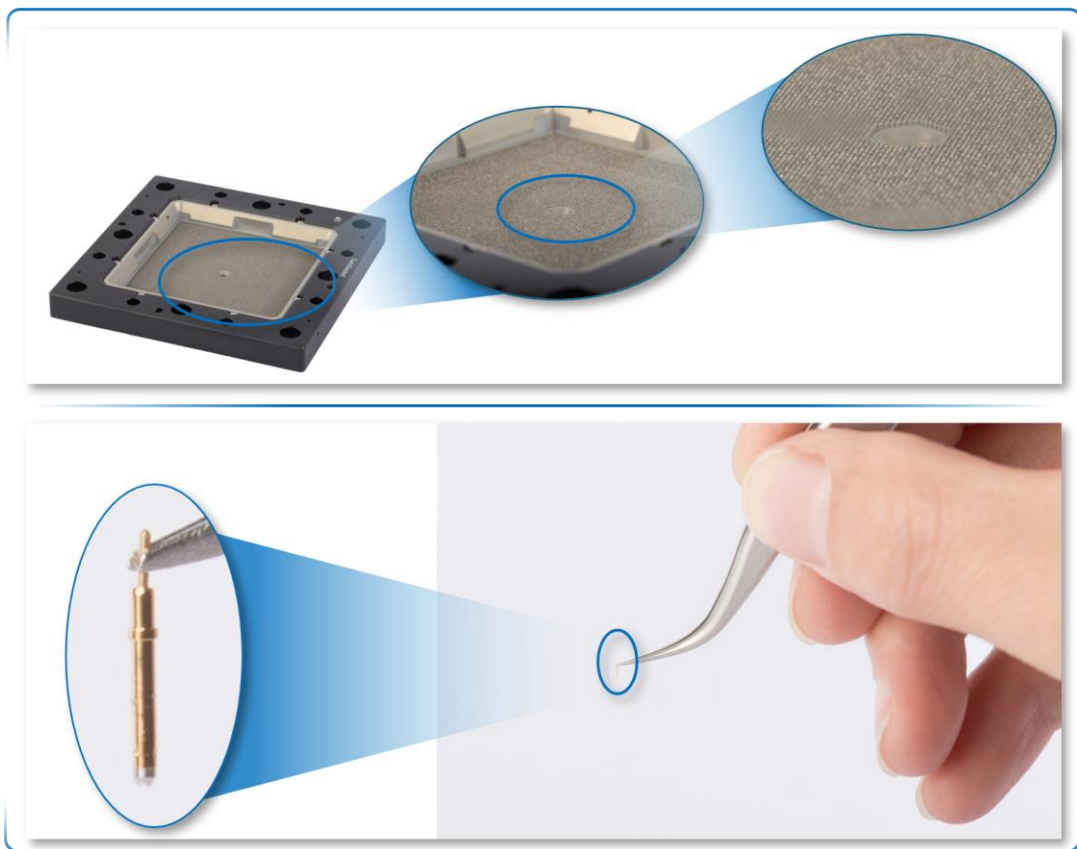
芯片测试接口一端连接精密复杂的待测芯片，一端对接标准化的测试机台，是测试信号在两者间高效穿梭的“数据桥梁”。芯片测试接口必须以极高的信号保真度与运行稳定性，确保关键测试信息在传输过程中精准无误。因此，面对形态各异、设计不同、参数繁杂的各类芯片，能否精准提取测试信号，并实现与测试机台的稳定交互，成为衡量芯片测试接口性能优劣的核心标准。具体而言，芯片测试接口的主要性能体现在以下方面：

首先，芯片测试接口需保证“精准适配”。芯片测试接口具有显著的定制化

属性，每款产品均需根据客户芯片参数、测试方案及下游应用需求，围绕电磁性能、电气性能、散热性能、压力分布、形态材质等核心维度开展针对性设计。作为国内最早投身芯片测试接口研发与生产的企业之一，公司已构建起全面的技术解决方案体系：可提供覆盖高端数字芯片、存储芯片、射频芯片、功率芯片的上百类测试探针和超 4,000 种芯片测试接口方案，并兼容 2.5D/3D 封装、CoWoS 封装、PoP 封装、Chiplet 封装等主流先进封装类型，具备丰富的芯片测试接口全套技术解决方案设计经验与实施能力。

其次，芯片测试接口需实现“精密对位”。随着半导体制程不断突破微观极限，芯片引脚数量呈爆发式增长，这对测试接口提出了更高要求——需同步提升测试探针的装配数量与密度，确保与芯片引脚精准匹配。目前，公司芯片测试接口最高可装配近 30,000 根测试探针，探针间距低至 0.13mm，这一距离仅相当于人类发丝直径，相当于芝麻粒大小的面积内植入超过 30 根测试探针，能够充分满足 CPU、GPU、AI 芯片等先进高引脚密度数字芯片的测试需求。

芯片测试接口探针间距低至0.13mm，仅相当于发丝直径，探针密度与人类头发密度相当



第三，芯片测试接口需确保“传输保真”。在人工智能和先进算力爆发的信

息时代，单颗芯片算力的大幅跃升带来逻辑测试复杂度的显著提升，测试数据吞吐量不断提高，推动测试信号的传输频率迈入 224Gbps 量级，这对芯片测试接口的高频传输性能提出了严苛要求——需在数万个测试探针与芯片触点的精准连接中，实现近乎零失真的高速互联。目前公司已成功研发可稳定支持 224Gbps 高频信号的高保真传输的测试接口，为高端数字芯片测试结果的准确性提供了关键保障。



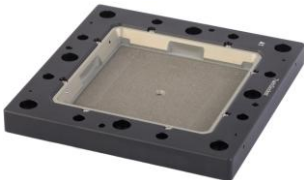

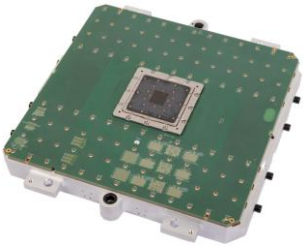
## 2、晶圆测试接口（Probe Card）


晶圆测试接口又称探针卡，是晶圆测试设备与待测晶圆之间的沟通桥梁。公司探针卡产品包括 MEMS 探针卡和非 MEMS 探针卡。公司 MEMS 探针卡是利用光刻、刻蚀、薄膜沉积、CMP 等半导体微纳加工工艺，制造出的高密度、微型化探针阵列和互联结构。公司是国内为数不多的具备 MEMS 探针全流程国产化生产能力的厂商。公司现阶段产品主要包括 2D MEMS 探针卡和 2.5D MEMS 探针卡。公司掌握 MEMS 探针制造、MEMS 探针检测、多层复合陶瓷基板（MLC）制造、探针卡结构等方面的关键技术，能够为客户提供定制化的探针卡解决方案。在非 MEMS 探针卡领域，公司核心产品涵盖 WLCSP 探针卡与垂直探针卡两大品类，其中 WLCSP 探针卡专门适配晶圆级封装的检测环节，垂直探针卡采用冲压工艺制备的垂直探针作为核心工作部件，可满足通用逻辑芯片及中低速测试需求芯片的检测场景。

### 3、测试设备及部件

公司经过多年的技术积累，能够自主研发、制造芯片测试设备，可应用于系统级测试和可靠性测试一体化的并行测试场景。此外，公司自主开发了自动分选机等与测试相关的自动化辅助设备，可适用于多种芯片产品的长时间自动测试场景。

公司主要产品基本情况具体如下表所示。

产品名称	产品图片	产品描述	应用领域	典型客户
芯片测试接口 (Socket)	 功能性芯片测试接口	公司量产的芯片测试接口包括功能性芯片测试接口和可靠性芯片测试接口，其中，功能性测试接口主要用于芯片性能指标的测试，接口设计过程中需解决测试过程中的信号辐射干扰、阻抗失配等难点；可靠性测试接口主要用于可靠性测试，通过将半导体置于高温环境中并施加温度与电压应力，以此检验其质量。公司产品可应用于先进制程高端数字芯片、存储芯片、射频芯片、功率芯片，以及 2.5D/3D 封装、CoWoS 封装、POP 封装、Chiplet 封装等先进封装类型芯片的功能性测试、老化测试等环节。	GPU 和 AI 芯片领域	客户 X、客户 Z、沐曦集成、摩尔线程、壁仞科技、昆仑芯、平头哥、全志科技、瑞芯微、燧原科技、清微智能、此芯科技等
	 可靠性芯片测试接口		CPU 领域	飞腾公司、海光信息、龙芯中科、奕斯伟计算等
			手机 SoC 领域	客户 X、小米玄戒等
			自动驾驶领域	地平线、Momenta、芯擎科技、理想汽车、蔚来汽车等
			先进存储领域	长江存储、澜起科技、联芸科技等
			射频通信芯片领域	翱捷科技、唯捷创芯、卓胜微等
功率芯片领域	杰华特、南芯科技、圣邦微、英诺赛科、展芯科技、伏达半导体等			
晶圆测试接口 (Probe Card)		公司探针卡现阶段主要包括 MEMS 探针卡、垂直探针卡、WLCSP 探针卡。其中，MEMS 探针卡是利用半导体微纳加工工艺制造出的高密度、微型化探针阵列和互联机构，可用于先进制程高端数字芯片、存储芯片、功率芯片等芯片的晶圆测试环节。	高端数字芯片领域、存储芯片领域、功率芯片领域	客户 Z、龙芯中科、长江存储、南芯科技等

产品名称	产品图片	产品描述	应用领域	典型客户
测试设备及部件		公司围绕测试所需的相关设备，自主开发了自动分选机等与测试相关的自动化辅助设备，同时自主开发了可同时应用于系统级测试和可靠性测试一体化并行测试的 XLT 设备，可适用于多种芯片产品的长时间无人化测试场景。	各类型芯片的测试领域	沐曦集成、摩尔线程、圣邦微、复旦微、苹果等

### （三）公司主营收入构成及特征

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
芯片测试接口	16,526.22	86.12%	28,618.57	86.44%	17,391.63	83.38%	13,829.95	83.69%
探针卡	1,575.65	8.21%	3,435.69	10.38%	1,702.05	8.16%	1,095.64	6.63%
测试设备	1,088.10	5.67%	1,053.19	3.18%	1,765.35	8.46%	1,600.01	9.68%
合计	<b>19,189.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>33,107.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,859.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,525.60</b>	<b>100.00%</b>

### （四）公司主要经营模式

#### 1、盈利模式

公司专注于半导体测试接口的研发、设计、制造和销售，主营产品为芯片测试接口和探针卡，通过直接向下游芯片设计企业、封装测试企业等销售测试接口等实现收入。报告期内，公司的主营业务收入为芯片测试接口和探针卡销售以及与半导体测试相关的设备销售等。

#### 2、研发模式

公司构建了规范严谨的研发内控体系，形成了贴合行业特性的研发模式。公司紧密追踪行业前沿趋势，洞察客户个性化需求，以提升产品性能、拓展产品种类为出发点，结合自身发展规划，于技术预研、工艺开发、新产品研发以及产品迭代升级等方面布局研发工作。

公司通过自身前瞻性判断、市场调研及客户需求分析制定研发目标，提前预研下一代甚至未来两代技术，设立研发项目进行技术攻关。各研发项目下，由管

理层及研发总监任命项目负责人，由项目负责人推荐并经审批后组建研发项目团队。研发项目团队编制研发项目立项及可行性分析报告等文件，经研发总监及管理層审批后启动研发项目。

待研发项目完成既定目标后，研发团队编制项目结项报告，由管理层、研发总监、研发项目负责人依据项目计划与实际交付成果，全面审核评估确认研发目标是否实现，审核评估通过后研发项目完成结项。

### 3、销售模式

测试接口具备显著的定制化特性，为契合客户在芯片与晶圆定制化测试方面的技术与工艺要求，公司采用直销模式向客户进行销售。借助直销模式，公司得以与客户构建起高效的沟通机制与全方位的客户关系。双方紧密协作，保障产品精准契合客户的技术需求。此外，该模式还有助于公司强化客户关系管理，精准洞察市场动态，提升快速响应能力，进而及时推进技术改进与研发创新工作。

销售部门牵头制定销售计划、开发新客户与维护现有客户关系、产品定价、签订销售合同、接收订单。经过商务谈判和内部评估等一系列流程后，销售部门取得正式的销售合同或订单。经过商务谈判和内部评估等一系列流程后，销售部门将取得正式的销售合同或订单，并在后续跟进发货、退货、返修事宜。

### 4、采购模式

公司在供应商管理、采购过程控制等方面制定了相关的内控管理制度，建立了规范的采购流程。公司采购部门负责新供应商的开发，直接物料、辅料及消耗品等的采购，以及主导供应商管理及评估等事项。质检部门负责对生产用物料的检验，并参与对供应商质量的评估。仓库部门负责对所购入的各种物料数量的清点、发放及管理。

公司遵循“以销定产，以产定采，适度备货”的策略进行原材料采购，并结合原材料的安全库存、采购周期以及市场变动预期等因素，制定详细的采购计划。公司会先进行市场预测，并结合当前在手订单的情况，经过相关生产部门的审批后，形成物料需求。采购人员接到物料需求后，进行询价、比价和议价等步骤。通过综合评估供应商的价格、质量、交货期等因素后，最终确定最合适的供应商并下达采购订单。采购完成后，原材料需经过质检部门检验合格后统一入库，并

由仓库根据采购订单进行接收。

## 5、生产模式

公司主要产品为半导体测试接口，具体包括芯片测试接口和探针卡，核心工序均由公司自主完成。测试接口具有鲜明的客制化特征，每一款测试接口产品均需要根据客户芯片或晶圆的技术参数和产品特性进行定制化生产。

在产品生产过程中，计划部门负责制定生产计划并进行排产安排。采购部门则根据生产计划，准备所需的原材料。质检部门负责对产品进行全面的质量检测和监控，以确保产品质量符合标准。产品生产完成后，只有经过质检部门检测并确认合格的产品，方可入库。仓库部门随后负责对入库的产成品进行存储和管理，确保产品的安全与有序存放，以便于后续的发货和配送工作。

## 6、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及经营模式、影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司经营模式是经过多年深耕发展而不断积累和完善所形成的，具有较强的行业特征，能够满足公司经营发展的需求，符合公司自身业务特征和行业惯例。影响公司经营模式的关键因素主要包括行业发展趋势、上下游市场供需情况、公司自身产品及技术特征和业务水平等因素。报告期内，公司经营模式未发生重大变化，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，在可预见的未来一定期间内公司经营模式不会发生重大变化。

### （五）公司成立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

#### 1、2007-2011 年，公司注册成立，率先在境内开展芯片测试接口业务

21 世纪初期，中国大陆地区的半导体产业经历了快速发展，诸多境外芯片制造厂商在中国建立了高级别芯片产线，境内芯片制造企业在技术上亦取得显著进展。2006 年，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》及相关配套政策，从科技投入、税收激励、金融支持、知识产权保护等多方面大力鼓励本土半导体产业的发展。

在此宏观背景下，公司核心团队敏锐洞察产业趋势，着眼于芯片测试环节关键硬件耗材，于 2007 年成立了上海韬盛电子科技有限公司（发行人前身），开

展芯片测试接口的研发、生产和销售。2009 年公司首款自主开发的芯片测试接口实现量产出货，是境内较早开展芯片测试接口自主研发和生产制造的企业之一，形成了测试接口技术的原始积累。

## **2、2012-2019 年，不断完善业务版图，积极布局海外市场**

随着全球半导体产业链的转移，中国境内的封装测试行业迎来了快速发展的机遇，对芯片测试接口产品的需求量持续增长。与此同时，中国的封装测试厂商逐步向高端市场迈进，并逐步开展 CPU 等先进数字芯片封装测试，对芯片测试接口的技术要求亦不断提升。在此行业背景下，公司于 2012 年设立子公司苏州韬盛电子科技有限公司，进一步扩大芯片测试接口的经营规模。与此同时，公司持续推进芯片测试接口核心技术的研发，先后攻克了可应用于以 GPU、CPU、AI 芯片为代表的高端数字芯片的技术方案，持续丰富产品类别，进一步巩固在行业中的领先地位。

2014 年，国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，提出“充分利用全球资源，推进产业链各环节开放式创新发展，加强国际交流合作，提升在全球产业竞争格局中的地位 and 影响力”。公司积极响应政策，开始国际化进程，分别在中国香港、美国等地设立分支机构，与国际大厂同台竞技，致力于为全球客户提供高端测试接口综合解决方案。

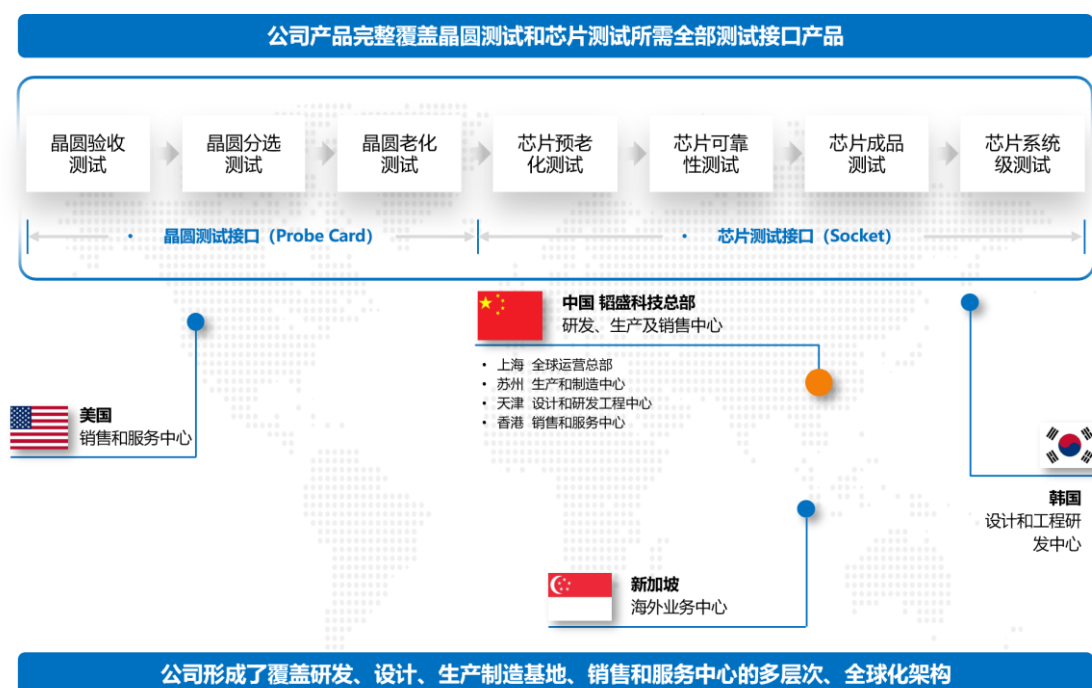
## **3、2020 年至今，公司芯片测试接口行业龙头地位持续巩固，积极开拓第二增长曲线，高端 MEMS 探针卡关键技术实现自主可控**

2020 年前后，境内半导体产业供应链的安全接连受到冲击，全球半导体产业逐步迈向区域化发展新阶段。在此背景下，半导体产业链各环节所依赖的关键技术、核心设备以及重要耗材等，均面临着愈发严峻的“卡脖子”风险，产业自主可控的战略意义愈发凸显。在此背景下，公司不断丰富芯片测试接口产品矩阵，累计形成了上百类测试探针和超 4,000 种芯片测试接口技术方案，并向境内各 CPU、GPU、AI 芯片、自动驾驶芯片等各领域头部客户提供高端芯片测试接口，助力关键测试硬件的国产替代。公司芯片测试接口业务的收入规模快速增长，行业龙头地位不断巩固，根据 Yole 数据，以营业收入规模计，公司位居 2024 年度中国境内芯片测试接口行业第一位，以公司销售收入测算，2024 年公司销售额

位居全球芯片测试接口领域第 11 位。

在芯片测试接口取得领先地位的基础上，公司积极开拓公司第二增长曲线，开拓晶圆测试领域的核心硬件耗材 MEMS 探针卡业务，集中优势资源开展技术攻关。2021 年至 2022 年，公司先后成立苏州晶晟和韩国韬盛，专注研发高端 MEMS 探针卡，致力于打造自主可控的半导体晶圆测试关键耗材供应体系。公司先后布局了 2D MEMS 探针卡、2.5D MEMS 探针卡关键技术，实现了核心部件 MEMS 探针的自主可控，并且顺利通过了下游行业龙头客户严苛的技术验证，实现了销售。公司亦开展 3D MEMS 探针卡关键技术预研，大力推进 MEMS 探针卡主要部件多层复合陶瓷基板（MLC）的自主研发，致力于构建更加完整的产业链生态。

公司持续拓展国际化布局，在中国香港、韩国、新加坡、美国等地设立子公司、研发中心、销售和服务中心、海外业务中心，不断强化其全球竞争力和本地化服务能力，获得了多家境外知名客户的认可，在国际舞台上逐步树立起良好的品牌形象。



## （六）公司主要业务经营情况和核心技术产业化情况

公司是境内最早自主研发生产芯片测试接口的企业之一，自主研发了针对复杂测试场景的超 4,000 种芯片测试接口全套技术解决方案，适用于先进制程和

2.5D/3D、CoWoS、PoP、Chiplet 等多种先进封装类型。在芯片测试接口处于行业领先地位的基础上，公司开辟第二增长曲线，拓展用于晶圆测试的探针卡产品，形成了包括 WLCSP 探针卡、垂直探针卡和 MEMS 探针卡为代表的丰富的探针卡产品矩阵，实现了 MEMS 探针的自主可控，布局了关键部件多层复合陶瓷基板（MLC）的核心技术。

报告期内，公司核心技术应用于芯片测试接口、探针卡等产品，致力于协助芯片设计企业等加速芯片量产进程，服务境内外单体客户数量超 700 家，其中包括 CPU、GPU、AI 芯片、自动驾驶芯片、存储芯片、射频通信芯片、功率芯片等各个细分领域的头部客户，核心技术实现了较好的产业化应用。报告期内，公司的核心技术产品收入占比情况如下所示：

单位：万元

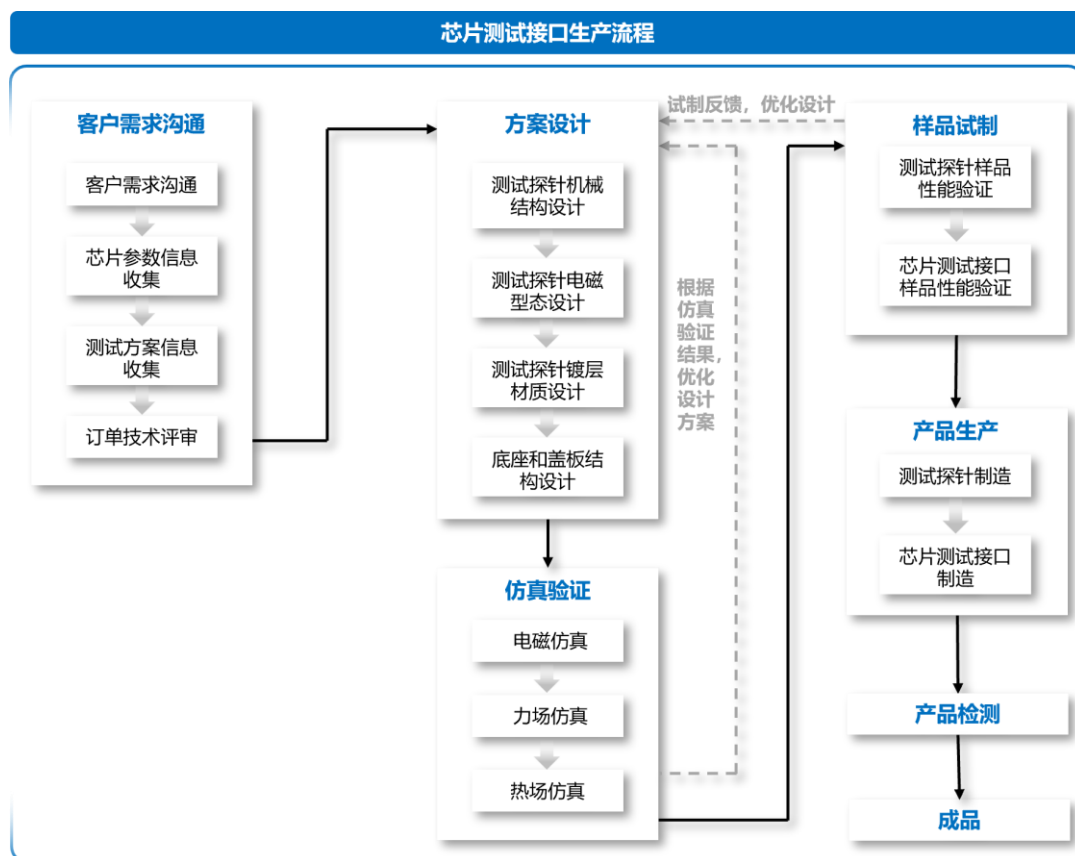
项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
核心技术产品收入	18,101.86	32,054.27	19,093.68	14,925.59
其中：芯片测试接口	16,526.22	28,618.57	17,391.63	13,829.95
探针卡	1,575.65	3,435.69	1,702.05	1,095.64
营业收入	19,189.96	33,107.46	20,859.03	16,525.60
核心技术产品占营业收入的比例	94.33%	96.82%	91.54%	90.32%

报告期内，公司核心技术产品收入对营业收入的贡献占比较高，且核心技术产品收入规模呈现持续增长趋势，实现了较好的产业化应用。公司核心技术的具体情况请参见本招股说明书之“第五节 业务和技术”之“七、发行人的核心技术及研发情况”之“（一）公司主要产品的核心技术情况”。

## （七）公司主要产品或服务的工艺流程图或服务的流程图

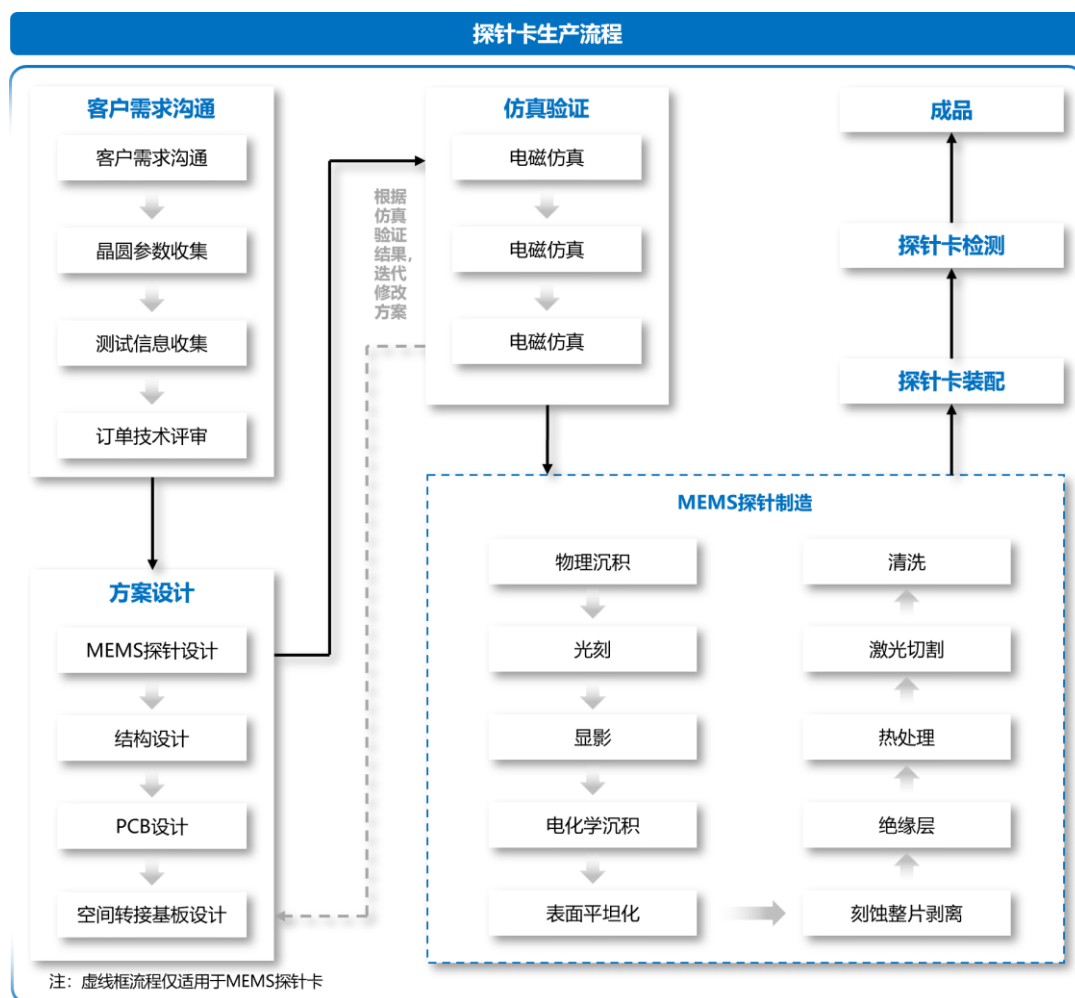
### 1、芯片测试接口工艺流程图

公司芯片测试接口工艺流程主要包括客户需求沟通、方案设计、仿真验证、样品试制、产品生产、产品检测等主要环节，在产品生产环节则主要包括测试探针制造以及芯片测试接口制造等细分环节。公司围绕芯片测试接口搭建了核心技术体系，覆盖了芯片测试接口生产制造的核心环节，具体情况详见本招股说明书本节之“七、发行人的核心技术及研发情况”之“（一）公司主要产品的核心技术情况”之“1、公司核心技术”。



## 2、探针卡工艺流程图

公司探针卡工艺流程主要包括客户需求沟通、方案设计、仿真验证、探针卡装配等主要环节。MEMS 探针卡则进一步包括 MEMS 探针制造环节，主要包括物理沉积、光刻、显影、电化学沉积、表面平坦化、刻蚀整片剥离、绝缘层、热处理、激光切割、清洗等细分步骤。公司围绕探针卡搭建了核心技术体系，覆盖了探针卡生产制造的核心环节，具体情况详见本招股说明书本节之“七、发行人的核心技术及研发情况”之“（一）公司主要产品的核心技术情况”之“1、公司核心技术”。



#### (八) 报告期各期具有代表性的业务指标变动情况及原因

结合所处行业的特点，公司选取主营业务收入和研发费用等具有代表性的业务指标进行分析，具体如下：

单位：万元

项目	选取标准	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
主营业务收入	反映公司业务规模	19,189.96	33,107.46	20,859.03	16,525.60
研发费用	反映研发活动强度	2,707.10	3,933.22	3,071.56	1,533.29

公司经过多年的持续积累，在核心技术、产品质量、本土化服务能力等方面打下了牢固的基础。报告期内，随着公司在核心技术产业化方面不断积累成功案例，公司的品牌口碑持续增强，同时国家对半导体产业关键耗材的重视程度不断提高，公司在良好的市场环境下进入了业务高速增长期，主营业务收入规模不断扩大。为保持行业竞争力，推动技术进步和产品创新，公司在报告期内不断提升研发投入，持续建设高水平的研发团队，加大了对新技术、新产品的研发投入，

研发费用保持增长的趋势。

### （九）主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况

公司主营业务为半导体测试接口的研发、设计、生产和销售，是半导体测试环节的关键硬件。

根据国家发展改革委员会公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，公司主营业务所属领域为“1 新一代信息技术产业”之“1.3 电子核心产业”。根据国家发展改革委员会公布的《产业结构调整指导目录》，公司主营业务所属领域为“鼓励类”产业目录之“信息产业”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类》，公司主营业务属于“1、新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。此外，公司主营业务还属于国家统计局颁布的《新产业新业态新商业模式统计分类》中的“新一代信息技术设备制造”之“新型电子元器件及设备制造”。近年来，国家多个政府部门先后出台政策鼓励、支持公司所处产业的发展，具体情况详见本招股说明书本节之“二、发行人所处行业的基本情况”之“（二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对发行人的主要影响”之“2、所属行业主要法律法规及政策”的相关内容。

因此，公司主营业务属于由国家政府部门对外正式发布的产业规划文件中鼓励和支持的关键产品，公司主营业务及研究方向与国家产业规划的主要任务相匹配，符合国家经济发展战略和产业政策导向。

## 二、发行人所处行业的基本情况

### （一）所属行业及确定所属行业的依据

公司主营业务为半导体测试接口的研发、设计、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司属于“C 制造业”之“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类》，公司主营业务属于“1、新一代信息技术产业”中的“1.2 电子核心产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

公司主要产品与所属行业具体对应关系如下：

公司主要产品	《国民经济行业分类》		《战略性新兴产业分类》	
	代码	分类	代码	行业
芯片测试接口，探针卡	C39	计算机、通信和其他电子设备制造业	1.2.1	新型电子元器件及设备制造

## （二）行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规政策及对发行人的主要影响

### 1、行业主管部门、行业监管体制和行业自律组织

公司所属行业主管部门主要为工信部。工信部主要职责包括提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展等。

中国半导体行业协会是公司所属行业的行业自律组织，其主要职能包括：提供决策支撑服务，根据授权开展行业数据统计分析工作，广泛开展行业交流活动，开展国际交流与合作，为行业企业提供咨询等服务，促进行业质量与标准化工作，组织开展半导体行业技术、业务、管理、法规等培训工作等。

### 2、行业主要法律法规政策

为了鼓励半导体和集成电路产业的发展，规范行业秩序，我国各级政府先后出台了一系列针对半导体和集成电路产业的法律法规和鼓励政策，为半导体产业提供了全方位的政策支持，优化了产业发展环境，提升了创新能力和发展质量，同时，进一步支持自主创新，强化半导体产业链各个关键环节供应链的可靠性。

法律法规及政策	发布单位	发布时间	主要内容
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》	中共中央	2025年10月	完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。
《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》	国务院	2025年8月	以科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等领域为重点，深入实施“人工智能+”行动，涌现一批新基础设施、新技术体系、

法律法规及政策	发布单位	发布时间	主要内容
			新产业生态、新就业岗位等，加快培育发展新质生产力，使全体人民共享人工智能发展成果，更好服务中国式现代化建设。
《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》	中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部	2024年5月	围绕集成电路关键领域，加大先进计算芯片、新型存储芯片关键技术标准攻关。
《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》	工业和信息化部、科技部、国家能源局、国家标准委	2023年8月	研制集成电路材料、专用设备与零部件等标准，制修订设计工具、接口规范、封装测试等标准，研制新型存储、处理器等高端芯片标准，开展人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研究。
《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》	工业和信息化部、财政部	2023年8月	聚焦集成电路、新型显示、服务器、光伏等领域，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，促进产业链上中下游融通创新、贯通发展，全面提升产业链供应链稳定性。
《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》	中共中央、国务院	2022年12月	壮大战略性新兴产业。深入推进国家战略性新兴产业集群发展，建设国家级战略性新兴产业基地。全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。
《“十四五”数字经济发展规划》	国务院	2022年1月	着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	全国人民代表大会	2021年3月	在事关国家安全和全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。
《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023）》	工业和信息化部	2021年1月	优势产品竞争力进一步增强，产业链安全供应水平显著提升，面向智能终端、5G、工业互联网等

法律法规及政策	发布单位	发布时间	主要内容
年）》			重要行业，推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，提升产业链供应链现代化水平。
《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部	2020年9月	加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。稳步推进工业互联网、人工智能、物联网、车联网、大数据、云计算、区块链等技术集成创新和融合应用。
《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	国务院	2020年7月	聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。

### 3、报告期初以来新制定或修订、预计近期出台的相关法律法规、行业政策对公司的具体影响

报告期初以来新制定或修订、预计近期出台的相关法律法规、行业政策对公司经营资质、准入门槛、运营模式等不存在重大不利影响。近年为积极推动半导体和集成电路全产业链的蓬勃发展，我国各级政府颁布了一系列专门针对该产业的法律法规与鼓励政策，为半导体产业构筑了良好的政策支撑体系。这些法律法规及政策，一方面通过优化产业发展环境，为半导体产业链相关企业的茁壮成长创造了有利条件，释放发展活力；另一方面，相关法律法规及政策进一步聚焦自主创新领域，致力于强化半导体产业链各个关键环节的供应链可靠性，有助于加快半导体产业链国产化进程，有效增强自主可控能力，助力我国半导体产业在全球竞争中占据更为有利的位置。公司有望受益于相关政策的鼓励和支持，有望提升相对于国际传统巨头的市场竞争力，进一步实现业务的持续快速发展。

#### （三）所属行业发展情况

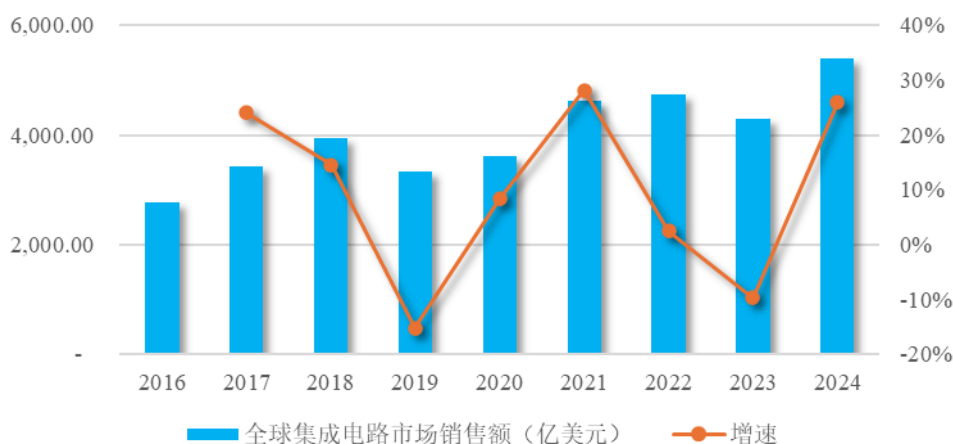
##### 1、半导体产业发展情况

半导体产业作为信息技术产业的核心支柱，是支撑经济社会高质量发展、保障国家安全的战略性、基础性与先导性产业，其重要性贯穿于科技进步与产业升

级的全链条。从市场规模演变来看，据全球半导体贸易统计组织（WSTS）数据显示，全球集成电路市场规模在 2016 至 2023 年期间由 2,767 亿美元提升至 4,284 亿美元，复合增长率为 6.44%。近年来，得益于 5G 通信、移动智能终端、汽车电子等下游应用市场的爆发式需求增长，叠加集成电路产能持续紧张引发的芯片价格结构性上涨，共同推动了市场规模的扩张。

当前，在新兴技术革命的驱动下，全球半导体行业正逐步走出调整期，整体复苏态势日渐清晰。从需求端观察，人工智能、新能源汽车、物联网等前沿领域的快速崛起，为半导体产业注入了强劲的增长新动能。在人工智能领域，AI 大模型的训练与推理过程对算力提出了极致需求，直接拉动了高性能计算芯片（如 GPU、AI 芯片）的市场需求，相关产品出货量与技术迭代速度均显著提升。新能源汽车的加速普及则成为另一重要增长引擎，其电子电气架构的复杂度远高于传统燃油车，车规级 MCU、功率半导体、传感器等芯片的数量与性能要求大幅提升，推动汽车半导体市场成为行业增长的核心贡献板块。2024 年，随着行业景气度的持续回升，全球集成电路市场销售规模将同比增长 25.93%，达到 5,395 亿美元，同时预计市场规模将在 2025 年提升至 6,166 亿美元。长远来看，在人工智能、数据中心、自动驾驶等新兴领域的协同驱动下，全球集成电路市场有望依托技术创新与场景拓展，继续保持较高的增长韧性，为全球科技产业发展提供坚实的硬件支撑。

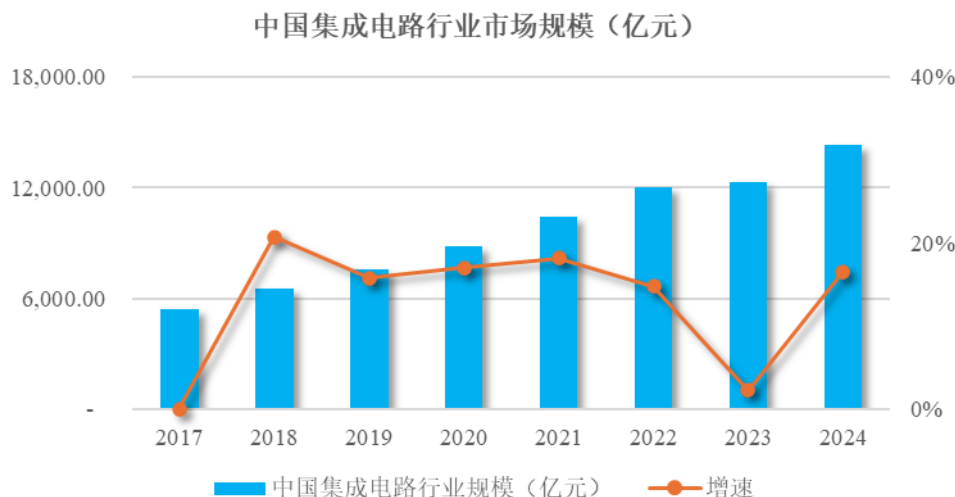
全球集成电路市场规模及预测（亿美元）



数据来源：WSTS

中国作为全球集成电路产业的核心市场，在行业发展中占据着举足轻重的地位。近年来，我国通过持续强化政策扶持、系统推进人才培养、优化产业生态等

一系列举措,全力推动本土集成电路行业的技术突破与产业升级,国产化进程不断加速,产业整体呈现出蓬勃发展的良好态势。从市场规模的成长轨迹来看,据中国半导体行业协会统计数据显示,2023年中国集成电路市场规模达到12,277亿元,2017至2023年复合增长率达到14.63%,展现出强劲的增长韧性,2024年中国集成电路行业市场规模预计将攀升至约14,313亿元,同比增长16.58%,显示出国内市场在技术迭代与需求升级驱动下的广阔增长空间。



数据来源:中国半导体行业协会

从下游应用领域来看,全球存储行业已迈入新一轮高速增长周期,市场规模持续攀升,为上游芯片测试接口和探针卡提供了广阔的发展空间。据行业权威机构 Yole 公开数据显示,受益于全球数据中心人工智能训练需求的爆发式增长,2024年全球存储市场营收创下1,700亿美元的历史新高。其中,DRAM存储贡献营收约970亿美元,在整体市场中占据主导地位;FLASH存储(含NAND FLASH和NOR FLASH)营收达709亿美元,稳居市场第二大细分品类。Yole进一步预测,2025年全球存储市场营收将突破2,000亿美元大关,至2030年有望攀升至3,020亿美元,2024年至2030年期间年复合增长率将超过10%,存储行业增长确定性较强。在DRAM细分领域,HBM作为面向高端AI算力场景的核心产品,市场表现领跑整个DRAM市场。2025年,受行业产能供给约束,叠加AI及高性能计算平台的刚性战略需求的双重支撑,全球HBM市场规模有望实现跨越式增长,并在2024年不足180亿美元的基础上近乎翻倍,达到约340亿美元。长期来看,Yole预计至2030年,全球HBM市场年复合增长率将维持在33%的高位水平,届时其营收占DRAM整体市场的份额有望超过50%,成为

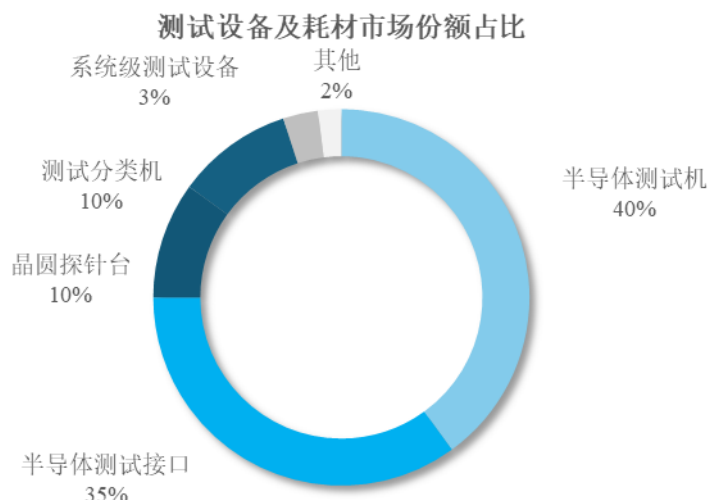
驱动 DRAM 市场增长的核心引擎。与此同时，中国本土存储芯片企业加速崛起，正逐步重塑全球存储市场竞争格局。2024 年，长鑫存储凭借具备成本优势的 DDR3、DDR4 等产品成功打破全球 DRAM 市场原有竞争态势，驱动国际主流供应商加快向 HBM 等高附加值产品转型；同期，长江存储推出第五代 3D NAND FLASH 芯片，彰显了国内企业在 NAND FLASH 领域的技术突破。面对外部出口限制带来的挑战，境内头部存储企业纷纷加大存储领域的研发投入力度，本土存储产业链的自主可控进程正持续提速，进一步拉动境内对于存储领域芯片测试接口和探针卡的需求。

## 2、测试接口行业发展情况

**（1）测试接口作为半导体测试领域的关键硬件，在测试设备及耗材领域其市场规模仅次于半导体测试机，市场份额超过三分之一**

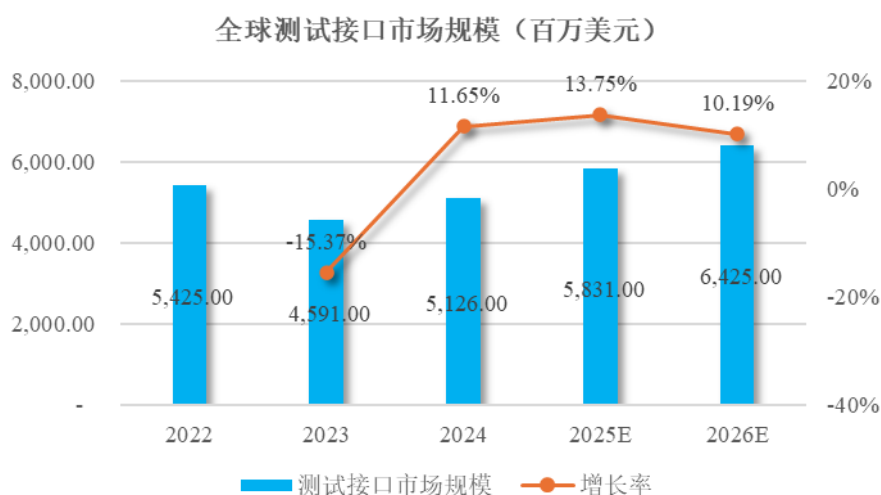
半导体产业的上游涵盖半导体技术服务、相关软件、材料及设备等领域；中游聚焦于半导体的设计与制造环节；下游则延伸至半导体产品及其应用场景。由于该产业发展历程悠久、市场规模庞大、产业链条绵长、生产工序繁杂且专业分工精细，因而催生出众多细分行业。从产业链布局来看，公司所生产的测试接口产品，主要包括探针卡与芯片测试接口，它们主要服务于半导体产业链中游的设计及制造环节，具体应用于晶圆测试和芯片测试流程，是半导体测试领域中不可或缺的关键耗材。随着半导体制造工艺的持续精进，晶圆和芯片的复杂程度日益提升，这也对测试接口的技术水平提出了越来越高的要求。

测试接口为半导体测试环节的关键耗材，并且随着晶圆和芯片测试要求的不断提升，其市场份额亦不断提高。据 Yole 数据，2024 年度全球半导体测试接口市场份额占测试设备及耗材的比例为 35%，其市场份额仅次于半导体测试机，位居第二位。



数据来源：Yole

根据 Yole 数据，2022 年，全球测试接口市场规模约 54.25 亿美元。2023 年，受全球半导体产业周期性波动影响，全球测试接口市场规模下降至 45.91 亿美元。随着半导体产业整体景气度回升，以及以 GPU、CPU、AI 芯片为代表的高端数字芯片和大功率芯片对于测试环节技术要求的提升，2024 年度全球测试接口市场规模同比大幅增加 11.65%，达到了 51.26 亿美元。据 Yole 预测，未来两年受到下游人工智能、新能源汽车等新兴需求的持续驱动，全球测试接口市场规模将维持高速增长，2025 年有望同比增长 13.75%，达到 58.31 亿美元，并且预计 2026 年全球测试接口市场规模有望突破 60 亿美元。



数据来源：Yole

## （2）测试接口行业由境外厂商主导，国产替代刻不容缓

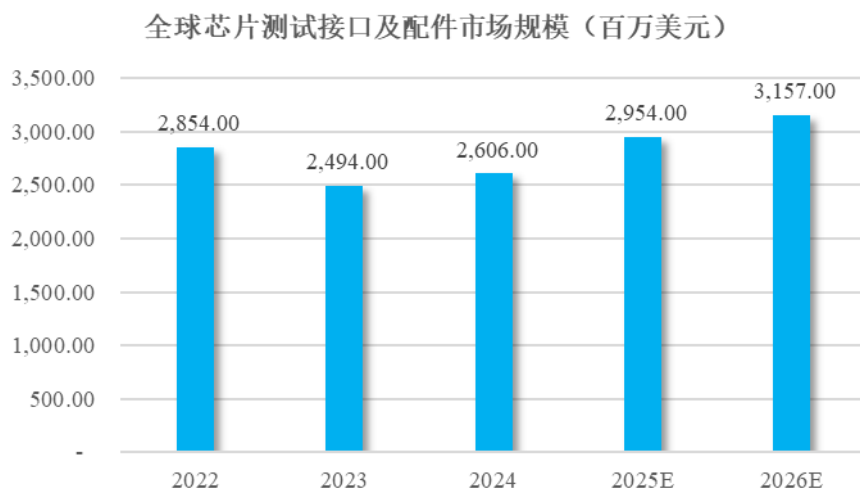
测试接口行业长期由境外厂商主导。以芯片测试接口为例，据 Yole 数据，2024 年度全球芯片测试接口领域前五大厂商分别为日本的 Yamaichi、中国台湾地区的颖崴科技、韩国的 Leeno、美国的 Cohu 和日本的 Enplas。

排名	名称	市场份额	国家/地区
1	Yamaichi	10%	日本
2	颖崴科技	9%	中国台湾
3	Leeno	7%	韩国
4	Cohu	7%	美国
5	Enplas	5%	日本

我国半导体产业起步相对较晚，在芯片设计、晶圆制造及测试等核心环节中，对关键设备、耗材等仍存在不同程度的进口依赖，其中国产测试接口行业的发展尤为滞后，与国际先进水平存在一定差距。近年来，随着本土在 CPU、GPU、AI 等高端数字芯片领域的技术不断突破，海外对华半导体技术的制裁力度也随之加剧，导致我国半导体产业链的安全性与可靠性持续受到国际政治环境的冲击和制约。作为高端数字芯片测试环节不可或缺的关键部件，测试接口的国产化替代不仅是突破技术封锁的必然选择，更蕴含着广阔的市场空间，其自主化进程对于保障产业链供应链安全具有重要意义。

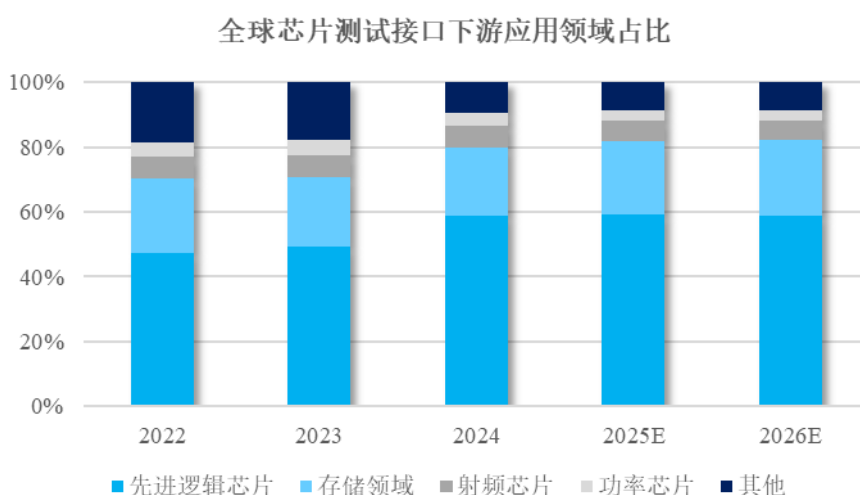
### 3、芯片测试接口行业结构及发展情况

据 Yole 数据显示，2024 年全球芯片测试接口及配件市场规模约为 26.06 亿美元。当前，下游人工智能领域的爆发式发展持续催生对高端数字芯片及存储芯片的旺盛需求，这种需求传导效应正进一步推动上游芯片测试接口环节的市场规模加速扩张。展望未来，行业增长动能依然强劲。Yole 预测，2025 年全球芯片测试接口及配件市场规模有望实现 13.35% 的同比增长，达到 29.54 亿美元，显示出该细分领域在半导体产业链中的重要增长潜力。



数据来源：Yole

从应用领域来看，芯片测试接口可应用于以 CPU、GPU、AI 芯片为代表的先进逻辑芯片、存储芯片、射频芯片、功率芯片等多个下游领域。就整体趋势而言，2023 年各应用领域芯片测试接口的市场规模受到半导体行业周期的影响，呈现一定下滑，但 2024 年均呈现出显著的增长。各细分市场中，以 CPU、GPU、AI 等为代表的先进逻辑芯片是芯片测试接口最大的细分应用领域，据 Yole 数据，2023 年先进逻辑芯片领域占芯片测试接口全部市场规模的份额为 49.30%，2024 年市场份额提升至 58.83%，预计 2025 年将进一步提升至 59.17%。

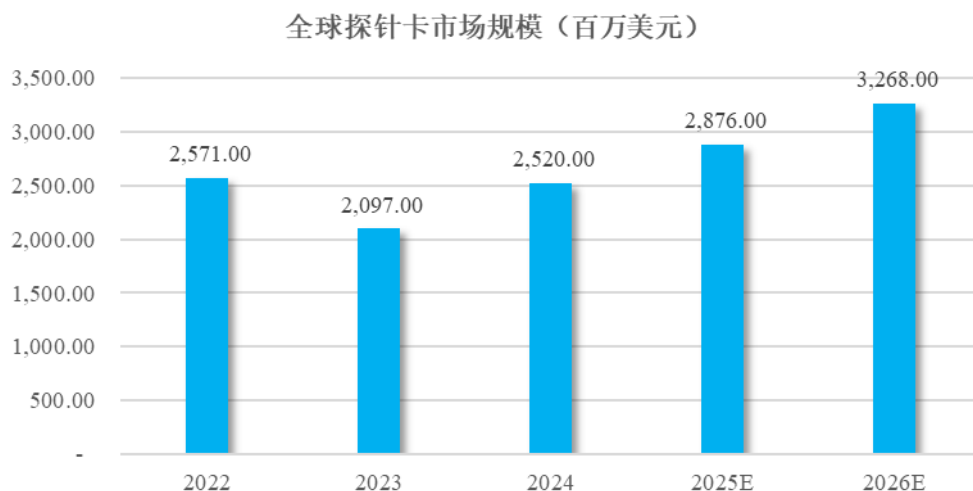


数据来源：Yole

#### 4、探针卡行业结构及发展情况

全球探针卡市场已步入快速增长的全新阶段。据 Yole 数据显示，2024 年全球探针卡市场规模约 25.20 亿美元，受到 AI、新能源汽车以及通信等新兴领域需

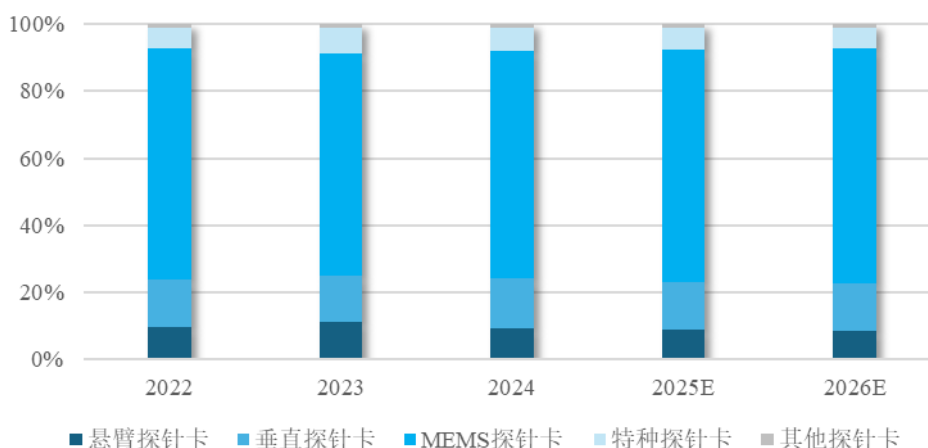
求驱动，2025 年全球探针卡市场规模有望同比增长 14.13%，达到 28.76 亿美元，全球市场规模正逐步逼近 30 亿美元的重要里程碑。该行业市场规模从 10 亿美元到 20 亿美元，行业用了 15 年时间完成跨越；而从 20 亿美元到 30 亿美元，这一进程仅耗时 5 年。照此增长态势，Yole 预计到 2030 年全球探针卡市场规模将突破 40 亿美元关口。



数据来源：Yole

从产品结构维度分析，探针卡可细分为 MEMS 探针卡、垂直探针卡、悬臂探针卡、特种探针卡等核心品类。其中，MEMS 探针卡以精密度高、测试效率高、耐用性强、稳定性好的显著优势，占据当前行业主导地位，不仅广泛覆盖高端芯片的晶圆测试场景，更能精准适配市场上最先进制程芯片的晶圆测试需求，成为支撑前沿芯片制造工艺验证的关键测试组件。近年来，MEMS 探针卡占据了全球探针卡的主要市场份额。2023 年度，全球 MEMS 探针卡市场规模约 13.90 亿美元，市场份额为 66.29%；2024 年全球 MEMS 探针卡呈现强劲复苏态势，同比大幅增长 23.09%，全球市场规模达到了 17.11 亿美元，市场份额进一步提升至 67.90%。随着下游人工智能领域的快速发展，GPU、CPU、AI 等先进逻辑芯片销量提升以及新封装技术的加速推出，带来了更为复杂的探针测试要求和更长的测试时间，进而带动全球 MEMS 探针卡的销量。预计 2025 年全球 MEMS 探针卡市场规模将达到 19.94 亿美元，市场份额将接近探针卡市场的 70%。

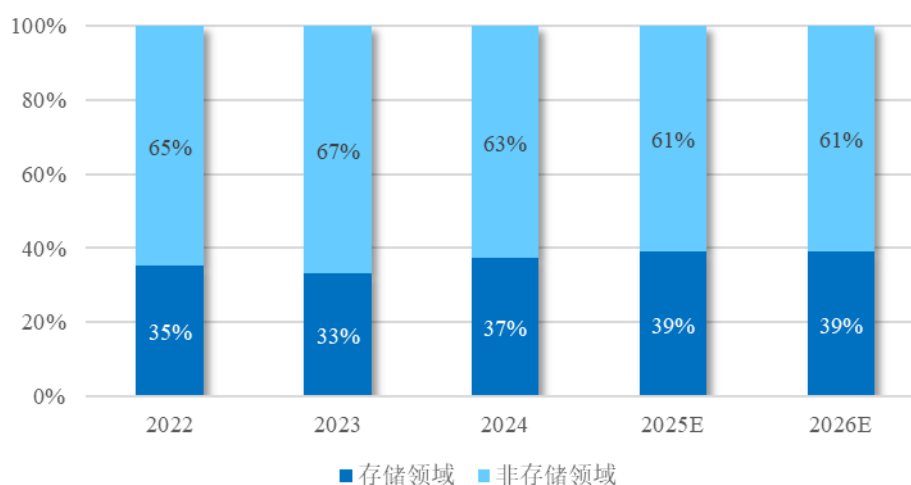
全球探针卡不同产品占比



数据来源：Yole

从应用领域分析，2024 年度全球探针卡市场中，非存储领域全球市场规模约 15.77 亿美元，市场占比约为 63%，主要包括 SoC、CPU、GPU、电源管理芯片等细分应用领域；存储领域全球市场规模约 9.43 亿美元，市场占比约为 37%。随着全球存储行业迈入新一轮高速增长周期，2025 年全球存储领域探针卡市场规模有望达到 11.27 亿美元，增速接近 20%，并且全球市场占比有望进一步提升至 39%。

全球探针卡应用领域占比



#### (四) 进入本行业主要壁垒

##### 1、技术壁垒

半导体测试接口作为芯片或晶圆与测试机台数据交互的核心枢纽，其技术复

杂度远超传统电气机械连接器的范畴。在先进封装与异构集成等前沿技术不断推陈出新、GPU 和 AI 芯片千瓦级算力密度稳步提升的技术变革中，高端芯片和晶圆的测试环节面临电磁、电气、机械、热力学等多物理场融合带来的复杂难题，对于芯片测试接口的技术要求亦涉及多个跨学科领域。因此，开发一套完整的测试接口技术解决方案，需要将电磁兼容性、高频信号完整性、机械力学以及热力学等多学科交叉技术进行深度融合，才能应对多物理场耦合的复杂技术挑战。此外，随着芯片制程工艺的不断演进和人工智能、第三代半导体、车规级测试等新型场景的爆发，测试接口向着微纳精密制造、万针级探针数量以及 224Gbps 信号频率等方向进化。这些性能需求和技术趋势要求测试接口生产企业掌握核心技术，具备综合性的产品设计和研究开发能力，对新进入者而言具有较高的技术壁垒。

## 2、客户准入壁垒

测试接口作为半导体测试环节的核心硬件，承担着高精度信号传输、电力供应、机械支撑和数据交互等核心功能，其接触稳定性、信号完整性等技术指标直接影响下游客户产品测试数据的真实性和性能评估的准确性。其性能上的微小偏差将直接带来良率误判、故障漏检等风险。下游客户为保证自身产品质量的稳定性，会综合考量供应商的技术创新能力、产品性能、交货能力等因素。因此，客户更愿意选择行业内技术能力强、业务开展时间久、产品经验丰富、品牌与声誉较好的供应商建立稳定、持续的合作。因此，新进入者与客户快速建立合作的门槛较高，具有较高的客户准入壁垒。

## 3、资金壁垒

测试接口对产品性能和加工工艺要求较高，并且具有鲜明的客制化特征。行业内企业一方面需要建设形成多品种、规模化的制造能力，以满足客户在产品性能、生产效率、交货速度等方面的需求，另一方面，还需要在生产加工及检测设备投入、规模化生产及工艺流程把控等方面进行大量的资金投入。同时，作为技术密集型行业，且处于快速发展的半导体产业链，企业必须持续引入高端技术人才，并且持续投入资金开展高强度的研发活动，不断进行技术攻关、产品创新以适应市场的发展。因此，行业存在较高的资金壁垒。

## （五）行业发展态势

### 1、芯片性能升级，驱动测试接口向着更高信号频率、更大探针密度、更小探针间距的方向发展

先进制程技术的突破将继续推动芯片性能的提升。目前，全球领先的半导体制造企业已经在 2 纳米以下制程技术上取得了显著进展。光模块封装对测试工序也提出了更高要求，行业对高速、大功耗、超大规模芯片组的测试要求呈指数级提升。未来，随着更小制程技术芯片和更大规模芯片组的逐步量产，芯片的性能和能效比将进一步提高，为人工智能、自动驾驶、先进存储等领域的发展提供更强大的支持。随着芯片性能的提升，以 CPU、GPU 和 AI 芯片为代表的高端数字芯片数据传输速度提升，推动测试信号向着更高的频段发展，对测试接口的高频信号传输能力提出了严苛的技术要求。

此外，半导体工艺跟随摩尔定律向微观极限迈进，先进封装和异构集成技术的突破性进展使得芯片集成度进一步提升，芯片引脚间距持续缩小，芯片的引脚数量迅速攀升。与此相呼应，用于芯片测试的测试接口所需装配的探针数量和密度大幅上升。半导体行业技术水平的升级促使测试接口需持续提升探针密度和一致性、缩小探针间距，促使产品的制造精度进一步提高。

### 2、新型应用场景推动测试接口向高电压、大电流、高可靠性方向发展

在第三代半导体领域，以碳化硅为代表的新型大功率芯片具有高击穿电场、高电子迁移率等特性，以及智能驾驶对 ADAS 芯片和智能座舱芯片需求的提升，下游客户对芯片测试接口的可靠性提出了更为严苛的要求。由于第三代半导体芯片工作时面临高电压和大电流等极端环境，测试接口同样需要具备优异的电气性能稳定性，以确保测试数据的精准可靠。随着新能源汽车市场的蓬勃发展，近年来车规级芯片和自动驾驶芯片的需求量迎来爆发式增长，车规级测试的应用场景同样对测试接口的可靠性发起挑战。车规级芯片均需经历严格的环境模拟测试，如高温、低温、高湿度等极端条件。在这样的应用场景下，测试接口须能够在复杂多变的环境中维持稳定的连接和信号传输，保障测试过程的顺利进行以及测试结果的高度可信。第三代半导体芯片测试和车规级测试等新型应用场景推动测试接口向高电压、大电流和高可靠性方向发展。

## （六）行业面临的机遇和风险

### 1、所属行业面临的主要机遇

#### （1）国家政策长期支持行业发展

公司所处行业为半导体产业的细分环节之一。我国政府积极发布产业政策，为半导体产业的长期可持续发展创造了良好的政策环境。2014年，国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，强调需求牵引、创新驱动、软硬结合、重点突破的原则，努力实现集成电路产业跨越式发展的目标。2020年，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，再次强调集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。此外，国家各级政府部门近年来陆续颁布《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》等政策。这些产业政策的出台为公司所处的半导体产业的发展创造了长期、稳定、良好的环境。

#### （2）自主可控需求推动行业进口替代

芯片测试接口是用于测试环节的核心硬件，是测试行业的“咽喉要道”之一，其产品性能和可靠性直接决定了测试环节的精准性与效率。随着半导体制程的迭代升级，芯片测试复杂度激增，突破高密度、高频率、高耐温等复杂测试环境下测试接口的技术瓶颈，已成为推动测试行业升级、保障本土半导体产业链自主可控的关键突破口之一。

近年来，地缘政治加剧国际贸易摩擦，不断冲击我国半导体产业的供应链安全，对于我国相关领域核心硬件耗材的自主、安全、可控提出了迫切需求，提高国产化率以避免关键时刻受制于人已成为我国半导体产业链各环节企业的共识。自主可控需求推动了国产替代浪潮，也为本土技术领先的高端测试接口企业提供了良好的发展机遇。

### 2、所属行业面临的主要风险

#### （1）境外厂商凭借先发优势占据领先地位

在芯片测试接口行业，境外厂商起步较早，形成了较完整的产品线、较成熟

的技术解决方案，凭借长期的经验积累和丰富的成功案例，产品得到境内外下游用户的广泛认可。相较之下，境内厂商起步较晚，整体规模与境外竞争对手相比偏小，在与境外厂商竞争以及替代国际厂商产品的过程中，境内厂商需不断提升技术实力、产品性能与服务水平，持续加深对下游细分应用场景的需求理解，并通过产品在不同行业与使用场景中的成功验证积累案例、经验与口碑，才能突破国际厂商的先发优势壁垒。因此，境外厂商凭借先发优势占据着领先地位，以及境内厂商与境外厂商的差距，是行业面临的挑战之一。

## （2）行业升级迭代对高端人才和资金投入提出挑战

公司所处行业属于技术密集型和资金密集型行业，具备较高的技术门槛和资金门槛，参与企业需具备良好的基础研究和资金实力。在半导体制造工艺持续朝着微缩化方向发展、先进封装与异构集成等前沿技术不断推陈出新、千瓦级算力密度稳步提升的大背景下，开发一套完整的测试接口技术解决方案，需要将电磁兼容性、高频信号完整性、机械力学以及热力学等多学科交叉技术进行深度融合，以形成适配半导体产业快速升级迭代的研发能力和技术体系，对于从业人员有着较高的要求。同时，高端测试接口固定资产投资较大，需要企业在产能建设、技术研发、运营控制等层面保持稳定且持续的资金投入，以紧跟半导体产业升级迭代与变革创新的需要。因此，半导体产业技术的快速发展使得行业面临人才和资金的挑战。

## （七）行业周期性特征

公司主营产品为芯片测试接口，与半导体产业的需求和供给具有较强的相关性。从半导体产业的产业发展规律来看，受到全球宏观经济波动、下游应用领域景气度等因素影响，半导体行业存在一定的周期性。

## （八）公司所属行业在产业链中的地位和作用

半导体产业链主要包括芯片设计、晶圆制造、封装和测试等主要环节。测试环节作为半导体产业链“质量中枢”，贯穿芯片从纳米级微观结构到宏观功能实现的全维度品质把控，是半导体产业链的关键环节之一，亦是推动我国半导体产业从规模扩张向质量跃升转型的核心动能，对推动半导体产业生态“强链补链”与可持续发展有着不可替代的战略意义。

公司主营产品测试接口是用于半导体测试环节的核心硬件，是测试行业的“咽喉要道”之一，其产品性能与可靠性直接决定了测试环节的精准性与效率。测试接口承担着高精度信号传输、电力供应、机械支撑和数据交互等核心功能，其接触稳定性、信号完整性和电源完整性等技术指标直接影响测试数据的真实性和性能评估的准确性，在半导体产业链中发挥着不可或缺的重要作用。

### （九）公司所属行业与上、下游行业之间的关联性

公司所处行业上游包括测试接口的研发、生产制造所需的原材料、设备，其中公司采购的原材料主要包括芯片测试接口和探针卡所需的 PCB、工程塑料、金属材料等，上游原材料的供需情况、生产能力以及价格波动等对本行业采购端有一定影响。公司与上游行业各类原材料厂商有着较为长期的合作历史，供应链体系较为稳定。

公司所处行业下游为半导体测试环节，主要面向下游芯片设计企业、晶圆制造企业、封装测试企业、IDM 企业和实验室及科研机构。下游半导体测试行业的需求扩张以及工艺升级都将促使测试接口行业的技术升级与规模提升。近年来，中国境内集成电路产业发展迅速，高端数字芯片与存储芯片市场需求不断增加，推动测试需求增加，对于测试接口的市场需求也在提升。

## 三、发行人所处行业的竞争情况

### （一）所属细分行业竞争格局

芯片测试接口行业，尤其是高端芯片测试接口，设计和制造工艺复杂、门槛较高，现阶段市场份额主要被境外厂商长期占据。据 Yole 数据，2024 年度全球芯片测试接口行业，Yamaichi 位居第一，颖葳科技位居第二，Leeno、Cohu 和 Enplas 分别位列第三至第五。近年来，境内集成电路产业虽然实现了快速发展，技术水平和产业规模均有显著提升。芯片测试接口作为半导体产业关键硬件之一，在境内半导体产业蓬勃发展的促进下，亦有较为显著的发展。境内芯片测试接口行业其他主要厂商包括凯智通、捷策创、法特迪等，科创板上市公司和林微纳近年来亦布局芯片测试接口相关业务。相比于境外厂商，境内企业整体规模较小。据 Yole 数据，2024 年度，以营业收入口径计算，公司位居中国境内芯片测试接口行业第一名。全球探针卡市场仍主要由境外企业主导，近年来，随着境内

半导体产业的发展，本土探针卡厂商亦加速成长，主要厂商包括强一股份、道格特等企业。

## （二）行业内主要企业

据 Yole 数据，2024 年度以营业收入口径计算，全球前五大芯片测试接口厂商依次为 Yamaichi、颖崴科技、Leeno、Cohu 和 Enplas，上述境外厂商普遍成立时间较早，进入芯片测试接口行业时间较久，经营规模较大，面向全球经营，其基本情况如下表所示。

公司名称	2024 年度全球排名	国家或地区	基本情况
Yamaichi (6941.T)	1	日本	Yamaichi (Yamaichi Electronics Co., Ltd.) 成立于 1956 年 11 月 1 日，总部位于日本，主营产品包括芯片测试接口、连接器和光学产品。
颖崴科技 (6515.TW)	2	中国台湾	颖崴科技（颖崴科技股份有限公司）成立于 2001 年，公司总部位于中国台湾地区，为 IC 芯片测试接口主要供应商之一，在全球各地都设有销售据点，跨足半导体光通讯、资讯科技和光电技术等领域。
Leeno (058470.KS)	3	韩国	Leeno (Leeno Industrial Co.,Ltd) 成立于 1978 年，总部位于韩国，专业从事半导体测试设备的生产，是该领域内的主要企业。核心产品为半导体测试探针和芯片测试接口。
Cohu (COHU.O)	4	美国	Cohu (Cohu, Inc.) 成立于 1947 年，是一家全球技术领军企业，为半导体行业提供测试、自动化、检测与计量产品和服务。Cohu 丰富且独具特色的产品组合有助于优化良率和生产效率，从而加快客户产品的制造上市速度。
Enplas (6961.T)	5	日本	Enplas (Enplas Corporation) 成立于 1962 年，主要业务板块包括节能解决方案业务、半导体事业部、网络解决方案、显示解决方案以及生命科学业务，其中半导体事业部中包括芯片测试接口产品线。

资料来源：Yole，各企业官网等公开信息。

近年来，随着境内半导体产业升级，以公司为代表的境内芯片测试接口厂商快速发展，据 Yole 数据，2024 年度以营业收入口径计算，公司位居中国境内芯片测试接口行业第一位。除公司以外，境内其他主要的芯片测试接口厂商概况如下：

公司名称	成立时间	注册资本	基本情况
和林微纳 (688661.SH)	2012 年	11,683.6789 万元	和林微纳（苏州和林微纳科技股份有限公司）成立于 2012 年，和林微纳从事微型精密制造，主要产品包括测试探针、芯片测试

公司名称	成立时间	注册资本	基本情况
			接口及精密结构件等。
凯智通	2005 年	5,000 万元	凯智通（深圳凯智通微电子有限公司）成立于 2005 年，专业研制、开发、生产类芯片测试 Socket 及各类 IC 测试治具。
捷策创	2011 年	2,106.4683 万元	捷策创（上海捷策创电子科技有限公司）成立于 2011 年，主要从事集成电路测试完整技术研究、测试软硬件及设备开发、生产、应用，以及实验室验证分析等业务。
法特迪	2014 年	3,900 万元	法特迪（苏州法特迪科技股份有限公司）成立于 2014 年，从事设计、开发、制造和组装半导体测试接口产品，主要产品包括芯片测试接口和测试设备等。

资料来源：公开信息，各企业官网等。

### （三）发行人产品或服务的市场地位

公司是境内最早独立研发芯片测试接口并实现规模化量产的企业之一，实现了高端芯片测试接口的国产替代和自主可控。公司坚守自主创新发展路径，为人工智能、自动驾驶、先进存储等多个新兴领域的硬科技客户，提供芯片测试接口全套技术解决方案，产品涵盖以 CPU、GPU、AI 芯片为代表的高端数字芯片和以 2.5D/3D 封装、CoWoS 封装、PoP 封装、Chiplet 封装为代表的先进封装芯片。根据 Yole 披露的公开市场数据，2024 年公司芯片测试接口营收规模位居境内第一，以公司销售收入测算，2024 年公司销售额位居全球芯片测试接口领域第 11 位。

凭借良好的品牌声誉、强大的研发实力、长期的经验积累、领先的产品性能和优质的本地化服务，报告期内公司已服务超 700 家客户，较为全面地覆盖各领域代表性硬科技客户：在 GPU 和 AI 芯片领域，如客户 X、客户 Z、沐曦股份、摩尔线程、壁仞科技、昆仑芯、平头哥、全志科技、瑞芯微、燧原科技、清微智能、此芯科技等；在 CPU 领域，如飞腾公司、海光信息、龙芯中科、奕斯伟计算等；在手机 SoC 芯片领域，如客户 X、小米玄戒等；在自动驾驶领域，如地平线、Momenta、芯擎科技、理想汽车、蔚来汽车等；在存储领域，如长江存储、澜起科技、联芸科技等；在射频通信芯片领域，如翱捷科技、唯捷创芯、卓胜微等；在功率芯片领域，如杰华特、南芯科技、圣邦微、英诺赛科、展芯科技、伏达半导体等；在封测领域，如长电科技、华天科技、京隆科技、利扬芯片、渠梁电子、日月光、盛合晶微、通富微电、伟测科技、矽佳半导体、芯云半导体、甬

矽半导体等。

公司积极践行“走出去”，在韩国设立设计和工程研发中心，并在中国香港、美国和新加坡等地区和国家设立销售和服务中心，与国际大厂同台竞技，已进入英伟达（Nvidia）、苹果（Apple）、高通（Qualcomm）、亚马逊（Amazon）、亚德诺（Analog Devices）、意法半导体（ST）、芯源系统（MPS）、安世半导体（Nexperia）、微芯科技（Microchip）等境外知名客户的供应链体系。

#### （四）竞争优势与劣势

##### 1、公司竞争优势

###### （1）人才优势

半导体测试接口技术复杂度远超传统机械连接器范畴，企业需具备跨领域的综合技术能力与解决方案提供能力。此外，测试接口面临电磁、电气、机械、热力学等多物理场耦合的复杂挑战，技术能力需覆盖多个跨学科领域。因此，测试接口对于人才要求较高。

公司拥有一支多年从事半导体产业的优秀管理及研发团队，具备一流的战略运筹、市场开拓、技术研发和运营管理团队。公司核心团队人员的平均从业经验超过 20 年，拥有国际知名半导体企业的从业经历，对于芯片特性、测试机台和测试接口有着较为深刻的理解。公司充分重视人才培养和技术团队梯次化配置，具有完备的团队人才管理体系，在公司设立之初即开展人才培养储备工作，持续提升公司的技术人才储备纵深。

###### （2）长期经验积累和技术优势

测试接口具备鲜明的客制化特性，每一款产品都须依据客户的晶圆或芯片的技术参数、下游应用领域的要求以及测试方案的需求，进行客制化开发。公司自 2007 年成立以来，经过近二十年的发展，始终专注于测试接口产品的创新和开发，目前在芯片测试接口领域已积累上百类测试探针设计方案、超 4,000 种芯片测试接口技术方案，龙头地位显著；在探针卡领域实现了 MEMS 探针卡核心技术自主可控，并已实现了产品销售。依托多年的技术和经验积累，公司可一站式满足客户对于测试接口的定制化需求，实现了先进制程、高端数字芯片等下游领域所需的关键高端测试硬件的国产替代。

### （3）前后道测试接口全覆盖和完善的产品矩阵优势

公司是境内较早自主研发生产半导体测试接口产品的企业之一，同时覆盖了前道晶圆测试和后道芯片成品测试所需的芯片测试接口产品和探针卡产品。在晶圆测试环节，公司产品包括 WLCSP 探针卡、垂直探针卡、MEMS 探针卡，并且实现了高端探针卡核心部件 MEMS 探针从设计到生产全流程的自主可控。在芯片成品测试环节，公司量产的芯片测试接口技术水平稳居全球前列，可用于 CPU、GPU、AI 芯片等高端数字芯片、存储芯片、射频通信芯片、功率芯片的测试环节。测试硬件产品的全覆盖为公司提供了独特的技术创新优势和经验复用优势，有助于公司积累丰富的行业经验和数据，为公司的产品优化、技术升级以及新市场开拓提供了有力支持，进一步巩固了公司的竞争优势。

### （4）客户认可优势

公司持续服务中国本土半导体产业链硬科技客户，公司产品可应用于下游包括 CPU、GPU 和 AI 芯片在内的人工智能、自动驾驶、先进存储等多个领域，并且较为全面地覆盖了各领域代表性硬科技客户，助力本土半导体产业链实现关键测试硬件的自主可控。

报告期内公司已服务超 700 家客户，较为全面地覆盖各领域代表性硬科技客户：在 GPU 和 AI 芯片领域，如客户 X、客户 Z、沐曦股份、摩尔线程、壁仞科技、昆仑芯、平头哥、全志科技、瑞芯微、燧原科技、清微智能、此芯科技等；在 CPU 领域，如飞腾公司、海光信息、龙芯中科、奕斯伟计算等；在手机 SoC 芯片领域，如客户 X、小米玄戒等；在自动驾驶领域，如地平线、Momenta、芯擎科技、理想汽车、蔚来汽车等；在存储领域，如长江存储、澜起科技、联芸科技等；在射频通信芯片领域，如翱捷科技、唯捷创芯、卓胜微等；在功率芯片领域，如杰华特、南芯科技、圣邦微、英诺赛科、展芯科技、伏达半导体等；在封测领域，如长电科技、华天科技、京隆科技、利扬芯片、渠梁电子、日月光、盛合晶微、通富微电、伟测科技、矽佳半导体、芯云半导体、甬矽半导体等。

公司积极践行“走出去”，在韩国设立设计和工程研发中心，并在中国香港、美国和新加坡等地区和国家设立销售和服务中心，与国际大厂同台竞技，已进入英伟达（Nvidia）、苹果（Apple）、高通（Qualcomm）、亚马逊（Amazon）、

亚德诺（Analog Devices）、意法半导体（ST）、芯源系统（MPS）、安世半导体（Nexperia）、微芯科技（Microchip）等境外知名客户的供应链体系。

## 2、公司竞争劣势

### （1）融资渠道较为单一

当前阶段公司处于快速发展期，为保持竞争力，公司需要持续加大对技术研发的投入，提升本地化服务能力，引进高端优质人才，扩大生产规模。此外，虽然报告期内公司业务保持较快的增长趋势，但整体收入规模与境外已上市企业相比仍有一定差距。因此，为实现公司业务与技术快速发展，扩大生产经营规模，公司存在较大的融资需求。但目前，公司的融资渠道较为单一，为满足市场需求以及自身规模发展需要，公司需拓展融资渠道，提升融资效率。

### （2）品牌国际影响力与境外龙头相比仍有差距

在测试接口行业，芯片测试接口领域的 Yamaichi、颖崴科技、Leeno、Cohu 和 Enplas 等境外知名厂商成立时间较早，具有先发优势，并且经过长期的生产经营已经建立起丰富的业务布局和较高的品牌知名度。公司自设立以来专注测试接口的产品研发，但相比前述大型境外企业悠久的历史，公司在品牌国际影响力、客户群体的多样性等方面与境外知名企业相比存在一定差距。

### （五）发行人与同行业可比公司的比较情况

#### 1、公司与同行业公司的比较情况

##### （1）市场地位与经营情况的比较情况

据 Yole 数据，2024 年度公司位居中国境内芯片测试接口行业第一位，系境内芯片测试接口市场地位领先的国产厂商，在业务开展过程中公司与境外的全球领先芯片测试接口厂商直接竞争。

根据可获取的最新数据，公司与境内外同领域主要公司的经营情况对比如下表所示。

公司名称	财年截止日	营业收入 (亿元)	净利润 (亿元)	总资产 (亿元)	净资产 (亿元)
Yamaichi (6941.T)	2025 年 3 月 31 日	17.18	1.00	24.08	18.04

公司名称	财年截止日	营业收入 (亿元)	净利润 (亿元)	总资产 (亿元)	净资产 (亿元)
颖崴科技 (6515.TW)	2024年12月31日	12.94	2.64	16.90	12.35
Leeno (058470.KS)	2024年12月31日	13.74	5.59	32.46	30.75
Cohu (COHU.O)	2024年12月28日	28.89	-5.02	71.85	61.60
Enplas (6961.T)	2024年3月31日	17.83	1.62	28.31	24.84
和林微纳 (688661.SH)	2024年12月31日	5.69	-0.09	14.08	12.09
凯智通	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露
捷策创	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露
法特迪	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露
发行人	2024年12月31日	3.31	0.12	5.38	2.62

资料来源：上市公司数据来自 Wind。

## （2）技术实力和衡量核心竞争力的关键业务数据、指标的比较情况

据 Yole 数据，2024 年度以营业收入口径计算，全球前五大芯片测试接口厂商依次为 Yamaichi、颖崴科技、Leeno、Cohu 和 Enplas。公司选取包括最小探针间距、最大传输带宽、极限工作温度以及最大承载电流等代表性技术指标，与 2024 年度 Yole 披露的全球该领域前五大厂商 Yamaichi、颖崴科技、Leeno、Cohu、Enplas 以及本土代表性厂商和林微纳、凯智通、捷策创、法特迪进行对比。下表所示为各公司官方网站披露的产品技术指标。

技术指标	最小探针间距	最大传输带宽	最低工作温度	最高工作温度	最大承载电流
<b>指标说明</b>	探针间距，又称 Pitch 间距或 Pitch，最小探针间距指芯片测试接口中，相邻两根测试探针所能实现的最小中心距，探针间距越小意味着待测芯片越先进，芯片测试接口技术难度越高	最大传输带宽指芯片测试接口可实现的最高带宽，其数值越大意味着芯片越先进，对于芯片测试接口的信号传输性能要求越高，一般以在-1dB 衰减下所事项的最大带宽表示	最低工作温度指芯片测试接口可稳定工作的最低温度，其数值越低，意味着芯片测试接口的耐低温性能越好	最高工作温度指芯片测试接口可稳定工作的最高温度，其数值越高，意味着芯片测试接口的耐高温性能越好	最大承载电流指芯片测试接口工作过程中可以传输的最大电流数值，其数值越大意味着芯片测试接口耐大电流性能越好
<b>Yamaichi (6941.T)</b>	0.30mm	未披露	-55℃	170℃	未披露
<b>颖崴科技 (6515.TW)</b>	0.30mm	-1dB@83GHz	-60℃	200℃	6.0A
<b>Leeno (058470.KS)</b>	0.092mm	最高达 100GHz	未披露	未披露	未披露
<b>Cohu (COHU.O)</b>	0.10mm	-1dB@100GHz	-60℃	175℃	4.1A
<b>Enplas (6961.T)</b>	0.25mm	未披露	未披露	未披露	未披露

技术指标	最小探针间距	最大传输带宽	最低工作温度	最高工作温度	最大承载电流
和林微纳 (688661.SH)	0.30mm	-1dB@80GHz	-55℃	150℃	6.0A
凯智通	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露
捷策创	0.30mm	>40GHz 高频性能	未披露	未披露	3.0A
法特迪	0.30mm	-1dB@50GHz	-55℃	150℃	12.0A
韬盛科技	0.13mm	-1dB@84GHz	-60℃	175℃	6.0A

资料来源：同行业公司产品数据取自其官方网站公开披露的信息<sup>2</sup>。

最小探针间距方面，公司可实现的最小探针间距为 0.13mm，相关性能高于境外厂商 Yamaichi、颖威科技、Enplas 和其他主要境内企业，并接近于境外厂商 Leeno 和 Cohu 可实现的 0.092mm 至 0.10mm。探针间距越小，意味着芯片测试接口可测试的芯片引脚间距越小且越密，有助于公司更好地服务人工智能等下游新兴领域芯片的测试需求。

最大传输带宽方面，Leeno 和捷策创公开披露的信息中，未指明其所实现最大带宽时的信号衰减前提，故无法与公司及其他境内外厂商进行直观对比。公司可实现的最大带宽为-1dB@84GHz，相关性能仅低于 Cohu 的-1dB@100GHz，优于境外头部厂商颖威科技以及和林微纳、法特迪等境内厂商。最大传输带宽越高，意味着芯片测试接口可更好地满足人工智能等高端数字芯片的测试需求，有助于公司更好地开拓高端数字芯片领域客户。

最低工作温度方面，公司可实现的最低工作温度为-60℃。与境外厂商颖威科技、Cohu 持平；境外厂商 Yamaichi 以及境内厂商和林微纳和法特迪均为-55℃，均低于公司；Leeno、Enplas、凯智通以及捷策创未披露该参数。最高工作温度方面，公司可实现的最高工作温度为 175℃。境外厂商颖威科技为 200℃，为上述披露该参数的厂商中，唯一一家高于公司的企业；境外厂商 Yamaichi、Cohu 均为 175℃，与公司持平；境内厂商和林微纳、法特迪均为 150℃，均低于公司；Leeno、Enplas、凯智通以及捷策创未披露该参数。

最大承载电流方面，发行人为 6.0A。以和林微纳、Cohu 等为代表的境外头部厂商以及和林微纳、捷策创等境内厂商，其公开披露的参数普遍在 3.0A 至 6.0A 区间，低于公司或与公司持平。

<sup>2</sup> 同行业公司产品参数官方网站信息查询日为 2025 年 12 月 12 日

因此，公司芯片测试接口多项技术指标均领先于或持平于海外龙头厂商，整体技术水平处于全球行业第一梯队。

## 2、可比公司的选取依据及相关业务可比程度

公司主要产品为芯片测试接口，目前 A 股上市公司不存在与公司在产品结构、产品种类等方面完全可比的公司。考虑到细分行业代表性，同时考虑经营信息以及财务数据的可获取性以及业务的可比性，公司选取主要产品及主营业务主要聚焦在芯片测试接口、具有一定行业代表性，并且经营信息以及财务数据可获取的上市企业作为可比公司，选取标准具有客观性。

根据上述标准，公司选取了颖崴科技（6515.TW）、Leeno（058470.KS），以及中国境内布局芯片测试接口业务的上市公司和林微纳（688661.SH）作为可比公司。

### （六）上述情况在报告期内的变化及未来可预见的变化趋势

上述情况在报告期内未发生重大不利变化，未来亦无可预见的会对公司产生重大不利影响的变化趋势。

## 四、销售情况和主要客户

### （一）报告期内主要产品的产销情况

#### 1、主要产品的产能、产量、销量、产能利用率情况

报告期内，公司主要产品芯片测试接口的产能、产量、产能利用率及销量和产销率情况如下表所示：

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
产能（万孔）	1,967.30	2,927.37	1,583.66	932.14
产量（万孔）	1,858.39	2,878.76	1,537.46	1,029.18
产能利用率	94.46%	98.34%	97.08%	110.41%
销量（万孔）	1,777.12	2,844.94	1,497.67	1,025.69
产销率	95.63%	98.83%	97.41%	99.66%

注：公司芯片测试接口产品呈现多品种、定制化的特点，不同客户芯片所使用的芯片测试接口所需的孔数差异较大，因此公司以每个期间生产、销售的芯片测试接口的总孔数为单位统计产能、产量和销量。

报告期内，公司产能利用率分别为 110.41%、97.08%、98.34% 和 94.46%，

公司的产销率分别为 99.66%、97.41%、98.83% 以及 95.63%。报告期内，受到下游客户需求拉动，公司持续扩产，在产能不断提高的同时，产能利用率和产销率均维持在较高的水平。

## 2、营业收入构成情况及主要产品销售单价变动分析

报告期内，公司营业收入的构成情况及主要产品销售单价的变动分析详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“六 经营成果分析”之“（一）营业收入分析”。

### （二）报告期内前五大客户情况

报告期内，公司各期对前五大客户的销售金额和占当期营业收入的比例如下表所示：

2025 年 1-6 月				
序号	客户名称	主要销售内容	销售金额（万元）	占比
1	客户 X	芯片测试接口	2,450.62	12.77%
2	日月光	芯片测试接口	2,119.42	11.04%
3	芯云半导体	芯片测试接口	2,070.51	10.79%
4	地平线	芯片测试接口	1,983.34	10.34%
5	矽佳半导体	芯片测试接口	721.31	3.76%
合计			<b>9,345.20</b>	<b>48.70%</b>
2024 年度				
序号	集团客户名称	主要销售内容	销售金额（万元）	占比
1	客户 X	芯片测试接口	6,821.30	20.60%
2	日月光	芯片测试接口	3,358.00	10.14%
3	芯云半导体	芯片测试接口	2,980.80	9.00%
4	客户 Z	芯片测试接口，探针卡	1,361.95	4.11%
5	华天科技	芯片测试接口，探针卡	987.39	2.98%
合计			<b>15,509.43</b>	<b>46.85%</b>
2023 年度				
序号	集团客户名称	主要销售内容	销售金额（万元）	占比
1	客户 X	芯片测试接口	4,244.93	20.35%
2	日月光	芯片测试接口	1,225.61	5.88%
3	长江存储	芯片测试接口，探针卡	954.45	4.58%

4	燧原科技	芯片测试接口, 测试设备	634.61	3.04%
5	安路科技	芯片测试接口, 测试设备	616.66	2.96%
合计			<b>7,676.26</b>	<b>36.80%</b>
<b>2022 年度</b>				
序号	集团客户名称	主要销售内容	销售金额（万元）	占比
1	渠梁电子	芯片测试接口	2,907.01	17.59%
2	日月光	芯片测试接口	711.51	4.31%
3	通富微电	芯片测试接口	482.80	2.92%
4	地平线	芯片测试接口, 测试设备	437.66	2.65%
5	苏试试验	芯片测试接口	418.40	2.53%
合计			<b>4,957.38</b>	<b>30.00%</b>

注：受同一实际控制人控制的客户合并计算销售金额，其中包括：

- （1）客户 X 合并口径包括客户 X1、客户 X2 等；
- （2）日月光合并口径包括环旭电子股份有限公司、上海月芯半导体科技有限责任公司等；
- （3）芯云半导体合并口径包括芯云半导体（诸暨）有限公司、杭州芯云半导体集团有限公司等；
- （4）地平线合并口径包括地平线征程（上海）科技有限公司、北京地平线信息技术有限公司等；
- （5）矽佳半导体合并口径包括矽佳半导体（嘉兴）有限公司、矽佳半导体科技（江苏）股份有限公司等；
- （6）客户 Z 合并口径包括客户 Z1、客户 Z2 等；
- （7）华天科技合并口径包括宇芯（成都）集成电路封装测试有限公司、华天科技（昆山）电子有限公司等；
- （8）燧原科技合并口径包括北京燧原智能科技有限公司、上海燧原科技股份有限公司等；
- （9）安路科技合并口径包括上海安路信息科技股份有限公司、成都维德青云电子有限公司等；
- （10）渠梁电子合并口径包括渠梁电子有限公司、深圳忆联信息系统有限公司等；
- （11）通富微电合并口径包括通富微电子股份有限公司、南通通富微电子有限公司等；
- （12）苏试试验合并口径包括苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司、苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司等。

报告期内，公司向前五大客户销售金额占各期营业收入的比例分别为 30.00%、36.80%、46.85% 和 48.70%，公司主要客户包括境内知名的芯片设计或封装测试厂商，公司与主要客户均保持了良好的合作关系。报告期内，公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司前五大客户不存在关联关系。

## 五、采购情况和主要供应商

### （一）报告期内主要采购情况

#### 1、主要原材料采购情况

报告期内，公司主要原材料采购情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
金属结构部件	4,642.20	46.78%	6,748.90	38.42%	3,586.74	35.59%	3,235.83	36.76%
探针	2,564.28	25.84%	5,676.05	32.32%	3,327.14	33.01%	3,067.46	34.84%
非金属结构部件	1,253.29	12.63%	1,715.80	9.77%	1,037.58	10.29%	723.24	8.22%
电气部件	466.63	4.70%	1,159.60	6.60%	571.10	5.67%	460.24	5.23%
设备部件	113.40	1.14%	867.69	4.94%	848.63	8.42%	983.86	11.18%
加工耗材及治具	513.00	5.17%	578.28	3.29%	357.22	3.54%	265.88	3.02%
化学品及辅材	370.48	3.73%	817.65	4.66%	350.68	3.48%	67.06	0.76%
<b>合计</b>	<b>9,923.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,563.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,079.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,803.55</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主要原材料包括金属结构部件、探针、非金属结构部件、电气部件、设备部件等，公司采购原材料金额逐年增长，与公司整体业务规模增长趋势一致。

具体而言，公司近年来采购金属结构部件金额占比总体增长，主要系公司持续加大对核心零部件探针的自主研发力度并逐步以自主生产的探针替代进口探针，由直接采购成品探针逐步转向采购金属结构部件自主制造，相应地公司采购探针比例逐年下降；公司2024年采购电气部件金额较大主要系公司2024年因探针卡业务需要采购较多的空间转接基板，同时探针卡业务的开拓导致公司采购化学品等材料的规模扩大；此外，公司设备部件采购主要与下游客户设备订单需求有关，2025年上半年公司承接测试设备订单较少，因此采购金额较以前有所减少。

公司产品具有定制化特点，所需原材料种类及型号众多，各类材料的价格因规格、材质等不同存在差异。报告期各期，公司采购的主要原材料价格变动情况如下：

单位：元/件、元/根

项目		2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
金属结构部件	顶部柱塞	1.19	1.28	1.35	1.55
	套筒	0.74	0.72	0.76	0.82
	底部柱塞	0.45	0.46	0.51	0.58
	弹簧	0.25	0.26	0.28	0.29
	盖体	141.03	144.71	159.26	167.90
探针	功能性探针	6.47	6.73	6.78	6.29
	老化探针	1.36	1.61	1.40	1.35

报告期内，公司采购主要金属结构部件的单位价格总体呈下降趋势，主要系公司芯片测试接口业务规模持续扩大，采购金属结构部件自产探针的比例逐年提升，金属结构部件采购量的逐年增长，交易单价有所下降。

公司探针的采购单价存在一定波动，主要与产品结构以及汇率变动有关，功能性探针主要进口外国品牌，采购价格受汇率波动影响较大，2023年人民币汇率下行明显，公司功能性探针采购单价较2022年有所增长；2024年公司采购老化探针的单位价格较以前年度显著提高，主要由于当年度承接客户XAI芯片测试接口订单，该产品需要采购单价更高的高性能老化探针以适配测试需求。

## 2、委外加工情况

报告期各期，公司采购委外加工服务的金额较小，分别为58.04万元、33.69万元、387.51万元和47.72万元，占各期采购总额的比例分别为0.65%、0.33%、2.16%和0.48%。报告期内，公司综合考虑加工成本以及产能情况等因素，将流程简单、技术含量较低的非核心生产环节委托外协供应商完成，主要包括金属结构件加工、PCBA加工、结构件组装等。2024年，公司由于芯片测试接口订单量大幅增长，测试接口产线产能紧张，为满足客户交付时效要求，公司将部分探针制造的组装工序交由外协供应商完成，因此当年度公司委外金额大幅高于其他年度。

## 3、主要能源采购情况

报告期内，公司采购的主要能源为电力，采购金额分别为140.33万元、242.77万元、427.25万元和306.25万元，均由市政供应，供应较为充足，价格稳定。

## (二) 报告期内前五大供应商情况

报告期内,公司向前五大供应商主要采购内容、采购金额及占各期采购总额的比例如下表所示:

2025年1-6月				
序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额 (万元)	占采购总额 比例
1	Will Co.Ltd.	金属结构部件、辅材	1,862.51	18.68%
2	Megatouch Co., Ltd.	探针	1,156.86	11.60%
3	浙江金连接科技股份有限公司	金属结构部件、辅材	951.82	9.55%
4	深圳市新富城电子有限公司	探针、金属结构部件	949.44	9.52%
5	Mikuro Spring Co, Ltd.	金属结构部件、辅材	396.54	3.98%
合计			<b>5,317.17</b>	<b>53.33%</b>
2024年度				
序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额 (万元)	占采购总额 比例
1	Will Co.Ltd.	金属结构部件、辅材	3,049.03	16.98%
2	Megatouch Co., Ltd.	探针	2,623.14	14.61%
3	深圳市新富城电子有限公司	探针、金属结构部件	1,837.54	10.24%
4	M.D.Mechanical Devices Ltd.	设备部件	812.15	4.52%
5	苏州德百尼机械科技有限公司	金属结构部件	606.29	3.38%
合计			<b>8,928.15</b>	<b>49.73%</b>
2023年度				
序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额 (万元)	占采购总额 比例
1	Will Co.Ltd.	金属结构部件、辅材	1,236.47	12.23%
2	Megatouch Co., Ltd.	探针	1,222.33	12.09%
3	深圳市新富城电子有限公司	探针、金属结构部件	1,036.71	10.25%
4	M.D.Mechanical Devices Ltd.	设备部件	755.36	7.47%
5	浙江金连接科技股份有限公司	金属结构部件、辅材	524.68	5.19%
合计			<b>4,775.56</b>	<b>47.22%</b>
2022年度				
序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额 (万元)	占采购总额 比例
1	Megatouch Co., Ltd.	探针	1,536.18	17.34%
2	Will Co.Ltd.	金属结构部件、辅材	1,140.12	12.87%

3	M.D.Mechanical Devices Ltd.	设备部件	842.14	9.50%
4	深圳市新富城电子有限公司	探针、金属结构部件	618.65	6.98%
5	浙江金连接科技股份有限公司	金属结构部件、辅材	513.21	5.79%
合计			4,650.29	52.48%

报告期内，公司向前五大供应商采购金额占采购总额的比例分别为 52.48%、47.22%、49.73%和 53.33%，不存在向单个供应商采购比例超过公司当年采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情况。报告期内，公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司前五大供应商不存在关联关系。

## 六、发行人的主要固定资产和无形资产

### （一）主要固定资产情况

#### 1、固定资产基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的主要固定资产情况如下：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	净值	成新率
机器设备	16,386.78	4,588.70	11,798.08	72.00%
运输工具	105.23	96.69	8.54	8.12%
电子设备及其他	612.01	352.67	259.34	42.37%
合计	17,104.01	5,038.06	12,065.95	70.54%

#### 2、房屋及建筑物

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人不存在房屋及建筑物。

### （二）房产及土地租赁情况

#### 1、主要租赁房产

截至 2025 年 6 月 30 日，公司租赁房产具体情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁期限	房屋坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	用途
1	发行人	上海浦东软件园股份有限公司	2025.06.16-2027.06.15	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 1 幢 201/02, 201/04, 201/06 室	247.04	研发及办公
2	苏州韬盛	苏州正得利环保技术服务	2024.02.01-2027.04.30	唯新路 83 号二期厂房一楼西侧、二楼整层厂房、	16,100	研发、生产、办公

序号	承租方	出租方	租赁期限	房屋坐落	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	用途
		务有限公司		南侧三楼办公、C幢办公区2楼西侧		
3	苏州晶晟	方正科技集团苏州制造有限公司	2025.05.10-2031.05.09	苏虹东路188号C幢103	3,900	研发、生产
4			2022.01.01-2027.03.31	苏虹东路188号C幢101-102、201-203	4,318	研发、生产
5			2023.02.01-2027.03.31	苏虹东路188号C幢301-303、111	2,503	研发、生产
6			2023.10.11-2027.03.31	苏虹东路188号B幢217	257	办公
7			2024.08.01-2027.03.31	苏虹东路188号B幢218	535	研发、生产、仓储
8	苏州晶晟	合肥联佳宝商务管理有限公司	2024.05.01-2026.04.30	安徽省合肥市经开区习友路5899号联想科技港B座2层202	206.31	办公
9	天津韬盛	天津凌奥创业科技企业孵化器有限公司	2023.08.01-2026.02.28	天津凌奥创业产业园一期8号楼215、216室	415	办公
10	韩国韬盛	株式会社Orja	2024.02.15-2026.02.14	京畿道华城市尖滩产业1路51-9,606、607号(灵川洞,东滩M大厦)	315.84	研发
11	美国韬盛	B9 Sequoia Santa Clara Owner LP	2024.01.01-2026.01.31	Santa Clara Commerce Park - 2370-2378 Walsh Avenue, Santa Clara, CA 95051	107.7675	办公
12	新加坡韬盛	Teletech Park Pte Ltd	2025.08.01起38个月	20 Science Park Road, #03-23 Teletech Park, Singapore Science Park II, Singapore 117674	93.69	办公

## 2、租赁用地

截至2025年6月30日,发行人不存在租赁用地情况。

### (三) 主要无形资产情况

#### 1、土地使用权

截至2025年6月30日,发行人及其子公司不存在土地使用权。

#### 2、专利

##### (1) 境内专利

截至2025年6月30日,发行人及其子公司拥有境内77项授权专利,均为原始取得,其中发明专利26项、实用新型专利51项,具体情况如下:

序号	专利类型	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权公告日
1	发明	苏州韬盛	一种芯片测试系统	2024112158734	2024.09.02	2024.12.03
2	发明	苏州韬盛	IGBT 芯片测试装置	2024105631155	2024.05.08	2025.03.25
3	发明	苏州韬盛	探针组装机构及探针组装方法	2024105313383	2024.04.29	2025.05.06
4	发明	苏州韬盛	测试插座开合机构及芯片测试装置	2024103794302	2024.03.29	2024.12.20
5	发明	苏州韬盛	浮动转接结构及芯片测试装置	2024103562131	2024.03.27	2025.02.28
6	发明	苏州韬盛	半导体测试插座及其安装方法	2024103120028	2024.03.19	2025.03.21
7	发明	苏州韬盛	一种用于芯片高低温测试的散热冷却装置	2023114456659	2023.11.02	2024.03.26
8	发明	苏州韬盛	一种交错微流道散热结构及芯片散热系统	2023111547158	2023.09.08	2023.12.02
9	发明	苏州韬盛	探针组装装置	2023108414593	2023.07.11	2023.09.29
10	发明	苏州韬盛	低温高速测试治具	202210218375X	2022.03.08	2025.02.11
11	发明	苏州韬盛	一种 IGBT&KGD 芯片的测试治具	2021107485164	2021.07.02	2021.09.14
12	发明	苏州韬盛	半导体芯片测试装置及其制作方法	2020110208410	2020.09.25	2024.04.16
13	发明	苏州韬盛	微细同轴插座的制作方法	2020100381278	2020.01.14	2021.07.06
14	发明	苏州韬盛	阻抗匹配结构的半导体芯片测试同轴插座及其制备方法	2019109146779	2019.09.25	2022.04.05
15	发明	苏州韬盛	混合同轴结构的半导体测试插座及其制备方法	2019109144701	2019.09.25	2022.04.05
16	发明	苏州韬盛	垂直探针卡	2017103521273	2017.05.18	2020.06.02
17	发明	苏州韬盛	一种用于继电器的测试设备	2016106644872	2016.08.15	2023.03.21
18	发明	苏州韬盛	一种基于 FEA 仿真设计芯片测试插座结构的方法及其应用	2016106477827	2016.08.10	2021.03.09
19	发明	苏州韬盛	陶瓷基板穿线的转接板及其加工方法	2015106541551	2015.10.12	2017.08.11
20	发明	苏州晶晟	一种在聚酰亚胺层上刻蚀种子层的方法	2024105233783	2024.04.28	2025.02.28
21	发明	苏州晶晟	一种探针测试台、制备方法及 CP 测试装置	2023109911201	2023.08.08	2025.01.28
22	发明	苏州晶晟	一种 3D-MEMS 探针及其制备方法	2023107804313	2023.06.29	2025.02.14
23	发明	苏州晶晟	一种改善光刻胶图案失真的方法	2023106723056	2023.06.08	2023.08.25
24	发明	苏州晶晟	一种 PCB 板微型化焊盘划伤和脱落的修复方法	2023106204641	2023.05.30	2023.08.15
25	发明	苏州晶晟	一种陶瓷基板及其制备方法和用途	2023105684177	2023.05.19	2023.08.29
26	发明	苏州晶晟	一种用于钼和铜化学机械抛光的抛光液及其制备方法和使用方法	2023105551813	2023.05.17	2024.12.27
27	实用新型	苏州韬盛	小尺寸大功率 QFN 芯片的散热测试插座	2022219729210	2022.07.28	2024.07.09
28	实用新型	苏州韬盛	芯片测试插座 S 参数测试结构	2024209030938	2024.04.28	2025.01.28
29	实用新型	苏州韬盛	测试插座	2024208386837	2024.04.22	2025.02.07

序号	专利类型	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权公告日
30	实用新型	苏州韬盛	芯片测试探针及安装结构	2024204373679	2024.03.07	2024.11.08
31	实用新型	苏州韬盛	无压痕测温的芯片测试座	2022224385699	2022.09.16	2023.05.26
32	实用新型	苏州韬盛	具有过温保护的自加热芯片测试夹具	2022222120373	2022.08.22	2023.03.07
33	实用新型	苏州韬盛	安装便捷且使用安全的测试插座手柄机构	2022222120369	2022.08.22	2023.03.07
34	实用新型	苏州韬盛	应用于真空环境的测试插座	2022219736958	2022.07.28	2023.11.17
35	实用新型	苏州韬盛	辅助芯片测试的自动下压机构	2022206058843	2022.03.18	2022.11.01
36	实用新型	苏州韬盛	弹簧针自动组装设备	2020220056049	2020.09.15	2021.06.01
37	实用新型	苏州韬盛	一种自动导正的芯片测试插座	2020220055915	2020.09.15	2021.04.27
38	实用新型	苏州韬盛	芯片测试治具导气槽	2020220056195	2020.09.15	2021.04.27
39	实用新型	苏州韬盛	一种微探针的半自动组装的定位工具	2020220071119	2020.09.15	2021.04.27
40	实用新型	苏州韬盛	一种应用于裸芯片测试的探针	2020220071617	2020.09.15	2021.04.27
41	实用新型	苏州韬盛	一种微调探针卡水平的结构	2020219846910	2020.09.11	2021.04.27
42	实用新型	苏州韬盛	较薄芯片的下压测试装置	2020219847063	2020.09.11	2021.04.27
43	实用新型	苏州韬盛	一种兼容不同尺寸的芯片测试夹具	2020219862472	2020.09.11	2021.04.27
44	实用新型	苏州韬盛	基于微机电系统的垂直探针	2020215606640	2020.07.31	2021.01.12
45	实用新型	苏州韬盛	一种应用于芯片测试的连接机构	2019219898698	2019.11.18	2020.09.11
46	实用新型	苏州韬盛	一种基于开尔文测试的全新测试插座	2019219910276	2019.11.18	2020.09.11
47	实用新型	苏州韬盛	一种真空灌胶机	2019219946884	2019.11.18	2020.08.28
48	实用新型	苏州韬盛	高频测试探针卡	2019211773711	2019.07.25	2020.05.12
49	实用新型	苏州韬盛	接触指纹芯片机测治具	2019211774837	2019.07.25	2020.05.01
50	实用新型	苏州韬盛	小型 SLT 测试分选系统	2019211773251	2019.07.25	2020.04.21
51	实用新型	苏州韬盛	芯片测试座的大功耗散热手测盖	2019204377005	2019.04.02	2019.12.27
52	实用新型	苏州韬盛	带气道高低温测试座	2019204377185	2019.04.02	2019.12.27
53	实用新型	苏州韬盛	机测手测二合一测试治具	2019204398425	2019.04.02	2019.12.03
54	实用新型	苏州韬盛	多冲头式铆合装置	2018203787328	2018.03.20	2018.12.04
55	实用新型	苏州韬盛	适用于芯片高频测试的探针装置	2017216938228	2017.12.07	2018.06.01
56	实用新型	苏州韬盛	指纹芯片模拟测试装置	2017203977953	2017.04.17	2017.11.21
57	实用新型	苏州韬盛	一种用于继电器的测试设备	2016208773680	2016.08.15	2017.09.05
58	实用新型	苏州韬盛	一种用于 50GHz 高频的检测装置	2016207740957	2016.07.22	2017.01.04
59	实用新型	苏州韬盛	一种用于芯片的测试插座	2016207637138	2016.07.20	2017.05.10
60	实用新型	苏州韬盛	适用于晶元检测的测试装置	201620283678X	2016.04.07	2016.08.17

序号	专利类型	专利权人	专利名称	专利号	申请日	授权公告日
61	实用新型	苏州韬盛	一种适用于芯片的测试装置	2016202404288	2016.03.28	2016.08.17
62	实用新型	苏州韬盛	一种用于测试芯片的手动夹具	201620237448X	2016.03.25	2016.08.17
63	实用新型	苏州韬盛	一种悬挂式垂直探针	2016201815610	2016.03.10	2016.08.17
64	实用新型	苏州韬盛	一种适用芯片堆叠装配测试的插座	2016200802948	2016.01.27	2016.08.31
65	实用新型	苏州韬盛	适用于地磁传感器芯片的测试插座	2016200807161	2016.01.27	2016.08.17
66	实用新型	苏州韬盛	以导电胶模拟人手指测试指纹芯片的插座	2016200809947	2016.01.27	2016.08.17
67	实用新型	苏州韬盛	一种弹簧探针转接板	2015211260106	2015.12.30	2016.06.29
68	实用新型	苏州韬盛	一种芯片测试针	2015211278932	2015.12.30	2016.06.22
69	实用新型	苏州韬盛	芯片测试装置	2015211275366	2015.12.30	2016.05.25
70	实用新型	苏州韬盛	指纹识别芯片的带状测试插座	2015211276852	2015.12.30	2016.05.25
71	实用新型	苏州韬盛	一种用于探针的夹持板	2015211161331	2015.12.29	2016.05.25
72	实用新型	苏州晶晟	一种探针卡盒和芯片测试装置	2024202845656	2024.02.06	2024.09.24
73	实用新型	苏州晶晟	芯片三温测试装置	2023216444045	2023.06.27	2023.11.07
74	实用新型	苏州晶晟	芯片封装测试机构	2023215888068	2023.06.21	2023.11.14
75	实用新型	苏州晶晟	一种探针卡	2023214938197	2023.06.13	2024.02.20
76	实用新型	苏州晶晟	芯片测试定位装置及芯片测试插座	2023214404240	2023.06.07	2023.11.14
77	实用新型	苏州晶晟	芯片测试装置	2023214044067	2023.06.05	2023.11.14

## (2) 境外专利

截至 2025 年 6 月 30 日, 发行人及其子公司拥有以下 4 项境外专利:

序号	地区	专利类型	专利权人	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日
1	中国台湾	发明	苏州晶晟	一种针对 224Gbps 超高速率同轴测试插座	I871090	2023.11.15	2025.1.21
2	美国	实用新型	苏州韬盛	用于半导体芯片测试的阻抗匹配结构同轴插座及其制造方法	US11,199,571 B2	2019.11.1	2021.12.14
3	中国台湾	发明	苏州韬盛	阻抗匹配结构的半导体芯片测试同轴插座及其制备方法	I729545	2019.10.28	2021.6.1
4	美国	实用新型	苏州韬盛	垂直探针卡	US10,884,026 B2	2019.1.3	2021.1.5

### 3、商标

截至 2025 年 6 月 30 日,发行人及其子公司共拥有 7 项注册商标,具体如下:

序号	注册人	注册号	图案	类别	有效期限	取得方式
1	发行人	12812765		9	2015.01.14-2035.01.13	原始取得
2	发行人	12812740		9	2014.12.07-2034.12.06	原始取得
3	发行人	8452646	<b>TwinTech</b>	9	2012.10.07-2032.10.06	原始取得
4	发行人	8424993		9	2012.08.14-2032.08.13	原始取得
5	发行人	8425133	<b>TwinSocket</b>	9	2011.07.14-2031.07.13	原始取得
6	苏州晶晟	66866665		9	2023.08.28-2033.08.27	原始取得
7	苏州晶晟	57486716		9	2022.04.28-2032.04.27	原始取得

### 4、软件著作权

截至 2025 年 6 月 30 日,发行人及其子公司共拥有软件著作权 2 项,具体如下:

序号	权利人	名称全称	简称	登记号	登记日期
1	发行人	基于 Windows7 平台下用.Netframework4.5 编写的探针电阻寿命测试仪器软件	探针电阻寿命测试仪器软件	2015SR028755	2015.02.10
2	苏州韬盛	半导体 Mini3 机械手自动化测试系统	Mini3 Handler	2022SR1412601	2022.10.25

### 5、域名

截至 2025 年 6 月 30 日,发行人及其子公司共拥有 2 项域名,具体情况如下:

序号	主办单位名称	网站备案/许可证号	域名	审核通过日期
1	发行人	沪 ICP 备 19040573 号-1	twinsolution.com	2019.11.04
2	苏州晶晟	苏 ICP 备 2024091075 号-1	nfprobecard.com	2024.04.12

发行人前述无形资产不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷,对发行人持续经营不存在重大不利影响。

#### (四) 发行人拥有的特许经营权情况

截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司无特许经营权。

## （五）生产经营资质情况

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司已取得与生产经营相关的业务资质如下：

序号	持有主体名称	资质名称	颁证单位	证书编号	有效期限
1	发行人	海关进出口货物收发货人备案	中华人民共和国上海浦东海关	3122268094	长期
2	苏州韬盛	固定污染源排污登记回执	-	91320594588448374H001W	2024.11.1-2029.10.31
3	苏州韬盛	海关进出口货物收发货人备案	中华人民共和国苏州工业园区海关	3205261108	长期
4	苏州晶晟	固定污染源排污登记回执	-	91320594MA26BY7F6M001Y	2024.1.8-2029.1.7
5	苏州晶晟	海关进出口货物收发货人备案	中华人民共和国苏州工业园区海关	32052690Z1	2099.12.31
6	苏州晶晟	易制毒化学品购买备案证明	苏州市公安局园区分局禁毒大队	-	-

注：发行人子公司苏州晶晟对历次购买的丙酮等化学品向当地公安局进行备案，并取得其核发的《易制毒化学品购买备案证明》。

## 七、发行人的核心技术及研发情况

### （一）公司主要产品的核心技术情况

#### 1、公司核心技术

公司经过多年持续的研发投入和技术创新，在芯片测试接口和探针卡等领域积累了 21 项核心技术，公司取得了多项与核心技术相关的知识产权，并在其主要产品中实现产业化应用。公司核心技术概况如下表所示。

序号	技术名称	核心技术描述	先进性表征	技术来源	对应产品
1	高频芯片测试接口设计和制造技术	在高频测试技术领域，公司依托自主研发构建精密同轴核心结构，通过一体化集成设计形成阻抗匹配度可调的同轴架构。该设计实现内外导体的微米级同轴度控制，从物理结构层面最大限度抑制信号辐射干扰（EMI）与电磁耦合噪声，为高频信号传输构建稳定的物理屏障。同时，结合三维电磁仿真技术与内部结构拓扑创新优化，对同轴探针信号传输通道进行多维度阻抗校准，确保通道特征阻抗与测试系统实现精准匹配，避免因阻抗失配引发的信号反射损耗，保障高频测试信号的完整性（Signal Integrity）与传输保真度。	该核心技术的信号完整性可满足插损、回损和隔离度的要求。通过减少树脂气泡对绝缘体黏合性能和电磁特性的影响，实现小间距测试探针针孔内以体积占比计算的气泡残留率控制在小于 0.1%，从而提升同轴芯片测试接口电磁传输特性。	自主研发	芯片测试接口

序号	技术名称	核心技术描述	先进性表征	技术来源	对应产品
		针对高频芯片测试接口绝缘体制作中树脂填充不均的行业难题，公司自主研发真空环境绝缘树脂精密填充技术。该技术通过搭建负压可控真空腔体，配合高精度点胶系统与阶梯式加压填充工艺，实现绝缘树脂在插座内孔中的均匀渗透与致密填充，气泡残留率控制在 $\leq 0.1\%$ （按体积占比）。此外，公司配套研发了相应的芯片测试接口部件，进一步提升芯片测试接口性能。为解决芯片测试产线在量产测试过程中手工放置待测芯片效率较低的问题，公司研发了自动化开合装置，提升了芯片测试的整体效率。			
2	先进测试探针设计技术	为应对芯片测试严苛的测试需求，公司基于精密力学设计自主开发的测试探针能够在长达 5,000 小时的老化测试环境中依然具备优异弹性性能，可自适应待测芯片 $\pm 0.1\text{mm}$ 的制造公差，有效消除接触不良导致的测试误差。同时，配套开发定制化固定装置，通过微米级公差控制实现测试探针的稳固安装，避免接触电阻异常波动，保障测试过程中接触稳定性，并且通过探针结构与表面涂层设计，可实现最大单针 3A 的大电流耐受能力，完美适配大电流测试环境下的可靠性需求。	基于公司自主研发的测试探针核心技术，可提升测试探针的电磁特性，优化测试探针机械性能，增强测试探针耐受大电流的能力，从而可应用于射频测试以及可靠性测试等诸多下游领域。	自主研发	芯片测试接口
3	芯片测试接口阻抗精准匹配技术	1、针对高速芯片测试领域同轴芯片测试接口阻抗失配与微米级加工精度难把控的技术瓶颈，公司创新采用可调节内导体结构，配合三维电磁仿真优化的外导体屏蔽层拓扑，实现多规格阻抗的精准适配，可按需满足同一待测芯片不同信号引脚的差异化阻抗匹配要求。同时，依托微米级精密加工工艺，确保同轴结构的高同轴度，可保障超高频信号传输的完整性。 2、针对高频测试领域 线路板表面走线寄生参数干扰高频信号的行业痛点，公司开发芯片测试接口匹配线路板高精度走线设计技术。通过三维电磁仿真对走线进行全频段特性分析，同时通过构建屏蔽屏障，抑制耦合噪声。该设计可有效规避高频信号传输中的串扰、反射等干扰问题，可提升高频信号传输完整性，完美适配 CPU、GPU、AI 芯片等高端器件的高频测试需求。	该核心技术解决了绝缘体材料电磁特性以及芯片测试接口底面阻抗匹配问题，提升了同轴芯片测试接口的高频信号传输特性，从而可满足 CPU、GPU、AI 芯片等高端数字芯片的测试需求。	自主研发	芯片测试接口
4	芯片测试接口精准温控及补偿技术	1、针对高功耗芯片（如服务器级 CPU、GPU）测试过程中的散热瓶颈，公司研发交错凸起式微流道冷却腔体技术。通过计算流体动力学仿真优化微流道拓扑结构，	该核心技术解决了可靠性芯片测试接口散热微流道设计、高精度测温 and 实时	自主研发	芯片测试接口

序号	技术名称	核心技术描述	先进性表征	技术来源	对应产品
		<p>采用交错排布的半球形凸起扩大散热面积,并配合流道截面设计进一步优化风道的流速分布,产生涡流和二次流,促进微流道内冷、热流之间的相互混合,可实现高达 1000W 功耗芯片的高效热管理,将芯片的核心温度稳定控制在客户要求的范围内,满足高功率密度芯片测试过程中的长效散热需求。针对大功率芯片强制风冷场景需求,公司开发芯片测试接口大功率散热部件集成技术。该技术创新采用散热管和散热片一体化架构,配合定制化大功率风扇组成强制风冷模组,快速将芯片热量传导至外界,避免高温导致的测试性能偏差。</p> <p>2、为解决芯片老化测试中“控温精度低、温度响应慢”的问题,公司在芯片测试接口中创新集成实时测温-加热-散热三位一体模块。通过自研的温度控制算法,在结温 125℃工况下可将芯片测试温度精准调控在设定值±0.5℃范围内,显著提升老化测试过程中的温度稳定性,保障测试数据的准确性。</p>	控温的技术难题,可满足大功耗芯片测试接口的散热要求,且在芯片结温较高的工况下可将温度波动范围控制在±0.5℃的精度范围内。		
5	极端测试工况下 IGBT KGD 芯片测试接口设计技术	针对未封装超薄 IGBT KGD 芯片在大电流、高电压极端测试场景下的可靠性需求,公司自主研发 IGBT KGD 芯片专用测试接口设计技术。该技术创新引入高导热-高绝缘复合基材,可快速导出芯片测试过程中产生的局部高温,同时在测试环境方面进行优化,集成惰性气体闭环保护系统,避免极端电压下芯片击穿问题,同时防止大电流产生的电弧对芯片裸 die 造成损伤,为未封装 IGBT KGD 芯片的极限性能验证提供关键技术保障。	在 800V 高电压和 300A 瞬时大电流的测试环境中,可避免因漏电导致待测芯片击穿损坏的问题。	自主研发	芯片测试接口
6	多物理场耦合仿真平台与芯片测试接口数字化模型开发验证技术	依托研发团队在电磁工程、结构力学、热分析领域的跨学科技术积淀,公司深度整合电磁仿真、结构仿真、热力仿真等仿真软件核心能力,通过自研数据交互接口打破软件间的协同壁垒,搭建独有的多物理场耦合仿真平台。该平台可实现“电磁-力场-热场”的多物理量融合仿真,在设计阶段即可在线优化芯片测试接口的电磁特性、机械性能与热力学性能,从源头缩短产品研发周期。公司已构建规模化数字化知识体系,累计开发上百种测试探针高精度仿真模型、上千种芯片测试接口模块化数字模型,覆盖 CPU、GPU、AI 高端数字芯片, NAND/DRAM 存储芯片, 5G 射频芯片,功率芯片领域的标准化数字方案	通过多物理场融合仿真,在设计阶段在线优化测试探针及互联接口的电磁特性、机械性能与热力学性能,并可模拟芯片测试接口在实际工况下的工作状态,从仿真环节优化芯片测试接口性能。	自主研发	芯片测试接口

序号	技术名称	核心技术描述	先进性表征	技术来源	对应产品
		库。 此外，公司结合自主搭建的硬件验证平台与“电磁-力场-热场”全维度数字化模型体系，可精准模拟实际测试工况（如大电流加载、高频信号传输、高低温循环），对芯片测试接口的内部机械损伤、电磁性能衰减等关键指标进行前瞻性验证，实现设计方案的快速迭代优化（方案迭代周期缩短 $\geq 30\%$ ），确保产品性能与实际应用需求高度匹配。			
7	测试探针精密制造技术	在探针结构强度优化领域，针对实际应用中探针铆合位点性能提升的核心需求，公司研发高精度探针铆合强化技术。通过有限元分析（FEA）模拟应力分布，精准优化铆合压力及铆合点位布局等关键工艺参数，实现铆合强度提升 $\geq 30\%$ ，从根本上保障测试探针的长期稳固，有效规避数十万量级高频次测试场景下的结构失效风险。公司自主开发探针自动化制造装置。该装置搭载视觉定位系统（定位精度 $\leq 5$ 微米）与多轴联动机械臂，具备全自动上料、精准插针、压力检测及不良品筛选功能，相比传统人工装配，生产效率提升 $\geq 2.2$ 倍，实现探针制造环节的高效化、精准化与规模化生产。 公司自主开发自动化植针设备，将植针位置偏差率控制在 $\leq 10$ 微米，产品良率稳定在 $\geq 99.8\%$ ，实现芯片测试接口植针环节的自动化。	测试探针铆合力提升了30%以上，提升了测试探针的机械强度和使用寿命，同时基于自主开发的自动化测试探针装配设备，测试探针的日产量提高2倍以上。	自主研发	芯片测试接口
8	纳米导电胶芯片测试接口制造技术	针对小间距高密度芯片的高精度测试需求，公司自主研发纳米导电胶芯片测试接口制造技术。该技术通过精准调控液态硅橡胶基材与微导电颗粒的混合配比，并采用梯度升温固化工艺实现微观结构可控成型，最终形成兼具稳定弹力与导电性的纳米导电胶体。 该纳米导电胶芯片测试接口可实现带宽最高可达到40Ghz@-1dB，同时通过导电颗粒有序排布设计与硅橡胶基材的电磁屏蔽特性显著降低信号干扰。此外，其独特的弹性形变能力，压缩量可达20%-30%，可自适应芯片引脚的微观高度差，确保每路信号接触可靠，有效提升高密度芯片测试的准确性与稳定性，为先进制程芯片测试提供关键接口解决方案。	该核心技术解决了液态硅橡胶和导电颗粒的控制和固化难点，进一步降低芯片测试接口探针间距，并提升信号传输带宽频率。	自主研发	芯片测试接口
9	高精度微间距芯片测试接口精密制造技术	针对芯片测试接口核心部件浮动支撑板（常规设计厚度小于0.40mm）的超薄加工痛点，传统铣削挖腔与钻孔工艺易因板材	该核心技术提高了芯片测试接口加工的平面精度，平面精	自主研发	芯片测试接口

序号	技术名称	核心技术描述	先进性表征	技术来源	对应产品
		<p>刚性不足，导致变形量超 0.05mm，造成制造过程中孔深公差超 0.05mm，同时会引发超过<math>\geq 10\%</math>的产品碎裂率。</p> <p>公司自主研发柔性真空吸附工装系统，通过负压调控与蜂窝状吸附孔布局设计，实现浮动支撑板固定面与加工基准平面的无缝贴合可保证加工过程中贴合间隙小于 2 微米，从源头抑制板材翘曲、振动变形，将加工变形量控制在 20 微米以内，并将产品碎裂率降至 2% 以内，保障超薄部件的制造稳定性与良品率。</p> <p>针对芯片测试接口制造中正反面加工的同轴度难题，传统工艺易产生正反面错位，导致关键孔位同心度偏差超 50 微米，影响接口信号传输精度。公司创新集成在线量测与误差补偿一体化系统，通过加工过程中实时采集正反面基准孔坐标，结合自研的动态误差补偿算法，自动计算位置偏差量，并同步反馈至数控加工系统进行参数修正，最终将正反面制造的同轴度偏差控制在 10 微米以内，彻底消除错位对产品性能的影响，满足高精度芯片测试接口的制造要求。</p>	度可控制在 20 $\mu\text{m}$ 以内。正反面同心度可达到 10 $\mu\text{m}$ 的精度，提升了产品加工精度，同时可将加工破碎率控制在 2% 以内，提升产品良率。		
10	多层叠层对准精控技术	<p><b>MEMS</b> 探针通常都是多层结构，制作多层 <b>MEMS</b> 探针时，层和层之间需要通过套刻的方法来完成转换，对位越精准，探针的边缘和外壁结构越完整和越接近图纸和设计要求。</p> <p>该核心技术通过专门设计的先进的对准标记识别和光刻胶热变形与机械振动补偿，来减小每层再叠加的时候层和层之间的对位误差。</p>	该核心技术可实现套刻精度小于 1 $\mu\text{m}$ 。	自主研发	探针卡
11	异构集成界面平坦化技术	传统的表面平坦化技术主要针对金属或者陶瓷单一材料表面的抛光和研磨来完成表面平坦化，该核心技术主要针对金属掺杂有机物异构集成表面的平坦化技术，通过使用较厚的结构层和 Flying Cutting 的技术来控制整个 <b>Substrate</b> 的共面指标，通过平坦化工艺和机械研磨的工艺结合，使不同厚度的器件结构达到相同厚度且保证表面光洁。	可实现 6 寸 <b>Substrate</b> 平整度控制在 $\pm 1\mu\text{m}$ 范围内，器件结构表面粗糙度和低结构厚度的均匀性控制在 $\pm 1.5\mu\text{m}$ ，结构件表面粗糙度小于 5nm。	自主研发	探针卡
12	高强度合金材料以及电镀应力消除技术	通过控制镍合金镀液的成分和比例来进行调控，使得探针本体材质的材料特性得到加强，同时配合针尖硬质合金电镀、针尾镀金技术，以及调整镀液成分、添加自研的去应力添加剂、电镀工艺参数的优化，消除电镀应力，避免 <b>Wafer</b> 翘曲。	该核心技术可将 <b>MEMS</b> 探针 X 方向翘曲控制在 10 $\mu\text{m}$ 以内，Y 方向翘曲控制在 $\pm 10\mu\text{m}$ 以内，提高 <b>MEMS</b> 探针的良率。	自主研发	探针卡

序号	技术名称	核心技术描述	先进性表征	技术来源	对应产品
13	全维度金属机械参数深度热处理技术	金属材料在初期成膜时, 由于电镀工艺有参与应力和氢脆的问题, 导致性能不稳定、不可控, 同时复合材料之间形成的金属间化合物和原子迁移也会加剧整体探针的弹力表现波动。该核心技术通过温度、时长、材料比例、材料品种等多个参数的协同优化, 可完成除氢, 进而优化晶格相位。	该核心技术带来特有的相组成以及分布, 可以提升硬度、杨氏模量和抗拉强度。	自主研发	探针卡
14	多场耦合三温精密探针卡仿真技术	该核心技术利用先进的仿真技术来模拟探针卡变形并指导探针卡设计方向。通过接触电阻蒙特卡洛分析, 引入群针温升算法以优化探针选型和设计, 同时利用探针和上下盖板之间的机械配合从而使探针 Pad 接触表面产生可控的划痕。	该核心技术可大幅降低烧针风险, 并提供较长的测试间隔次数和稳定的低接触电阻针卡具备高低温三温测试功能。	自主研发	探针卡
15	接地回路重塑探针卡技术	通过导电的上下盖板, 为原本没有设计接地隔离区域的芯片增加接地探针。	可实现小于-40dB 的隔离度, 提升晶圆测试过程中测试信号的传输质量。	自主研发	探针卡
16	3D MEMS 探针和探针卡制造技术	通过深硅刻蚀工艺, 光刻研磨电镀成膜工艺制作出带 Pillar 和塔尖针尖的 3D MEMS 探针	基于该核心技术, 公司可完成 12 寸 3D MEMS DUTLET 的针卡制作	自主研发	探针卡
17	分子级定向排列低摩擦涂层	激光加工的孔内部粗糙度较差, 因此 CVD 成膜的厚度和均匀性有较高的工艺要求, 并且探针结构和盖板之间的匹配需要经过多重优化。通过 CVD 的方法, 该核心技术在上下盖板上沉积防止摩擦的涂层, 从而控制整体探针 Contac Mark。	该核心技术可降低探针的接触弹力波动, 从而在高 Pin Count 产品上大幅降低探针和盖板之间的摩擦	自主研发	探针卡
18	Sub 微米级 2.5D MEMS 融合焊接技术	随着晶圆工艺制程的提升, 晶圆引脚间距越来越小, 对激光焊接的对位翘曲偏摆等公差要求非常严格。该核心技术通过激光技术将 2.5D MEMS 针的 Solder 部分熔化, 实现和 Thin Film 多层复合陶瓷基板 (MLC) 的紧密焊接。	该核心技术可实现最小焊接间距 50 $\mu$ m, 焊接精度可控制在 $\pm$ 5 $\mu$ m 内。	自主研发	探针卡
19	半导体级超精微大规模阵列多层 LTCC 智能加工技术和高效电路成型技术	生瓷片带有 PET 薄膜, 两种不同的材料吸热系数不同, 碳化温度差异大, 激光参数调整困难, 该核心技术利用先进的飞秒激光设备和 DOE 的方法调试制造参数, 以达到微小孔径和数万孔阵列情况下无漏钻孔。采用先进的工艺实现高精度的堆叠对位精度, 每层通孔之间的垂直精度, 克服 LTCC 烧结时的材料收缩引起的位置偏移, 实现了高致密堆叠, 并利用行业高精度的厚膜制造设备形成微米级的线宽和线距。	生瓷片和 PET 薄膜成孔后, 孔边缘整齐且无碳化颗粒, 孔径小于 100 $\mu$ m, 孔数大于 2 万孔。多层堆叠层数已实现 24 层 core 层堆叠, 电测线路无开、短路。线宽和线距分别达到 50 $\mu$ m 和 50 $\mu$ m。	自主研发	探针卡
20	陶瓷表面微纳处理和精准对位技术	该核心技术将烧结后的多层复合陶瓷基板 (MLC) 经过表面纳米级镜面平坦化, 以达到半导体级别的再布线技术的要求, 并利用微米尺度陶瓷收缩率与电路光刻精准适配, 通过精准的测量和精确的掩膜版设	该核心技术可实现多层复合陶瓷基板 (MLC) 的表面粗糙度 Ra $\leq$ 0.05 $\mu$ m, 可实现 5 层的 RDL 层,	自主研发	探针卡

序号	技术名称	核心技术描述	先进性表征	技术来源	对应产品
		计,对 LTCC 烧结产生的物理收缩进行补偿,确保光刻电路的位置精准度,然后通过先进的薄膜技术,在多层复合陶瓷 core 上制造多层有机再布线层。	且对位精度达到 $\pm 2\mu\text{m}$ ;可实现 24 层 core+5 层 RDL 的多层复合结构,性能测试无开路、短路。		
21	精准热膨胀系数匹配技术	低热膨胀系数 LTCC 陶瓷的制备工艺相对复杂,需要精确控制材料的成分和烧结条件,其性能也不稳定;此外,金属化技术也需要精确控制金属层的厚度和均匀性,以降低陶瓷异型件的热膨胀系数并提高其热导率和抗热震性能;低热膨胀系数陶瓷材料的性能不稳定,由于低热膨胀系数陶瓷的制备过程中存在许多变量,如成分比例、烧结温度和时间等,这些因素都会影响最终产品的性能。 LTCC 陶瓷热膨胀系数与 Wafer 热膨胀系数精密补偿,使得陶瓷和待测晶圆热变形基本同步,增加了测试的准确度。	可实现高低温下分别测试 C4 焊盘和待测晶圆焊盘相对位移控制在 $\pm 3\mu\text{m}$ 。	自主研发	探针卡

## 2、核心技术产品占营业收入的比例

报告期内,发行人的核心技术应用于芯片测试接口和探针卡,报告期内公司的核心技术产品收入占比情况如下:

单位:万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
核心技术产品收入	18,101.86	32,054.27	19,093.68	14,925.59
营业收入	19,189.96	33,107.46	20,859.03	16,525.60
核心技术产品占营业收入的比例	<b>94.33%</b>	<b>96.82%</b>	<b>91.54%</b>	<b>90.32%</b>

报告期各期,发行人核心技术产品收入占营业收入的比例较高,核心技术产品收入对营业收入的贡献占比较高,核心技术的产业化情况良好。

## 3、核心技术的科研实力和成果情况

截至本招股说明书签署日,公司获得的奖项、荣誉或科研平台认定情况如下:

序号	奖项	获奖年度
1	国家级专精特新重点小巨人	2024年
2	高新技术企业	2024年
3	江苏省高新区瞪羚企业	2023年
4	江苏省省级企业技术中心	2023年

序号	奖项	获奖年度
5	国家级专精特新小巨人	2023年
6	江苏省民营科技企业	2022年
7	江苏省省级工程技术研究中心	2022年
8	江苏省专精特新中小企业	2022年
9	SIP 瞪羚企业	2022年
10	苏州工业园区专精特新小巨人	2021年
11	苏州工业园区管理委员会上市苗圃企业	2020年
12	苏州高精度激光聚酯薄膜加工技术工程研究中心	2019年
13	苏南国家自主创新示范区瞪羚企业	2018年
14	苏州市企业技术中心	2017年

#### 4、公司核心技术的保护措施

公司积极申请专利，对公司核心技术进行有效保护。对于部分不宜公开的非专利核心技术，公司制定了技术保密制度和措施加以保护，有效地防范了公司核心技术的泄露。公司与可能接触公司保密事项及核心技术的员工均签署了保密协议，协议对保密信息的内容与范围、保密义务、违约责任及竞业禁止等内容进行了明确约定，以确保公司的核心技术与合法权益受到最大程度的保护。

#### (二) 公司研发情况

##### 1、公司在研项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司正在从事的研发项目及其进展情况如下：

序号	项目名称	研发内容和目标	所处阶段
1	高功耗大尺寸芯片老化测试插座	针对芯片高功耗测试需求，研究风道技术和热管结构，开发能满足 300W 以上芯片的老化测试需求。	在研
2	弹簧探针自动抓取组装工艺及设备开发	实现大于 0.35 毫米 pitch 单动针，及 2.4 毫米超短针的自动抓取和铆合。	在研
3	三温循环下疲劳寿命优化的测试插座开发	针对芯片三温测试循环条件下的需求，通过结构优化和耐高低温且热膨胀系数低材料选用，减少探针磨损和提升接触阻值，提高测试插座使用的耐久性。	在研
4	高频高速等多场景测试探针开发及性能提升	在高频高速测试场景下，针对塑料插座短针和同轴插座的探针需求，优化探针尺寸匹配插座尺寸和信号设计，实现高速芯片测试需求。	在研
5	大功率芯片高低温系统开发	开发一个产品系列，满足不同功率阶梯的大功率芯片的高低温测试需求。充分发挥公司在半导体相关产品行业的开发生产经验，打破进口设备在	在研

序号	项目名称	研发内容和目标	所处阶段
		该领域的垄断地位。融合多种先进的温控技术，为产品赋能，提升我司产品的竞争力。	
6	MEMS 颗粒互联装置产品研发	利用 MEMS 技术，生产制造出相应的导电颗粒，从而实现 0.3 毫米间距的导电橡胶，拟实现公司 MLOC 和探针卡、PCB 之间的互联，同时，研发测试频率超过 85Ghz 的产品的导电胶插座。	在研
7	高密度 Mems 探针卡开发	实现支持微间距（ $\leq 50\mu\text{m}$ ）接触，穿透钝化层测试 TSV 和微凸点（Microbump）；2D 探针阵列设计，适应多层堆叠芯片的同步测试。	在研
8	3D MEMS 探针卡开发	用 MEMS 技术实现真 3D 结构的探针制造，并通过先进的互联技术实现探针和 Dutlet 的连接，Dutlet 和后方的 PCB、机械结构通过灵活的 interposer 相连接，Dutlet 和 Interposer 共同控制针尖的水平性能，从而制造出 3D 结构的探针卡。	在研
9	MEMS 探针研发	开发基于 MEMS 工艺的亚 $50\mu\text{m}$ 超密阵列探针，实现最小 $50\mu\text{m}$ 间距的探针结构加工，突破传统光刻与电铸工艺极限，满足下一代 MEMORY 及 5nm 以下 SOC 芯片测试需求。	在研
10	Memory 2D Nand Flash 探针卡研发	在 12 寸多层陶瓷复合基板上实现针尖间距 61 微米，多达接近 6 万根探针的高密度微小间距探针卡，用于先进的存储芯片的晶圆测试。	在研
11	2.5D MEMS DRAM 探针卡研发	在 12 寸多层陶瓷复合基板上实现针尖间距 57 微米，多达接近 6 万根探针的高密度微小间距探针卡，用于先进的存储芯片的晶圆测试。	在研
12	碳化硅 KGD 裸芯片测试分选机开发	拟开发常高温测试 KGD 裸芯片自动化测试分选机，实现高速多工位串行或并行的测试，并通过高精度视觉系统实现裸芯片正反及侧面的缺陷检测。	在研
13	多基板键合工艺开发	拟开发满足 MEMS 探针卡对多个晶粒（Die）的同步检测；通过植球回流焊键合等方式实现 MEMS 针卡对其相应的多个空间转换器（Substrate）所需的相对位置度、水平及电气性能等方面的技术要求。	在研

## 2、研发投入情况

报告期内，公司研发投入整体保持较高水平，公司研发费用及占营业收入的比例如下：

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
研发费用（万元）	2,707.10	3,933.22	3,071.56	1,533.29
营业收入（万元）	19,189.96	33,107.46	20,859.03	16,525.60
研发费用占营业收入比例	14.11%	11.88%	14.73%	9.28%

### 3、合作研发情况

报告期内，公司不存在合作研发情况。

#### （三）公司核心技术人员和研发人员情况

##### 1、公司研发人员构成情况

公司重视科技创新和技术迭代，结合业务拓展和行业发展趋势，积极进行研发人才的储备。为实现灵活高效的组织架构，公司以业务和产品为导向设置相应部门，同时开展生产活动和研发活动，并将部门内研发工时占比超过 50% 以上的人员认定为研发人员，2022 年末、2023 年末、2024 年末和 2025 年 6 月末，公司研发人员数量分别为 38 人、46 人、58 人和 70 人，占发行人各期期末全体员工的比例为 16.03%、15.59%、14.57% 和 15.38%。

报告期各期期末，公司研发人员情况如下：

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
员工总数	455	398	295	237
研发人员数量	70	58	46	38
研发人员占员工总数的比例	15.38%	14.57%	15.59%	16.03%

##### 2、核心技术人员情况及对公司的贡献

公司认定核心技术人员主要依据员工承担的职责、从业经验、参与研发项目情况以及对公司实际生产经营的贡献度等多个维度。根据前述核心技术人员的认定标准和依据，公司的核心技术人员为殷岚勇、施元军、吉迎冬、王守旭。公司的核心技术人员情况如下：

姓名	学历与专业资质、获得奖项情况	重要科研成果、对公司研发的具体贡献
殷岚勇	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本科毕业于东南大学电子工程专业</li> <li>● 自 1994 年起从事半导体行业，拥有超 30 年半导体行业研发和管理经验。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司创始人，现任公司董事长、总经理、首席运营官，负责公司芯片测试接口和探针卡核心技术的研发。</li> <li>● 主导了公司多款芯片测试接口的开发；主导了公司 2D MEMS 探针卡、2.5D MEMS 探针卡核心技术的研发。</li> </ul>
施元军	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本科毕业于苏州大学物理系电子工程专业</li> <li>● 自 1998 年起从事半导体行业，拥有近 30 年半导体行业研发和管理经验。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 现任公司董事、副总经理，负责公司探针卡相关核心技术的研发。</li> <li>● 负责并参与了公司芯片测试接口领域包括同轴技术、阻抗匹配技术、高</li> </ul>

姓名	学历与专业资质、获得奖项情况	重要科研成果、对公司研发的具体贡献
		频传输技术等多项核心技术的研发工作。 ● 主导了公司 2D MEMS 探针卡、2.5D MEMS 探针卡相关核心技术的研发，带领团队攻克了核心部件 MEMS 探针制造工艺技术难题。
吉迎冬	● 硕士研究生学历，本科毕业于东南大学，硕士毕业于苏州大学。 ● 自 2005 年起从事半导体行业，拥有约 20 年半导体行业研发经验。	● 现任苏州韬盛研发总监，负责公司芯片测试接口相关核心技术的研发，主导了公司应用于包括高密度超大面积高端算力数字芯片、高功耗芯片的芯片测试接口的研发工作，包括芯片测试接口的设计、仿真以及验证。
王守旭	● 博士研究生学历，博士毕业于南京理工大学化学工程与技术专业； ● 自 2013 年起从事半导体行业，拥有超过 10 年半导体行业研发经验； ● 发表微纳领域相关的学术论文 11 篇。	● 现任苏州晶晟研发经理，完成多个系列 MEMS 探针成套工艺的研发，主导开发了提升公司 MEMS 探针耐流性能的新型工艺，主导开发了 MEMS 探针良率提升技术。

### 3、公司对核心技术人员实施的约束激励措施

约束措施方面，公司主要通过股权激励、签署保密及竞业禁止协议等方式对核心技术人员进行约束。激励措施方面，公司搭建了具备市场竞争力的薪酬体系，并对员工进行短期及中长期激励。此外，公司还通过优良的研发条件、体系化的科研项目管理、良好的技术培训体系等方式激励核心技术人员。

### 4、报告期内核心技术人员的变动情况及对发行人的影响

报告期内，公司核心技术人员未发生重大变化，不存在核心技术人员变动对公司的经营及研发活动造成不利影响的情况。

#### （四）公司保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新安排

截至本招股说明书签署日，公司建立了较为完善的技术创新机制，不断提升产品的技术水平、积极推动产业创新发展。报告期内，发行人主要通过以下措施保持核心技术的先进性：

#### 1、科学的研发体系

公司拥有完善的研发体系，在中国、韩国等地设有研发机构，并按照研发方向分别设立了芯片测试接口研发、探针卡研发、多层复合陶瓷基板（MLC）研发、自动化研发、测试接口配件研发等。公司各个研发方向的主要职能如下表所

示：

研发方向	主要职能
芯片测试接口研发	负责芯片测试接口和测试探针的相关研发；开展新型材料的研究，提升产品性能和降低成本；优化产品生产工艺，提高效率和产品质量
探针卡研发	负责探针卡的相关研发；密切关注半导体芯片的制程和品种的变化和发展趋势，实时研究对测试硬件要求的变化并做出相关研发的需求和相关项目；对现有产品进行持续跟踪和评估，收集客户反馈、市场数据以及内部使用过程中的问题，分析产品存在的不足和改进空间；研究和探索新的生产工艺、方法和流程，通过实验验证和技术评估，确定是否能够提高生产效率、降低生产成本、提升产品质量
多层复合陶瓷基板（MLC）研发	负责陶瓷多层复合测试板研发技术路线的制定，并开展相关技术开发的验证工作
自动化研发	负责公司内部自动化制造设备的研发以及芯片测试自动化设备的研发工作
测试接口配件研发	负责各类测试电路板等测试接口配套产品的研究开发工作

## 2、持续的高研发投入

为切实贯彻自主创新的研发模式，公司多年来始终坚持高投入研发策略。公司秉持长期主义理念，注重研发方向的精准性。在研发过程中，公司稳扎稳打，循序渐进，以时间为沉淀积累的基石，逐步实现技术覆盖和突破，致力于在测试接口领域构建坚实的技术壁垒。

## 3、完善的技术保护和人才培养机制

公司高度重视对技术创新的保护和对人才的培养。公司通过申请专利等方式对知识产权进行保护和利用，并且不断通过校园招聘和社会招聘等多种形式选拔优秀人才，充实公司的人才储备，同时通过职业培训、项目实践等方式对公司研发人员进行持续培训，不断提高研发团队的专业能力。

公司重视员工的学习和成长，通过提供行业内具有竞争力的薪酬以及股权激励等方式，极大地提高了研发人员的积极性，增加了研发人才的稳定性，提升了团队整体的创新实力。公司鼓励员工进行专利申请，并向具有突出科研成果的技术人员授予相应的奖励，从多角度激发了研发人员的创造力。

## 4、与产业上下游保持紧密合作

公司高度重视与产业链的沟通与交流，紧随客户产品需求和技术发展趋势进行技术创新，通过参加展会、市场调研、与客户紧密沟通等方式，深入了解行业

技术最新发展趋势，持续进行技术升级和产品开发，确保公司的产品符合行业发展趋势并能满足客户要求。

## 八、发行人环境保护和安全生产情况

### （一）公司生产经营中的主要污染物及处理措施情况

公司不属于重污染行业企业。公司拥有与生产经营过程产生的污染物相匹配的废气、废水、噪声和固体废物处理相关的环保装置和防护措施，且相关环保设施运行情况良好。公司生产经营过程中涉及的主要环境污染物和主要处理方法具体情况如下：

#### 1、废气

公司在生产经营过程中产生的废气主要为非甲烷总烃、颗粒物等，其中，激光打孔、切割及刀具维修保养工序粉尘经设备自带除尘器处理后达标排放；机加工、车削加工废气经设备自带油雾净化器处理后达标排放；其他工序产生的有机废气、颗粒物、锡及化合物、酸性废气、碱性废气等，通过各设备的抽风口进行收集，经废气处理设施处理后通过排气筒达标排放。公司废气的处理及排放符合相关法律法规的要求。

#### 2、废水

公司在生产经营过程中外排废水主要为生活污水和冷却废水，经市政污水管网接入园区污水处理厂处理达标后排放。

#### 3、噪声

公司在生产经营过程中所产生的噪声主要为设备运行过程中产生的噪声，公司通过采用低噪声设备、厂区合理布局等措施后，噪声满足相关法律法规的要求。

#### 4、固体废物

公司在生产经营过程中产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾。危险废物主要生产过程中产生的废切削液、废润滑油、废包装容器、过滤蒸馏残渣、废油桶等，委托有资质的危险废物处理机构处理。一般工业固废主要为金属边角料、不合格品、废包装材料等，集中后统一处置。职工生活垃圾由当地环卫部门统一清运。公司固体废物的处置符合相关法律法规的要求。

## （二）公司环保投入情况和环保设施实际运行情况

报告期内，公司及子公司均按照环保相关要求配置污染处理措施，环保处理设施运作正常有效，能够保障有效处理公司生产经营所产生的污染。报告期内，发行人及其子公司环保投入金额分别为21.15万元、15.24万元、40.04万元和50.33万元，主要用于建设环保设施、购置环保设备及日常治污等。

## （三）公司环保合规情况

报告期内，公司严格遵守环境保护各项法律法规，在生产经营过程中未发生过严重违反环境保护相关法律法规的行为，也未受到过环保方面的行政处罚。

## （四）公司安全生产情况

公司不属于高危险行业。公司结合生产运营实际，组织建立了较为完善的安全生产管理制度体系，制定了安全生产相关的规章制度，并得到有效执行。报告期内，公司在生产经营过程中未发生过安全生产违法违规行为，也未受到过任何安全生产行政处罚。

## 九、发行人的境外经营及境外资产情况

公司涉及中国大陆以外的地区和国家的客户销售，为更好服务境外客户、开拓境外市场以及引入先进的技术，公司在境外设立了子公司香港韬盛、美国韬盛、韩国韬盛、BVI韬盛、开曼韬盛和新加坡韬盛，主要负责销售和研发等。相应子公司经营和财务情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、发行人控股及参股公司情况”。

## 第六节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据和相关的分析说明反映了公司报告期内经审计的财务状况、经营成果和现金流量。引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报告。

公司在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项标准为合并口径税前利润的5%，或金额虽未达到上述标准但公司认为较为重要的相关事项。

公司提醒投资者关注公司披露的财务报告、审计报告和全文，以获取详细的财务资料。

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	17,152.05	10,670.14	9,779.59	5,823.13
交易性金融资产	202.51	201.01	3,007.31	-
应收票据	982.41	912.49	142.01	149.02
应收账款	16,349.33	14,560.39	8,065.98	6,210.78
应收款项融资	1,198.59	485.84	145.22	36.79
预付款项	117.82	200.04	52.03	45.66
其他应收款	395.76	408.88	122.82	341.94
存货	8,902.54	7,343.49	4,665.90	4,340.22
其他流动资产	422.70	387.28	196.10	188.94
<b>流动资产合计</b>	<b>45,723.72</b>	<b>35,169.57</b>	<b>26,176.97</b>	<b>17,136.48</b>
<b>非流动资产：</b>				
固定资产	12,065.95	11,799.09	7,456.04	3,558.94
在建工程	4,411.21	2,622.05	1,078.38	1,447.46
使用权资产	1,713.84	1,638.67	1,199.96	1,048.38
无形资产	173.36	196.73	204.22	130.94
长期待摊费用	1,959.54	1,937.20	723.07	567.74
递延所得税资产	217.15	177.49	147.89	84.52

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
其他非流动资产	2,403.68	292.42	774.33	451.27
<b>非流动资产合计</b>	<b>22,944.73</b>	<b>18,663.65</b>	<b>11,583.90</b>	<b>7,289.25</b>
<b>资产总计</b>	<b>68,668.45</b>	<b>53,833.22</b>	<b>37,760.87</b>	<b>24,425.74</b>
<b>流动负债:</b>				
短期借款	0.77	500.91	500.86	1,979.77
应付账款	10,288.96	8,431.92	4,309.16	4,990.18
合同负债	46.14	357.22	160.06	104.14
应付职工薪酬	1,339.96	1,348.93	974.94	625.74
应交税费	656.07	606.08	563.20	702.29
其他应付款	238.38	180.53	92.96	73.28
一年内到期的非流动负债	3,854.42	4,734.87	2,928.75	1,277.76
其他流动负债	6.00	46.44	20.05	13.54
<b>流动负债合计</b>	<b>16,430.69</b>	<b>16,206.89</b>	<b>9,549.97</b>	<b>9,766.69</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	7,288.85	7,997.18	2,770.00	1,790.00
租赁负债	937.94	739.78	490.35	456.97
长期应付款	1,369.74	1,876.84	123.98	269.38
预计负债	337.82	589.93	335.35	324.52
递延收益	185.17	208.03	86.13	30.73
递延所得税负债	11.57	4.12	4.15	4.61
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,131.10</b>	<b>11,415.87</b>	<b>3,809.96</b>	<b>2,876.21</b>
<b>负债合计</b>	<b>26,561.79</b>	<b>27,622.77</b>	<b>13,359.93</b>	<b>12,642.90</b>
<b>所有者权益:</b>				
股本	3,279.93	3,060.93	3,060.93	2,623.43
资本公积	34,561.27	19,721.63	19,118.67	5,115.15
盈余公积	362.86	362.86	362.86	267.43
未分配利润	3,916.13	3,075.93	1,861.66	3,770.25
归属于母公司所有者权益合计	42,120.18	26,221.35	24,404.12	11,776.26
少数股东权益	-13.52	-10.89	-3.18	6.58
<b>所有者权益合计</b>	<b>42,106.66</b>	<b>26,210.45</b>	<b>24,400.94</b>	<b>11,782.83</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>68,668.45</b>	<b>53,833.22</b>	<b>37,760.87</b>	<b>24,425.74</b>

## (二) 合并利润表

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
一、营业收入	19,189.96	33,107.46	20,859.03	16,525.60
二、营业总成本	17,956.52	30,773.38	20,965.86	13,995.69
其中：营业成本	12,130.44	21,191.80	13,566.04	9,428.13
税金及附加	53.08	96.99	146.47	67.54
销售费用	1,020.25	2,103.80	1,457.00	996.03
管理费用	1,765.44	3,042.16	2,451.66	1,818.10
研发费用	2,707.10	3,933.22	3,071.56	1,533.29
财务费用	280.22	405.41	273.13	152.59
其中：利息费用	238.93	318.61	247.10	211.70
利息收入	33.54	99.11	89.60	41.71
加：其他收益	348.48	558.60	244.84	68.92
投资收益（损失以“-”号填列）	2.42	4.14	50.05	10.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1.50	1.01	7.31	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-97.20	-417.63	-106.42	-136.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-247.10	-469.54	-445.06	-209.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2.77	59.63	0.92	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,244.32	2,070.28	-355.20	2,263.95
加：营业外收入	0.04	0.01	0.01	0.00
减：营业外支出	12.88	3.59	0.07	9.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,231.47	2,066.69	-355.27	2,254.76
减：所得税费用	393.90	860.14	467.66	513.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	837.56	1,206.56	-822.92	1,741.67
（一）按经营持续性分类：				
1、持续经营净利润（净亏损	837.56	1,206.56	-822.92	1,741.67

项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
以“-”号填列)				
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
<b>(二) 按所有权归属分类:</b>				
1、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	840.20	1,214.27	-813.16	1,752.15
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2.63	-7.71	-9.76	-10.48
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>				
归属于母公司所有者的综合收益总额	840.20	1,214.27	-813.16	1,752.15
归属于少数股东的综合收益总额	-2.63	-7.71	-9.76	-10.48
<b>八、每股收益:</b>				
(一) 基本每股收益	0.27	0.40	-0.28	0.67
(二) 稀释每股收益	0.27	0.40	-0.28	0.67

**(三) 合并现金流量表**

单位: 万元

项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	17,710.00	35,972.91	25,389.07	16,026.49
收到的税费返还	42.68	431.30	529.52	40.96
收到其他与经营活动有关的现金	152.96	362.80	419.70	169.79
经营活动现金流入小计	17,905.63	36,767.01	26,338.29	16,237.24
购买商品、接受劳务支付的现金	9,374.87	24,314.23	16,872.42	8,988.12
支付给职工以及为职工支付的现金	5,883.92	9,020.69	6,522.15	4,835.55
支付的各项税费	625.33	1,471.60	1,734.75	655.62
支付其他与经营活动有关的现金	905.32	1,747.43	1,672.05	1,060.37
经营活动现金流出小计	16,789.45	36,553.95	26,801.38	15,539.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,116.18</b>	<b>213.06</b>	<b>-463.08</b>	<b>697.59</b>

项目	2025年 1-6月	2024年	2023年	2022年
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资收到的现金	500.00	6,707.31	1,500.00	4,400.00
取得投资收益收到的现金	2.42	4.14	50.05	10.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	502.42	6,711.45	1,550.05	4,410.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,062.10	9,052.68	5,104.35	2,851.40
投资支付的现金	500.00	3,900.00	4,500.00	4,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	6,562.10	12,952.68	9,604.35	7,251.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,059.69</b>	<b>-6,241.23</b>	<b>-8,054.30</b>	<b>-2,840.57</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
吸收投资收到的现金	14,730.00	-	14,500.00	3,247.05
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	17.05
取得借款收到的现金	4,484.52	10,566.67	3,505.42	2,950.56
收到其他与筹资活动有关的现金	1.34	3,100.00	-	-
筹资活动现金流入小计	19,215.86	13,666.67	18,005.42	6,197.62
偿还债务支付的现金	6,429.18	4,655.22	2,479.07	935.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153.84	219.38	1,150.23	108.79
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,153.35	1,707.58	1,811.60	4,122.65
筹资活动现金流出小计	7,736.37	6,582.17	5,440.90	5,167.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,479.49</b>	<b>7,084.49</b>	<b>12,564.52</b>	<b>1,030.43</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-54.07</b>	<b>-165.78</b>	<b>-90.68</b>	<b>78.97</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>6,481.92</b>	<b>890.55</b>	<b>3,956.46</b>	<b>-1,033.57</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	10,670.14	9,779.59	5,823.13	6,856.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>17,152.05</b>	<b>10,670.14</b>	<b>9,779.59</b>	<b>5,823.13</b>

#### （四）审计意见和关键审计事项

##### 1、审计意见

容诚会计师作为公司本次发行的财务审计机构，审计了公司财务报表，包括2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年1-6月、2024年度、2023年度、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2025]230Z4853号）。

##### 2、关键审计事项

容诚会计师在审计中识别出的关键审计事项具体如下：

关键审计事项	审计应对
<b>一、收入确认</b>	
<p>相关会计期间：2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月韬盛科技合并报表所列示的营业收入分别为16,525.60万元、20,859.03万元、33,107.46万元和19,189.96万元。</p> <p>由于收入是韬盛科技的关键业绩指标之一，从而存在公司管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此会计师将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>会计师针对韬盛科技销售产品收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计与执行有效性；了解和评价公司收入确认政策；</p> <p>（2）执行分析性复核程序，结合同行业和公司实际情况，分析销售收入波动及毛利率变动的合理性，识别是否存在异常情况；</p> <p>（3）选取样本，检查并核对销售合同或订单、发票、出库单、物流单、客户签收单或验收单等收入确认支持性文件；</p> <p>（4）选取样本对客户进行函证，函证内容包括当期销售金额及期末应收账款余额；</p> <p>（5）通过公开渠道查询重要客户的工商资料，包括重要客户的成立时间、注册资本、主营业务、股权结构、主要人员等信息，检查客户的真实性，以及考虑是否存在未识别的关联方关系迹象；</p> <p>（6）对重要客户进行现场走访，访谈客户相关人员，并就报告期间与客户的销售及收款情况进行确认；</p> <p>（7）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
<b>二、应收账款坏账准备的计提</b>	
<p>截至2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日及2025年6月30日，韬盛科技合并报表所列示的应收账款账面余额分别为6,539.16万元、8,501.03万元、15,367.65万元和17,258.29万元，坏账准备分别为</p>	<p>会计师针对韬盛科技应收账款减值执行的主要审计程序包括：</p> <p>（1）了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）针对管理层以前年度就坏账准备和减值准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；</p>

关键审计事项	审计应对
<p>328.38 万元、435.04 万元、807.26 万元和 908.96 万元，账面价值分别为 6,210.78 万元、8,065.98 万元、14,560.39 万元和 16,349.33 万元。</p> <p>由于管理层基于单项和组合并考虑不同类型客户的信用风险，评估应收账款的预期信用损失。由于在确定预期信用损失的过程中，对包括历史损失经验数据、宏观经济、行业风险及前瞻性信息等关键假设的评估涉及管理层运用重大会计估计和判断，会计师将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。</p>	<p>(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；</p> <p>(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款和合同资产预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备和减值准备的计算是否准确；</p> <p>(5) 结合应收账款函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备和减值准备的合理性；</p> <p>(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>

## （五）合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况

### 1、财务报表编制基础

#### （1）编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

#### （2）持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 2、合并报表范围及变化情况

报告期内，公司合并范围内子公司情况如下：

序号	合并报表范围	是否纳入合并范围			
		2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
1	苏州韬盛	是	是	是	是
2	苏州晶晟	是	是	是	是
3	香港韬盛	是	是	是	是
4	美国韬盛	是	是	是	是

序号	合并报表范围	是否纳入合并范围			
		2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
5	韩国韬盛	是	是	是	是
6	天津韬盛	是	是	是	否
7	BVI 韬盛	是	是	否	否
8	开曼韬盛	是	是	否	否
9	新加坡韬盛	是	是	否	否

## （六）分部信息

公司不呈报分部信息，按产品列示的主营业务收入情况详见本节之“六、经营成果分析”之“（二）营业收入分析”之“2、主营业务收入按业务类别分析”。

## 二、主要会计政策和会计估计

报告期内，公司全部会计政策和会计估计参见容诚会计师出具的《审计报告》（容诚审字[2025] 230Z4853 号），公司主要的会计政策及会计估计具体情况如下：

### （一）收入

#### 1、一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不

确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售,公司在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入,按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债;同时,按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,即应收退货成本,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日,公司重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进行重新计量。

### 质保义务

根据合同约定、法律规定等,本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证,本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证,本公司将其作为一项单项履约义务,按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例,将部分交易价格分摊至服务类质量保证,并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时,本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

### 客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的,首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回,且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时,本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的,按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入;否则,本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时,才将上述负债的相关余额转为收入。

## 2、具体方法

本公司与客户之间的销售商品合同,属于在某一时刻履行履约义务。

### ①国内销售

A、芯片测试接口及 WLCSP 探针卡按照双方约定将产品交付至客户指定地

点经客户签收后确认收入。

B、探针卡（除 WLCSP 探针卡）、测试设备按照双方约定完成交付并验收后确认收入。

## ②出口销售

A、芯片测试接口及 WLCSP 探针卡出口销售：在 FOB、CIF 结算条款下，公司在取得海关出口货物报关单时，按照报关单载明的出口日期确认销售收入的实现，在 DAP、DDP 结算条款下，公司在取得出口报关单，将货物运送至客户指定地点时确认销售收入的实现，采用 EXW 结算条款，在公司厂区内交货，以收货确认凭据的签收日期作为销售收入确认时点。

B、探针卡（除 WLCSP 探针卡）、测试设备按照双方约定完成交付并验收后确认收入。

## （二）金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买

卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## 2、金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产

终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入留存收益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。

## 3、金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类:

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益,当该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。

### ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指,当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后,对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外,金融负债与权益工具按照下列原则进行区分:

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

## 4、衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外,衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失,直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

## 5、金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

### ①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信

用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A.应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据确定组合的依据如下:

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。本公司评估银行承兑汇票无收回风险,不计提预期信用损失;商业承兑汇票预期信用损失的计提参照应收账款执行,应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。

应收账款、其他应收款确定组合的依据如下:

### 组合 1 合并范围内关联方组合

### 组合 2 账龄组合

对于划分为组合 1 的应收账款、其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合 2 的应收账款、其他应收款，本公司以账龄作为信用风险特征组合，按信用风险特征组合对第三方应收款项计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

### 应收款项融资组合 1 银行承兑汇票组合

对于划分为组合 1 的应收款项融资，本公司认为该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5.00%	5.00%
1-2 年	20.00%	20.00%
2-3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

### B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期

未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### 6、金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金

融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

## 7、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 8、金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见“（三）公允价值计量”

### （三）公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或

者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

#### ① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

#### ② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

### （四）存货

#### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程

中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。

## 2、发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用月末一次加权平均法计价。

## 3、存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

## 4、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损

益。

## 5、周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

### （五）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营

业周期,在“存货”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“其他流动资产”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

## (六) 固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

### 1、确认条件

固定资产在同时满足下列条件时,按取得时的实际成本予以确认:

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### 2、各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧,按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

对于已经计提减值准备的固定资产,在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了,公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命。

## (七) 在建工程

- 1、在建工程以立项项目分类核算。
- 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

## (八) 股份支付

### 1、股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### 2、权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。

②对于授予职工的股票期权,在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权,公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计。

### 4、股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

#### 以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### 5、股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

### 6、股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

### （九）其它重大特殊事项会计政策

报告期内，公司不存在其他重大特殊事项的会计政策。

### （十）报告期内重大会计政策/会计估计变更事项分析

报告期内，发行人重要会计政策变更均系因执行财政部新发布的相关规定所致，未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响；不存在重大会计估计变更和差错更正的情况。

## 三、非经常性损益情况

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的规定，容诚会计师对发行人的非经常性损益明细表进行了核验，出具了《非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2025] 230Z2177号），具体情况列示如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
非流动资产处置损益	2.43	56.05	0.92	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	62.65	93.95	134.11	62.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3.92	5.15	57.35	10.83
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-12.50	0.00	-0.06	-9.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-60.00	-63.74	-45.31

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
小计	56.50	95.15	128.58	18.48
减：所得税影响数（所得税费用减少以“-”表示）	4.55	22.47	26.56	9.05
<b>非经常性损益净额</b>	<b>51.94</b>	<b>72.68</b>	<b>102.02</b>	<b>9.43</b>
其中：归属于母公司股东的非经常性损益净额	51.93	72.68	102.02	9.43
归属于少数股东的非经常性损益净额	0.01	-0.00	-0.00	-0.00
<b>归属于母公司股东的净利润</b>	<b>840.20</b>	<b>1,214.27</b>	<b>-813.16</b>	<b>1,752.15</b>
<b>扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润</b>	<b>788.27</b>	<b>1,141.58</b>	<b>-915.18</b>	<b>1,742.71</b>
<b>非经常性损益占归属于母公司股东净利润的比例</b>	<b>6.18%</b>	<b>5.99%</b>	<b>-12.55%</b>	<b>0.54%</b>

报告期各期，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额为 9.43 万元、102.02 万元、72.68 万元和 51.93 万元。报告期内，公司非经常性损益主要由政府补助以及一次性确认的股份支付费用构成。

#### 四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况

##### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	13%、9%、6%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育附加	应纳流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表

公司合并范围内不同主体适用的企业所得税税率情况如下：

序号	纳税主体名称	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
1	韬盛科技	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
2	苏州韬盛	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%
3	苏州晶晟	15.00%	15.00%	25.00%	20.00%
4	天津韬盛	20.00%	20.00%	20.00%	不适用
5	韩国韬盛	应纳税所得额不超过 2.00 亿韩元时，所得税税率为 10.00%；2.00-200.00 亿韩元，所得税率为 20.00%；	应纳税所得额不超过 2.00 亿韩元时，所得税税率为 9.00%；2.00-200.00 亿韩元，所得税率为 19.00%；200.00-3000.00 亿韩元，所得税税率		

序号	纳税主体名称	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
		200.00-3000.00 亿韩元，所得税税率为 22.00%；超过 3000.00 亿韩元，所得税税率为 25.00%	为 21.00%；超过 3000.00 亿韩元，所得税税率为 24.00%		
6	香港韬盛	应纳税所得额不超过 200.00 万港币时，所得税税率为 8.25%，超过部分所得税税率为 16.50%			
7	美国韬盛	联邦所得税 21%，州所得税 8.84%	联邦所得税 21%，州所得税 8.84%	联邦所得税 21%，州所得税 8.84%	联邦所得税 21%，州所得税 8.84%
8	BVI 韬盛	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	开曼韬盛	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10	新加坡韬盛	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%

## （二）税收优惠情况

### 1、企业所得税

#### （1）高新技术企业税收优惠

2020年12月2日，子公司苏州韬盛取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202032007369，有效期三年）；2023年11月6日，苏州韬盛再次取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202332002106，有效期三年）。故报告期内苏州韬盛适用高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

2024年11月6日，子公司苏州晶晟取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202432000281，有效期三年）。故2024年至2025年6月，苏州晶晟适用高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

#### （2）企业所得税加计扣除优惠

根据财政部、税务总局、科技部《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部税务总局科技部公告2022年第28号），高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。子公司苏州韬盛为高新技术企业，2022年度可享受企业所得税加计扣除优惠政策。

根据《财政部税务总局科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》(财政部税务总局科技部公告 2022 年第 16 号)科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自 2022 年 1 月 1 日起,再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除,形成无形资产的,自 2022 年 1 月 1 日起,按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

根据《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》(财政部税务总局国家发展改革委工业和信息化部公告 2023 年第 44 号)的相关规定,集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间,再按照实际发生额的 120% 在税前扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的 220% 在税前摊销。子公司苏州晶晟 2024 年度享受该优惠政策。

### (3) 小微企业税收优惠

根据财政部、税务总局 2021 年 4 月 2 日联合颁发的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2021 年第 12 号),自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。

根据财政部、税务总局 2022 年 3 月 14 日联合颁发的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 13 号),自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、税务总局 2023 年 3 月 26 日联合颁发的《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 6 号),自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100

万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、税务总局 2023 年 8 月 2 日联合颁发的《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

2022 年度享受小微企业税收优惠的公司为苏州晶晟。2023 年度至 2025 年 6 月享受小微企业税收优惠的公司为天津韬盛。

## 2、增值税

根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税〔2023〕17 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业（以下称集成电路企业），按照当期可抵扣进项税额加计 15% 抵减应纳增值税税额。子公司苏州韬盛、苏州晶晟享受进项税额加计抵减政策。

## 3、其他优惠

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号），由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

2022 年度享受小微企业税收优惠的公司为苏州晶晟。2023 年度至 2025 年 6 月享受小微企业税收优惠的公司为天津韬盛。

#### 4、税收优惠对经营成果的影响

报告期内公司享受的税收优惠主要为企业所得税、增值税的优惠，该等税收优惠政策对报告期内公司经营成果不构成重大影响，公司对税收优惠不存在严重依赖。

### 五、主要财务指标

#### （一）主要财务指标

主要财务指标	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
流动比率（倍）	2.78	2.17	2.74	1.75
速动比率（倍）	2.24	1.72	2.25	1.31
资产负债率（合并）	38.68%	51.31%	35.38%	51.76%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	12.84	8.57	7.97	4.49
主要财务指标	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
利息保障倍数（倍）	6.15	7.49	-0.44	11.65
应收账款周转率（次）	2.35	2.77	2.77	2.60
存货周转率（次）	2.64	3.11	2.72	2.70
息税折旧摊销前利润（万元）	3,295.44	5,094.74	1,412.37	3,320.08
归属于发行人股东的净利润（万元）	840.20	1,214.27	-813.16	1,752.15
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	788.27	1,141.58	-915.18	1,742.71
研发投入占营业收入的比例	14.11%	11.88%	14.73%	9.28%
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.34	0.07	-0.15	0.27
每股净现金流量（元/股）	1.98	0.29	1.29	-0.39

注：指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=总负债/总资产；

归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的净资产/期末股本总额；

利息保障倍数=息税前利润/利息费用；

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，其中2025年1-6月数据已年化计算；

存货周转率=营业成本/存货平均余额，其中2025年1-6月数据已年化计算；

息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

归属于发行人股东的净利润=归属于母公司股东的净利润；

归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润=归属于母公司股东的净利润-非经常性损益的影响数；

研发投入占营业收入比例=研发费用/营业收入；

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；  
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额。

## (二) 净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,本公司加权平均净资产收益率及每股收益计算如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)			
	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
归属于公司普通股股东的净利润	2.46	4.80	-3.91	16.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.31	4.51	-4.40	16.55
报告期利润	基本每股收益(元/股)			
	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
归属于公司普通股股东的净利润	0.27	0.40	-0.28	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.25	0.37	-0.32	0.67
报告期利润	稀释每股收益(元/股)			
	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
归属于公司普通股股东的净利润	0.27	0.40	-0.28	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.25	0.37	-0.32	0.67

注:计算公式如下:

(1) 加权平均净资产收益率的计算公式如下:

加权平均净资产收益率=  $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$ , 其中:  $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;  $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润;  $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产;  $E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;  $E_j$  为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;  $M_0$  为报告期月份数;  $M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;  $M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;  $E_k$  为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;  $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 基本每股收益的计算公式如下:

基本每股收益=  $P_0 \div S$ ,  $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ , 其中:  $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;  $S$  为发行在外的普通股加权平均数;  $S_0$  为期初股份总数;  $S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;  $S_i$  为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;  $S_j$  为报告期因回购等减少股份数;  $S_k$  为报告期缩股数;  $M_0$  为报告期月份数;  $M_i$  为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;  $M_j$  为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(3) 稀释每股收益的计算公式如下:

稀释每股收益=  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换}$

债券等增加的普通股加权平均数)其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值。由于公司不存在稀释性潜在普通股, 故稀释性每股收益的计算与基本每股收益的计算结果相同。

## 六、经营成果分析

### (一) 报告期内经营情况概述

报告期内, 公司总体经营情况如下表所示:

单位: 万元

项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
营业收入	19,189.96	33,107.46	20,859.03	16,525.60
营业毛利	7,059.53	11,915.65	7,292.99	7,097.48
销售毛利率	36.79%	35.99%	34.96%	42.95%
营业利润	1,244.32	2,070.28	-355.20	2,263.95
利润总额	1,231.47	2,066.69	-355.27	2,254.76
净利润	837.56	1,206.56	-822.92	1,741.67
其中: 芯片测试业务	3,034.64	5,281.46	2,384.06	3,355.10
晶圆测试业务	-2,197.08	-4,074.90	-3,206.98	-1,613.43
净利润(剔除股份支付费用)	1,166.21	1,809.52	-348.78	1,974.74
归属于母公司股东的净利润	840.20	1,214.27	-813.16	1,752.15
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	788.27	1,141.58	-915.18	1,742.71

注: 报告期内公司分业务类型的财务数据引用自申报会计师出具的《关于上海韬盛电子科技股份有限公司分业务类型信息的专项核查报告》, 芯片测试业务包括芯片测试接口及测试设备的研发、生产和销售, 晶圆测试业务即探针卡的研发、生产和销售。

报告期各期, 公司分别实现营业收入 16,525.60 万元、20,859.03 万元、33,107.46 万元以及 19,189.96 万元, 2022 年至 2024 年的复合增长率达到 41.54%, 实现营业收入的快速增长, 取得了一定的经营成果, 公司营业收入增长的主要驱动因素如下:

#### 1、人工智能等新兴产业快速发展, 推动半导体测试接口需求持续增长

近年来, 人工智能、自动驾驶、物联网等新兴技术为全球半导体市场注入了增长新动能。根据 WSTS 数据, 2024 年全球半导体市场规模已达 6,280 亿美元, 较上年同期增长 19%。下游半导体市场的发展持续推动半导体测试接口需求的攀

升，而 GPU、AI 等高性能芯片的爆发式增长更进一步带动了高端芯片测试接口的强劲需求。Yole 数据显示，2024 年全球测试接口市场规模达到 51.26 亿美元，2025 年预计将达到 58.31 亿美元，增幅有望达到 13.75%。公司紧抓这一市场发展契机，不断夯实自身产品竞争力，积极开拓优质客户，报告期内营收规模实现逐年增长，2023 年和 2024 年收入增幅分别达到 26.22% 和 58.72%。

## 2、公司占据境内市场领先地位，品牌效应进一步增强，市场份额不断提升

公司是境内最早独立研发芯片测试接口并实现规模化量产的企业之一，并率先实现高端芯片测试接口的国产替代。在长期由境外厂商主导的半导体测试接口行业，公司凭借业内领先的技术实力、稳定可靠的产品质量、快速高效的响应服务赢得众多半导体客户的认可，2024 年度，公司成为境内收入规模排名第一的芯片测试接口企业。随着行业优势地位的持续巩固，公司的品牌效应进一步增强，逐步获得涵盖 GPU、CPU、AI 芯片等在内的高端数字芯片、存储芯片、自动驾驶芯片等多个领域更多半导体企业的认可，公司的营收规模逐年提升，并进一步夯实境内市场领先地位，为本土半导体产业链关键测试硬件自主可控提供有力支撑。

## 3、长期保持高强度研发创新，技术实力突出，产能规模进一步扩张

作为半导体测试环节的核心硬件，测试接口需要适配下游半导体产业的发展节奏与需求变化，随着下游先进制程、先进封装技术的发展，测试接口产品面临高密度、高频率、高耐温等复杂挑战，人工智能、自动驾驶等多元化应用场景也对测试接口提出更高个性化需求。公司长期保持高强度研发投入，依托掌握的先进测试探针设计技术、芯片测试接口阻抗精准匹配技术等一系列关键核心技术，针对不同类型客户的定制化测试需求，提供精准可靠的芯片测试接口产品解决方案，可满足各项严苛的技术要求。同时，基于下游客户旺盛的需求，公司积极扩产，报告期内产能实现翻倍式增长，为公司收入规模增长奠定基础。

报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 1,742.71 万元、-915.18 万元、1,141.58 万元以及 788.27 万元。报告期内，公司利润水平未与营收规模保持同步增长，总体呈现波动趋势，主要系公司在 MEMS 探针卡领域保持高强度研发投入，影响整体利润释放节奏。根据申报会计师出具

的《关于上海韬盛电子科技股份有限公司分业务类型信息的专项核查报告》，报告期内公司芯片测试业务实现净利润分别为 3,355.10 万元、2,384.06 万元、5,281.46 万元以及 3,034.64 万元，盈利能力良好。

## (二) 营业收入分析

### 1、营业收入的构成与变动分析

报告期内，公司营业收入的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	19,189.96	100.00%	33,107.46	100.00%	20,859.03	100.00%	16,525.60	100.00%
其他业务收入	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<b>19,189.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>33,107.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,859.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,525.60</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司营业收入分别为 16,525.60 万元、20,859.03 万元、33,107.46 万元以及 19,189.96 万元，收入规模持续增长，报告期内公司聚焦主业，无其他业务收入。

### 2、主营业务收入按业务类别分析

报告期内，公司主营业务收入按业务类别划分，构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
芯片测试接口业务	16,526.22	86.12%	28,618.57	86.44%	17,391.63	83.38%	13,829.95	83.69%
探针卡业务	1,575.65	8.21%	3,435.69	10.38%	1,702.05	8.16%	1,095.64	6.63%
测试设备业务	1,088.10	5.67%	1,053.19	3.18%	1,765.35	8.46%	1,600.01	9.68%
合计	<b>19,189.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>33,107.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,859.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,525.60</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司的主营业务收入主要为芯片测试接口、探针卡以及测试设备的销售收入。报告期各期，公司芯片测试接口的销售收入分别为 13,829.95 万元、17,391.63 万元、28,618.57 万元以及 16,526.22 万元，占营业收入的比重分别为 83.69%、83.38%、86.44% 以及 86.12%，是公司主要收入来源。

报告期内，公司逐步开拓探针卡业务，各期收入分别为 1,095.64 万元、1,702.05 万元、3,435.69 万元以及 1,575.65 万元，公司在探针卡业务领域陆续获得客户认可，收入规模逐年增长。

报告期公司来自测试设备的收入呈现一定的波动，主要与下游客户需求以及设备调试验收周期有关，各期收入分别为 1,600.01 万元、1,765.35 万元、1,053.19 万元以及 1,088.10 万元。

### （1）芯片测试接口业务

报告期内，公司芯片测试接口业务收入包括芯片测试接口以及相关配件，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年		2023 年		2022 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
芯片测试接口	13,894.19	84.07%	23,506.69	82.14%	13,734.08	78.97%	10,410.13	75.27%
其中：功能性测试接口	9,652.14	58.41%	18,147.51	63.41%	10,298.17	59.21%	8,217.33	59.42%
可靠性测试接口	4,242.05	25.67%	5,359.18	18.73%	3,435.91	19.76%	2,192.80	15.86%
芯片测试接口配件	2,632.03	15.93%	5,111.89	17.86%	3,657.55	21.03%	3,419.82	24.73%
<b>合计</b>	<b>16,526.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>28,618.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,391.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,829.95</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司来自芯片测试接口的销售收入快速增长，芯片测试接口配件的销售规模随芯片测试接口同步增长，配件主要为测试板、测试探针以及测试接口盖板等零部件。

报告期内，公司芯片测试接口的销售数量、销售单价情况如下：

项目	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
销售收入（万元）	13,894.19	23,506.69	13,734.08	10,410.13
销售数量（套）	32,124	53,972	56,477	28,649
销售单价（万元/套）	0.43	0.44	0.24	0.36

随着下游半导体客户需求的持续增长，公司进一步提升芯片测试接口产能，报告期内销售收入实现快速增长，销售数量呈现翻倍式提升。

公司所提供的芯片测试接口产品具有多品种、定制化的特点，公司需根据客户各类型芯片的参数性能等特点，并结合客户的测试需求，设计不同结构的芯片

测试接口，各类接口所需插入的探针数量亦有所差异，通常单个芯片测试接口插入探针数量越多，芯片测试接口的单价越高。近年来随着先进制程技术的持续迭代与突破，人工智能、GPU 等高性能运算芯片加速演进并广泛运用，多引脚、高集成等芯片复杂架构已逐步成为行业的发展趋势，公司生产的芯片测试接口复杂程度持续提升，芯片测试接口的销售单价也随之提升。

## （2）探针卡业务

报告期内，公司探针卡业务收入包括 MEMS 探针卡、WLCSP 探针卡、垂直探针卡以及相关部件，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
MEMS 探针卡	387.06	24.56%	1,733.68	50.46%	714.29	41.97%	178.95	16.33%
WLCSP 探针卡	1,013.92	64.35%	1,293.79	37.66%	692.64	40.69%	527.79	48.17%
垂直探针卡	8.18	0.52%	127.29	3.71%	55.62	3.27%	119.40	10.90%
探针卡部件	166.48	10.57%	280.94	8.18%	239.49	14.07%	269.51	24.60%
合计	<b>1,575.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,435.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,702.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,095.64</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司在探针卡业务领域保持高强度研发投入，伴随研发成果逐步实现产业化落地，公司来自探针卡业务的销售收入快速增长，尤其是 MEMS 探针卡业务，销售收入自 2022 年的 178.95 万元增长至 2024 年的 1,733.68 万元，成为公司新的收入增长点。

### ① MEMS 探针卡

报告期内，公司 MEMS 探针卡的销售数量、销售单价情况如下：

项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
销售收入（万元）	387.06	1,733.68	714.29	178.95
销售数量（张）	78	89	58	28
销售单价（万元/张）	4.96	19.48	12.32	6.39

报告期内公司在 MEMS 探针卡的研发取得突破性成果，并成功获得长江存储、客户 Z、翱捷股份等半导体知名客户的认可，销售收入实现大幅增长。公司

销售的 MEMS 探针卡存在定制化的特点，因此各期的销售单价存在一定差异。2023 年、2024 年公司销售的 MEMS 探针卡价格较高，主要是因为客户 Z、翱捷股份等客户的晶圆测试要求较为复杂，单张探针卡的装针数量较多，导致探针卡的销售单价较其他订单更高。此外，公司在 2024 年度成功实现针对存储领域的 2.5D MEMS 探针卡的销售，2.5D MEMS 探针卡的销售单价较部分 2D MEMS 探针卡更高，因此拉高了当年度整体 MEMS 探针卡的销售价格。

## ② WLCSP 探针卡

报告期内，公司 WLCSP 探针卡的销售数量、销售单价情况如下：

项目	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
销售收入（万元）	1,013.92	1,293.79	692.64	527.79
销售数量（张）	286	437	257	250
销售单价（万元/张）	3.55	2.96	2.70	2.11

报告期内，公司 WLCSP 探针卡的销售收入及销售数量逐年增长。受晶圆级封装等先进封装技术发展的影响，WLCSP 探针卡的设计制造难度日益增加，公司产品需满足下游客户超薄规格、高速稳定的晶圆级测试要求，公司销售高密度、多针数的探针卡数量逐年增加，因此 WLCSP 探针卡的销售单价逐年提升。

## 3、主营业务收入按应用领域分析

报告期内，公司主营业务收入按应用领域的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月		2024 年		2023 年		2022 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
人工智能	4,585.92	23.90%	7,614.17	23.00%	3,370.14	16.16%	3,103.74	18.78%
手机 SoC	4,455.85	23.22%	7,607.20	22.98%	2,478.46	11.88%	793.82	4.80%
消费电子	2,928.48	15.26%	4,982.90	15.05%	3,676.83	17.63%	3,631.84	21.98%
自动驾驶	2,373.64	12.37%	1,461.93	4.42%	848.47	4.07%	791.63	4.79%
信息通讯	1,749.65	9.12%	5,048.51	15.25%	4,958.23	23.77%	4,353.16	26.34%
先进存储	1,177.63	6.14%	2,958.32	8.94%	2,073.09	9.94%	1,112.13	6.73%
工业制造	1,040.61	5.42%	2,200.63	6.65%	2,455.69	11.77%	1,792.18	10.84%
其他	878.20	4.58%	1,233.81	3.73%	998.13	4.79%	947.10	5.73%
<b>合计</b>	<b>19,189.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>33,107.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,859.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,525.60</b>	<b>100.00%</b>

受益于人工智能等新兴产业的蓬勃发展、半导体国产化发展的良好态势，公司报告期内来自于 AI 芯片、GPU、CPU 等人工智能领域的收入实现快速增长，手机 SoC 领域的收入大幅提升，自动驾驶领域的收入增量也推动了公司整体收入规模的增长。

#### 4、主营业务收入按客户类型分析

报告期内，公司主营业务收入按客户类型的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
芯片设计	10,821.15	56.39%	18,712.47	56.52%	14,200.94	68.08%	9,369.90	56.70%
封装测试	6,734.45	35.09%	11,100.76	33.53%	4,077.52	19.55%	5,398.47	32.67%
实验室及科研机构	833.52	4.34%	1,993.80	6.02%	1,126.37	5.40%	773.93	4.68%
IDM	672.58	3.50%	922.81	2.79%	1,171.79	5.62%	704.61	4.26%
设备厂商及晶圆代工	128.26	0.67%	377.61	1.14%	282.41	1.35%	278.70	1.69%
合计	<b>19,189.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>33,107.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,859.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,525.60</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，芯片设计公司以及封装测试企业为公司的主要客户群体，公司来自于芯片设计公司、封装测试企业的合计收入占比分别达到 89.37%、87.63%、90.05%以及 91.48%。

#### 5、主营业务收入按区域分析

报告期内，公司主营业务收入分区域构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
境内	18,006.84	93.83%	31,012.81	93.67%	19,488.56	93.43%	14,688.85	88.89%
其中：华东地区	11,140.08	58.05%	17,475.39	52.78%	9,489.01	45.49%	7,844.15	47.47%
华南地区	3,182.56	16.58%	8,376.62	25.30%	5,622.51	26.95%	4,505.27	27.26%
华北地区	2,562.44	13.35%	3,409.22	10.30%	2,394.39	11.48%	1,570.33	9.50%
西南地区	239.20	1.25%	483.94	1.46%	483.46	2.32%	401.76	2.43%
华中地区	529.40	2.76%	821.79	2.48%	1,050.79	5.04%	146.95	0.89%

项目	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
西北地区	353.16	1.84%	445.85	1.35%	448.39	2.15%	220.38	1.33%
境外	1,183.12	6.17%	2,094.64	6.33%	1,370.47	6.57%	1,836.75	11.11%
合计	<b>19,189.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>33,107.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,859.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,525.60</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务收入以内销为主，境内收入各期占比分别为88.89%、93.43%、93.67%以及93.83%，其中，公司境内销售收入主要来自于华东地区、华南地区以及华北地区。报告期各期公司来自境外的销售收入占比分别为11.11%、6.57%、6.33%以及6.17%，外销收入有所波动。随着国内半导体市场的迅速发展，公司来自境内客户的收入占比逐年增长。

## 6、主营业务收入按销售模式分析

报告期内，公司销售收入均为直销，不存在经销等非直销销售方式。

## 7、主营业务收入的季节性变动

报告期内，公司各季度主营业务收入情况如下：

单位：万元

季度	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一季度	10,128.02	52.78%	6,210.69	18.76%	4,232.41	20.29%	2,848.19	17.24%
二季度	9,061.94	47.22%	8,555.73	25.84%	5,423.57	26.00%	3,753.04	22.71%
三季度	-	-	7,961.04	24.05%	4,893.26	23.46%	4,776.03	28.90%
四季度	-	-	10,379.99	31.35%	6,309.79	30.25%	5,148.34	31.15%
合计	<b>19,189.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>33,107.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,859.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,525.60</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务收入呈现出一定的季节性特征，下半年的收入占比略高于上半年收入。公司为下游客户提供的芯片测试接口、探针卡等产品用于新产品研发的测试验证或产品出厂前的测试环节，下游客户通常在年初制定经营计划，后续陆续投入研发以及生产，对测试接口及探针卡的需求量相对较大，因此公司下半年的收入占比相对较高。

### （三）营业成本分析

#### 1、营业成本结构分析

报告期内，公司营业成本的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	12,130.44	100.00%	21,191.80	100.00%	13,566.04	100.00%	9,428.13	100.00%
其他业务成本	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<b>12,130.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,191.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,566.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,428.13</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司主营业务成本金额分别为9,428.13万元、13,566.04万元、21,191.80万元以及12,130.44万元，公司无其他业务成本。

#### 2、主营业务成本按业务类别分析

报告期各期，公司主营业务成本按业务类别分类情况如下：

单位：万元

成本类型	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
芯片测试接口业务	9,828.96	81.03%	17,070.62	80.55%	10,627.78	78.34%	7,514.80	79.71%
探针卡业务	1,565.27	12.90%	3,393.40	16.01%	1,573.58	11.60%	863.40	9.16%
测试设备业务	736.21	6.07%	727.78	3.43%	1,364.68	10.06%	1,049.93	11.14%
合计	<b>12,130.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,191.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,566.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,428.13</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务成本的变动趋势与同期主营业务收入变动趋势相匹配，芯片测试接口成本是公司主营业务成本的主要构成。

#### 3、主营业务成本构成情况分析

报告期内，公司主营业务成本主要包括直接材料、直接人工、制造费用等，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

项目	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	7,330.49	60.43%	13,076.15	61.70%	8,606.53	63.44%	6,286.22	66.68%
直接人工	2,225.92	18.35%	3,633.18	17.14%	2,498.79	18.42%	1,506.76	15.98%
制造费用及其他	2,115.03	17.44%	3,476.54	16.41%	1,931.91	14.24%	1,276.28	13.54%
售后服务费	458.99	3.78%	1,005.93	4.75%	528.81	3.90%	358.87	3.81%
合计	<b>12,130.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>21,191.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,566.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,428.13</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用及其他、售后服务费构成。其中，直接材料主要为金属结构部件、探针等材料采购，直接人工主要为生产人员的职工薪酬，制造费用及其他包括设备折旧费用、委外加工以及运费等。报告期内，公司主营业务成本以直接材料为主，成本项目构成整体保持稳定，与产品销售结构相匹配。

#### （四）毛利及毛利率分析

##### 1、主营业务毛利分析

报告期各期，公司综合毛利情况如下表所示：

单位：万元

毛利类型	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务毛利	7,059.53	100.00%	11,915.65	100.00%	7,292.99	100.00%	7,097.48	100.00%
其他业务毛利	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<b>7,059.53</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,915.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,292.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,097.48</b>	<b>100.00%</b>

由上表可见，公司综合毛利均来自于主营业务。报告期各期，公司主营业务各产品的毛利及其占比情况如下：

单位：万元

毛利类型	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
芯片测试接口业务	6,697.25	94.87%	11,547.95	96.91%	6,763.86	92.74%	6,315.15	88.98%
探针卡业务	10.38	0.15%	42.29	0.35%	128.47	1.76%	232.24	3.27%
测试设备	351.89	4.98%	325.41	2.73%	400.67	5.49%	550.08	7.75%

毛利类型	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
业务								
合计	7,059.53	100.00%	11,915.65	100.00%	7,292.99	100.00%	7,097.48	100.00%

报告期内，公司主营业务毛利分别为 7,097.48 万元、7,292.99 万元、11,915.65 万元以及 7,059.53 万元，其中芯片测试接口的毛利占比在 85% 以上，是公司毛利的主要来源。

## 2、综合毛利率分析

报告期内，公司综合毛利率具体情况如下表所示：

项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
综合毛利率	36.79%	35.99%	34.96%	42.95%

报告期各期，公司综合毛利率分别为 42.95%、34.96%、35.99% 和 36.79%，2023 年以来毛利水平总体稳定。报告期内，公司主营业务的毛利率及收入占比情况如下：

产品类型	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
芯片测试接口业务	40.53%	86.12%	40.35%	86.44%	38.89%	83.38%	45.66%	83.69%
探针卡业务	0.66%	8.21%	1.23%	10.38%	7.55%	8.16%	21.20%	6.63%
测试设备业务	32.34%	5.67%	30.90%	3.18%	22.70%	8.46%	34.38%	9.68%
合计	36.79%	100.00%	35.99%	100.00%	34.96%	100.00%	42.95%	100.00%

## 3、分业务类型毛利率分析

报告期内，公司不同业务类型的毛利率变动情况具体如下：

### （1）芯片测试接口

报告期各期，公司芯片测试接口业务的毛利率分别为 45.66%、38.89%、40.35% 和 40.53%，具体来看，公司芯片接口业务毛利率情况如下表所示：

项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
----	-----------	-------	-------	-------

	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
芯片测试接口	40.15%	84.07%	39.11%	82.14%	38.36%	78.97%	45.47%	75.27%
其中：功能性测试接口	46.32%	58.41%	45.79%	63.41%	42.98%	59.21%	51.07%	59.42%
可靠性测试接口	25.80%	25.67%	14.66%	18.73%	22.84%	19.76%	25.84%	15.86%
芯片测试接口配件	42.50%	15.93%	46.06%	17.86%	40.88%	21.03%	46.25%	24.73%
<b>合计</b>	<b>40.53%</b>	<b>100.00%</b>	<b>40.35%</b>	<b>100.00%</b>	<b>38.89%</b>	<b>100.00%</b>	<b>45.66%</b>	<b>100.00%</b>

芯片测试接口业务主要由芯片测试接口构成，芯片测试接口毛利率 2023 年较 2022 年的下降幅度较大，2023 年以来，芯片测试接口业务的毛利率水平较为稳定，逐年略有提升。

其中，芯片测试接口的销售单价、单位成本、毛利率情况如下表所示：

项目	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
销售金额（万元）	13,894.19	23,506.69	13,734.08	10,410.13
数量（套）	32,124	53,972	56,477	28,649
单位售价（万元/套）	0.43	0.44	0.24	0.36
单位成本（万元/套）	0.26	0.27	0.15	0.20
毛利率	40.15%	39.11%	38.36%	45.47%

如上表所示，公司 2023 年芯片测试接口的销售单价较 2022 年下降 33.08%，而单位成本仅下降 24.35%，销售单价降幅超过单位成本降幅，导致当年度毛利率水平较 2022 年有所下滑。主要原因包括：一方面，半导体行业市场处于弱周期，下游客户更加注重成本管控，公司产品价格略有下降；另一方面，公司为进一步开拓重点客户长江存储等，应其测试需求承接数量较多设计结构简单、单位装针数量较少的测试接口订单，该类测试接口的单价及毛利空间较低。

2024 年以来，公司芯片测试接口的销售价格保持稳定，随着人工智能等高性能芯片的发展，下游客户对芯片测试的要求更高，芯片的复杂设计架构也导致测试接口的设计制造难度更高，销售单价同步提高；同时，公司持续改进生产工艺，测试接口中探针的自主生产比例进一步提高，毛利率也随之提升。

功能性测试接口主要用于芯片性能指标的测试，接口设计过程中需解决测试

过程中的信号辐射干扰、阻抗失配等难点，测试接口的结构设计相较于可靠性测试接口更为复杂，销售单价更高，毛利水平较可靠性测试接口更高。

## （2）探针卡业务

报告期各期，公司探针卡业务的毛利率分别为 21.20%、7.55%、1.23% 和 0.66%，具体来看，公司探针卡业务毛利率情况如下表所示：

项目	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
MEMS 探针卡	-35.56%	24.56%	-7.48%	50.46%	2.67%	41.97%	2.39%	16.33%
WLCSP 探针卡	16.05%	64.35%	14.20%	37.66%	12.64%	40.69%	20.78%	48.17%
垂直探针卡	-4.92%	0.52%	-9.03%	3.71%	-10.71%	3.27%	23.79%	10.90%
探针卡部件	-8.59%	10.57%	-0.11%	8.18%	11.61%	14.07%	33.35%	24.60%
合计	<b>0.66%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.23%</b>	<b>100.00%</b>	<b>7.55%</b>	<b>100.00%</b>	<b>21.20%</b>	<b>100.00%</b>

探针卡业务主要包括 MEMS 探针卡、WLCSP 探针卡、垂直探针卡以及相关部件。受 MEMS 探针卡影响，探针卡业务报告期内总体毛利率波动较大。探针卡业务主要产品的毛利率情况分析如下：

### ① MEMS 探针卡

MEMS 探针卡的销售单价、单位成本以及毛利率情况如下：

项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
销售金额（万元）	387.06	1,733.68	714.29	178.95
数量（张）	78	89	58	28
单位售价（万元/张）	4.96	19.48	12.32	6.39
单位成本（万元/张）	6.73	20.94	11.99	6.24
毛利率	-35.56%	-7.48%	2.67%	2.39%

报告期内，公司积极开拓 MEMS 探针卡业务，已成功实现销售，但总体来看目前 MEMS 探针卡的生产及销售规模较小，生产工艺尚不稳定，各订单的制造难度、投入成本等差异较大，受限于自制探针，MEMS 探针卡销售暂未稳定实现正毛利，且各年度的毛利率波动较大。

## ② WLCSP 探针卡

WLCSP 探针卡的销售单价、单位成本以及毛利率情况如下：

项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
销售金额（万元）	1,013.92	1,293.79	692.64	527.79
数量（张）	286	437	257	250
单位售价（万元/张）	3.55	2.96	2.70	2.11
单位成本（万元/张）	2.98	2.54	2.35	1.67
毛利率	16.05%	14.20%	12.64%	20.78%

报告期内，受具体型号销售结构差异、销售价格变动等因素影响，WLCSP 探针卡的毛利率呈现一定波动。2023年，在半导体行业整体严峻的市场环境下，为应对激烈的市场竞争并积极拓展客户，公司 WLCSP 探针卡的销售价格增幅不及单位成本增幅，导致当年度毛利率水平有所下降。2024年以来，随着晶圆级封装等技术的发展，WLCSP 探针卡设计结构的复杂度随客户要求持续提升，WLCSP 探针卡的销售单价及毛利率较以前年度总体增长。

## 4、毛利率同行业比较分析

报告期内，公司与同行业可比公司的综合毛利率比较情况如下表所示：

公司	综合毛利率（%）			
	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
颖崴科技（6515.TW）	48.85	43.70	37.06	45.33
Leeno（058470.KS）	51.13	49.67	50.21	47.96
和林微纳（688661.SH）	24.74	18.29	25.06	38.97
平均值	41.57	37.22	37.44	44.09
韬盛科技	<b>36.79</b>	<b>35.99</b>	<b>34.96</b>	<b>42.95</b>
韬盛科技芯片测试接口	<b>40.53</b>	<b>40.35</b>	<b>38.89</b>	<b>45.66</b>

注1：同行业可比公司数据来源为 Wind 及财务报告。

由上表可知，公司综合毛利率处于同行业可比公司的区间内，且毛利率变化趋势与同行业可比公司基本一致。受探针卡业务影响，报告期内公司综合毛利率相对较低，不及同行业可比公司的平均水平，报告期各期，公司芯片测试接口毛利率分别为 45.66%、38.89%、40.35% 以及 40.53%，与同行业可比公司均值较为相近。

同行业可比公司中,各家公司的毛利率差异主要受业务结构差异等因素的影响,其中,和林微纳毛利率水平较低,主要是其受消费电子行业影响较大,收入占比较高的精密结构件业务毛利空间较小。

### (五) 期间费用分析

报告期各期,公司的期间费用金额及占营业收入比例的变化情况如下表:

单位:万元

项目	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	1,020.25	5.32%	2,103.80	6.35%	1,457.00	6.99%	996.03	6.03%
管理费用	1,765.44	9.20%	3,042.16	9.19%	2,451.66	11.75%	1,818.10	11.00%
研发费用	2,707.10	14.11%	3,933.22	11.88%	3,071.56	14.73%	1,533.29	9.28%
财务费用	280.22	1.46%	405.41	1.22%	273.13	1.31%	152.59	0.92%
<b>合计</b>	<b>5,773.01</b>	<b>30.08%</b>	<b>9,484.59</b>	<b>28.65%</b>	<b>7,253.35</b>	<b>34.77%</b>	<b>4,500.02</b>	<b>27.23%</b>
股份支付费用	254.85	1.33%	462.77	1.40%	403.02	1.93%	197.82	1.20%
<b>剔除股份支付后</b>	<b>5,518.16</b>	<b>28.76%</b>	<b>9,021.82</b>	<b>27.25%</b>	<b>6,850.34</b>	<b>32.84%</b>	<b>4,302.19</b>	<b>26.03%</b>

报告期各期,公司期间费用合计分别为4,500.02万元、7,253.35万元、9,484.59万元以及5,773.01万元,占营业收入的比例分别为27.23%、34.77%、28.65%和30.08%。2023年公司期间费用率较高,一方面系当年度公司对核心员工实施股权激励,计入期间费用的股份支付金额合计为403.02万元,另一方面系公司2023年起大规模投入MEMS探针卡业务研发,研发费用率较以前年度大幅提升。剔除股份支付的影响后,报告期各期公司期间费用占营业收入的比例分别为26.03%、32.84%、27.25%和28.76%。

#### 1、销售费用

##### (1) 销售费用构成分析

报告期内,公司销售费用明细情况如下:

单位:万元

项目	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	663.04	64.99%	1,321.78	62.83%	858.51	58.92%	691.03	69.38%

项目	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
差旅办公费	111.51	10.93%	179.91	8.55%	131.60	9.03%	79.54	7.99%
样品费	21.08	2.07%	153.96	7.32%	95.32	6.54%	56.36	5.66%
股份支付费用	90.30	8.85%	130.42	6.20%	160.97	11.05%	86.90	8.72%
业务招待费	46.99	4.61%	117.18	5.57%	74.34	5.10%	35.86	3.60%
业务宣传费	60.77	5.96%	96.62	4.59%	99.99	6.86%	23.42	2.35%
折旧及摊销	17.78	1.74%	91.54	4.35%	21.03	1.44%	14.51	1.46%
其他	8.79	0.86%	12.40	0.59%	15.25	1.05%	8.40	0.84%
<b>合计</b>	<b>1,020.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,103.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,457.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>996.03</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司销售费用分别为 996.03 万元、1,457.00 万元、2,103.80 万元以及 1,020.25 万元，占营业收入的比例分别为 6.03%、6.99%、6.35% 和 5.32%。公司的销售费用主要为职工薪酬、差旅办公费等。报告期内，公司销售费用随业务规模扩大而逐年增加，销售团队进一步扩张，销售人员整体薪酬增加较多。

## （2）同行业可比公司销售费用率对比分析

报告期内，同行业可比公司销售费用率与发行人的对比情况如下：

公司	销售费用率			
	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
颖威科技 (6515.TW)	6.78%	8.00%	9.67%	6.65%
Leeno (058470.KS)	未披露	未披露	未披露	未披露
和林微纳 (688661.SH)	3.62%	4.43%	6.78%	4.86%
<b>平均值</b>	<b>5.20%</b>	<b>6.22%</b>	<b>8.23%</b>	<b>5.76%</b>
<b>发行人</b>	<b>5.32%</b>	<b>6.35%</b>	<b>6.99%</b>	<b>6.03%</b>

注：Leeno 未单独披露销售费用

报告期内，公司销售费用率总体与同行业可比公司销售费用率变动趋势一致，与平均值水平较为接近。其中，和林微纳主营业务包括半导体测试探针及 MEMS 精微电子零部件，客户群体与公司有所差异，且其客户集中度较高，销售费用率相对偏低。

## 2、管理费用

### （1）管理费用构成分析

报告期内，公司管理费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	709.81	40.21%	1,283.06	42.18%	1,117.65	45.59%	972.31	53.48%
折旧及摊销	405.17	22.95%	713.71	23.46%	402.02	16.40%	284.16	15.63%
水电及物业费	211.47	11.98%	313.58	10.31%	92.89	3.79%	33.46	1.84%
差旅办公费	123.73	7.01%	221.79	7.29%	195.15	7.96%	83.16	4.57%
咨询服务费	126.32	7.16%	113.07	3.72%	231.43	9.44%	95.96	5.28%
股份支付费用	81.82	4.63%	180.56	5.94%	123.67	5.04%	45.60	2.51%
业务招待费	38.89	2.20%	79.14	2.60%	66.55	2.71%	43.20	2.38%
其他	68.22	3.86%	137.25	4.51%	222.29	9.07%	260.24	14.31%
<b>合计</b>	<b>1,765.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,042.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,451.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,818.10</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期，公司管理费用分别为 1,818.10 万元、2,451.66 万元、3,042.16 万元以及 1,765.44 万元，占营业收入的比例分别为 11.00%、11.75%、9.19% 和 9.20%。公司的管理费用主要为职工薪酬、折旧及摊销、水电物业费等。

报告期内公司的管理费用率呈现一定波动，2022 年以及 2023 年管理费用占营业收入的比重较高。2021 年 6 月，公司新设立子公司苏州晶晟，进一步开展 MEMS 探针卡业务的研发，在子公司筹办期间，产生一定的开办费用计入 2022 年以及 2023 年的管理费用，这也导致当期管理费用中其他类别金额较大。随着业务规模的提升，公司管理费用率整体有所下降。

2024 年以来，公司管理费用中的折旧摊销费用以及水电物业费较以前年度大幅提升，主要系公司扩产搬入新厂区后新增较大金额的装修摊销费用、物业费。

### （2）同行业可比公司管理费用率对比分析

报告期内，同行业可比公司管理费用率与发行人的对比情况如下：

公司	管理费用率			
	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年

公司	管理费用率			
	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
颖崴科技 (6515.TW)	5.80%	6.41%	5.84%	7.17%
Leeno (058470.KS)	未披露	未披露	未披露	未披露
和林微纳 (688661.SH)	4.01%	5.95%	10.33%	8.77%
平均值	<b>4.91%</b>	<b>6.18%</b>	<b>8.09%</b>	<b>7.97%</b>
发行人	<b>9.20%</b>	<b>9.19%</b>	<b>11.75%</b>	<b>11.00%</b>

注：Leeno 未单独披露管理费用

报告期内，公司管理费用率高于同行业可比公司管理费用率平均值，主要由于公司当前仍处于快速发展阶段，经营规模小于同行业可比公司，业务规模效应尚未体现，因此管理费用率较同行业可比公司更高。

### 3、研发费用

#### (1) 研发费用构成及变动分析

单位：万元

项目	2025年1-6月		2024年		2023年		2022年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	1,067.81	39.44%	1,746.89	44.41%	1,412.96	46.00%	793.40	51.74%
材料费	1,094.02	40.41%	1,296.61	32.97%	896.34	29.18%	391.06	25.50%
折旧及摊销	404.83	14.95%	604.27	15.36%	444.67	14.48%	161.36	10.52%
股份支付费用	82.72	3.06%	151.79	3.86%	118.37	3.85%	65.32	4.26%
其他	57.71	2.13%	133.66	3.40%	199.21	6.49%	122.15	7.97%
合计	<b>2,707.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,933.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,071.56</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,533.29</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司研发费用分别为 1,533.29 万元、3,071.56 万元、3,933.22 万元以及 2,707.10 万元，占营业收入的比例分别为 9.28%、14.73%、11.88% 和 14.11%。报告期内，公司重视研发投入，研发费用金额持续增长。公司研发费用主要包括职工薪酬、材料费、折旧及摊销等，具体情况如下：

#### ① 职工薪酬

报告期内，公司研发费用中职工薪酬分别为 793.40 万元、1,412.96 万元、1,746.89 万元以及 1,067.81 万元，占当期研发费用的比例分别为 51.74%、46.00%、

44.41%和 39.44%，为公司研发费用的主要构成部分。随着业务开展的需求，报告期内公司持续扩充研发团队，引进优秀研发人员，研发费用中职工薪酬金额呈逐年增长趋势。

### ② 材料费

报告期内，公司研发费用中材料费分别为 391.06 万元、896.34 万元、1,296.61 万元以及 1,094.02 万元，占当期研发费用的比例分别为 25.50%、29.18%、32.97% 和 40.41%，2023 年以来公司陆续开展 MEMS 探针卡、空间转接基板等相关的研发活动，所需研发材料数量多，且多层复合陶瓷基板（MLC）、贵金属液等原材料较为昂贵，因此公司近年来研发领用的物料金额逐年增长。2025 年上半年公司领用的研发材料金额较高，主要系碳化硅 KGD 裸芯片测试分选机开发以及 4 英寸高密度多层陶瓷复合基板工艺开发等项目需领用物料进行实验以测试产品研发效果，以上项目消耗的研发物料价格昂贵且消耗较多所致。

### ③ 折旧摊销费

报告期内，公司研发费用中折旧摊销费分别为 161.36 万元、444.67 万元、604.27 万元以及 404.83 万元，主要包括设备折旧以及房屋租赁等使用权资产折旧，占当期研发费用的比例分别为 10.52%、14.48%、15.36% 和 14.95%。报告期内公司持续加大研发投入，并根据研发需求采购先进的机器设备，研发设备的折旧金额逐年增长。

## （2）研发费用分项目明细表

报告期内，公司主要研发项目（预算金额大于 100 万元）投入情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	整体预算	研发支出				研发阶段
			2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年	
1	MEMS 探针研发	3,000	548.20	890.95	541.12	403.39	研发进行中
2	Memory 2.5D Nand Flash 探针卡研发	2,000	30.41	604.34	634.82	102.80	研发进行中
3	大功率芯片高低温系统开发	900	63.08	86.94	240.26	150.72	研发进行中
4	碳化硅 KGD 裸芯片测试	800	197.41	250.19	12.78	-	研发进行中

序号	项目名称	整体预算	研发支出				研发阶段
			2025年 1-6月	2024年	2023年	2022年	
	分选机开发						
5	高密度同轴测试插座的开发	800	274.71	297.11	216.79	-	研发完成
6	高功耗大尺寸芯片老化测试插座	700	244.96	188.28	149.42	-	研发进行中
7	三温循环下疲劳寿命优化的测试插座开发	600	145.51	273.13	126.95	-	研发进行中
8	4英寸高密度多层陶瓷复合基板工艺开发	650	278.58	165.60	153.54	-	研发完成
9	MEMS颗粒互联装置产品研发	300	38.64	92.97	71.54	-	研发进行中
10	高密度 Mems 探针卡开发	500	191.48	228.17	-	-	研发进行中
11	高频高速等多场景测试探针开发及性能提升	500	150.14	215.36	-	-	研发进行中
12	自动化开合 socket 测试分选机开发	350	111.65	140.20	-	-	研发完成
13	弹簧探针自动抓取组装工艺及设备开发	300	119.34	10.26	-	-	研发进行中
14	3D MEMS 探针卡开发	3,000	84.53	3.92	-	-	研发进行中
15	2.5D MEMs DRAM 探针卡研发	800	204.37	-	-	-	研发进行中
17	4英寸高密度多层陶瓷基板工艺开发	200	-	36.68	110.19	25.29	研发完成
18	PCB 基板焊接工艺开发	300	-	91.07	106.96	40.82	研发完成
19	AI 芯片用探针卡研发	550	-	152.78	165.17	133.92	研发完成
20	弹簧探针倒置组装工艺开发	400	-	162.30	229.88	-	研发结束
21	新型测试探针开发及性能提升	300	-	-	157.31	90.18	研发完成
22	高速率同轴测试插座的开发	300	-	-	51.90	155.61	研发完成
23	紧凑型省力老化测试插座	200	-	-	49.82	104.24	研发完成
24	微间距超薄层叠封装测试插座的开发	300	-	-	37.05	103.62	研发完成
25	弹性导电胶体测试插座开发	150	-	-	16.06	45.20	研发完成
26	实验室双 Site 三温芯片自动分选机开发	200	-	-	-	95.16	研发结束
27	宽频带大电流异形针测试插座的开发	300	-	-	-	64.22	研发完成

### （3）同行业可比公司研发费用率对比分析

报告期内，同行业可比公司研发费用率与发行人的对比情况如下：

公司	研发费用率			
	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
颖崑科技 (6515.TW)	5.20%	5.99%	6.30%	4.97%
Leeno (058470.KS)	未披露	未披露	未披露	未披露
和林微纳 (688661.SH)	6.92%	10.01%	25.26%	18.66%
平均值	<b>6.06%</b>	<b>8.00%</b>	<b>15.78%</b>	<b>11.82%</b>
发行人	<b>14.11%</b>	<b>11.88%</b>	<b>14.73%</b>	<b>9.28%</b>

报告期内，公司研发费用率总体处于同行业可比公司研发费用率区间，相较于颖崑科技的研发费用率更高，与和林微纳报告期内的总体研发费用率较为相近。公司所处半导体测试接口行业需要密切跟踪下游半导体产业的技术变革，持续进行技术创新，公司与同行业可比公司一致，均长期保持高强度研发投入，与专注于芯片测试接口业务的颖崑科技相比，发行人报告期内持续加大对 MEMS 探针卡的研发投入，因此研发费用率相对较高。

#### 4、财务费用

报告期各期，公司财务费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
利息费用	238.93	318.61	247.10	211.70
减：利息收入	33.54	99.11	89.60	41.71
汇兑净损失	60.84	160.13	90.97	-32.25
其他	13.99	25.78	24.67	14.85
合计	<b>280.22</b>	<b>405.41</b>	<b>273.13</b>	<b>152.59</b>

报告期内，公司财务费用分别为 152.59 万元、273.13 万元、405.41 万元以及 280.22 万元，总体呈增长趋势，公司的财务费用主要由利息收支、汇兑损益等构成。随着业务规模的持续扩张，公司近年来资金需求量较大，借款规模的增加导致公司利息费用支出随之增长。此外，公司向境外供应商采购原材料主要以美元进行结算，2023 年以来人民币汇率下行明显，公司受汇率波动形成的汇兑

损失较多。

## （六）其他利润表重要项目分析

### 1、税金及附加

报告期各期，公司税金及附加分别为 67.54 万元、146.47 万元、96.99 万元和 53.08 万元，主要为城市维护建设税、教育费附加等。

### 2、其他收益

报告期各期，公司其他收益情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
政府补助	85.51	116.18	149.16	66.16
进项税加计扣除	257.87	437.02	93.98	-
个税扣缴税款手续费	5.11	5.40	1.70	2.76
<b>合计</b>	<b>348.48</b>	<b>558.60</b>	<b>244.84</b>	<b>68.92</b>

公司其他收益主要为与企业日常活动有关的政府补助以及进项税加计扣除。2024 年以来公司进项税加计扣除金额较以前年度显著增加，主要系享受集成电路企业增值税加计抵减政策。报告期各期，计入当期损益金额排名前五大的政府补助具体情况如下：

单位：万元

序号	政府补贴项目名称	与资产/ 收益相关	计入当期损益的金额			
			2025年 1-6月	2024年	2023年	2022年
1	第五批专精特新“小巨人”企业奖补	与收益相关	40.00	-	-	-
2	高企首次认定奖励	与收益相关	20.00	-	-	-
3	2022 年技改奖补	与资产相关	12.91	2.15	-	-
4	2021 年技改奖补	与资产相关	6.03	12.05	7.03	-
5	2021 年园区支持制造业企业有效投入奖补资金	与资产相关	3.93	8.02	8.02	4.01
6	省级研发机构认定奖励	与收益相关	-	25.00	-	-
7	2022 年度省级专精特新中小企业申报认定和 2019 年度省级专精特新企业奖励	与收益相关	-	20.00	-	-

8	省工程奖补	与收益相关	-	20.00	-	-
9	瞪羚培育工程企业成长奖励 2021	与收益相关	-	-	62.00	25.00
10	稳岗返还补贴	与收益相关	-	17.68	9.29	14.00
11	收到制造业第四批补助	与收益相关	-	-	-	10.00
12	留岗补贴	与收益相关	-	-	-	7.60
13	研发增长补助	与收益相关	-	-	-	5.25
14	2021 年度企业研发投入后补助资金	与收益相关	-	-	26.12	-
15	2022 年度省级研发机构认定奖励	与收益相关	-	-	25.00	-
16	租房补助	与收益相关	-	-	9.00	-
合计			<b>82.86</b>	<b>104.90</b>	<b>146.46</b>	<b>65.86</b>

### 3、投资收益

报告期各期，公司投资收益分别为 10.83 万元、50.05 万元、4.14 万元以及 2.42 万元，为公司购买银行理财取得的投资收益。

### 4、信用减值损失

报告期各期，公司信用减值损失情况（损失以“-”号填列）如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
应收票据坏账损失	13.19	-10.57	1.12	-1.10
应收账款坏账损失	-101.70	-374.88	-106.66	-105.06
其他应收款坏账损失	-8.69	-32.18	-0.88	-30.49
合计	<b>-97.20</b>	<b>-417.63</b>	<b>-106.42</b>	<b>-136.65</b>

报告期各期，公司信用减值损失分别为-136.65 万元、-106.42 万元、-417.63 万元以及-97.20 万元，主要为应收账款坏账损失，坏账计提金额随期末应收款项规模及账龄变动存在一定波动。2024 年度公司营业收入较以前年度大幅提升，应收账款规模较大，当期计提的应收账款坏账损失相应增加。

### 5、资产减值损失

报告期各期，公司资产减值损失分别为-209.07 万元、-445.06 万元、-469.54

万元以及-247.10万元，均为存货跌价损失。

## 6、纳税情况分析

### （1）所得税费用情况

报告期各期，公司所得税费用分别为 513.09 万元、467.66 万元、860.14 万元以及 393.90 万元，公司所得税缴纳的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
当期所得税费用	426.11	889.77	531.48	522.48
递延所得税费用	-32.21	-29.63	-63.83	-9.39
合计	<b>393.90</b>	<b>860.14</b>	<b>467.66</b>	<b>513.09</b>

### （2）按税种分项披露报告期公司应缴与实缴的税额情况

#### ① 增值税

单位：万元

期间	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2022年度	204.43	226.69	356.64	74.48
2023年度	74.48	873.18	1,016.15	-68.49
2024年度	-68.49	408.62	633.47	-293.34
2025年度1-6月	-293.34	198.68	225.94	-320.59

#### ② 企业所得税

单位：万元

期间	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2022年度	153.91	522.48	244.51	431.88
2023年度	431.88	531.48	559.68	403.68
2024年度	403.68	889.77	723.47	569.98
2025年度1-6月	569.98	426.11	389.93	606.16

公司适用的主要税率以及享受的税收优惠的具体情况详见本节“四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况”。

## 七、资产质量分析

### （一）资产构成及变动情况分析

报告期各期末公司的资产结构如下：

单位：万元

项目	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	17,152.05	24.98%	10,670.14	19.82%	9,779.59	25.90%	5,823.13	23.84%
交易性金融资产	202.51	0.29%	201.01	0.37%	3,007.31	7.96%	-	0.00%
应收票据	982.41	1.43%	912.49	1.70%	142.01	0.38%	149.02	0.61%
应收账款	16,349.33	23.81%	14,560.39	27.05%	8,065.98	21.36%	6,210.78	25.43%
应收款项融资	1,198.59	1.75%	485.84	0.90%	145.22	0.38%	36.79	0.15%
预付款项	117.82	0.17%	200.04	0.37%	52.03	0.14%	45.66	0.19%
其他应收款	395.76	0.58%	408.88	0.76%	122.82	0.33%	341.94	1.40%
存货	8,902.54	12.96%	7,343.49	13.64%	4,665.90	12.36%	4,340.22	17.77%
其他流动资产	422.70	0.62%	387.28	0.72%	196.10	0.52%	188.94	0.77%
<b>流动资产合计</b>	<b>45,723.72</b>	<b>66.59%</b>	<b>35,169.57</b>	<b>65.33%</b>	<b>26,176.97</b>	<b>69.32%</b>	<b>17,136.48</b>	<b>70.16%</b>
固定资产	12,065.95	17.57%	11,799.09	21.92%	7,456.04	19.75%	3,558.94	14.57%
在建工程	4,411.21	6.42%	2,622.05	4.87%	1,078.38	2.86%	1,447.46	5.93%
使用权资产	1,713.84	2.50%	1,638.67	3.04%	1,199.96	3.18%	1,048.38	4.29%
无形资产	173.36	0.25%	196.73	0.37%	204.22	0.54%	130.94	0.54%
长期待摊费用	1,959.54	2.85%	1,937.20	3.60%	723.07	1.91%	567.74	2.32%
递延所得税资产	217.15	0.32%	177.49	0.33%	147.89	0.39%	84.52	0.35%
其他非流动资产	2,403.68	3.50%	292.42	0.54%	774.33	2.05%	451.27	1.85%
<b>非流动资产合计</b>	<b>22,944.73</b>	<b>33.41%</b>	<b>18,663.65</b>	<b>34.67%</b>	<b>11,583.90</b>	<b>30.68%</b>	<b>7,289.25</b>	<b>29.84%</b>
<b>资产总计</b>	<b>68,668.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>53,833.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>37,760.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>24,425.74</b>	<b>100.00%</b>

从资产规模来看，2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司资产总额分别为24,425.74万元、37,760.87万元、53,833.22万元和68,668.45万元。报告期内，公司积极扩展业务布局，经营规模不断扩大，保持机器设备持续投入，应收账款、存货、固定资产及在建工程整体呈现上升趋势。总体来看，公司的资产规模及其变动符合实际业务发展情况和公司所处发展阶段的特征。

从资产结构来看，2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公

司流动资产占资产总额的比例分别为 70.16%、69.32%、65.33%和 66.59%，主要包括现金及其等价物、应收款项、存货等。非流动资产占资产总额的比例分别为 29.84%、30.68%、34.67%和 33.41%，主要包括固定资产、在建工程等。

## (二) 流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司流动资产构成如下：

单位：万元

项目	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	17,152.05	37.51%	10,670.14	30.34%	9,779.59	37.36%	5,823.13	33.98%
交易性金融资产	202.51	0.44%	201.01	0.57%	3,007.31	11.49%	-	0.00%
应收票据	982.41	2.15%	912.49	2.59%	142.01	0.54%	149.02	0.87%
应收账款	16,349.33	35.76%	14,560.39	41.40%	8,065.98	30.81%	6,210.78	36.24%
应收款项融资	1,198.59	2.62%	485.84	1.38%	145.22	0.55%	36.79	0.21%
预付款项	117.82	0.26%	200.04	0.57%	52.03	0.20%	45.66	0.27%
其他应收款	395.76	0.87%	408.88	1.16%	122.82	0.47%	341.94	2.00%
存货	8,902.54	19.47%	7,343.49	20.88%	4,665.90	17.82%	4,340.22	25.33%
其他流动资产	422.70	0.92%	387.28	1.10%	196.10	0.75%	188.94	1.10%
<b>流动资产合计</b>	<b>45,723.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,169.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>26,176.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,136.48</b>	<b>100.00%</b>

### 1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金主要由银行存款构成，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
库存现金	4.40	5.89	8.23	1.93
银行存款	17,147.66	10,664.24	9,771.36	5,821.21
其他货币资金	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>17,152.05</b>	<b>10,670.14</b>	<b>9,779.59</b>	<b>5,823.13</b>
其中：存放在境外的款项总额	361.81	433.87	451.32	109.27

报告期内，公司货币资金以银行存款为主，2025年6月末较2024年末增长较多，主要系2025年上半年公司引入新一轮外部投资者，股权融资金额到账导致当期末货币资金规模增加较多。报告期各期末，公司期末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产分别为 0 万元、3,007.31 万元、201.01 万元以及 202.51 万元，系公司为提高资金使用效率及收益，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下持有的银行理财产品。

## 3、应收票据及应收款项融资

### （1）应收票据

报告期各期末，公司应收票据的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
银行承兑汇票	913.85	810.08	23.60	9.30
商业承兑汇票	72.17	119.21	124.64	147.08
<b>小计</b>	<b>986.02</b>	<b>929.29</b>	<b>148.24</b>	<b>156.38</b>
坏账准备	3.61	16.80	6.23	7.35
<b>合计</b>	<b>982.41</b>	<b>912.49</b>	<b>142.01</b>	<b>149.02</b>

报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为 149.02 万元、142.01 万元、912.49 万元以及 982.41 万元，2024 年末、2025 年 6 月末公司应收票据规模较大，主要为银行承兑汇票，信用风险较低。报告期各期末，公司无已质押的应收票据，无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

### （2）应收款项融资

报告期各期末，公司应收账款融资的账面价值分别为 36.79 万元、145.22 万元、485.84 万元以及 1,198.59 万元，均为信用等级较高的银行开具的银行承兑汇票。

## 4、应收账款

报告期各期末，公司应收账款具体情况如下：

单位：万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
应收账款余额	17,258.29	15,367.65	8,501.03	6,539.16
应收账款坏账准备	908.96	807.26	435.04	328.38

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
应收账款净额	16,349.33	14,560.39	8,065.98	6,210.78
应收账款净额占流动资产的比例	35.76%	41.40%	30.81%	36.24%
营业收入	19,189.96	33,107.46	20,859.03	16,525.60
应收账款余额占营业收入比例	44.97%	46.42%	40.75%	39.57%

注：2025年6月末应收账款余额占营业收入比例已年化处理。

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为6,210.78万元、8,065.98万元、14,560.39万元和16,349.33万元，占流动资产的比例分别为36.24%、30.81%、41.40%和35.76%。报告期各期末，公司应收账款余额占当期营业收入的比例分别为39.57%、40.75%、46.42%和44.97%，应收账款规模随公司营业收入增长而增长，占比较为稳定。

#### (1) 应收账款坏账准备计提情况

报告期各期末，公司不存在单项计提坏账准备的应收账款情况，均为按账龄组合计提坏账准备的应收账款。报告期各期末，公司根据信用风险特征按组合计提坏账准备的情况如下：

单位：万元

账龄	2025.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比	金额	计提比例	
1年以内	17,021.47	98.63%	851.07	5.00%	16,170.40
1-2年	217.57	1.26%	43.51	20.00%	174.06
2-3年	9.75	0.06%	4.87	50.00%	4.87
3年以上	9.50	0.06%	9.50	100.00%	-
合计	17,258.29	100.00%	908.96	5.27%	16,349.33
账龄	2024.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比	金额	计提比例	
1年以内	15,159.13	98.64%	757.96	5.00%	14,401.18
1-2年	199.02	1.30%	39.80	20.00%	159.22
2-3年	-	-	-	-	-
3年以上	9.50	0.06%	9.50	100.00%	-

合计	15,367.65	100.00%	807.26	5.25%	14,560.39
账龄	2023.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比	金额	计提比例	
1年以内	8,453.41	99.44%	422.67	5.00%	8,030.74
1-2年	38.12	0.45%	7.62	20.00%	30.50
2-3年	9.50	0.11%	4.75	50.00%	4.75
3年以上	-	-	-	-	-
合计	8,501.03	100.00%	435.04	5.12%	8,065.98
种类	2022.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比	金额	计提比例	
1年以内	6,529.66	99.85%	326.48	5.00%	6,203.18
1-2年	9.50	0.15%	1.90	20.00%	7.60
2-3年	-	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-
合计	6,539.16	100.00%	328.38	5.02%	6,210.78

由上表可见，报告期各期公司账龄在 1 年以内的应收账款比例分别为 99.85%、99.44%、98.64% 以及 98.63%，公司主要客户为知名芯片设计公司、封测企业，客户资金实力强，信用情况良好，总体来看公司应收账款回款风险较小，报告期内应收账款期后回款情况良好。

公司与同行业公司的坏账准备计提比例对比情况如下：

公司	坏账准备计提比例					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
颖崑科技 (6515.TW)	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露
Leeno (058470.KS)	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露	未披露
和林微纳 (688661.SH)	5%	10%	30%	50%	80%	100%
发行人	5%	20%	50%	100%	100%	100%

注 1：Leeno 未披露具体坏账计提政策；

注 2：颖崑科技使用存续期间预期信用损失进行衡量，按照逾期天数分类披露信用损失率，根据其 2024 年年报披露信息：2024 年末，未逾期、逾期 30 天以下、逾期 31-60 天、逾期 61-90 天、逾期 91-180 天、逾期 181-365 天以及逾期 365 天以上的加权预期信用损失率分别为 0.04%、0.25%、1.81%、3.59%、3.50%、33.00% 以及 90.33%。

公司与同行业可比公司应收账款坏账准备实际计提比例的对比情况如下：

公司	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
颖崑科技 (6515.TW)	0.53%	0.45%	2.85%	1.25%
Leeno (058470.KS)	0.16%	0.23%	0.39%	0.30%
和林微纳 (688661.SH)	5.12%	5.14%	5.10%	5.02%
平均值	<b>1.94%</b>	<b>1.94%</b>	<b>2.78%</b>	<b>2.19%</b>
发行人	<b>5.27%</b>	<b>5.25%</b>	<b>5.12%</b>	<b>5.02%</b>

注：以上数据摘自同行业可比公司财务报表

由上表可见，公司应收账款坏账准备计提比例与境内同行业可比公司和林微纳较为相近，显著高于两家境外可比公司。公司已根据实际经营情况足额计提应收账款坏账准备，应收账款坏账准备计提政策合理、谨慎。

## （2）主要应收账款对象

报告期各期末，公司应收账款余额前五名对象情况如下：

单位：万元

2025.6.30				
序号	应收账款单位	关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例
1	地平线征程（上海）科技有限公司	非关联方	2,040.26	11.82%
2	矽品科技（苏州）有限公司	非关联方	1,673.95	9.70%
3	杭州芯云半导体集团有限公司	非关联方	1,470.46	8.52%
4	客户 X1	非关联方	1,366.93	7.92%
5	天津芯成测控技术有限公司	非关联方	623.76	3.61%
合计		-	<b>7,175.37</b>	<b>41.58%</b>
2024.12.31				
序号	应收账款单位	关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例
1	矽品科技（苏州）有限公司	非关联方	2,172.98	14.14%
2	客户 X1	非关联方	1,863.09	12.12%
3	杭州芯云半导体集团有限公司	非关联方	799.56	5.20%
4	芯云半导体（诸暨）有限公司	非关联方	616.05	4.01%
5	苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司	非关联方	568.63	3.70%
合计		-	<b>6,020.31</b>	<b>39.18%</b>

2023.12.31				
序号	应收账款单位	关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例
1	客户 X1	非关联方	1,661.29	19.54%
2	长江存储科技有限责任公司	非关联方	681.31	8.01%
3	矽品科技（苏州）有限公司	非关联方	584.11	6.87%
4	飞腾信息技术有限公司	非关联方	412.81	4.86%
5	上海安路信息科技股份有限公司	非关联方	270.31	3.18%
合计		-	<b>3,609.82</b>	<b>42.46%</b>
2022.12.31				
序号	应收账款单位	关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例
1	渠梁电子有限公司	非关联方	3,017.79	46.15%
2	矽品科技（苏州）有限公司	非关联方	348.11	5.32%
3	苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司	非关联方	313.02	4.79%
4	上海壁仞智能科技有限公司	非关联方	160.38	2.45%
5	中国电子科技集团公司第五十八研究所	非关联方	149.21	2.28%
合计		-	<b>3,988.51</b>	<b>60.99%</b>

报告期各期末，公司主要应收账款对象均为半导体行业内知名企业，期后回款情况良好。

## 5、预付款项

报告期各期末，公司预付款项分别为 45.66 万元、52.03 万元、200.04 万元和 117.82 万元，占流动资产的比例分别为 0.27%、0.20%、0.57%和 0.26%，金额及占比较小，公司的预付款项主要为预付原材料采购款。

## 6、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 341.94 万元、122.82 万元、408.88 万元和 395.76 万元，占流动资产的比例分别为 2.00%、0.47%、1.16%和 0.87%，主要为包括厂房租赁押金、融资租赁保证金在内的经常性保证金及押金等。

报告期各期末，其他应收款具体情况如下：

单位：万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
保证金及押金	492.52	482.83	165.11	205.99
备用金及借款	3.30	17.35	18.53	29.46
往来款及其他暂付款	4.35	4.43	2.73	169.15
<b>账面余额小计</b>	<b>500.17</b>	<b>504.61</b>	<b>186.37</b>	<b>404.60</b>
减：坏账准备	104.41	95.72	63.54	62.66
<b>账面价值小计</b>	<b>395.76</b>	<b>408.88</b>	<b>122.82</b>	<b>341.94</b>

## 7、存货

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 4,340.22 万元、4,665.90 万元、7,343.49 万元和 8,902.54 万元，占流动资产的比例分别为 25.33%、17.82%、20.88% 和 19.47%。

### (1) 存货构成及变动情况分析

报告期各期末，公司存货余额构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
原材料	6,323.83	62.94%	4,835.42	58.14%	3,050.62	57.24%	2,820.69	60.82%
在产品	1,256.80	12.51%	1,222.58	14.70%	710.65	13.34%	515.82	11.12%
半成品	943.41	9.39%	880.84	10.59%	996.15	18.69%	748.61	16.14%
发出商品	819.54	8.16%	743.43	8.94%	279.69	5.25%	325.54	7.02%
库存商品	558.35	5.56%	505.62	6.08%	196.30	3.68%	127.07	2.74%
周转材料	144.94	1.44%	128.49	1.54%	95.74	1.80%	97.88	2.11%
委托加工物资	0.09	0.00%	-	-	-	-	1.94	0.04%
<b>合计</b>	<b>10,046.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,316.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,329.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,637.55</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司存货主要由原材料、在产品以及半成品构成，整体随着业务规模的扩大而增加。原材料是公司存货的主要构成部分，包括金属结构部件、探针、非金属结构部件等，报告期各期，原材料余额分别为 2,820.69 万元、3,050.62 万元、4,835.42 万元以及 6,323.83 万元，占存货的比例分别为 60.82%、57.24%、58.14% 以及 62.94%。

## （2）存货跌价准备分析

报告期各期末，公司存货跌价准备的计提情况如下：

单位：万元

项目	2025.6.30			2024.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,323.83	662.26	5,661.56	4,835.42	624.00	4,211.42
在产品	1,256.80	-	1,256.80	1,222.58	-	1,222.58
半成品	943.41	138.24	805.17	880.84	104.67	776.18
发出商品	819.54	107.00	712.53	743.43	26.72	716.72
库存商品	558.35	202.30	356.06	505.62	181.75	323.87
周转材料	144.94	34.61	110.33	128.49	35.76	92.73
委托加工物资	0.09	-	0.09	-	-	-
<b>合计</b>	<b>10,046.95</b>	<b>1,144.41</b>	<b>8,902.54</b>	<b>8,316.38</b>	<b>972.89</b>	<b>7,343.49</b>
项目	2023.12.31			2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,050.62	442.53	2,608.09	2,820.69	180.67	2,640.02
在产品	710.65	-	710.65	515.82	-	515.82
半成品	996.15	125.06	871.09	748.61	88.47	660.14
发出商品	279.69	0.80	278.89	325.54	6.70	318.83
库存商品	196.30	67.68	128.61	127.07	21.49	105.59
周转材料	95.74	27.17	68.57	97.88	-	97.88
委托加工物资	-	-	-	1.94	-	1.94
<b>合计</b>	<b>5,329.15</b>	<b>663.25</b>	<b>4,665.90</b>	<b>4,637.55</b>	<b>297.33</b>	<b>4,340.22</b>

报告期各期末，公司存货跌价准备分别为 297.33 万元、663.25 万元、972.89 万元以及 1,144.41 万元，占存货账面余额的比例分别为 6.41%、12.45%、11.70% 和 11.39%。公司在报告期各期末对存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低值计量，并对可变现净值低于成本的部分计提跌价准备。报告期各期末，公司计提的存货跌价准备金额随存货规模增长而有所增加。

## 8、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 188.94 万元、196.10 万元、387.28

万元和 422.70 万元，占流动资产的比例分别为 1.10%、0.75%、1.10% 和 0.92%，主要为待抵扣进项税金，具体的明细如下：

单位：万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
待抵扣进项税金	337.10	293.34	181.24	149.11
其他	85.60	93.95	14.86	39.83
合计	<b>422.70</b>	<b>387.28</b>	<b>196.10</b>	<b>188.94</b>

### (三) 非流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司非流动资产构成如下：

单位：万元

项目	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	12,065.95	52.59%	11,799.09	63.22%	7,456.04	64.37%	3,558.94	48.82%
在建工程	4,411.21	19.23%	2,622.05	14.05%	1,078.38	9.31%	1,447.46	19.86%
使用权资产	1,713.84	7.47%	1,638.67	8.78%	1,199.96	10.36%	1,048.38	14.38%
无形资产	173.36	0.76%	196.73	1.05%	204.22	1.76%	130.94	1.80%
长期待摊费用	1,959.54	8.54%	1,937.20	10.38%	723.07	6.24%	567.74	7.79%
递延所得税资产	217.15	0.95%	177.49	0.95%	147.89	1.28%	84.52	1.16%
其他非流动资产	2,403.68	10.48%	292.42	1.57%	774.33	6.68%	451.27	6.19%
非流动资产合计	<b>22,944.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>18,663.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>11,583.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,289.25</b>	<b>100.00%</b>

#### 1、固定资产

##### (1) 固定资产构成情况

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
一、账面原值				
机器设备	16,386.78	15,154.35	9,583.37	4,990.64
运输工具	105.23	105.23	105.23	104.67
电子设备及其他	612.01	564.76	478.51	304.15
合计	<b>17,104.01</b>	<b>15,824.33</b>	<b>10,167.11</b>	<b>5,399.46</b>
二、累计折旧				

机器设备	4,588.70	3,626.06	2,383.50	1,592.69
运输工具	96.69	93.67	87.64	74.90
电子设备及其他	352.67	305.51	239.93	172.93
<b>合计</b>	<b>5,038.06</b>	<b>4,025.24</b>	<b>2,711.07</b>	<b>1,840.52</b>
<b>三、账面价值</b>				
机器设备	11,798.08	11,528.29	7,199.87	3,397.96
运输工具	8.54	11.56	17.59	29.77
电子设备及其他	259.34	259.25	238.58	131.22
<b>合计</b>	<b>12,065.95</b>	<b>11,799.09</b>	<b>7,456.04</b>	<b>3,558.94</b>
<b>综合成新率</b>	<b>70.54%</b>	<b>74.56%</b>	<b>73.33%</b>	<b>65.91%</b>

报告期各期末，公司固定资产原值分别为 5,399.46 万元、10,167.11 万元、15,824.33 万元和 17,104.01 万元，报告期内，随着公司经营规模的扩大，公司机器设备等固定资产逐年增加。

报告期内，公司固定资产主要为各类机器设备，是公司生产经营必需的资产。报告期内，公司固定资产运行状况良好，不存在减值的情形。截至 2025 年 6 月 30 日，公司固定资产的综合成新率为 70.54%。

## （2）固定资产折旧政策与同行业可比上市公司比较情况

同行业可比上市公司与发行人的固定资产折旧政策具体如下：

公司名称	类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率
颖威科技 (6515.TW)	房屋及建筑物	年限平均法	2-50	-
	机器设备	年限平均法	1-10	-
	其他设备	年限平均法	2-15	-
Leeno (058470.KS)	建筑物	年限平均法	40	-
	研究开发设备及运输设备	年限平均法	5	-
	机械设备	年限平均法	8	-
和林微纳 (688661.SH)	房屋及建筑物	年限平均法	20	5%
	机器机械设备	年限平均法	5-10	5%
	运输设备	年限平均法	3-5	5%
	电子设备	年限平均法	3-5	5%
	器具、工具、家具	年限平均法	5-10	5%
发行人	机器设备	年限平均法	5-10	5%

公司名称	类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率
	运输设备	年限平均法	4	5%
	电子设备及其他	年限平均法	3-5	5%

注：以上数据摘自同行业可比公司财务报表

公司固定资产折旧政策与实际经营情况相符，与同行业可比上市公司相比不存在重大差异。

## 2、在建工程

报告期各期，公司在建工程账面价值分别为 1,447.46 万元、1,078.38 万元、2,622.05 万元和 4,411.21 万元，占非流动资产的比例分别为 19.86%、9.31%、14.05%和 19.23%，报告期内公司的在建工程均为待安装设备。随着半导体行业的快速发展以及下游客户需求的持续增长，公司进一步扩大生产规模，并积极开拓探针卡等业务，报告期内新增采购较多生产所需的机器设备，在建工程规模总体大幅提升。

## 3、使用权资产

报告期内，公司使用权资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
<b>一、账面原值</b>				
房屋及建筑物	3,035.88	2,488.14	1,471.09	1,176.78
机器设备	-	216.93	496.03	279.10
<b>合计</b>	<b>3,035.88</b>	<b>2,705.07</b>	<b>1,967.12</b>	<b>1,455.88</b>
<b>二、累计折旧</b>				
房屋及建筑物	1,322.05	1,033.77	714.55	393.44
机器设备	-	32.63	52.60	14.06
<b>合计</b>	<b>1,322.05</b>	<b>1,066.40</b>	<b>767.15</b>	<b>407.50</b>
<b>三、账面价值</b>				
房屋及建筑物	1,713.84	1,454.38	756.53	783.34
机器设备	-	184.30	443.43	265.04
<b>合计</b>	<b>1,713.84</b>	<b>1,638.67</b>	<b>1,199.96</b>	<b>1,048.38</b>

报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 1,048.38 万元、1,199.96 万元、1,638.67 万元和 1,713.84 万元，占期末非流动资产的比例分别为 14.38%、

10.36%、8.78%和 7.47%，公司使用权资产主要为租赁房产以及融资租赁设备。

#### 4、无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 130.94 万元、204.22 万元、196.73 万元和 173.36 万元，占期末非流动资产的比例分别为 1.80%、1.76%、1.05% 和 0.76%，公司无形资产为产品设计及管理运营所需的软件，金额占比较小。

#### 5、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 567.74 万元、723.07 万元、1,937.20 万元和 1,959.54 万元，占非流动资产的比例分别为 7.79%、6.24%、10.38% 和 8.54%，公司长期待摊费用主要为待摊销的厂房装修费等。报告期内，公司长期待摊费用的具体构成如下：

单位：万元

工程名称	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
装修费	1,837.82	1,807.59	659.46	528.49
其他	121.72	129.61	63.61	39.25
合计	<b>1,959.54</b>	<b>1,937.20</b>	<b>723.07</b>	<b>567.74</b>

#### 6、递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产账面价值分别为 84.52 万元、147.89 万元、177.49 万元和 217.15 万元，占非流动资产的比例分别为 1.16%、1.28%、0.95% 和 0.95%。公司递延所得税资产主要由资产减值准备、信用减值准备、预计负债等事项导致。

#### 7、其他非流动资产

报告期各期末，其他非流动资产分别为 451.27 万元、774.33 万元、292.42 万元和 2,403.68 万元，占非流动资产的比例分别是 6.19%、6.68%、1.57% 和 10.48%，均为预付设备工程款。2025 年 6 月末公司其他非流动资产账面价值较大，主要由于公司不断扩张芯片测试接口产能，并进一步拓展探针卡业务，当期末预付机器设备款项大幅增加。

#### （四）资产周转能力分析

##### 1、应收账款周转率

公司及可比同行业上市公司应收账款周转率如下所示：

公司名称	应收账款周转率（次/年）			
	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
颖崴科技（6515.TW）	4.87	4.29	2.97	4.12
Leeno（058470.KS）	6.08	6.88	7.39	8.63
和林微纳（688661.SH）	4.04	3.53	3.15	4.25
平均值	<b>5.00</b>	<b>4.90</b>	<b>4.50</b>	<b>5.67</b>
发行人	<b>2.35</b>	<b>2.77</b>	<b>2.77</b>	<b>2.60</b>

注1：同行业可比公司数据来源为 Wind；

注2：2025年1-6月数据已进行年化处理。

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 2.60、2.77、2.77 和 2.35。报告期内，公司应收账款周转率低于同行业可比公司的平均值，与以上同行业公司相比，公司的经营规模较小，客户集中度较低，下游客户相对分散，总体应收账款周转水平偏低。

##### 2、存货周转率

公司及可比同行业上市公司存货周转率如下所示：

公司名称	存货周转率（次/年）			
	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
颖崴科技（6515.TW）	5.59	4.89	3.44	5.00
Leeno（058470.KS）	14.34	10.29	9.30	13.58
和林微纳 （688661.SH）	4.85	4.65	2.90	2.88
平均值	<b>8.26</b>	<b>6.61</b>	<b>5.21</b>	<b>7.15</b>
发行人	<b>2.64</b>	<b>3.11</b>	<b>2.72</b>	<b>2.70</b>

注1：同行业可比公司数据来源为 Wind；

注2：2025年1-6月数据已进行年化处理。

报告期各期，公司存货周转率分别为 2.70、2.72、3.11 和 2.64，公司的周转率水平低于同行业可比公司的平均值，与境内可比公司和林微纳的存货周转水平较为相近，且公司同时向客户提供探针卡及测试设备，探针卡及设备验收周期相对较长，导致公司整体存货周转率偏低。同行业可比公司中，Leeno 的存货周转

率较高主要由于其探针销售业务占比较大，探针的生产周期相较于测试接口更短，存货周转更快。

## 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

### (一) 负债构成及变动情况分析

报告期各期末，公司的负债结构如下：

单位：万元

项目	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	0.77	0.00%	500.91	1.81%	500.86	3.75%	1,979.77	15.66%
应付账款	10,288.96	38.74%	8,431.92	30.53%	4,309.16	32.25%	4,990.18	39.47%
合同负债	46.14	0.17%	357.22	1.29%	160.06	1.20%	104.14	0.82%
应付职工薪酬	1,339.96	5.04%	1,348.93	4.88%	974.94	7.30%	625.74	4.95%
应交税费	656.07	2.47%	606.08	2.19%	563.20	4.22%	702.29	5.55%
其他应付款	238.38	0.90%	180.53	0.65%	92.96	0.70%	73.28	0.58%
一年内到期的非流动负债	3,854.42	14.51%	4,734.87	17.14%	2,928.75	21.92%	1,277.76	10.11%
其他流动负债	6.00	0.02%	46.44	0.17%	20.05	0.15%	13.54	0.11%
<b>流动负债合计</b>	<b>16,430.69</b>	<b>61.86%</b>	<b>16,206.89</b>	<b>58.67%</b>	<b>9,549.97</b>	<b>71.48%</b>	<b>9,766.69</b>	<b>77.25%</b>
长期借款	7,288.85	27.44%	7,997.18	28.95%	2,770.00	20.73%	1,790.00	14.16%
租赁负债	937.94	3.53%	739.78	2.68%	490.35	3.67%	456.97	3.61%
长期应付款	1,369.74	5.16%	1,876.84	6.79%	123.98	0.93%	269.38	2.13%
预计负债	337.82	1.27%	589.93	2.14%	335.35	2.51%	324.52	2.57%
递延收益	185.17	0.70%	208.03	0.75%	86.13	0.64%	30.73	0.24%
递延所得税负债	11.57	0.04%	4.12	0.01%	4.15	0.03%	4.61	0.04%
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,131.10</b>	<b>38.14%</b>	<b>11,415.87</b>	<b>41.33%</b>	<b>3,809.96</b>	<b>28.52%</b>	<b>2,876.21</b>	<b>22.75%</b>
<b>负债合计</b>	<b>26,561.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,622.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,359.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,642.90</b>	<b>100.00%</b>

从负债规模来看，报告期各期末，公司负债总额分别为 12,642.90 万元、13,359.93 万元、27,622.77 万元和 26,561.79 万元。

从负债结构来看，报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 77.25%、71.48%、58.67% 和 61.86%，非流动负债占负债总额的比例分别为 22.75%、28.52%、41.33% 和 38.14%。公司流动负债主要包括应付账款、应付职

工薪酬、一年内到期的非流动负债等，非流动负债主要包括长期借款、长期应付款等。

## （二）流动负债构成及变动分析

报告期各期末，公司流动负债构成如下：

单位：万元

项目	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	0.77	0.00%	500.91	3.09%	500.86	5.24%	1,979.77	20.27%
应付账款	10,288.96	62.62%	8,431.92	52.03%	4,309.16	45.12%	4,990.18	51.09%
合同负债	46.14	0.28%	357.22	2.20%	160.06	1.68%	104.14	1.07%
应付职工薪酬	1,339.96	8.16%	1,348.93	8.32%	974.94	10.21%	625.74	6.41%
应交税费	656.07	3.99%	606.08	3.74%	563.20	5.90%	702.29	7.19%
其他应付款	238.38	1.45%	180.53	1.11%	92.96	0.97%	73.28	0.75%
一年内到期的非流动负债	3,854.42	23.46%	4,734.87	29.22%	2,928.75	30.67%	1,277.76	13.08%
其他流动负债	6.00	0.04%	46.44	0.29%	20.05	0.21%	13.54	0.14%
<b>流动负债合计</b>	<b>16,430.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,206.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,549.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,766.69</b>	<b>100.00%</b>

### 1、短期借款

报告期各期末，公司短期借款的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
保证借款	-	-	-	1,977.52
信用借款	0.77	500.48	500.41	0.57
未到期应付利息	-	0.43	0.44	1.67
<b>合计</b>	<b>0.77</b>	<b>500.91</b>	<b>500.86</b>	<b>1,979.77</b>

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 1,979.77 万元、500.86 万元、500.91 万元和 0.77 万元，2023 年以来公司更多地采用长期借款方式筹集日常经营所需资金，报告期内短期借款规模总体减少。

### 2、应付账款

报告期各期末，公司应付账款的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付货款	9,664.56	93.93%	7,974.06	94.57%	3,846.68	89.27%	4,203.14	84.23%
应付工程设备款	552.79	5.37%	430.33	5.10%	354.78	8.23%	737.61	14.78%
其他	71.62	0.70%	27.52	0.33%	107.70	2.50%	49.43	0.99%
<b>总计</b>	<b>10,288.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,431.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,309.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,990.18</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司应付账款账面价值分别为 4,990.18 万元、4,309.16 万元、8,431.92 万元和 10,288.96 万元，占各期末流动负债的比重分别为 51.09%、45.12%、52.03% 和 62.62%。公司应付账款主要为应付材料货款，随着公司经营规模扩大，原材料采购需求增加，应付账款余额总体呈增长趋势。

### 3、合同负债

报告期各期末，公司合同负债分别为 104.14 万元、160.06 万元、357.22 万元和 46.14 万元，占流动负债的比例分别为 1.07%、1.68%、2.20% 和 0.28%，均为预收的货款。

### 4、应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
短期薪酬	1,281.47	1,294.18	943.09	601.29
离职后福利-设定提存计划	13.48	13.75	11.73	24.44
辞退福利	45.01	41.00	20.12	-
<b>合计</b>	<b>1,339.96</b>	<b>1,348.93</b>	<b>974.94</b>	<b>625.74</b>

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 625.74 万元、974.94 万元、1,348.93 万元和 1,339.96 万元，占流动负债的比例分别为 6.41%、10.21%、8.32% 和 8.16%，主要由短期薪酬构成，其变动与公司职工人数、薪酬标准及激励制度相关。报告期各期末公司应付职工薪酬金额整体呈增长趋势，主要系公司经营规模扩大使得员工人数有所增长。

## 5、应交税费

报告期各期末，公司应交税费的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
企业所得税	606.16	569.98	403.68	431.88
个人所得税	21.64	23.73	15.73	3.33
增值税	16.51	-	112.75	223.59
印花税	4.39	4.49	4.35	2.10
城市维护建设税	4.30	4.59	15.57	24.15
教育费附加	1.84	1.97	6.67	10.35
地方教育附加	1.23	1.31	4.45	6.90
<b>合计</b>	<b>656.07</b>	<b>606.08</b>	<b>563.20</b>	<b>702.29</b>

报告期各期末，公司应交税费金额分别为 702.29 万元、563.20 万元、606.08 万元和 656.07 万元，占流动负债的比例分别为 7.19%、5.90%、3.74% 和 3.99%，公司应交税费主要由企业所得税、应交代扣代缴个人所得税构成。

## 6、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款明细如下：

单位：万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
费用款	221.06	167.17	77.80	52.25
代扣代缴款	17.32	13.36	15.15	21.03
<b>合计</b>	<b>238.38</b>	<b>180.53</b>	<b>92.96</b>	<b>73.28</b>

报告期各期末，公司其他应付款分别为金额 73.28 万元、92.96 万元、180.53 万元以及 238.38 万元，金额较小，主要由待付房租水电费、待付报销款等构成。

## 7、一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
一年内到期的长期借款	1,962.72	2,703.22	2,013.85	492.37
一年内到期的长期应付款	1,048.94	1,219.79	554.76	350.76

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
一年内到期的租赁负债	842.75	811.87	360.13	434.63
合计	3,854.42	4,734.87	2,928.75	1,277.76

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债金额分别为 1,277.76 万元、2,928.75 万元、4,734.87 万元和 3,854.42 万元，占流动负债的比例分别为 13.08%、30.67%、29.22%和 23.46%，由一年内到期的长期借款、长期应付款以及租赁负债构成。随着公司经营规模不断扩大，报告期各期末公司一年内到期的非流动负债金额总体呈增长趋势。

## 8、其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债金额分别为 13.54 万元、20.05 万元、46.44 万元和 6.00 万元，占流动负债的比例分别为 0.14%、0.21%、0.29%和 0.04%，由待转销项税额构成。

### (三) 非流动负债构成及变动分析

报告期各期末，公司非流动负债构成如下：

单位：万元

项目	2025.6.30		2024.12.31		2023.12.31		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	7,288.85	71.95%	7,997.18	70.05%	2,770.00	72.70%	1,790.00	62.23%
租赁负债	937.94	9.26%	739.78	6.48%	490.35	12.87%	456.97	15.89%
长期应付款	1,369.74	13.52%	1,876.84	16.44%	123.98	3.25%	269.38	9.37%
预计负债	337.82	3.33%	589.93	5.17%	335.35	8.80%	324.52	11.28%
递延收益	185.17	1.83%	208.03	1.82%	86.13	2.26%	30.73	1.07%
递延所得税负债	11.57	0.11%	4.12	0.04%	4.15	0.11%	4.61	0.16%
非流动负债合计	10,131.10	100.00%	11,415.87	100.00%	3,809.96	100.00%	2,876.21	100.00%

#### 1、长期借款

报告期各期末，公司长期借款的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
----	-----------	------------	------------	------------

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
保证借款	-	-	1,340.00	1,780.00
信用借款	9,246.44	10,691.30	3,440.00	500.00
长期借款应计利息	5.13	9.09	3.85	2.37
<b>小计</b>	<b>9,251.57</b>	<b>10,700.40</b>	<b>4,783.85</b>	<b>2,282.37</b>
减：一年内到期的长期借款	1,962.72	2,703.22	2,013.85	492.37
<b>合计</b>	<b>7,288.85</b>	<b>7,997.18</b>	<b>2,770.00</b>	<b>1,790.00</b>

报告期各期末，公司长期借款余额分别为 1,790.00 万元、2,770.00 万元、7,997.18 万元和 7,288.85 万元，是非流动负债的主要构成部分。随着公司建设投入的不断扩大，报告期各期末公司长期借款余额大幅增加。

## 2、租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债金额分别为 456.97 万元、490.35 万元、739.78 万元和 937.94 万元，占非流动负债的比例分别为 15.89%、12.87%、6.48% 和 9.26%，由公司承租房产以及融资设备租赁形成。

## 3、长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款分别为 269.38 万元、123.98 万元、1,876.84 万元和 1,369.74 万元，占非流动负债的比例分别为 9.37%、3.25%、16.44% 和 13.52%，均为应付租赁款。

## 4、预计负债

报告期各期末，公司预计负债金额分别为 324.52 万元、335.35 万元、589.93 万元和 337.82 万元，占非流动负债的比例分别为 11.28%、8.80%、5.17% 和 3.33%，主要系公司计提的产品质量保证费用。报告期内，公司预计负债规模持续增长，与公司业务规模变动趋势相匹配。

## 5、递延收益

报告期各期末，公司递延收益金额分别为 30.73 万元、86.13 万元、208.03 万元和 185.17 万元，占非流动负债的比例分别为 1.07%、2.26%、1.82% 和 1.83%，均为需进行摊销的与资产相关的政府补助。

#### （四）偿债能力分析

##### 1、主要偿债能力指标

报告期内，公司营业收入、净利润总体呈增长趋势，盈利能力进一步提升。报告期内，公司未发生无法偿还到期债务的情况。

报告期内反映公司偿债能力的主要财务指标如下：

项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
流动比率（倍）	2.78	2.17	2.74	1.75
速动比率（倍）	2.24	1.72	2.25	1.31
资产负债率（合并）	38.68%	51.31%	35.38%	51.76%
项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
息税折旧摊销前利润（万元）	3,295.44	5,094.74	1,412.37	3,320.08
利息保障倍数（倍）	6.15	7.49	-0.44	11.65

报告期各期，公司流动比率分别为 1.75 倍、2.74 倍、2.17 倍和 2.78 倍，速动比率分别为 1.31 倍、2.25 倍、1.72 倍和 2.24 倍，合并口径资产负债率分别为 51.76%、35.38%、51.31% 和 38.68%。

报告期内，公司流动比率和速动比率有所波动，总体指标良好。报告期内公司经营规模持续扩大，息税折旧摊销前利润总体增长，利息保障倍数整体处于较高水平，公司具备良好的偿债能力。

报告期内，公司生产经营规模不断扩大，持续加大业务投资布局，同时公司在报告期内开展对外融资，导致资产负债率在报告期内呈现一定波动。公司银行资信状况良好，未来将在继续与金融机构保持良好合作关系的同时，进一步借助资本市场融资，拓宽融资渠道，提高偿债能力，维持合理的财务杠杆水平。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在表外融资的情况，亦无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

##### 2、与同行业可比公司的比较

公司与同行业可比公司偿债能力指标对比情况如下：

公司	流动比率（倍）			
	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31

颖崴科技（6515.TW）	2.26	2.78	2.43	2.03
Leeno（058470.KS）	8.01	14.68	16.11	10.36
和林微纳（688661.SH）	3.90	5.30	7.34	16.41
平均值	<b>4.72</b>	<b>7.59</b>	<b>8.63</b>	<b>9.60</b>
发行人	<b>2.78</b>	<b>2.17</b>	<b>2.74</b>	<b>1.75</b>
公司	速动比率（倍）			
	<b>2025.6.30</b>	<b>2024.12.31</b>	<b>2023.12.31</b>	<b>2022.12.31</b>
颖崴科技（6515.TW）	2.00	2.37	1.84	1.64
Leeno（058470.KS）	7.79	14.26	15.50	10.00
和林微纳（688661.SH）	3.42	4.76	6.82	15.48
平均值	<b>4.40</b>	<b>7.13</b>	<b>8.05</b>	<b>9.04</b>
发行人	<b>2.24</b>	<b>1.72</b>	<b>2.25</b>	<b>1.31</b>
公司	资产负债率（合并）（%）			
	<b>2025.6.30</b>	<b>2024.12.31</b>	<b>2023.12.31</b>	<b>2022.12.31</b>
颖崴科技（6515.TW）	33.47	26.91	28.43	35.15
Leeno（058470.KS）	9.07	5.30	4.43	7.21
和林微纳（688661.SH）	18.97	14.15	11.16	6.14
平均值	<b>20.50</b>	<b>15.45</b>	<b>14.67</b>	<b>16.17</b>
发行人	<b>38.68</b>	<b>51.31</b>	<b>35.38</b>	<b>51.76</b>

注：同行业可比公司数据来源为 Wind 资讯、年报、招股说明书及问询函回复。

报告期内，公司流动比率、速动比率低于同行业可比公司平均值，主要系公司目前仍处于快速发展阶段，经营规模不及其他可比公司，总体偿债能力相对偏低。同时，报告期内公司的资产负债率高于同行业可比公司的平均值，主要系公司与上市公司相比，融资渠道更多依赖于银行借款等有息负债。

#### （五）报告期内股利分配的具体实施情况

2023年5月，公司2023年第三次临时股东大会决议通过《关于上海韬盛电子科技股份有限公司分红的议案》，按现有股东持股比例进行利润分配，合计分配金额为1,000万元。

除上述情况外，公司报告期内不存在其他分配利润的情况。

#### （六）现金使用分析

报告期各期，公司的现金流量基本情况如下所示：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
经营活动现金流入小计	17,905.63	36,767.01	26,338.29	16,237.24
经营活动现金流出小计	16,789.45	36,553.95	26,801.38	15,539.65
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,116.18</b>	<b>213.06</b>	<b>-463.08</b>	<b>697.59</b>
投资活动现金流入小计	502.42	6,711.45	1,550.05	4,410.83
投资活动现金流出小计	6,562.10	12,952.68	9,604.35	7,251.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,059.69</b>	<b>-6,241.23</b>	<b>-8,054.30</b>	<b>-2,840.57</b>
筹资活动现金流入小计	19,215.86	13,666.67	18,005.42	6,197.62
筹资活动现金流出小计	7,736.37	6,582.17	5,440.90	5,167.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,479.49</b>	<b>7,084.49</b>	<b>12,564.52</b>	<b>1,030.43</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-54.07	-165.78	-90.68	78.97
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>6,481.92</b>	<b>890.55</b>	<b>3,956.46</b>	<b>-1,033.57</b>

### 1、经营活动产生的现金流量情况

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
销售商品、提供劳务收到的现金	17,710.00	35,972.91	25,389.07	16,026.49
收到的税费返还	42.68	431.30	529.52	40.96
收到其他与经营活动有关的现金	152.96	362.80	419.70	169.79
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>17,905.63</b>	<b>36,767.01</b>	<b>26,338.29</b>	<b>16,237.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	9,374.87	24,314.23	16,872.42	8,988.12
支付给职工以及为职工支付的现金	5,883.92	9,020.69	6,522.15	4,835.55
支付的各项税费	625.33	1,471.60	1,734.75	655.62
支付其他与经营活动有关的现金	905.32	1,747.43	1,672.05	1,060.37
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>16,789.45</b>	<b>36,553.95</b>	<b>26,801.38</b>	<b>15,539.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,116.18</b>	<b>213.06</b>	<b>-463.08</b>	<b>697.59</b>
营业收入	19,189.96	33,107.46	20,859.03	16,525.60
净利润	837.56	1,206.56	-822.92	1,741.67
<b>销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入</b>	<b>92.29%</b>	<b>108.66%</b>	<b>121.72%</b>	<b>96.98%</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额/净利润</b>	<b>133.27%</b>	<b>17.66%</b>	<b>56.27%</b>	<b>40.05%</b>

**(1) 销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入比较分析**

报告期各期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 16,026.49 万元、25,389.07 万元、35,972.91 万元和 17,710.00 万元，占当期营业收入的比例分别为 96.98%、121.72%、108.66% 和 92.29%，公司销售回款情况良好。

**(2) 经营活动产生的现金流量变动及与净利润比较分析**

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 697.59 万元、-463.08 万元、213.06 万元和 1,116.18 万元，与净利润的比例分别为 40.05%、56.27%、17.66% 和 133.27%，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的勾稽关系如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
净利润	837.56	1,206.56	-822.92	1,741.67
加：资产减值准备	247.10	469.54	445.06	209.07
信用减值损失	97.20	417.63	106.42	136.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,019.34	1,366.06	870.55	414.86
使用权资产折旧	392.71	792.21	403.91	292.68
无形资产摊销	23.37	46.36	32.51	19.72
长期待摊费用摊销	389.62	504.80	213.57	126.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2.77	-59.63	-0.92	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.34	3.59	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1.50	-1.01	-7.31	-
财务费用（收益以“-”号填列）	306.48	494.80	353.82	193.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-2.42	-4.14	-50.05	-10.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-39.67	-29.60	-63.37	-14.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7.46	-0.03	-0.46	4.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,806.15	-3,147.13	-770.75	-2,311.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,440.57	-8,262.32	-1,948.11	-636.88

项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,759.43	5,812.41	300.81	298.38
其他	328.64	602.96	474.15	233.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,116.18</b>	<b>213.06</b>	<b>-463.08</b>	<b>697.59</b>

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要受固定资产折旧、使用权资产折旧、财务费用、经营性应收项目、经营性应付项目等变动影响。

## 2、投资活动产生的现金流量情况

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
收回投资收到的现金	500.00	6,707.31	1,500.00	4,400.00
取得投资收益收到的现金	2.42	4.14	50.05	10.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>502.42</b>	<b>6,711.45</b>	<b>1,550.05</b>	<b>4,410.83</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,062.10	9,052.68	5,104.35	2,851.40
投资支付的现金	500.00	3,900.00	4,500.00	4,400.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>6,562.10</b>	<b>12,952.68</b>	<b>9,604.35</b>	<b>7,251.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,059.69</b>	<b>-6,241.23</b>	<b>-8,054.30</b>	<b>-2,840.57</b>

报告期各期，公司投资活动现金流量净额分别为-2,840.57万元、-8,054.30万元、-6,241.23万元和-6,059.69万元，投资活动现金净流出金额较大，主要系报告期内公司业务快速发展，用于购建固定资产等长期资产的资金支出较高。

## 3、筹资活动产生的现金流量情况

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年	2023年	2022年
吸收投资收到的现金	14,730.00	-	14,500.00	3,247.05
取得借款收到的现金	4,484.52	10,566.67	3,505.42	2,950.56

项目	2025年 1-6月	2024年	2023年	2022年
收到其他与筹资活动有关的现金	1.34	3,100.00	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>19,215.86</b>	<b>13,666.67</b>	<b>18,005.42</b>	<b>6,197.62</b>
偿还债务支付的现金	6,429.18	4,655.22	2,479.07	935.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153.84	219.38	1,150.23	108.79
支付其他与筹资活动有关的现金	1,153.35	1,707.58	1,811.60	4,122.65
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>7,736.37</b>	<b>6,582.17</b>	<b>5,440.90</b>	<b>5,167.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,479.49</b>	<b>7,084.49</b>	<b>12,564.52</b>	<b>1,030.43</b>

报告期各期，公司筹资活动现金流量净额分别为 1,030.43 万元、12,564.52 万元、7,084.49 万元和 11,479.49 万元。公司筹资活动产生的现金流入主要系取得股东增资款和银行借款，筹资活动产生的现金流出主要系偿还银行借款、支付分红款和支付融资租赁的款项。

#### （七）流动性风险分析

报告期内，公司业务规模不断增长，营业收入快速增加，报告期各期分别实现营业收入 16,525.60 万元、20,859.03 万元、33,107.46 万元和 19,189.96 万元，扣非后归母净利润分别为 1,742.71 万元、-915.18 万元、1,141.58 万元以及 788.27 万元，随着公司研发成果的逐步产业化，经营规模的持续扩张，公司盈利能力稳步提升。

报告期各期，公司经营活动现金流量净额分别为 697.59 万元、-463.08 万元、213.06 万元和 1,116.18 万元，随着公司业务规模的提升，公司经营活动现金流保持在合理水平。截至 2025 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 17,152.05 万元，货币资金较为充足。

报告期各期末，公司的流动比率分别为 1.75 倍、2.74 倍、2.17 倍和 2.78 倍，速动比率分别为 1.31 倍、2.25 倍、1.72 倍和 2.24 倍，主要期间比率均大于 1，资产流动性较好。

综上，随着公司业务规模的持续扩大，公司整体流动性风险较小。未来公司将积极加强财务及资金管理，积极拓展外部融资渠道，优化债务结构，进一步控制公司的流动性风险。

## （八）持续经营能力分析

报告期内，公司经营情况良好，业务规模不断扩大，主营业务毛利率保持较高水平，盈利能力较强。

从行业发展来看，下游人工智能领域的爆发式发展持续催生对高端数字芯片及存储芯片的旺盛需求，这种需求传导效应正进一步推动上游芯片测试接口环节的市场规模加速扩张。根据 Yole 预测，2025 年全球测试接口市场规模有望实现 13.75% 的同比增长，达到 58.31 亿美元，行业增长动能依然强劲。受益于半导体行业的良好发展与下游客户旺盛的需求，公司经营业绩有望进一步提升。

公司将持续加大研发投入，坚持技术自主创新与产品创新，基于对行业需求的持续挖掘，不断迭代现有产品，巩固公司在市场上的竞争优势。同时，公司将持续开发新的芯片测试接口和探针卡产品，为半导体测试行业实现更加优良的测试效果持续努力，推动国产半导体产业链实现国产自主可控。

此外，公司已在本招股说明书“第三节 风险因素”中披露公司未来所面临的主要风险，公司特别提醒投资者仔细阅读本招股说明书中的上述内容。

## 九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项

### （一）报告期内主要资本性支出

报告期内，公司主要资本性支出的情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年	2023 年	2022 年
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	6,062.10	9,052.68	5,104.35	2,851.40

报告期内，公司的资本性支出主要为支付设备采购款以及厂区装修款项。

### （二）未来可预见的重大资本性支出及计划

公司未来可预见的重大资本性支出及计划主要为本次募集资金投资项目的投资支出，具体详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

## 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### （二）或有事项

截至 2025 年 6 月 30 日，公司无重大或有事项。

### （三）承诺事项及其他重要事项

截至 2025 年 6 月 30 日，公司无承诺事项及其他重要事项。

## 十一、盈利预测信息

公司未编制盈利预测报告。

## 第七节 募集资金运用与未来发展规划

### 一、募集资金运用情况

#### （一）募集资金运用概况

经发行人股东大会审议通过，发行人本次拟公开发行人民币普通股不超过1,093.3091万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），实际募集资金扣除发行等费用后，拟按照轻重缓急投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	苏州韬盛半导体测试接口及测试探针生产基地建设项目	58,127.00	40,000.00
2	苏州晶晟晶圆测试探针研发及晶圆测试探针卡生产基地建设项目	73,604.00	50,000.00
3	上海总部及研发中心建设项目	6,073.00	4,000.00
4	天津韬盛研发中心项目	3,155.00	1,800.00
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	150,959.00	105,800.00

上述项目实施后，公司不会新增同业竞争，对发行人的独立性不产生不利影响。

本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金进行先期投入，待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。

#### （二）募集资金使用管理制度

公司已按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定建立了《募集资金管理制度》，募集资金将存放于募集资金专户集中管理，其存放、使用、变更、管理与监督将根据公司《募集资金管理制度》进行。公司将根据实际经营活动及发展规划，合理使用募集资金。

（三）募集资金重点投向科技创新领域的具体安排，对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响

公司从事半导体测试接口的研发、设计、生产和销售，本次募集资金投资项

目均围绕公司主营业务进行，系按照公司业务发展的实际需求，在现有业务的基础上进一步扩大生产经营规模并提高技术研发实力。本次募集资金所投资的领域属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》所规定的“新一代信息技术领域”。

本次募集资金投资项目将充分利用公司在测试接口领域的先进技术优势和良好的市场口碑，打造流程更优化、管理更完善、更具国际化水准的芯片测试接口及探针和 MEMS 探针卡生产基地，使生产能力和场地空间的瓶颈在中长期内得到充分缓解，扩大产品生产规模，支持未来产品销售规模的持续增长。因此，本次募集资金投资项目有利于巩固和加强公司原有的竞争优势，进一步提升公司核心竞争力，提高市场占有率、行业地位和品牌影响力，成为公司加快芯片测试接口和探针卡行业战略布局、培育可持续综合竞争力与提升股东回报的重要保障，为公司持续稳健发展打下坚实的基础。

#### （四）募集资金用途的可行性及与发行人主要业务、核心技术之间的关系

本次募集资金投资项目是公司现有业务的延伸。公司本次募集资金运用围绕主营业务，投资建设苏州韬盛半导体测试接口及测试探针生产基地建设项目、苏州晶晟晶圆测试探针研发及晶圆测试探针卡生产基地建设项目、上海总部及研发中心建设项目、天津韬盛研发中心项目及补充流动资金。本次投资项目主要用于芯片测试接口及探针、先进 MEMS 探针卡以及测试相关核心技术领域的产品研发、生产、产业化工作，与公司目前主要业务以及经营战略方向相符，是公司未来业务发展目标的重要组成部分，与公司的主营业务、核心技术紧密相关。

## 二、未来发展与规划

### （一）公司发展战略规划

公司以国家战略及相关产业政策为指引，顺应半导体测试接口国产化发展趋势，致力于成为行业内领先的芯片测试接口和探针卡的研发及生产制造企业，打造高端测试接口领域领先的国产品牌。公司深耕测试接口行业十余年，建立了完善的测试接口设计、制造、装配、检测及市场应用体系，公司坚持自主创新，已与国内多家知名头部硬科技芯片客户建立了良好的长期战略合作关系，在行业内已建立较高的品牌知名度。

未来，公司仍将以客户产品需求和技术发展趋势为导向，专注重点应用领域和战略客户群体，大力开拓高端测试接口。公司将聚焦国家战略需求，坚持高端化、规模化、高质量的发展理念，充分发挥技术工艺、产品质量、市场地位、经营规模等优势。此外，公司将持续加大对技术和研发投入，致力于攻克我国高端测试接口领域的核心关键技术，打破技术垄断，加快国产替代，并积极开拓下游领域知名客户，进一步提升品牌知名度，扩大市场份额，巩固公司在行业中的领先地位。公司亦将不断改善治理结构，优化人才结构，健全人才吸引与发展机制，确保公司业务的可持续发展。

## （二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

### 1、夯实核心技术体系，以技术创新驱动业务发展

公司始终将产品研发与技术创新作为长期发展的核心战略，持续加强研发体系建设，优化研发管理流程，已经建立了一套相对完备的研发管理体系，构建了覆盖主要产品线的研发团队，并在芯片测试接口设计和制造、MEMS 探针设计和制造、多层复合陶瓷基板（MLC）设计和制造、MEMS 探针卡设计和制造等领域积累了多项核心技术。

报告期内，公司持续加大研发投入，不断完善和丰富产品品质和体系。截至2025年6月30日，公司已获得境内专利77项，其中境内发明专利26项，境外专利4项，为公司快速发展构筑了坚实的核心竞争力。

### 2、丰富产品品类，拓展产品矩阵

公司产品包括芯片测试接口和探针卡等，广泛用于半导体芯片成品测试和晶圆测试。在芯片测试接口领域，公司凭借早期布局形成显著的先发优势，核心技术能力与方案储备居于领先地位。公司具备高速高频测试探针自主研发和制造能力，已累计形成上百类测试探针技术方案，可精准匹配不同芯片类型的测试需求；同时，报告期内公司累计开发超4,000种芯片测试接口技术方案，能够满足从研发到量产阶段针对高低温、耐久、大电流、高功耗等多重场景下严苛的测试要求。公司形成多种高端芯片测试接口精密制造工艺，成功突破芯片测试接口的微纳精密制造瓶颈。公司深耕芯片测试接口领域，可精准匹配人工智能、自动驾驶、手机SoC、先进存储等多元领域客户的个性化需求，提供覆盖全流程的芯片测试接

口定制化解决方案：人工智能领域，公司已深度服务客户 X、客户 Z、沐曦股份、摩尔线程等头部芯片企业，为 AI 芯片从研发到量产的测试环节提供关键支撑，助力我国人工智能产业自主可控；自动驾驶领域，公司覆盖地平线、Momenta 等自动驾驶技术领军者，以及理想汽车、蔚来汽车等知名车企，其中，报告期内公司凭借稳定的技术实力与交付能力，成为地平线芯片测试接口的第一大供应商；手机 SoC 领域，公司持续为客户 X、小米玄戒等企业提供芯片测试接口解决方案，为“中国芯”打破国外垄断提供关键测试硬件；先进存储领域，公司成功为长江存储开发了首个能够实现 512 颗存储芯片并行测试的国产 DSA 芯片测试接口，有效助力本土存储产业链实现关键环节的国产替代。

后续，公司将进一步加大在高端芯片测试接口领域的研发投入与产品布局力度，重点推进超细测试探针自动化组装设备的开发以及基于 MEMS 工艺的芯片测试接口用 MEMS 测试探针研发。同时，公司将同步开展基于 MEMS Cubic 技术的高速 Elastomer 芯片测试接口研发工作，并推进超大功耗热管理系统芯片测试接口的研发团队建设。通过多维度技术布局与能力建设，公司将持续强化在该领域的技术竞争力与产品护城河，更精准地匹配下游人工智能等新兴领域未来的产品需求。

### 3、拓展客户群体，增加应用场景

凭借良好的品牌声誉、强大的研发实力、长期的经验积累、领先的产品性能和优质的本地化服务，报告期内公司已服务超 700 家客户，较为全面地覆盖各领域代表性硬科技客户：在 GPU 和 AI 芯片领域，如客户 X、客户 Z、沐曦股份、摩尔线程、壁仞科技、昆仑芯、平头哥、全志科技、瑞芯微、燧原科技、清微智能、此芯科技等；在 CPU 领域，如飞腾公司、海光信息、龙芯中科、奕斯伟计算等；在手机 SoC 芯片领域，如客户 X、小米玄戒等；在自动驾驶领域，如地平线、Momenta、芯擎科技、理想汽车、蔚来汽车等；在存储领域，如长江存储、澜起科技、联芸科技等；在射频通信芯片领域，如翱捷科技、唯捷创芯、卓胜微等；在功率芯片领域，如杰华特、南芯科技、圣邦微、英诺赛科、展芯科技、伏达半导体等；在封测领域，如长电科技、华天科技、京隆科技、利扬芯片、渠梁电子、日月光、盛合晶微、通富微电、伟测科技、矽佳半导体、芯云半导体、甬矽半导体等。

### （三）发行人未来发展规划采取的措施

#### 1、坚持技术创新与产品创新

公司将持续加大研发投入，坚持技术自主创新与产品创新。基于对行业需求通电的持续挖掘，不断迭代现有产品，巩固其在市场上的竞争优势并为行业带来更多价值。同时，公司将持续开发新的芯片测试接口和探针卡产品，为半导体测试行业实现更加优良的测试效果持续努力，推动国产半导体产业链实现国产自主可控。

#### 2、健全人才吸引与发展制度

人才是企业发展的核心驱动力。伴随业务规模持续扩张，公司对高素质人才的需求日益增长。为此，公司将进一步完善差异化薪酬与长效激励机制，持续招募经验丰富、专业技能匹配的技术与管理人才，支撑国内与海外的业务拓展，同时优化应届毕业生培养体系与发展通道，深化人才储备。

#### 3、加速全球化业务布局

海外市场是公司未来的战略增长极，未来公司将持续强化海外尤其是东南亚市场的投入，一方面通过本地化薪酬体系吸引国际化人才，提升组织能力与拓展业务覆盖范围；另一方面扩大运营规模，并通过深化与当地客户、高校的合作，增强本地化服务与创新能力。

## 第八节 公司治理与独立性

### 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

公司根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，建立健全股东会、董事会、独立董事、关联交易管理、对外担保管理、对外投资管理等制度，形成了规范的公司治理结构。公司股东会、董事会等治理机制按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，各股东、董事和高级管理人员均尽职尽责，按制度规定切实地行使权利、履行义务。

报告期内，公司股东会、董事会、监事会能够依法规范运行，形成了职责明确、相互制衡、科学高效的公司治理体系，未出现重大违法违规现象，不存在公司治理缺陷，公司法人治理结构不断得到完善。

### 二、发行人内部控制情况

#### （一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

#### （二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制出具《内部控制审计报告》（容诚审字[2025]230Z5178号），认为公司“韬盛科技于2025年6月30日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

#### （三）报告期内曾经存在的财务内控不规范情形及整改情况

公司于报告期外因关联方个人资金周转需求向关联方拆出资金，报告期初尚

有部分借款及利息未偿还，报告期内公司与关联方发生的资金拆借系关联方归还借款及利息。公司及相关关联方均依据借款期限合理、公允地计提并支付了相关资金拆借利息。截至 2025 年 6 月 30 日，前述资金拆借已清理完毕，具体情况详见本节之“七、关联方及关联交易”之“（二）关联交易”之“3、一般关联交易简要汇总表”之“（4）关联方资金拆借”。

### 三、报告期内发行人违法违规情况

2023 年 9 月 21 日，中华人民共和国苏州工业园区海关向苏州韬盛下发“苏园关唯缉违字[2023]15 号”《行政处罚决定书》，因苏州韬盛委托第三方申报进口货物时存在申报不实、影响国家税款征收的情况，对苏州韬盛作出处罚款人民币 0.65 万元的行政处罚。根据行政处罚决定书，苏州韬盛积极配合海关调查，中华人民共和国苏州园区海关根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第（五）项，决定对苏州韬盛从轻处罚。根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》的相关规定，苏州韬盛所受处罚金额较低。综上，前述行政处罚不属于重大违法违规行为。

2024 年 12 月 24 日，中华人民共和国苏州工业园区海关向苏州晶晟下发“苏园关娄缉违字[2024]15 号”《行政处罚决定书》，因苏州晶晟存在品牌类型申报不实的情况，对苏州晶晟作出处罚款人民币 0.15 万元的行政处罚。根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》《中华人民共和国海关统计工作管理规定》的相关规定，苏州晶晟所受处罚金额较低。苏州晶晟本次处罚所涉及的申报商品金额价值不足 200 万元，根据《中华人民共和国海关行政处罚裁量基准（一）》的相关规定，本次违法行为属于一般情节、不属于从重情节。综上，前述行政处罚不属于重大违法违规行为。

报告期内，发行人不存在重大违法违规行为。

### 四、发行人资金占用和对外担保情况

#### （一）公司近三年资金占用情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情况。

## (二) 公司近三年对外担保情况

报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

## 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全各项管理制度。目前,公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,具有完整的业务体系和独立面向市场自主经营的能力。

### (一) 资产完整

公司具备与生产经营有关的主要生产系统和配套设施,合法拥有与经营有关的机器设备、办公设备、授权专利、注册商标等,具有独立的原料采购和产品销售流程。

### (二) 人员独立

公司建立健全了法人治理结构,董事、高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生。公司的总经理、副总经理、首席运营官、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事、合伙企业执行事务合伙人以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;发行人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### (三) 财务独立

公司制定了财务管理制度,财务决策独立,不存在股东违规干预公司资金使用的情况。发行人建立独立的财务部门,并建立了独立的财务核算体系,具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司开立了独立的基本账户,财务核算独立于股东及任何其他单位或个人,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

### (四) 机构独立

按照《公司法》的要求,公司建立健全了股东会、董事会和经营管理层的组

织结构体系，各职能部门均独立运作。公司内部经营管理机构独立行使经营管理权，不存在与发行人的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的机构混同的情况。

#### （五）业务独立

公司拥有完整且独立的研发、采购、生产、销售流程，具备直接面向市场独立经营的能力。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

#### （六）主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定

公司主营业务、控制权、管理团队稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大不利变化；公司股份权属清晰，最近两年实际控制人未发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

#### （七）重大权属纠纷、或有事项、经营环境变化方面

公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

## 六、同业竞争

（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争情况

### 1、发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，发行人实际控制人殷岚勇以直接和间接方式合计控制公司 44.83% 的表决权。

截至本招股说明书签署日，除发行人及其控股子公司外，殷岚勇控制的其他企业为苏州厚积和昊日长晶，均为员工持股平台，具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十八、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排”之“（二）持股平台的基本信息及人员构成”。

## 2、发行人控股股东、实际控制人曾经控制的企业

上海涛思半导体科技有限公司系发行人控股股东、实际控制人殷岚勇曾经持股 50% 并担任执行董事、总经理的企业，已于 2023 年 2 月注销。上海涛思半导体科技有限公司在注销前由殷岚勇和赵仁志分别持股 50.00%，具体情况如下：

企业名称	上海涛思半导体科技有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2003 年 5 月 18 日
注销时间	2023 年 2 月 2 日
工商注册号	3102252018404
注册资本	50 万元
法定代表人	殷岚勇
注册地址	上海市南汇区六灶镇鹿园工业区鹿溪路 246 号 105 室 72 号
经营范围	半导体及计算机软件的研究、开发；半导体设备，系统集成设备，计算机软件，销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）

报告期内，上海涛思半导体科技有限公司无实际经营，与发行人不构成同业竞争。

综上所述，截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人殷岚勇控制的除发行人及其控股子公司外的企业为发行人持股平台，不存在从事与发行人相同或相似的业务，前述企业与发行人之间不存在同业竞争的情形。

### （二）发行人控股股东、实际控制人出具的避免同业竞争的承诺

为避免潜在的同业竞争，维护公司利益，保障公司正常经营，公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺》，具体内容参见本招股说明书之“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”之“（九）关于避免同业竞争的承诺”。

## 七、关联方及关联交易

### （一）关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则》以及《上市规则》等相关规定，发行人的主要关联方及关联关系如下：

### 1、与发行人存在控制关系的关联方

序号	姓名/名称	与发行人的关系	备注
1	殷岚勇	发行人的实际控制人；直接持有发行人 28.40% 股份并通过控制苏州厚积、昊日长晶间接控制发行人 16.43% 股份	/
2	苏州厚积	发行人实际控制人的一致行动人；直接持有发行人 14.42% 股份	系由殷岚勇担任普通合伙人的有限合伙企业
3	昊日长晶	发行人实际控制人的一致行动人；直接持有发行人 2.01% 股份	

### 2、除上述与发行人存在控制关系的关联方之外，其他持有发行人 5% 以上股份的关联方

序号	姓名/名称	与发行人的关系
1	高凯	直接持有发行人 14.20% 股份
2	景宁水獭	直接持有发行人 7.29% 股份
3	毅达贰号及其一致行动人毅达众创、毅达创投	毅达贰号直接持有发行人 6.07% 股份 毅达创投直接持有发行人 2.74% 股份 毅达众创直接持有发行人 1.13% 股份
4	柘中君信	直接持有发行人 5.50% 股份

### 3、发行人的董事、监事会取消前在任监事、高级管理人员

具体情况详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”。

### 4、发行人的其他关联自然人

除实际控制人、发行人的董事、监事会取消前在任监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的自然人股东外，公司的其他关联自然人还包括与公司实际控制人、董事、监事会取消前在任监事、高级管理人员、持有本公司 5% 以上股份的自然人股东关系密切的家庭成员。

### 5、报告期内的其他关联方

序号	关联方姓名/名称	关联关系说明
1	上海涛思半导体科技有限公司	发行人董事长殷岚勇曾经持股 50% 并担任执行董事的企业，已于 2023 年 2 月注销
2	华峰测控及其控制的其他企业	报告期内曾直接持有发行人 5% 以上股份
3	无锡思响数智科技有限公司	发行人董事、副总经理何金芳的配偶担任董事长、总经理的企业

序号	关联方姓名/名称	关联关系说明
4	苏州思响数智科技有限公司园区分公司	发行人董事、副总经理何金芳的配偶担任负责人的企业
5	无锡聚数咨询合伙企业（有限合伙）	发行人董事、副总经理何金芳的配偶担任执行事务合伙人的企业
6	无锡聚响咨询合伙企业（有限合伙）	发行人董事、副总经理何金芳的配偶担任执行事务合伙人的企业
7	驰必准科技（苏州）有限公司	发行人董事、副总经理何金芳的配偶曾经担任董事、总经理的企业，已于2024年2月辞任
8	驰必准科技（苏州）有限公司杭州分公司	发行人董事、副总经理何金芳的配偶曾经担任负责人的企业，已于2024年1月辞任
9	上海水獭投资合伙企业（有限合伙）	发行人董事赵仁志曾经担任执行事务合伙人的企业，已于2022年7月注销
10	上海互联远程医学网络系统有限公司	发行人董事赵仁志曾经担任董事的企业，已于2024年10月辞任
11	江苏安康通健康管理服务有限公司	发行人董事赵仁志曾经担任董事的企业，已于2024年4月辞任
12	上海安康通健康管理有限公司	发行人董事赵仁志曾经担任董事的企业，已于2025年3月辞任
13	青岛雅园圣景实业有限公司	发行人董事赵仁志姐姐的配偶担任执行董事兼总经理的企业
14	青岛珠山古镇建筑工程有限公司	发行人董事赵仁志姐姐的配偶担任执行董事兼总经理的企业
15	青岛宽仁建筑工程有限公司	发行人董事赵仁志姐姐的配偶曾经担任执行董事的企业，已于2024年6月注销
16	青岛鲁森建筑工程有限公司	发行人董事赵仁志姐姐的配偶曾经担任执行董事兼总经理的企业，已于2024年12月注销
17	江苏泰特尔新材料科技股份有限公司	发行人董事高嘉阳担任董事的企业
18	南京贝迪新材料科技（集团）股份有限公司	发行人董事高嘉阳担任董事的企业
19	苏州亚科科技股份有限公司	发行人董事高嘉阳担任董事的企业
20	艺唯科技股份有限公司	发行人董事高嘉阳担任董事的企业
21	昆山科腾生物科技有限公司	发行人董事高嘉阳担任董事的企业
22	江苏邦融微电子有限公司	发行人董事高嘉阳担任董事的企业
23	深圳市壹倍科技有限公司	发行人董事高嘉阳担任董事的企业
24	江苏科瑞恩科技股份有限公司	发行人董事高嘉阳担任董事的企业
25	浙江嘉泰禾清科技有限公司	发行人董事高嘉阳担任董事的企业
26	苏州诺存微电子有限公司	发行人董事高嘉阳担任董事的企业
27	苏州中科瑞龙科技有限公司	发行人董事高嘉阳担任董事的企业。该等选举事宜已经该公司股东会审议通过，目前正在办理工商变更手续。
28	昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司	发行人董事高嘉阳曾经担任董事的企业，已于2024年10月辞任
29	昆山阿普顿自动化系统有限公司	发行人董事高嘉阳曾经担任董事的企业，已于2025年4月辞任

序号	关联方姓名/名称	关联关系说明
30	若宇检具股份有限公司	发行人董事高嘉阳曾经担任董事的企业，已于2024年12月辞任
31	武汉优炜芯科技有限公司	发行人董事欧嘉骏担任董事的企业
32	无锡海力自控工程有限公司	发行人董事欧嘉骏的母亲担任董事的企业
33	无锡威孚高科技集团股份有限公司	发行人董事欧嘉骏的父亲曾经担任董事的企业，已于2024年5月辞任
34	无锡威孚力达催化净化器有限责任公司	发行人董事欧嘉骏的父亲曾经担任董事的企业，已于2023年8月辞任
35	南京威孚金宁有限公司	发行人董事欧嘉骏的父亲曾经担任董事的企业，已于2023年9月辞任
36	无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司	发行人董事欧嘉骏的父亲曾经担任董事的企业，已于2023年8月辞任
37	无锡威孚电驱科技有限公司	发行人董事欧嘉骏的父亲曾经担任董事的企业，已于2024年4月辞任
38	宁波威孚天力增压技术股份有限公司	发行人董事欧嘉骏的父亲曾经担任董事的企业，已于2023年8月辞任
39	无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司	发行人董事欧嘉骏的父亲曾经担任董事长的企业，已于2021年8月辞任
40	无锡威孚精密机械制造股份有限公司	发行人董事欧嘉骏的父亲曾经担任董事的企业，已于2022年8月辞任
41	无锡威孚环保催化剂有限公司	发行人董事欧嘉骏的父亲曾经担任副董事长的企业，已于2021年1月辞任
42	苏州诺必达信息科技有限公司	发行人独立董事丁仁刚的配偶担任执行董事、总经理的企业
43	吴中融之聚信息咨询服务部	发行人独立董事丁仁刚的配偶担任经营者的企业
44	苏州工业园区聚芳圆商务信息咨询服务部	发行人独立董事丁仁刚的配偶曾经担任经营者的企业，已于2024年12月注销
45	苏州工业园区聚财圆会计咨询服务部	发行人独立董事丁仁刚的配偶曾经担任经营者的企业，已于2024年12月注销
46	苏州工业园区爱因普特机电设备工程服务部	发行人独立董事丁仁刚配偶的母亲担任经营者的企业
47	苏州工业园区浦宏明机电设备工程服务部	发行人独立董事丁仁刚配偶的母亲担任经营者的企业
48	中宏信会计事务（苏州）有限公司	发行人独立董事丁仁刚配偶的母亲曾经担任执行董事的企业，已于2023年7月注销
49	上海睿戎达纺织科技有限公司	发行人原监事姚瑾怡的配偶担任执行董事兼总经理的企业
50	苏州斯锦合顺新材料科技有限公司	发行人原监事姚瑾怡的配偶担任执行董事的企业
51	朱学良	发行人原董事，已于2022年7月辞任
52	杨红举	发行人原董事，已于2025年3月辞任
53	蔡琳	发行人原董事，已于2024年8月辞任
54	天津芯华投资控股有限公司	发行人原董事蔡琳担任董事的企业
55	盛态思软件（天津）有限责任公司	发行人原董事蔡琳曾经担任董事的企业，已于

序号	关联方姓名/名称	关联关系说明
		2024年5月注销
56	成都中科四点零科技有限公司	发行人原董事蔡琳曾经担任董事的企业，已于2025年3月辞任
57	顾璇	发行人原董事，已于2022年11月辞任
58	上海康桥先进制造技术创业园有限公司	发行人原董事顾璇担任董事的企业
59	星土数据科技（上海）有限公司	发行人原董事顾璇担任董事的企业
60	上海顺舟智能科技股份有限公司	发行人原董事顾璇担任董事的企业
61	上海掌富网络技术有限公司	发行人原董事顾璇担任董事的企业
62	上海斯睿德信息技术有限公司	发行人原董事顾璇担任董事的企业
63	上海同想文化传播有限公司	发行人原董事顾璇担任董事的企业
64	上海商格信息科技有限公司	发行人原董事顾璇担任董事的企业
65	上海迈磁科技有限公司	发行人原董事顾璇担任董事的企业
66	宜态科水务技术（上海）有限公司	发行人原董事顾璇曾经担任董事的企业，已于2022年7月辞任
67	上海傲意信息科技有限公司	发行人原董事顾璇曾经担任董事的企业，已于2022年12月辞任
68	唐霖	发行人原监事，已于2022年11月辞任
69	上海瑞章投资有限公司	发行人原监事唐霖担任董事的企业
70	上海泓安信息科技有限公司	发行人原监事唐霖担任董事的企业
71	时代出版传媒投资研发中心（上海）有限公司	发行人原监事唐霖担任董事的企业
72	上海浦东软件平台有限公司	发行人原监事唐霖担任董事的企业
73	上海普坤信息科技有限公司	发行人原监事唐霖担任董事的企业
74	触智（上海）信息科技有限公司	发行人原监事唐霖担任董事的企业
75	上海优同科技有限公司	发行人原监事唐霖担任董事的企业
76	洁誉科技（上海）股份有限公司	发行人原监事唐霖担任董事的企业
77	上海车拍档汽车技术股份有限公司	发行人原监事唐霖担任董事的企业
78	艾琪康医药科技（上海）有限公司	发行人原监事唐霖担任董事的企业

## （二）关联交易

### 1、报告期内关联交易总体情况

单位：万元

类型	关联交易内容	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
一般经常性关联交易	关键管理人员薪酬	347.51	611.81	602.44	567.73
	关联销售	7.92	74.62	15.96	5.28

类型	关联交易内容	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
一般偶发性关联交易	关联担保	详见本节“3、一般关联交易简要汇总表”之“(3)关联担保”			
	关联方资金拆借	详见本节“3、一般关联交易简要汇总表”之“(4)关联方资金拆借”			

## 2、重大关联交易的判断标准及依据

根据《上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等对关联交易信息披露的规定，并结合实际经营情况，公司认定以下交易为重大关联交易：公司与关联人发生的交易金额（提供担保及关键管理人员薪酬除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元的交易。

发行人报告期内不存在重大关联交易。

## 3、一般关联交易简要汇总表

### (1) 关键管理人员薪酬

报告期内，公司支付给关键管理人员薪酬的薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
关键管理人员薪酬	347.51	611.81	602.44	567.73

### (2) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

类型	项目	关联方	关联交易内容	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
经常性关联交易	关联销售	华峰测控	半导体测试接口及设备	7.92	74.62	15.96	5.28

### (3) 关联担保

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
殷岚勇	发行人	500.00	2022/7/29	2023/7/28	是
殷岚勇	发行人	487.52	2022/4/1	2023/3/31	是
殷岚勇	发行人	1,000.00	2022/9/30	2023/9/29	是
殷岚勇、葛敏瑛	发行人	900.00	2021/8/4	2024/8/4	是
殷岚勇、葛敏瑛	发行人	600.00	2021/8/13	2024/8/13	是

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
殷岚勇	发行人	500.00	2022/1/27	2024/11/30	是

#### (4) 关联方资金拆借

报告期前,发行人存在部分董事、高管向发行人借款的情况,具体情况如下:

单位:万元

类型	关联方	期间	期初金额	本期拆出	计提利息	本期偿还	期末余额
偶发性关联交易	赵月玲	2022年度	11.00	-	0.46	-	11.46
		2023年度	11.46	-	0.27	11.46	0.27
		2024年度	0.27	-	-	-	0.27
		2025年1-6月	0.27	-	-	0.27	-

注:报告期初公司高管施元军存在 7.61 万元利息尚未归还,高凯存在 0.76 万元利息尚未归还,相关借款利息均在报告期内归还完毕。

针对上述借款,发行人按照同期中国人民银行 LPR 利率计提了利息。公司及相关关联方均依据借款期限合理、公允地计提并支付了相关资金拆借利息。

#### 4、关联方往来款项余额

报告期内,公司关联方往来款项余额情况如下:

单位:万元

科目	关联方	项目	2025.6.30	2024.12.31	2023.12.31	2022.12.31
应收账款	北京华峰测控技术股份有限公司	关联销售	50.85	50.85	3.12	-
应收账款	华峰测控技术(天津)有限责任公司	关联销售	8.95	-	-	-
其他应收	施元军	借款利息	-	7.61	7.61	7.61
其他应收	高凯	借款利息	-	0.76	0.76	0.76
其他应收	赵月玲	借款及利息	-	0.27	0.27	11.46

#### (三) 报告期内关联交易履行程序的合法合规情况

##### 1、报告期内关联交易的原因及对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内,发行人关联交易主要涉及关键管理人员薪酬、销售商品、关联担保等事项。发行人与关联方之间的关联交易不存在损害发行人利益的情况,对公司财务状况和经营成果不构成重大不利影响。

## 2、关联交易的制度安排

为保证关联交易的公允性，保护中小股东利益，发行人已根据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》和《独立董事工作制度》等内部控制制度文件中对关联交易的决策权力和程序作了明确规定，以保证公司关联交易的公允性，确保关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。

## 3、报告期内关联交易履行程序情况及独立董事意见

发行人于 2025 年 12 月 5 日分别召开第四届董事会第二次独立董事专门会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易情况的议案》，独立董事和监事会成员均未对关联交易发表不同意见。

发行人分别于 2025 年 12 月 5 日和 2025 年 12 月 20 日召开第四届董事会第五次会议及 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易情况的议案》，关联董事、股东回避表决，对发行人在报告期内与关联方发生的关联交易予以确认。

## 4、关于规范关联交易的承诺

为减少和规范关联交易，发行人依据有关法律、法规和规范性文件的规定，在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》中对关联交易做出了严格规定，包括关联交易的回避表决制度、决策权限、决策程序等内容，以确保关联交易的公开、公允、合理，从而保护公司全体股东及公司利益。

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事及高级管理人员已出具关于减少和规范关联交易的承诺，具体内容详见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”之“（十二）其他承诺事项”之“1、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事及高级管理人员关于减少和规范关联交易的承诺”。

#### (四) 关联方变化情况

关于关联方变化情况,参见招股说明书本节之“七、关联方及关联交易”之“ (一) 关联方和关联关系”之“5、报告期内的其他关联方”。

## 第九节 投资者保护

### 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序

经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过，本次发行上市前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

### 二、发行人的股利分配政策

#### （一）《公司章程（草案）》中利润分配相关规定

##### 1、公司利润分配政策的基本原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

##### 2、利润分配的方式及比例

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之八十；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之四十；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之二十；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（3）项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

### 3、利润分配的条件及期间间隔

在满足下列条件时，可以进行利润分配：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（3）公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

当公司存在以下情形时，可以不进行利润分配：（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；（2）当年末资产负债率高于 70%；（3）当年经营性现金流为负。公司利润分配不得损害公司持续经营能力。

公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

### 4、现金分红的条件及比例

在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体年度的分配比例由董事会根据公司当年经营情况制定方案。

### 5、利润分配的决策程序和机制

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

股东会对现金分红具体预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，如通过投资者关系电子邮箱、电话方式，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

## 6、利润分配政策调整的条件、决策程序和机制

公司应当严格执行本章程确定的分红政策以及股东会审议批准的分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者公司外部环境发生重大变化，确需调整本章程规定的现金分红政策时，董事会需就调整或者变更利润分配政策的可行性进行充分论证，形成专项决议后，提交公司股东会批准，公司提出调整利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对股东利益的保护，并在提交股东会的议案中详细说明调整的原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

### （二）董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由

着眼于公司可持续发展和目前处于成长期的发展阶段，为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规及规章的要求，公司于第四届董事会第五次会议中对股东回报事宜进行了专项研究论证，并审慎制定了《发行上市后三年内（含发行当年）的股东分红回报计划》。

股东回报规划制定考虑因素如下：

公司着眼于长远和可行性发展，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配做出制

度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

股东回报规划制定原则如下：

公司实施较为积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，充分考虑、听取公司中小股东的意见、诉求，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。

### （三）本次发行前后股利分配政策差异情况

本次发行前，公司根据《公司法》《证券法》等规定，制定了利润分配政策。根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，公司就利润分配政策进行了进一步完善，进一步明确利润分配方式、利润分配条件、利润分配期间间隔、现金分红的条件和比例等。

### （四）上市后三年内现金分红等利润分配计划以及相关安排

#### 1、利润分配的方式

公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；现金分红优先于其他分红方式。

具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

在有条件的情况下，根据公司实际经营情况，公司可以进行中期利润分配。

#### 2、利润分配的条件

公司实施现金分红应同时满足以下条件：

（1）公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。重大对外投资计划或重大现

金支出是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过5,000万元人民币。

公司采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，充分考虑公司的可分配利润总额、现金流状况、股本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应。

### 3、利润分配的期间间隔

在满足利润分配的条件下，公司原则上每年进行一次现金分红，有关法律、法规、规范性文件和《公司章程（草案）》另有规定的除外；公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求提议进行中期利润分配。

### 4、现金分红的比例

公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体年度的分配比例由董事会根据公司当年经营情况制定方案。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程（草案）》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（3）项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

### (五) 公司长期回报规划以及规划制定时的主要考虑因素

公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当前资金需求，制定分红方案。

## 第十节 其他重要事项

### 一、重要合同

#### （一）销售合同

公司的重要销售合同指公司与报告期各期前五大客户签署的框架合同，若与客户未签署框架合同，则选取报告期内单笔金额最大的销售订单，截至 2025 年 6 月 30 日，公司重要销售合同具体情况如下：

序号	客户名称	合同金额 (万元)	主要销售 内容	合同期限	履行 情况
1	客户 X1	框架协议	由订单具体约定	自 2023 年 1 月 1 日起生效，有效期至 2027 年 12 月 31 日，若协议双方未在协议终止前六十日前发出终止书面通知，则自动延续一年	正在履行
2	矽品科技（苏州）有限公司	框架协议	由订单具体约定	自 2021 年 9 月 22 日起生效，且长期有效	正在履行
3	杭州芯云半导体集团有限公司	框架协议	由订单具体约定	自 2025 年 3 月 24 日生效，本协议生效后在双方业务存续期间长期有效，但以下情况除外：（1）双方以书面方式约定终止本协议；或（2）双方签署新的相同主题的协议取代本协议	正在履行
4	地平线征程（上海）科技有限公司	框架协议	由订单具体约定	自 2025 年 2 月 27 日生效，至 2027 年 12 月 31 日起终止	正在履行
5	矽佳半导体（嘉兴）有限公司	框架协议	由订单具体约定	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日	正在履行
6	矽佳半导体科技（江苏）股份有限公司	框架协议	由订单具体约定	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日	正在履行
7	客户 Z1	354.60	探针卡	自 2024 年 6 月 2 日生效，至产品交付完成止	履行完毕
8	华天科技（南京）有限公司	324.00	芯片测试接口	自 2024 年 10 月 11 日生效，有效期自签订起 10 年	履行完毕
9	长江存储科技有限责任公司	框架协议	由订单具体约定	自 2023 年 11 月 20 日生效，且长期有效，直至协议项下的主要事项已经被完成，或一方提前终止	正在履行
10	北京燧原智能科技有限公司	166.31	设备	自 2023 年 7 月 24 日起生效，至产品交付完成止	履行完毕
11	上海安路信息科技股份有限公司	框架协议	由订单具体约定	2025 年 7 月 1 日至 2028 年 6 月 30 日	正在履行
12	渠梁电子有限公司	框架协议	由订单具体约定	自 2021 年 10 月 27 日起生效，且长期有效	正在履行

#### （二）采购合同

公司的重要采购合同指公司与报告期各期前五大供应商框架合同，若与供应

商未签署框架合同，则选取报告期内单笔金额最大的采购订单，截至 2025 年 6 月 30 日，公司重要采购合同具体情况如下：

序号	供应商名称	合同金额 (万元)	主要采购内容	合同期限	履行情况
1	Will Co.Ltd	166.23	金属结构部件	自 2024 年 12 月 2 日生效，至产品交付完成止	履行完毕
2	Megatouch Co., Ltd.	560.55	测试探针	自 2025 年 1 月 2 日生效，至产品交付完成止	履行完毕
3	浙江金连接科技股份有限公司	358.50	金属结构部件	自 2025 年 5 月 6 日生效，至产品交付完成止	履行完毕
4	深圳市新富城电子有限公司	559.29	金属结构部件	自 2024 年 12 月 2 日生效，至产品交付完成止	履行完毕
5	Mikuro Spring CO.,LTD	64.52	金属结构部件	自 2025 年 2 月 20 日生效，至产品交付完成止	履行完毕
6	M.D.Mechanical Devices Ltd.	350.62	设备部件	自 2024 年 7 月 19 日生效，至产品交付完成止	履行完毕
7	苏州德百尼机械科技有限公司	25.49	金属结构部件	自 2024 年 12 月 13 日生效，至产品交付完成止	履行完毕

### (三) 授信及借款合同

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人正在履行的授信额度/借款金额在 1,000 万元及以上的授信及借款合同情况如下：

序号	借款人	授信人/贷款人	授信额度/借款金额 (万元)	授信/借款期限	履行情况
1	苏州韬盛电子科技有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	3,000.00	2023 年 8 月 28 日至 2025 年 8 月 27 日	正在履行
2	苏州韬盛电子科技有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	3,500.00	2024 年 4 月 29 日至 2029 年 4 月 28 日	正在履行
3	苏州韬盛电子科技有限公司	交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	1,000.00	2024 年 12 月 25 日至 2027 年 3 月 27 日	正在履行
4	苏州韬盛电子科技有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	7,000.00	自实际提款日起算 5 年	正在履行

### (四) 融资租赁合同

截至 2025 年 6 月 30 日，发行人正在履行的租金总额在 1,000 万元及以上的融资租赁情况如下：

序号	承租人	出租人	租金总额(万元)	租赁期间	履行情况
1	苏州韬盛电子	平安国际融资租赁	1,105.68	共 36 个月，自	正在履行

序号	承租人	出租人	租金总额(万元)	租赁期间	履行情况
	科技有限公司	有限公司		起租日起算	
2	苏州韬盛电子科技有限公司	交银金融租赁有限责任公司	2,149.25	36个月	正在履行

## 二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日,发行人不存在对外担保事项。

## 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日,发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

## 四、控股股东、实际控制人、子公司,董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项

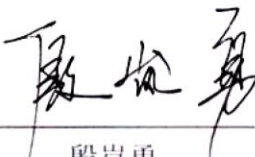
截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人、控股子公司,董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员和核心技术人员未涉及由其作为一方当事人的重大刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

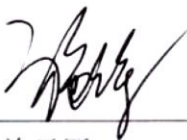
## 第十一节 声明

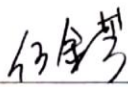
### 一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

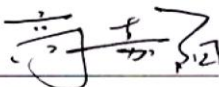
本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

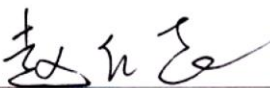
全体董事：


  
殷岚勇

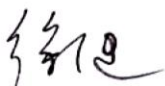
  
施元军

  
何金芳

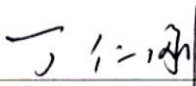
  
高嘉阳

  
赵仁志

  
欧嘉骏

  
徐健

  
夏克金

  
丁仁刚

上海韬盛电子科技股份有限公司

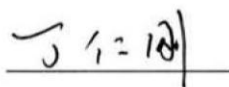


2025年12月26日

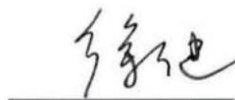
## 一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。

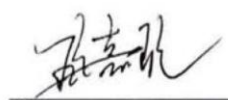
全体审计委员会成员:



丁仁刚



徐 健



欧嘉骏

除董事外的高级管理人员:



赵月玲


上海韬盛电子科技股份有限公司

2015年12月26日

## 二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,按照诚信原则履行承诺,并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人:

  
殷岚勇

上海韬盛电子科技股份有限公司

2015年12月26日

### 三、保荐人(主承销商)声明

本公司已对招股说明书进行核查,确认招股说明书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

项目协办人:

姚泽安  
姚泽安

保荐代表人:

孙天驰  
孙天驰

张鹏飞  
张鹏飞

法定代表人(或授权代表):


江禹  
江禹

华泰联合证券有限责任公司

2025年12月26日

本人已认真阅读上海韬盛电子科技股份有限公司招股说明书的全部内容,确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐人总经理:

  
马 骁

保荐人董事长(或授权代表):

  
江 禹

华泰联合证券有限责任公司

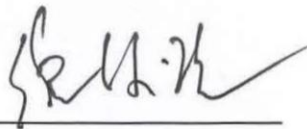
2025年12月26日

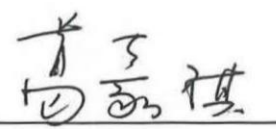


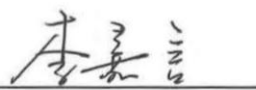
#### 四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

经办律师:

  
倪俊骥

  
葛嘉琪

  
李嘉言

  
张美华

律师事务所负责人:

  
徐晨





2025年12月26日

### 五、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书, 确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任。

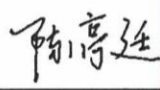

签字注册会计师:

郑少杰

张雪生

陈亭廷

会计师事务所负责人:

刘 维

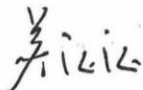
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



2025年 12月 26日

## 六、承担评估业务的资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

签字资产评估师:	(已离职)	(已离职)
	_____	_____
	黄 辉	方继勇
资产评估机构负责人:		
	_____	
	蔡懿懿	

  
万隆(上海)资产评估有限公司  
2025年12月26日

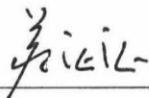
## 承担评估业务的资产评估机构 关于经办资产评估事项的签字资产评估师离职的说明

黄辉、方继勇原为本机构员工，现已因个人原因从本机构离职，因此无法在本机构出具的“承担评估业务的资产评估机构声明”中签字。

黄辉、方继勇在本机构任职期间，曾作为签字资产评估师，为上海韬盛电子科技有限公司（即上海韬盛电子科技股份有限公司之前身）提供资产评估服务，并出具了《上海韬盛电子科技有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的其净资产评估报告》（万隆评报字（2015）第 1238 号）。黄辉、方继勇从本机构离职，不会影响本机构已出具的上述资产评估报告的法律效力。

特此说明。

资产评估机构负责人：

  
蔡懿懿

  
万隆（上海）资产评估有限公司

2025年12月26日



大华会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]  
电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006  
[www.dahua-cpa.com](http://www.dahua-cpa.com)

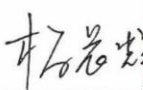

## 承担验资业务的机构声明

大华特字[2025]0011002299号

### 七、承担验资业务的机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书, 确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的《验资报告》(大华验字[2015]000710号)的内容无异议, 确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任。

签字注册会计师:	(已离职)	(已离职)
	_____ 吕秋萍	_____ 张昕

会计师事务所负责人:  

杨晨辉

大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京  
二〇二五年十二月二十六日





大华会计师事务所

大华会计师事务所（特殊普通合伙）  
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]  
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006  
[www.dahua-cpa.com](http://www.dahua-cpa.com)

## 承担验资业务的机构

### 关于经办验资事项的签字注册会计师离职的说明

大华特字[2025]0011002300号

吕秋萍、张昕原为本机构员工，现已因个人原因从本机构离职，因此无法在本机构出具的“承担验资业务的机构声明”中签字。

吕秋萍、张昕在本机构任职期间，曾作为签字注册会计师，为上海韬盛电子科技有限公司（即上海韬盛电子科技股份有限公司之前身）提供验资服务，并出具了《验资报告》（大华验字[2015]000710号）。吕秋萍、张昕从本机构离职，不会影响本机构已出具的上述验资报告的法律效力。

特此说明。

会计师事务所负责人：

杨晨辉



杨晨辉

大华会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二五年十二月二十六日

## 第十二节 附件

### 一、备查文件

- （一）发行保荐书；
- （二）上市保荐书；
- （三）法律意见书；
- （四）财务报告及审计报告；
- （五）公司章程（草案）；
- （六）内部控制审计报告；
- （七）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况

#### （一）发行人投资者关系的主要安排

##### 1、信息披露制度和流程

为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件，结合《公司章程》，制定了《信息披露管理制度》，自公司完成首次公开发行股票并在科创板上市之日起执行。《信息披露管理制度》对发行人信息披露的原则、流程等事项均进行了详细规定。

根据《信息披露管理制度》的规定，公司信息披露原则上应严格履行下列审批程序：

- “（一）董事会秘书办公室制作信息披露文件；
- （二）董事会秘书对信息披露文件进行合规性审核；
- （三）董事长对信息披露文件进行审批或提交董事会、股东会审批；

（四）董事会秘书或证券事务代表将信息披露文件报送上海证券交易所审核备案；

（五）公司依法披露的信息，应当在上海证券交易所网站和符合证券监督管理机构规定条件的媒体上发布；

（六）董事会秘书或证券事务代表将信息披露文件和相关备查文件报送证券监管部门，并置备于公司住所供社会公众查阅；

（七）董事会秘书办公室对信息披露文件进行归档保存。”

## 2、投资者沟通渠道的建立情况

公司董事会办公室负责公司信息披露，负责与证券监管部门联系，解答投资者的有关问题。负责人为董事会秘书赵月玲女士，联系方式如下：

董事会秘书	赵月玲
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 9 幢 20214 室
联系电话	0512-67069862
电子邮箱	security@twinsolution.com
网址	www.twinsolution.com

## 3、未来开展投资者关系管理的规划

投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。根据《投资者关系管理制度》，公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

### （二）发行人的股利分配政策

根据公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》和发行上市后三年内（含发行当年）的股东分红回报计划，本次发行后，公司的股利分配政策参见本招股说明书之“第九节 投资者保护”之“二、发行人的股利分配政策”。

### （三）发行人股东投票机制的建立情况

#### 1、累积投票制度建立情况

根据《公司章程（草案）》规定，股东提名的董事候选人，由现任董事会进行资格审查，通过后提交股东会选举。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东通知候选董事的简历和基本情况。

#### 2、中小投资者单独计票机制

根据《公司章程（草案）》规定，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

#### 3、对法定事项采取网络投票方式的相关机制

根据《公司章程（草案）》规定，公司召开股东会的地点为：公司日常办公地或股东会通知中载明的地点。股东会将设置会场，以现场会议形式召开，还可以同时采用电话会议、视频会议等电子通讯方式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。

#### 4、对征集投票权的相关机制

根据公司《公司章程（草案）》有关规定，公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

### 三、与投资者保护相关的承诺

#### （一）关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

##### 1、控股股东、实际控制人关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人殷岚勇承诺如下：

“（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。

（2）发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。本人在上述锁定期届满后 2 年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行价。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

（3）前述锁定期满后，本人在任职发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份；如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内仍遵守前述承诺。

（4）作为发行人的核心技术人员，本人所持发行人首次公开发行股票前已发行股份的限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首次公开发行股票前已发行股份不得超过发行人上市时本人所持发行人首次公开发行股票前已发行股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。如本人因任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让本人持有的发行人首发前股份。本人承诺不会因职务变更、离职等原因而拒绝或放弃履行上述承诺。”

##### 2、控股股东、实际控制人的一致行动人关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人的一致行动人苏州厚积、昊日长晶承诺如下：

“（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份；

（2）发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本企业持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月；本企业在上述锁定期届满后 2 年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行价。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。”

### **3、申报前 12 个月内入股的公司新增股东关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺**

申报前 12 个月内入股的公司新增股东毅达众创、混改基金、江苏装备基金、安徽中安、昆山玉澄承诺如下：

“发行人通过证券交易所审核通过并经中国证监会注册后，本公司/企业自取得股份之日起 36 个月内或自发行人股票上市之日起 12 个月内（以上两者孰长为准），不转让或者委托他人管理本公司/本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司/企业分次取得发行人股份的，取得股份之日分别起算。”

### **4、公司其他机构股东关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺**

公司其他机构股东景宁水獭、华峰测控、毅达贰号、柘中君信、毅达创投、俱成创投、皓骏创投、尚颀山高、山高弘金承诺如下：

“发行人通过证券交易所审核通过并经中国证监会注册后，本公司/企业自发行人股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本公司/本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。”

## 5、直接持有公司 5%以上股份的自然人股东关于所持公司股份锁定及减持意向的承诺

直接持有公司 5%以上股份的自然人股东高凯承诺如下：

“自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购该部分股份。”

## 5、董事、高级管理人员、核心技术人员及直接持有公司 5%以上股份的自然人股东关于所持公司股份锁定及减持意向的承诺

公司董事及高级管理人员何金芳、赵仁志、高嘉阳、欧嘉骏、徐健、夏克金、丁仁刚、赵月玲、施元军承诺如下：

“本人在担任发行人的董事和/或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份；如本人在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内仍遵守前述承诺。”

### （二）关于首次公开发行前股东持股意向及减持意向的承诺

#### 1、公司实际控制人、控股股东殷岚勇及其一致行动人苏州厚积、昊日长晶关于首次公开发行前股东持股意向及减持意向的承诺

公司实际控制人、控股股东殷岚勇及其一致行动人苏州厚积、昊日长晶承诺如下：

##### “1、持股意向

本人/企业承诺：将按照发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书以及本人/企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持发行人股票。

本人/企业未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股份。

##### 2、股份锁定期满后 2 年内减持股份的计划

本人/企业将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定的承诺，在持有发行人股份的锁定期届满后拟减持发行人股份的，将通过符合相关法律法规及证券交易所规则要求的方式进行减持。如本人/企业计划通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份，将在首次卖出前十五个交易日向证券交易所报告并披露减持计划。

### 3、遵守届时有关法律、法规、规章和规则的相关规定

本人/企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他法律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。

如本人/企业违反上述承诺的规定擅自减持发行人股份的，本人/企业承诺违规减持发行人股份所得收益（以下简称“违规所得”）归发行人所有，如未将违规所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人/企业现金分红中与本人/企业应上交发行人的违规所得金额相等的部分。”

## 2、其他持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人关于首次公开发行前股东持股意向及减持意向的承诺

其他持有公司 5%以上股份的股东高凯、景宁水獭、毅达贰号及其一致行动人（毅达创投、毅达众创）、柘中君信承诺如下：

### “1、持股意向

本企业承诺：将按照发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持发行人股票。

### 2、股份锁定期满后减持股份的计划

限售期届满后，若本企业减持发行人股份，将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股票，并按照相关法律法规的要求予以公告。

### 3、遵守届时有关法律、法规、规章和规则的相关规定

本企业将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》，上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他法律法规、上海证券交易所业务规则的相关规定。

如本企业违反上述承诺的规定擅自减持发行人股份的，本企业承诺违规减持发行人股份所得收益（以下简称“违规所得”）归发行人所有，如未将违规所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交发行人的违规所得金额相等的部分。”

### （三）关于股份回购和股份买回的承诺函

#### 1、发行人关于股份回购和股份买回的承诺

发行人承诺如下：

“1、如证券监督管理部门或其他有权部门认定公司本次发行上市的《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响，且以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，在该等违法事实被上述有权机关最终认定之日起5个工作日内（或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或其他有权机关要求的时间内），本公司将根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定召开董事会，并提议召开股东会，启动股份回购措施，回购价格为公司首次公开发行A股股票时的发行价并加算银行同期存款利息或者法律法规、证券监督管理部门规定及认可的其他价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）。

2、当《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》中约定的启动稳定股价措施的触发条件成就时，公司将按照此预案的规定履行回购公司股份的义务。

如公司违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未履行公开承诺事项的约束措施及承诺》承担相应责任。”

## 2、发行人控股股东、实际控制人关于股份回购和股份买回的承诺

发行人控股股东、实际控制人殷岚勇承诺如下：

“（1）如证券监督管理部门或其他有权部门认定公司本次发行上市的《招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响，且以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在有权机关作出上述认定后督促公司及时提出股份回购方案，并根据相关法律法规及公司章程的规定提交董事会、股东会审议，依法回购本次发行的全部 A 股股份。本人将在公司召开董事会和股东会审议股份回购方案时投赞成票。

本人将督促公司以公司首次公开发行 A 股股票时的发行价并加算银行同期存款利息或者法律法规、证券监督管理部门规定及认可的其他价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的有关规定作相应调整）为回购价格启动股份回购。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的，从其规定。

（2）当《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》中约定的启动稳定股价措施的触发条件成就时，本人将按照此预案的规定履行相应的义务、承担相应的责任。

如本人违反上述承诺，将遵照另行出具的《关于未履行公开承诺事项的约束措施及承诺》承担相应责任。”

### （四）关于上市后三年内稳定公司股价预案的承诺

#### 1、启动稳定股价措施的条件

公司上市后三年内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总额出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），则触发公司稳定股价机制。为便于表述，上述第 20 个交易日为“触发日”。

## 2、稳定股价的具体措施

公司、公司的控股股东/实际控制人、领取薪酬的董事（独立董事除外）及高级管理人员，是公司稳定股价机制实施的义务人（以下合称“义务人”）。在触发日之后 10 个工作日内，义务人将与公司沟通，确定稳定公司股价方案，逐项采取以下措施以稳定上市后的公司股价：

**措施 1：**公司控股股东/实际控制人在触发日起 10 个工作日内，向公司提出公司回购股份的提案，公司召开董事会审议议案，并通知召开股东大会进行表决。回购股份的议案应包含以下内容：回购目的、方式、价格或价格区间、定价原则，拟回购股份的种类、数量及其占公司总股本的比例，拟用于回购股份的资金总额及资金来源，预计回购股份后公司股权结构的变动情况，管理层对回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析等。经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司实施回购股份。公司回购本公司股份的措施应符合我国法律、法规、规范性文件和证券交易所关于上市公司回购股份的相关规定。

上述议案中回购期限不得超过 120 天（自触发日起算）；回购价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产值；公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额，公司单次回购股份的数量不超过公司发行后总股本的 1%，单一会计年度累计回购股份的数量不超过公司发行后总股本的 2%；公司回购股份应符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

公司控股股东/实际控制人应在审议公司回购股份的股东大会上就相关议案投赞成票。如果公司股东大会未通过相关议案，则直接启动措施 2。

**措施 2：**当公司根据股价稳定措施 1 完成股份回购后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产时，公司控股股东/实际控制人在触发日起 10 个工作日内，书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。增持计划完成期限不得超过 120 天（自触发日起算），公司控股股东/实际控制人股价稳定措施启动后的增持期限内，增持股份总金额不低于其上一年度从公司所获得现金分红金额的 30% 和上一年度自公司获取薪酬

（税后）总额的 50% 的孰高者，且不超过其上一年度从公司所获得现金分红总额和上一年度自公司获取薪酬（税后）总额的孰高者。

公司控股股东/实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的前提下，对公司股票进行增持，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

**措施 3：** 当公司控股股东/实际控制人根据股价稳定措施 2 完成股份增持后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一期经审计的每股净资产时，领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员在触发日起 10 个工作日内，书面通知公司董事会其增持公司股票的计划并由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。增持计划中完成期限不得超过 120 天（自触发日起算），用于增持公司股份的资金额不低于该等人员上一会计年度从公司处领取的薪酬总额（税后）的 30%，且不超过该等人员上一会计年度从公司处领取的薪酬总额（税后）。

公司董事、高级管理人员应在符合《证券法》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的前提下，对公司股票进行增持，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

公司未来聘任新的领取薪酬的董事（不包括独立董事）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行股票上市时相关董事、高级管理人员已做出的相关承诺。

### **3、股价稳定措施的继续实施和终止**

自公司稳定股价措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

（1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；

（2）继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

### **4、发行人关于上市后三年内稳定公司股价预案的承诺**

发行人承诺如下：

“若股价达到《公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件时，本公司将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，按照该预案的规定履行稳定本公司的义务。

在《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》有效期内，本公司新聘任的符合条件的董事和高级管理人员应当遵守上述预案中关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定。同时，本公司将确保新聘任的该等董事、高级管理人员在其被正式选举/聘任前签署相关承诺。

如本公司未能履行稳定股价的承诺，本公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的5个交易日内公告相关情况，并将在股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开作出解释，及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向本公司股东和社会公众投资者道歉。除不可抗力外，如因本公司未履行承诺给投资者造成损失的，本公司应按照法律、法规及相关监管机构的要求向投资者依法赔偿损失并承担相应的责任。

若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

## **2、控股股东、实际控制人关于上市后三年内稳定公司股价预案的承诺**

公司控股股东、实际控制人殷岚勇承诺如下：

“若股价达到《公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件，且在第一顺位回购义务人（公司）无法实施回购股份，或公司回购股份议案未获得董事会或股东会审议通过，或公司回购股份实施完毕后再次触发稳定股价预案启动条件时，本人将严格遵照执行《公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》，按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务。

当触发公司稳定股价措施的启动条件时，在符合回购股份相关法律法规的条件下，本人承诺将在公司股东会和董事会上对公司回购股份的议案投赞成票。如本人未能履行或未按期履行稳定股价承诺，则本人将在股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开作出解释，及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无

法按期履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。除不可抗力外，如因本人未履行承诺给其他投资者造成损失的，本人将按照法律、法规及相关监管机构的要求向其他投资者依法赔偿损失并承担相应的责任，且公司有权自触发日起 120 个自然日届满后扣留应付本人的现金分红及薪酬直至本人履行增持义务，同时公司有权限制本人所持公司股份（如有）不得转让，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

### **3、在发行人处领取薪酬的董事或高级管理人员关于上市后三年内稳定公司股价预案的承诺**

在发行人处领取薪酬的董事或高级管理人员殷岚勇、何金芳、施元军、赵月玲承诺如下：

“若股价达到《公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件，且在第一顺位回购义务人（公司）及第二顺位回购义务人（公司控股股东、实际控制人）无法实施回购股份，或公司回购股份议案未获得董事会或股东会审议通过，或公司回购股份实施完毕后再次触发稳定股价预案启动条件时，本人将严格遵照执行《公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》，按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务。当触发公司稳定股价措施的启动条件时，在符合回购股份相关法律法规的条件下，本人承诺将在公司股东会和董事会上对公司回购股份的议案投赞成票。

如本人未能履行或未按期履行稳定股价承诺，则本人将在股东会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开作出解释，及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。除不可抗力外，如因本人未履行承诺给其他投资者造成损失的，本人将按照法律、法规及相关监管机构的要求向其他投资者依法赔偿损失并承担相应的责任，且公司有权自触发日起 120 个自然日届满后扣留应付本人的现金分红及薪酬直至本人履行

增持义务，同时公司有权限制本人所持公司股份（如有）不得转让，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。

若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

#### （五）关于对欺诈发行上市的股份购回承诺

##### 1、发行人关于对欺诈发行上市的股份购回承诺

发行人承诺如下：

“本公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何欺诈发行行为。

若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或其他有权机关认定公司存在欺诈发行行为，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被上述有权机关最终认定之日起 5 个工作日内（或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或其他有权机关要求的时间内）启动股份购回程序，依法购回首次公开发行的股票。

若上述欺诈发行行为致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者的损失。”

##### 2、控股股东、实际控制人关于对欺诈发行上市的股份购回承诺

控股股东、实际控制人殷岚勇承诺如下：

“发行人申请首次公开发行股票并在科创板上市的相关申报文件所披露的信息真实、准确、完整，不存在欺诈发行行为。

若中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或其他有权机关认定发行人存在欺诈发行行为，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在该等违法事实被上述有权机关最终认定之日起 5 个工作日内（或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或其他有权机关要求的时间内）启动股份购回程序，依法购回首次公开发行的股票。

若上述欺诈发行行为致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投

投资者的损失。”

## （六）关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

### 1、发行人关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

发行人承诺如下：

#### “（一）积极实施募投项目，提升公司盈利水平和综合竞争力

本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务，符合公司未来发展战略，有利于提高公司的持续盈利能力及市场竞争力。公司董事会对募集资金投资项目进行了充分的论证，在募集资金到位后，公司将积极推动募投项目的实施，充分调动各方面资源，及时、高效完成项目建设计划，积极拓展市场，进一步提高收入水平和盈利能力。

#### （二）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用

为保障公司规范、有效的使用募集资金，本次募集资金到账后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金按照规定用于指定的投资项目、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

#### （三）积极提升公司核心竞争力，规范内部制度

公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，加大研发投入，扩大产品与技术领先优势，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。公司将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

#### （四）优化利润分配制度，强化投资者回报机制

公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了公司上市后三年股东分红回报规划，明确公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式

和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。

本次发行完成后，公司将严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报从而切实保护公众投资者的合法权益。

#### （五）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断优化治理结构、加强内部控制，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保审计委员会能够有效行使《中华人民共和国公司法》项下的监事会职权，为公司发展提供制度保障。

制定上述填补被摊薄即期回报具体措施不等于对本公司未来利润做出保证，但为保障本公司、全体股东及社会公众投资者的合法利益，本公司承诺将积极推进上述填补被摊薄即期回报的措施。

若本公司未能履行前述承诺，本公司将在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。”

## 2、控股股东、实际控制人关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

控股股东、实际控制人殷岚勇承诺如下：

“（1）在任何情况下，不会越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。

（2）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。

（3）本人将对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

（4）本人不会动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（5）本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守相关制度。

（6）本人将尽责促使发行人未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守相关条件。

（7）本人承诺出具日后至发行人完成首次公开发行股票并在科创板上市前，若中国证监会或证券交易所对首发上市摊薄即期回报有关事项作出新的规定或要求的，本人承诺届时将按照前述最新规定和要求出具补充承诺。

（8）如果违反或拒不履行上述承诺，本人应在发行人股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；无条件接受中国证监会、证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规则对本人作出的处罚或采取的监管措施；违反上述承诺给发行人或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。”

### **3、公司董事、高级管理人员关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺**

公司全体董事、高级管理人员承诺如下：

“（1）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。

（2）本人将对本人的职务消费行为进行约束。

（3）本人不会动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（4）本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守相关制度。

（5）本人将尽责促使发行人未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守相关条件。

（6）本人承诺出具日后至发行人完成首次公开发行股票并在科创板上市前，若中国证监会或证券交易所对首发上市摊薄即期回报有关事项作出新的规定或要求的，本人承诺届时将按照前述最新规定和要求出具补充承诺。

（7）如果违反或拒不履行上述承诺，本人应在发行人股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；无条件接受中国证监会、证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规则对本人作出的处罚或采取的监管措施；违反上述承诺给发行人或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。”

#### （七）关于执行利润分配政策的承诺

发行人承诺如下：

“公司在上市后将严格按照《公司法》《公司章程（草案）》《关于公司股东未来分红回报规划的议案》等法律、法规、监管机构的规定及公司治理制度的规定执行利润分配政策。如遇相关法律、法规及规范性文件修订的，将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。若公司未能依照本承诺严格执行利润分配政策的，公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。”

#### （八）关于依法承担赔偿责任的承诺

##### 1、发行人关于依法承担赔偿责任的承诺

发行人承诺如下：

“本公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者的损失。”

##### 2、控股股东、实际控制人关于依法承担赔偿责任的承诺

公司控股股东、实际控制人殷岚勇承诺如下：

“公司本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者的损失。”

##### 3、公司非独立董事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任的承诺

公司全体非独立董事、高级管理人员承诺如下：

“公司本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者的损失。”

#### **4、公司独立董事关于依法承担赔偿责任的承诺**

公司独立董事承诺如下：

“公司本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者的损失，但能够证明本人没有过错的除外。”

#### **（九）关于避免同业竞争的承诺**

公司控股股东、实际控制人殷岚勇承诺如下：

“1、截至本承诺出具之日，本人及本人近亲属控制的公司或其他组织中，不存在从事与发行人和控股子公司相同或相似的业务，不存在同业竞争。

2、本人及本人近亲属控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人和控股子公司现有相同或相似业务。

3、若发行人和控股子公司今后从事新的业务领域，则本人及本人近亲属控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人和控股子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动。

4、如若本人及本人近亲属控制的法人出现与发行人和控股子公司有直接竞争的经营业务情况时，发行人和控股子公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人和控股子公司经营。

5、本人承诺不以发行人控股股东/实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害发行人和控股子公司其他股东的权益。

如本人、本人近亲属及其控制的公司或其他组织违反上述承诺而导致发行人

及其控股子公司的权益受到损害的,本人同意向发行人及其控股子公司承担相应法律责任。”

#### (十) 关于业绩下滑延长股份锁定期的承诺

公司控股股东、实际控制人殷岚勇及其一致行动人苏州厚积、昊日长晶承诺如下:

“ (1) 发行人上市当年较上市前一年经审计的扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50% 以上的,在本人/本企业所持股份原锁定期的基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月;

(2) 发行人上市第二年较上市前一年经审计的扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50% 以上的,在本人/本企业所持股份原锁定期及本承诺第 1 项基础上(如适用)延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月;

(3) 发行人上市第三年较上市前一年经审计的扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50% 以上的,在本人/本企业所持股份原锁定期及本承诺第 1、2 项基础上(如适用)延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6 个月。”

#### (十一) 关于在审期间不进行现金分红的承诺

发行人承诺如下:

“1、在本公司于上海证券交易所科创板首次公开发行股票并上市的申报受理后至本公司股票在上海证券交易所科创板上市前不进行现金分红或提出现金分红的方案。

2、上述承诺为公司的真实意思表示,公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺,公司将依法承担相应责任。”

#### (十二) 其他承诺事项

**1、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5% 以上的股东及其一致行动人、董事及高级管理人员关于减少和规范关联交易的承诺**

控股股东、实际控制人殷岚勇及其一致行动人苏州厚积、昊日长晶;其他持有公司 5% 以上股份的股东高凯、景宁水獭、毅达贰号及其一致行动人(毅达创投、毅达众创)、柘中君信;董事及高级管理人员承诺如下:

“1、承诺人将严格按照证券监督法律、法规及规范性文件所要求对关联方以及关联交易进行了完整、详尽的披露。除本次发行及上市文件中披露的关联交易外（如有），承诺人及承诺人控制的企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。

2、在发行人上市以后，承诺人严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件与证券交易所的相关规定，以及发行人的公司章程，行使权利，履行义务，在股东会和/或董事会对承诺人以及承诺人控制的企业与发行人之间的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

3、承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量减少与发行人的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取适当措施消除与发行人之间发生关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，承诺人保证承诺人及承诺人控制的企业将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和发行人公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时履行信息披露义务，绝不通过关联交易损害发行人及其非关联股东合法权益。

4、承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利益，不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的合法权益。

5、如承诺人违背上述承诺，给发行人造成了经济损失、索赔责任及额外的费用，并赔偿发行人及发行人的其他股东因此遭受的全部损失，承诺人因违反上述声明与承诺所取得的利益亦归发行人所有。

6、上述承诺一经签署立即生效，上述承诺在承诺人与发行人存在关联关系期间及关联关系终止之日起十二个月内，或对发行人存在重大影响期间，持续有效，且不可变更或撤销。”

## **2、关于未履行公开承诺事项的约束措施及承诺**

### **（1）发行人关于未履行公开承诺事项的约束措施及承诺**

发行人承诺如下：

“上市后，本公司将严格履行上市前所作出的各项承诺。如果本公司未履行

招股说明书披露的承诺事项（因相关法律法规政策变化、自然灾害及其他不可抗力等不可控制的客观原因导致的除外），将视情况通过公司股东会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定途径披露未履行的具体原因，并向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。”

### **（2）控股股东、实际控制人关于未履行公开承诺事项的约束措施及承诺**

控股股东、实际控制人殷岚勇承诺如下：

“上市后，本人将严格履行上市前所作出的各项承诺。如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项（因相关法律法规政策变化、自然灾害及其他不可抗力等不可控制的客观原因导致的除外），将视情况通过发行人股东会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定途径披露未履行的具体原因，并向发行人投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的发行人股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。

本人在作为发行人控股股东/实际控制人期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。”

### **（3）公司其他持股 5%以上的股东关于未履行公开承诺事项的约束措施及承诺**

公司其他持股 5%以上的股东承诺如下：

“上市后，本人/本企业将严格履行上市前所作出的各项承诺。如果本人/本企业未履行招股说明书披露的承诺事项（因相关法律法规政策变化、自然灾害及其他不可抗力等不可控制的客观原因导致的除外），将视情况通过发行人股东会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定途径披露未履行的具体原因，并向发行人投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

如果因本人/本企业未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本企业将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人/本企业未承担前述赔偿责任，则本人/本企业持有的发行人股份在本人/本企业履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人/本企业所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。”

#### **（4）公司董事、高级管理人员及核心技术人员关于未履行公开承诺事项的约束措施及承诺**

公司全体董事、高级管理人员及核心技术人员承诺如下：

“上市后，本人将严格履行上市前所作出的各项承诺。如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项（因相关法律法规政策变化、自然灾害及其他不可抗力等不可控制的客观原因导致的除外），将视情况通过发行人股东会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定途径披露未履行的具体原因，并向发行人投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。”

#### **四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项**

发行人关于申请首发上市企业股东信息披露的专项承诺：

“1、截至本承诺函出具之日，公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份。

2、截至本承诺函出具之日，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形。

3、本公司股东中不存在离开证监会系统未满十年的原工作人员，即不存在从证监会机关、派出机构、沪深证券交易所、全国股转公司离职的工作人员，从证监会系统其他会管单位离职的原会管干部，在证监会发行司或公众司借调累计满 12 个月并在借调结束后三年内离职的证监会其他会管单位人员，从证监会机关、派出机构、沪深证券交易所、全国股转公司调动到证监会系统其他会管单

位并在调动后三年内离职的人员或其父母、配偶、子女及其配偶。

4、本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

5、本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。”

## 五、股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

股份公司设立以来，公司依照《公司法》《证券法》及其他有关上市公司治理的法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，逐步建立健全了符合上市公司要求的规范化公司治理结构。

公司股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会专门委员会和董事会秘书均能依照《公司法》和《公司章程》规定履行职责，切实保障了公司及全体股东的利益。

### （一）股东会运行情况

根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》《股东会议事规则》，其中《公司章程》中规定了股东会的职责、权限及股东会会议的基本制度，《股东会议事规则》针对股东会的召开程序制定了详细规则。

自股份公司设立以来，相关股东或股东代表出席了公司召开的历次股东大会，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （二）董事会运行情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司设立了董事会，对股东会负责，制定了《董事会议事规则》。截至本招股说明书签署日，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。

截至本招股说明书签署日，公司董事会能够根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定规范运作，出席董事会的人员符合相关规定，会议的召集方式、议事程序、表决方式、决议内容合法有效。

### (三) 监事会运行情况

#### 1、监事会的建立健全

报告期内，发行人曾设监事会，由3名监事组成，包括1名职工代表监事。监事任期三年，任期届满，连选可以连任。监事会设主席一名。监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定履行职责、行使职权。

#### 2、监事会的运作情况

股份公司设立以来，公司监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范，对公司董事会工作的监督、高级管理人员的考核、公司重大经营决策、关联交易的执行、主要管理制度的制定等重大事宜实施了有效监督，公司监事按照相关规定出席监事会会议并依法行使权利和履行义务，不存在管理层、监事会违反《公司法》《公司章程》及相关制度等要求行使职权的行为。

2025年12月20日，发行人股东大会审议取消了监事会及监事，并对《公司章程》及相关制度进行相应修改，由审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。

### (四) 独立董事制度的运行情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关法律法规的相关要求，本公司建立了独立董事制度，并制定了《独立董事工作制度》。公司独立董事规范有序运行，保障了董事会决策的科学性，维护了中小股东的利益，发挥了应有的作用。

截至本招股说明书签署日，公司董事会会有3名独立董事，占董事会全体成员的比例不少于1/3。公司3位独立董事任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

截至本招股说明书签署日，公司独立董事依照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地履行权利和义务，对公司重大关联交易等事项发表了独立公允的意见，为本公司的重大决策提出建设性意见，为本公司完善公司治理结构、规范公司运作、保护中小股东权益等方面发挥了重要作用。截至本招股说明书签署日，未发生独立董事对公司有关事项提出

异议的情况。

### （五）董事会秘书制度的运行情况

根据《公司章程》的规定，发行人聘任了1名董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会和公司负责。公司董事会秘书自任职以来，按照《公司法》《公司章程》和《董事会秘书工作制度》认真履行其职责，负责筹备董事会和股东会，确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要作用。

## 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

根据《公司章程》规定，公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并制定了相应的议事规则。

董事会专门委员会是经股东会批准设立的董事会专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。公司董事会专门委员会的组成成员具体如下：

委员会名称	成员
战略与投资委员会	殷岚勇（主任委员）、徐健、夏克金
审计委员会	丁仁刚（主任委员）、徐健、欧嘉骏
提名委员会	夏克金（主任委员）、徐健、施元军
薪酬与考核委员会	徐健（主任委员）、夏克金、赵仁志

公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会自设立以来能够有效履行法律法规和《公司章程》赋予的职权，运行正常。

## 七、募集资金具体使用情况

### （一）苏州韬盛半导体测试接口及测试探针生产基地建设项目

#### 1、项目基本情况

本项目实施主体为苏州韬盛电子科技有限公司，建设周期3年。本项目建设总投资金额58,127.00万元，主要投资内容包括场地租赁、场地装修、设备购置及安装投资、基本预备费、铺底流动资金等必要投资。

近年来，半导体产业快速发展，半导体测试接口及探针作为芯片测试环节的核心耗材，市场需求不断扩大。在此背景下，公司拟通过本次项目建设，扩充半导体测试接口及探针的生产区域，同时购置高精密加工中心等先进设备，扩大现有主营业务产品半导体测试接口及测试探针的产能规模，满足下游日益增长的市场需求，促进公司的可持续健康发展。

## 2、项目投资概算

本项目建设投资总额为 58,127.00 万元，其中拟使用募集资金投入金额为 40,000.00 万元，具体投资如下表所示：

序号	项目名称	投资金额（万元）	占总投资额的比例
1	场地租赁	1,598.00	2.75%
2	场地装修	3,850.00	6.62%
3	设备购置及安装	48,227.00	82.97%
4	基本预备费	1,042.00	1.79%
5	铺底流动资金	3,410.00	5.87%
	合计	<b>58,127.00</b>	<b>100.00%</b>

## 3、项目实施进度安排

本项目计划建设期为 3 年，项目实施进度安排具体如下：

建设进度												
	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
工程前期工作、工程建设	■	■	■	■	■	■	■					
设备询价、订购				■	■	■	■	■	■	■		
设备安装、调试							■	■	■	■	■	
生产线试运行											■	■
竣工验收												■

## 4、项目备案和环评情况

本项目已完成备案，已经取得《江苏省投资项目备案证》，项目代码：2511-320571-89-01-486980。截至本招股说明书签署日，本项目环评批复手续正在办理中。

## 5、项目实施地点

本项目拟使用现有办公场所及新租赁场地作为项目实施地点，不涉及新增建设用地。

### （二）苏州晶晟晶圆测试探针研发及晶圆测试探针卡生产基地建设项目

#### 1、项目基本情况

本项目实施主体为苏州晶晟微纳半导体科技有限公司，建设周期3年。本项目建设总投资金额73,604.00万元，主要投资内容包括场地租赁、场地装修、设备购置及安装投资、基本预备费、铺底流动资金等必要投资。

本次项目公司拟新建生产车间，同步购入光刻设备等MEMS工艺设备，优化公司生产布局及装备水平，提升公司生产经营效率。通过本次项目，公司将立足于自身战略发展方向，提升MEMS探针卡工艺水平和整体盈利能力，为公司可持续发展做充足准备。

#### 2、项目投资概算

本项目建设总投资金额73,604.00万元，拟使用募集资金50,000.00万元，具体金额如下表所示：

序号	项目名称	投资金额（万元）	占总投资额的比例
1	场地租赁	2,131.00	2.90%
2	场地装修	7,400.00	10.05%
3	设备购置及安装	59,245.00	80.49%
4	基本预备费	1,333.00	1.81%
5	铺底流动资金	3,495.00	4.75%
合计		<b>73,604.00</b>	<b>100.00%</b>

#### 3、项目实施进度安排

本项目计划建设期为3年，项目实施进度安排具体如下：

建设进度												
	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
工程前期工作、工程建设												

设备询价、订购												
设备安装、调试												
生产线试运行												
竣工验收												

#### 4、项目备案和环评情况

本项目已完成备案，已经取得《江苏省投资项目备案证》，项目代码：2511-320571-89-01-426912。截至本招股说明书签署日，本项目环评批复手续正在办理中。

#### 5、项目实施地点

本项目拟使用现有办公场所及新租赁场地作为项目实施地点，不涉及新增建设用地。

### （三）上海总部及研发中心建设项目

#### 1、项目基本情况

本项目实施主体为上海韬盛电子科技股份有限公司，建设周期3年。本项目建设总投资金额6,073.00万元，主要投资内容包括设备购置及安装投资、研发支出、基本预备费等必要投资。

通过本次项目建设，公司拟购置专业测试仪器，针对大算力芯片高速测试方案开发及验证，蓝牙、wifi、RF芯片高频方案测试验证，可靠性方案验证等研发课题展开研究，持续加大研发投入，提升对主营产品芯片测试接口及探针卡的测试能力。

#### 2、项目投资概算

本项目建设总投资金额6,073.00万元，拟使用募集资金4,000.00万元，具体投资如下表所示：

序号	项目名称	投资金额（万元）	占总投资额的比例
1	设备购置及安装	5,150.00	84.80%
2	基本预备费	103.00	1.70%
3	研发支出	820.00	13.50%
合计		<b>6,073.00</b>	<b>100.00%</b>

### 3、项目实施进度安排

本项目计划建设期为3年，项目实施进度安排具体如下：

建设进度												
	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
设备询价、订购												
研发人员招聘及培训												
设备安装、调试												
竣工验收												

### 4、项目备案和环评情况

本项目已完成备案，已经取得《上海市企业投资项目备案证明》，项目代码：2511-310115-04-02-325710。本项目主要建设内容为研发中心，无需办理环境影响评价手续。

### 5、项目实施地点

公司拟使用公司现有办公场所作为项目实施地点，不涉及新增建设用地。

#### （四）天津韬盛研发中心项目

##### 1、项目基本情况

本项目实施主体为天津韬盛芯海设计有限公司，建设周期3年。本项目建设总投资金额3,155.00万元，主要投资内容包括建筑工程投资、设备购置及安装投资、基本预备费等必要投资。

通过本次项目建设，公司拟对现有场地进行装修改造，同步购入飞针测试机、自动植针机及相关的设计软件或测试仪器等先进研发及实验设备，针对测试负载板的设计和工程开发测试、第三代半导体芯片和模拟芯片的垂直探针卡和MEMS探针卡、CIS探针卡等课题展开研究。

##### 2、项目投资概算

本项目建设总投资金额3,155.00万元，拟使用募集资金1,800.00万元，具体投资如下表所示：

序号	项目名称	投资金额（万元）	占总投资额的比例
1	建筑工程投资	300.00	9.51%
2	设备购置及安装	2,755.00	87.32%
3	基本预备费	100.00	3.17%
合计		3,155.00	100.00%

### 3、项目实施进度安排

本项目计划建设期为3年，项目实施进度安排具体如下：

建设进度												
	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
工程前期工作、工程建设												
设备询价、订购												
设备安装、调试												
竣工验收												

### 4、项目备案和环评情况

本项目已完成备案，已经取得《天津市内资企业固定资产投资项目备案证明》，项目代码：2511-120104-89-05-799867。本项目主要建设内容为研发中心，无需办理环境影响评价手续。

### 5、项目实施地点

公司拟使用公司现有办公场所作为项目实施地点，不涉及新增建设用地。

#### （五）补充流动资金

##### 1、项目基本情况

公司综合考虑行业和市场发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等经营情况，拟使用本次发行募集资金中的 10,000.00 万元补充公司流动资金。

##### 2、项目管理运行安排

公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司募集资金管理制度对上述流动资金进行管理，根据公司的业务发展需要进行合理运用，对上述

流动资金的使用履行必要的审批程序。